

BOND-PRIME

TAM OTOMATİK İHK VE İŞH BOYAMA SİSTEMİ

KULLANIM KILAVUZU

(Çin'de KULLANILAMAZ)



CE

Advancing Cancer Diagnostics
Improving Lives

Leica
BIO SYSTEMS

İçindekiler

İçindekiler	2
1 BOND-PRIME donanımı	23
1.1 BOND-PRIME hakkında	24
1.1.1 BOND-PRIME yardımcı malzemeleri ve sarf malzemesi öğeleri	25
1.2 BOND-PRIME İşleme Modülü	27
1.2.1 Önden görünüm	27
1.2.2 Arkadan görünüm	28
1.3 Kaput	29
1.4 Ön Yükleme ve Boşaltma Çekmeceleri	30
1.5 Lam Çekmecesini Parçaları, Atık Giderleri ve Kartierleri ve Alım Filtresi	31
1.5.1 Lam Çekmecesini Parçaları	31
1.5.2 Atık Giderleri	32
1.5.3 Kartierler ve Filtreli Alım Tümü	33
1.6 Reagent Platform (Reaktif Platformu)	34
1.7 Toplu Kaplar	35
1.8 Hazne Kabini	37
1.9 AC güç anahtarı	38
1.10 Reagent Tray'ler (Reaktif Tepsisi)	39
1.11 Çalışma Yüzeyi (Kaputun altında)	40
1.11.1 Çalışma Yüzeyi (önden görünüm)	42
1.11.2 High-Speed Robot (Yüksek Hızlı Robot)	43
1.11.3 Probe Selector (Prob Seçici)	44
1.11.4 Yıkama Robotları	45
1.11.5 ARC (Aktif Reaktif Kontrolü) Modülleri	46
1.11.6 Yıkama/Hazırlama İstasyonları	48
1.11.7 Mixing Well Plate (Karıştırma Kuyucuğu Plakası)	49
1.11.8 Lam Hazırlama İstasyonu	50
1.12 İşleme modülünü bağlama ve açma	51
1.13 İşleme modülünü ayırma	53
1.14 İşleme modülünü yeni bir konuma taşıma	55
1.15 İşleme modülünü hizmetten çıkarma ve atma	57

2 Dokunmatik Ekran	58
2.1 Oturum açma ve kapatma	59
2.1.1 Oturum açma	59
2.1.2 Oturumu kapatma	60
2.2 Gezinme Çubuğu	61
2.3 Durum Ekranı	62
2.3.1 Yüklenen Lam Bölümü	62
2.3.2 Lamlar İşleniyor Bölümü	64
2.3.3 Lamların İşlenmesi Tamamlandı Bölümü	66
2.3.4 Daha fazla lam bilgisi görüntüleme	67
2.3.5 İşleme sırasında beklenmeyen olaylar	68
2.4 İşlem Sırası ve Uyarı Başlığı	70
2.4.1 İşlem Sırasını gösterme ve gizleme	70
2.4.2 İşlem Sırası Öğesinde önerilen bir görevi tamamlama	71
2.4.3 Uyarı Başlığını manuel olarak gizleme	71
2.5 Lamları ön yükleme	73
2.6 Ön Yükleme Ekranı	75
2.6.1 Preload Drawer (Ön Yükleme Çekmecesi) görünümü	76
2.6.2 Ön Yükleme Vaka görünümü	78
2.7 Lamları boşaltma	80
2.8 Boşaltma Ekranı	82
2.8.1 Boşaltma Çekmecesi görünümü	83
2.8.2 Boşaltma vaka görünümü	84
2.9 Ayrıntılı vaka ve lam bilgileri	86
2.9.1 Bir vakadaki her bir lamı görüntüleme	88
2.9.2 Devam eden bir lamı durdurma	89
2.10 Reaktifler Ekranı	90
2.10.1 Reagent Container'ı (Reaktif Kabı) ve Reagent Tray'leri (Reaktif Tepsisi) Hazırlama	90
2.10.2 Reagent Tray'leri (Reaktif Tepsisi) yükleme	92
2.10.3 Reaktif sistemi simgelerine örnekler	93
2.10.4 Reagent Container (Reaktif Kabı) simgelerine örnekler	94
2.10.5 Reaktif sistemi ve Reagent Container (Reaktif Kabı) ayrıntılarını görüntüleme	95
2.10.6 Reagent Tray'leri (Reaktif Tepsisi) boşaltma	97

2.11 Bakım Ekranı	98
3 Hızlı başlangıç	99
3.1 Giriş	100
3.2 İşleme modülünü başlatma	101
3.3 Reagent Tray'i (Reaktif Tepsisi) ve DS9824 Saptama Sistemini Yükleme	103
3.4 Lamları ön yükleme, işleme ve boşaltma	105
4 Temizlik ve bakım	109
4.1 Bakım planları	110
4.1.1 Önleyici servis hatırlatması	110
4.1.2 Temizlik ve bakım planı	110
4.1.3 Temizlik ve bakım kontrol listesi	112
4.2 DI Water (DI Su) Kabını yeniden doldurma	113
4.3 Alcohol (Alkol) Kabını yeniden doldurma	115
4.4 Lotu Takip Edilen Toplu Kapları yeniden doldurma	118
4.5 Atık Kaplarını boşaltma	121
4.6 BOND-PRIME Cleaning Kit'i (BOND-PRIME Temizlik Kiti) kullanma	123
4.7 Bakımı Başlatma	127
4.8 ARC Module'lerin (ARC Modülü) iç yüzeyini silme	129
4.9 Reagent Platform (Reaktif Platformu) ve ARC Bank (ARC Sırası) yüzeylerini silme	133
4.10 Emme Kabını temizleme	137
4.11 Emme Kabını değiştirme	141
4.12 Lam Çekmecesi Parçalarını, Atık Giderlerini ve Karterlerini ve Alım Filtresini temizleme	145
4.13 Yıkama/Hazırlama İstasyonlarını temizleme	154
4.14 BOND-PRIME ARC Refresh Kit (BOND-PRIME ARC Yenileme Kiti) kullanma	158
4.15 Bulk DI Water Container'ı (Toplu DI Su Kabı) temizleme	164
4.16 Kilitli Bulk Reagent Container'ları (Toplu Reaktif Kabı) Temizleme	167
4.17 Atık Kaplarını Temizleme	177
4.18 Karter Tepsisini temizleme	180
4.19 Bakımı durdurma	182
4.20 İşleme modülünü kapatma	184
4.21 Güç kaynağı sigortalarını değiştirme	186
5 Sorun Giderme	189
5.1 Başlatılamadı	190

5.2 Ağ bağlantısı hatası	190
5.3 Lamları işleme modülünden manuel olarak geri alma	190
5.3.1 Lamları manuel olarak Ön Yükleme ve Boşaltma Çekmecelerinden geri alma	191
5.3.2 Lamları Çalışma Yüzeyinden manuel olarak geri alma	192
5.3.3 Lamları manuel olarak ARC Module'lerden (ARC Modülü) geri alma	194
5.3.4 Güç kesintisi sırasında lamları manuel olarak ARC Module'lerden (ARC Modülü) geri alma	197
5.4 ARC Module'den (ARC Modülü) lam parçasını çıkarma	199
6 Teknik Özellikler	201
6.1 Sistem teknik özellikleri	202
6.2 Fiziksel teknik özellikler	202
6.3 Elektrik gücü ve UPS gereksinimleri	202
6.4 Çevresel teknik özellikler	203
6.5 Çalıştırma teknik özellikleri	203
6.6 Mikroskop lamı teknik özellikleri	204
6.7 Taşıma ve saklama teknik özellikleri	205
Dizin	206

Yasal bildirimler

Ticari Markalar

BOND, BOND-III, BOND-MAX, BOND-PRIME, BOND-ADVANCE, Covertile, Bond Polymer Refine Detection, Bond Polymer Refine Red Detection, Parallel Automation, Compact Polymer ve Oracle; Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd ACN 008 582 401'in ticari markalarıdır.

Telif Hakkı

Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd bu belge ve ilişkili tüm yazılımların telif hakkına sahiptir. Yasa kapsamında, belgeler veya yazılım kopyalanmadan, yeniden üretilmeden, çevrilmeden veya tamamen ya da kısmen, elektronik ya da makine tarafından okunabilir diğer bir şekilde dönüştürülmeden önce yazılı iznimiz gereklidir.

Copyright © 2023 Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd

Ürün tanımlama

Doc. 91.7500.530 A09

Üretici



Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd
495 Blackburn Road
Mount Waverley VIC 3149
Australia

Tüm kullanıcılar için önemli bilgiler

Bu kılavuz, BOND-PRIME'in nasıl kullanılacağına dair önemli bilgiler içermektedir. Leica Biosystems ürünleri ve hizmetleri hakkındaki en yeni bilgiler için lütfen www.leicabiosystems.com adresini ziyaret edin.

Sürekli gelişime yönelik şirket politikası doğrultusunda Leica Biosystems, bildirimde bulunmaksızın teknik özellikleri değiştirme hakkını saklı tutar.

Terminoloji

Bu belgede ařađıdaki terimler kullanılmaktadır:

- Leica Biosystems—bkz. Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd.
- BOND - BOND-III, BOND-MAX ve BOND-PRIME ieren Leica Biosystems platformu
- BOND-PRIME - bir tr otomatik IHC ve ISH boyama cihazı
- BOND yazılımı - kullanıcıların BOND-III, BOND-MAX veya BOND-PRIME sistemini yapılandırmak ve iřletmek iin kullanabileceđi yazılım uygulaması

Hedef kullanıcılar

BOND-PRIME sisteminin amalanan kullanıcıları yeterince eđitim grmř laboratuvar personelleridir.

Bir BOND-PRIME İřlem Modl alıřtıran kiřiler, iřlem modln alıřtırmadan nce bu belgeye uygun olarak kullanılmasını sađlamak iin yeterli eđitim almıř olmalı ve potansiyel tehlikeler veya tehlikeli prosedrlerin tam olarak farkında olmalıdır. İřlem modlnden kapakları veya paraları yalnızca bu kılavuzdaki talimatları okumuř eđitimli personel ıkarmalıdır.

Kurulum ve onarımlar

Kurulum ve onarımlar, yalnızca Leica Biosystems tarafından yetkilendirilmiř yeterlilik sahibi servis personeli tarafından yapılmalıdır.

Garanti ile ilgili talepler, ancak rn belirlenmiř uygulama iin ve bu belgedeki talimatlara gre kullanılmıřsa yapılabilir. rnn uygun olmayan řekilde kullanılmasından ve/veya yanlış kullanılmasından kaynaklanan hasarlar garantiyi geersiz kılar. Bu tip hasarlardan Leica Biosystems sorumlu tutulamaz.

Ciddi olay raporlama

Bir hastanın veya kullanıcının lmne yol aan veya yol aabilecek herhangi bir ciddi olayın meydana gelmesi veya bir hastanın veya kullanıcının sađlık durumunda geici veya kalıcı bozulma yerel bir Leica Biosystems temsilcisine ve ilgili yerel Dzenleyici Makama bildirilmelidir.

Kullanıcı Veri Gvenliđi ve Gizliliđi Beyanı

Leica Biosystems, kiřisel veri gvenliđine ve gizliliđine zen gsterir ve bunları korumaya karardır. Ařađıdaki Leica Biosystems Gizlilik Bildiriminde toplayabileceđimiz, kullanabileceđimiz ve saklayabileceđimiz kiřisel veriler aıklanmaktadır.

Gizlilik Bildirimi

Lisans alan, kiřisel verileri iřlemeden nce hastalara ve diđer veri znelerine tm gerekli bildirimleri sađlayarak ve onlardan tm gerekli onayları alarak, sınırlama olmaksızın BOND-PRIME kullanarak kiřisel verileri iřlerken tm geerli veri koruma ve gizlilik kanunlarına uyacaktır.

BOND İşleme Modülünde aşağıdaki Kişisel Veri türleri mevcuttur:

- **Hasta Adı** – lam işlenirken lamın çalışma ayrıntılarını izlemek amacıyla geçici olarak BOND-PRIME içinde tutulur.
- **Hekim Adı** – lam işlenirken lamın çalışma ayrıntılarını izlemek amacıyla geçici olarak BOND-PRIME içinde tutulur.
- **Lam ID** – lam işlenirken lamın çalışma ayrıntılarını izlemek amacıyla geçici olarak BOND-PRIME içinde tutulur.
- **Kullanıcı hesabı ayrıntıları** – Kullanıcı hesabı ayrıntıları veri dosyalarında şifrelidir ve bir Şef tarafından silinene kadar BOND-PRIME Kontrolöründe saklanır. BOND-PRIME İşleme Modülünde kullanıcı verisi saklanmaz.
- **Lam Görüntüleri** – Lamın çalışma ayrıntılarını izlemek amacıyla, işlenen lamın görüntüleri toplanır. Lam görüntüleri veri dosyalarında şifrelidir ve BOND Kontrolöründe süresizce saklanır. Görüntüler, bir gün sonra otomatik olarak BOND-PRIME İşleme Modülünden kaldırılır.

Leica Biosystems ile iletişim

Servis veya destek için yerel Leica Biosystems temsilcinizle irtibat kurun veya www.leicabiosystems.com adresine bakın.

Revizyon kaydı

Rev	Yayın Tarihi	Etkilenen kısımlar	Detaylar
A09	Aralık 2023	Tümü	Çeviri düzeltmeleri.
A01 -A08	-	-	Yayınlanmadı.

Mevzuata ilişkin bildirimler

Kullanım amacı

IVD

BOND sistemi, mikroskop lamalarına yerleştirilmiş patoloji numunelerinin immünoboyanmasına yönelik klinik protokolleri otomatikleştirir. İşlemlerden sonra, mikroskop lamaları tanıya yardımcı olması için nitelikli bir sağlık uzmanı tarafından yorumlanır.

FCC uyumluluğu

Bu ekipman FCC Kurallarının 15. bölümü B alt bölümü uyarınca test edilmiş ve A Sınıfı dijital cihaz limitlere uygun olarak derecelendirilmiştir. Bu limitler, ekipman ticari bir ortamda çalıştırıldığında zararlı parazitlere karşı makul koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve kullanma kılavuzuna uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa radyo iletişimde zararlı parazite neden olabilir. Bu ekipmanın bir yerleşim alanında çalıştırılması zararlı parazite neden olabilir ve bu durumda kullanıcının paraziti, masrafları kendine ait olmak üzere düzeltmesi gerekecektir.

Uyumluluğu sürdürmek için yalnızca alet ile sağlanan kabloları kullanın.



UYARI: Leica Biosystems tarafından açıkça onaylanmayan herhangi bir değişiklik veya modifikasyon kullanıcının bu ekipmanı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

CE İşareti



CE İşareti, üreticinin uygunluk beyanında listelenen geçerli AB Direktiflerine uygunluğu belirtir.

Profesyonel kullanım amaçlı in vitro tanısal ekipmanlar için talimatlar

Bu IVD ekipmanı, IEC 61326 bölüm 2-6 ve IEC 60601 bölüm 1-2'nin emisyon ve bağışıklık gerekliliklerine uygundur.

Cihaz kullanılmaya başlanmadan önce elektromanyetik ortamın değerlendirmesi yapılmalıdır.

Kendi işletimini engelleyebileceği için bu cihazı, güçlü elektromanyetik radyasyon kaynaklarının (ör. kasıtlı korumasız RF kaynakları) ve/veya manyetik alanların yakınında kullanmayın.



UYARI: Bu ekipman CISPR 11 Sınıf A için tasarlanmış ve test edilmiştir. Ev ortamında radyo parazitine neden olabilir ve bu durumda paraziti azaltmak için önlemler almanız gerekebilir.

Bilgisayara yönelik mevzuat gereklilikleri: UL Listesinde (UL 60950), IEC 60950 sertifikalı.



DİKKAT: Federal Kanun, bu cihazın satışını lisanslı bir sağlık uzmanı tarafından veya talimatıyla yapılacak şekilde kısıtlar.

CISPR 11 (EN 55011) Uyarınca Ekipman Sınıflandırması

Bu ekipman CISPR 11 (EN 55011) uyarınca Grup 1 Sınıf A olarak sınıflandırılmıştır. Grup ve sınıf için açıklama aşağıda ifade edilmiştir.

Grup 1 - Bu, grup 2 ekipmanı olarak sınıflandırılmayan tüm ekipmanlar için geçerlidir.

Grup 2 - Bu, 9 kHz ila 400 GHz frekans aralığındaki radyo frekans enerjisinin kasti olarak oluşturulduğu ve kullanıldığı ya da yalnızca elektromanyetik radyasyon ve endüktif ve/veya kapasitif kuplaj biçiminde ya da malzeme işleme veya inceleme/analiz amaçları için kullanıldığı tüm ISM RF ekipmanları için geçerlidir.

Sınıf A - Bu, mesken amaçlı olarak kullanılan binalara güç sağlayan alçak voltajlı güç besleme ağına doğrudan bağlı olanlar ve mesken tipi olanlar dışında tüm tesislerde kullanıma uygun tüm ekipmanlar için geçerlidir.

Sınıf B - Bu, mesken amaçlı olarak kullanılan binalara güç sağlayan alçak gerilim güç kaynağı ağına doğrudan bağlı meskenlerde ve binalarda kullanıma uygun tüm ekipmanlar için geçerlidir.

Tanımlar

ISM: Endüstriyel, Bilimsel ve Medikal

RF: Radyo Frekansı

Semboller sözlüğü

Bu bölümde, ürün etiketinde kullanılan yasal ve güvenlik sembolleri açıklanmaktadır.

Düzenleyici semboller

BOND için kullanılan düzenleyici sembollerin açıklaması.










Bu sözlük, ilgili standartlarda sunulan sembollerin görüntülerini sağlar, ancak kullanılan bazı sembollerin renkleri farklılık gösterebilir.

Aşağıda, ürün etiketleme sarf malzemelerinde ve cihaz üzerinde kullanılan semboller ve anlamlarının bir listesi bulunmaktadır.

ISO 15223-1


Tıbbi cihazlar – tıbbi cihaz etiketlerinde kullanılacak semboller, etiketleme ve sağlanacak bilgiler – Bölüm 1: Genel gereklilikler.


Sembol	Standart/ Düzenleme	Referans	Açıklama
	ISO 15223-1	5.1.1	Üretici Tıbbi cihaz üreticisini gösterir.
	ISO 15223-1	5.1.2	Avrupa Topluluğunda Yetkili Temsilci Avrupa topluluğunda yetkili temsilciyi gösterir.
	ISO 15223-1	5.1.3	Üretim tarihi Tıbbi cihazın üretildiği tarihi gösterir.
	ISO 15223-1	5.1.4	Şu tarihe kadar kullanın (son kullanma tarihi) Tıbbi cihazın son kez kullanılabilceği tarihi gösterir.
	ISO 15223-1	5.1.5	Parti kodu Parti veya lotun tanımlanabilmesi için kullanılan üretici parti kodunu gösterir.
	ISO 15223-1	5.1.6	Katalog numarası / Referans numarası Tıbbi cihazın tanımlanabilmesi için üreticinin katalog numarasını gösterir.
	ISO 15223-1	5.1.7	Seri numarası Belirli bir tıbbi cihazın tanımlanabilmesi için üreticinin seri numarasını gösterir.

Sembol	Standart/ Düzenleme	Referans	Açıklama
	ISO 15223-1	5.1.8	İthalatçı Tıbbi cihazı Avrupa Birliği'ne ithal eden kuruluşu gösterir.
	ISO 15223-1	5.1.9	Distribütör Tıbbi cihazı yerel bölgeye dağıtan kuruluşu belirtir.
	ISO 15223-1	5.3.1	Kırılabilir, dikkatli taşıyın Tıbbi cihazın dikkatlice taşınmaması halinde kırılabileceğini veya hasar görebileceğini belirtir.
	ISO 15223-1	5.3.4	Yağmurdan uzak tutun Taşınacak paketin yağmurdan uzak ve kuru koşullarda tutulması gerektiğini gösterir.
	ISO 15223-1	5.3.7	Sıcaklık limiti Tıbbi cihazın güvenli bir şekilde maruz kalabileceği sıcaklık limitlerini gösterir.
	ISO 15223-1	5.4.2	Tekrar kullanmayın Tek kullanımlık veya tek bir işlem sırasında tek hasta üzerinde kullanılacak şekilde tasarlanmış bir tıbbi cihazı gösterir.
	ISO 15223-1	5.4.3	Kullanma talimatına başvurun Kullanıcının, kullanma talimatına başvurması gerektiğini belirtir.
	ISO 15223-1	5.4.4	Dikkat Çeşitli nedenlerle tıbbi cihaz üzerinde belirtilemeyen uyarılar ve önlemler gibi dikkat edilmesi gereken önemli bilgiler için kullanıcının kullanma talimatına başvurması gerektiğini belirtir.
	ISO 15223-1	5.5.1	In Vitro Diagnostik tıbbi cihaz In vitro diagnostik tıbbi cihaz olarak kullanılması amaçlanan bir tıbbi cihazı gösterir.

ISO 7000

Ekipmanda kullanım için grafik semboller – Tescilli semboller.


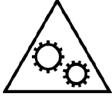

Sembol	Standart/ Düzenleme	Referans	Açıklama
	ISO 7000	1135	Geri dönüşüm İşaretlenmiş öğenin veya materyalinin geri kazanım veya geri dönüşüm sürecinin bir parçası olduğunu belirtir.

Sembol	Standart/ Düzenleme	Referans	Açıklama
	ISO 7000	1640	Teknik kılavuz; servis kılavuzu El kitabının saklandığı yeri veya ekipman için servis talimatlarıyla ilgili bilgileri tanımlar. Sembolün yerleştirildiği yere yakın bir yerde cihaza bakım yaparken servis kılavuzunun veya el kitabının dikkate alınması gerektiğini belirtmek için.
	ISO 7000	2594	Havalandırma açık Dış havanın iç ortama girmesini sağlayan kontrolü tanımlar.
	ISO 7000	3650	USB Evrensel Seri Veriyolunun (USB) genel gereksinimlerini karşılayan bir bağlantı noktası veya fişi tanımlar. Cihazın bir USB bağlantı noktasına takılı olduğunu veya bir USB bağlantı noktasıyla uyumlu olduğunu belirtmek için.





IEC 60417








Ekipmanda kullanım için grafik semboller.

Sembol	Standart/ Düzenleme	Referans	Açıklama
	IEC 60417	5007	Açık En azından ana şebeke anahtarları veya konumları için şebekeye bağlantıyı ve güvenliğin söz konusu olduğu tüm vakaları gösterir
	IEC 60417	5008	Kapalı En azından ana şebeke anahtarları veya konumları için şebekeden bağlantı kesintisini ve güvenliğin söz konusu olduğu tüm vakaları gösterir
	IEC 60417	5009	Beklemede Ekipmanı bekleme durumuna getirmek için ekipmanın hangi parçasının açık olduğunu kullanarak anahtar veya anahtar konumunu tanımlar.
	IEC 60417	5016	Sigorta Sigorta kutularını veya konumlarını tanımlar.
	IEC 60417	5019	Koruyucu topraklama: koruyucu toprak akımı Bir hata durumunda elektrik çarpmasına karşı koruma sağlamak için harici bir iletkene veya koruyucu topraklama elektrotunun terminaline bağlanmak için tasarlanmış bir terminaldir.
	IEC 60417	5032	Tek faz alternatif akım İlgili terminalleri belirlemek için ekipmanın yalnızca alternatif akıma uygun olduğunu anma değeri plakasında belirtir.

Sembol	Standart/ Düzenleme	Referans	Açıklama
	IEC 60417	5988	Bilgisayar ağı Bilgisayar ağının kendisini tanımlar veya bilgisayar ağının bağlantı terminallerini gösterir.
	IEC 60417	6057	Dikkat: hareketli parçalar Hareketli parçalardan uzak tutmak için eğitim amaçlı bir koruyucu.
	IEC 60417	6222	Bilgi; genel Ekipmanın durumunu incelemek için kontrolü tanımlar; ör. çok işlevli kopyalama makineleri.

Diğer semboller ve işaretler

Sembol	Standart/Düzenleme	Açıklama
	21 CFR 801.15(c)(1) (i)F	Sadece reçeteyeyle satılır ABD FDA tarafından şuna alternatif olarak tanınmaktadır: "Dikkat: Federal yasalar, bu cihazın satışını lisanslı bir hekim tarafından veya hekim talimatıyla yapılacak şekilde kısıtlar."
	Cihazın Uygunluk Beyanı, sistemin uyumlu olduğu Direktifleri listeler	Avrupa Uygunluğu Cihazın Uygunluk Beyanı, sistemin uyumlu olduğu Direktifleri listeler.
	2012/19/EC AB Direktifi: atık elektrikli ve elektronik ekipman (WEEE)	Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman (WEEE) Direktifi Elektronik ürün, sınıflandırılmamış atık olarak atılmamalı, geri kazanım ve geri dönüşüm için ayrı toplama tesislerine gönderilmelidir. Bu etiketin varlığı şunları belirtir: <ul style="list-style-type: none"> Cihaz Avrupa Pazarına 13 Ağustos 2005 tarihinden sonra sunuldu. Cihaz, herhangi bir Avrupa Birliği üye devletinin belediye atık toplama sistemi aracılığıyla atılmamalıdır. Müşteriler, elektrikli ekipmanın doğru dekontaminasyonu ve güvenli bir şekilde atılması ile ilgili tüm yasaları anlamalı ve bunlara uymalıdır.
	AS/NZS 4417.1	Mevzuata Uygunluk İşareti (RCM) Avustralya ve Yeni Zelanda için Avustralya İletişim ve Medya Kurumu (ACMA) gerekliliklerine (güvenlik ve EMC) uygunluğu gösterir.

Sembol	Standart/Düzenleme	Açıklama
	Çin Halk Cumhuriyeti Elektronik Endüstri Standardı SJ/T11364	Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması (RoHS 2) Bu elektronik bilgi ürününün belirli toksik veya tehlikeli öğeler içerdiğini ve çevre koruma kullanım süresi boyunca güvenle kullanılabileceğini gösterir. Logonun ortasındaki sayı, ürünün çevre koruma kullanım süresini (yıl olarak) gösterir. Dıştaki halka, ürünün geri dönüştürülebileceğini gösterir. Logo ayrıca, ürünün çevre koruma kullanım süresi dolduktan hemen sonra geri dönüştürülmesi gerektiğini de belirtir. Etiketdeki tarih, üretim tarihini gösterir.
	Çin Halk Cumhuriyeti Elektronik Endüstri Standardı SJ/T11364	Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması (RoHS 2) Bu elektronik bilgi ürününün herhangi bir tehlikeli madde içermediğini veya GB/T 26572'de belirtilen konsantrasyon sınırlarını aşmadığını gösterir. Geri dönüştürülebilen çevre dostu bir üründür.
	Başlık 47 Birleşik Devletler Federal Düzenlemeler Yasası Bölüm 15	Federal İletişim Komisyonu (FCC) Bu ürün test edilmiş ve FCC Kuralları bölüm 15 uyarınca limitlerle uyumlu olduğu bulunmuştur.
	Geçerli Değil	Underwriters Laboratory (UL) sertifika işareti Underwriter Laboratories, listelenen ürünlerin hem ABD hem de Kanada güvenlik gerekliliklerine uygun olduğunu onaylamıştır.
	CSA International	CSA Group test kurumunda kayıtlı cihaz CSA Group, listelenen ürünlerin hem ABD hem de Kanada güvenlik gerekliliklerine uygun olduğunu onaylamıştır.
	Geçerli Değil	Intertek test kurumunda kayıtlı cihaz Intertek Test Kurumu, listelenen ürünlerin hem ABD hem de Kanada güvenlik gerekliliklerine uygun olduğunu onaylamıştır.
	İn Vitro Diagnostik Tıbbi Cihazlara (İvDO) ilişkin 4 Mayıs 2022 tarihli Yönetmelik.	İsviçre Yetkili Temsilcisi İsviçre Yetkili temsilcisini belirtir.
	Geçerli Değil	Bağıl nem aralığı Taşıma ve saklama için kabul edilebilir bağıl nem üst ve alt limitlerini gösterir. Bu sembole, geçerli bağıl nem limitleri eşlik eder.
	Geçerli Değil	Bağlı olmayan port Bu ürün şırınga pompasında bağlanmamış bir bağlantı noktasına sahiptir.

Güvenlik sembolleri

BOND için kullanılan güvenlik sembollerinin açıklaması

ISO 7010

Grafik semboller – Güvenlik renkleri ve güvenlik işaretleri – Tescilli güvenlik işaretleri.

Sembol	Standart/Düzenleme	Referans	Açıklama
	ISO 7010	W001	Genel uyarı Çeşitli nedenlerle tıbbi cihaz üzerinde belirtilemeyen uyarılar ve önlemler gibi dikkat edilmesi gereken önemli bilgiler için kullanıcının kullanım talimatlarına başvurması gerektiğini belirtir.
	ISO 7010	W004	Uyarı: lazer ışını Lazer tehlikesi. Ciddi göz hasarı potansiyeli. Lazer ışınlarıyla doğrudan göz temasından kaçının.
	ISO 7010	W007	Uyarı: zemin seviyesinde engel Zemin seviyesinde engel tehlikesi Zemin seviyesinde engel yakınında dikkatli olun.
	ISO 7010	W009	Uyarı: biyolojik tehlike Biyolojik tehlike. Biyolojik tehlikeye maruz kalma potansiyeli. Maruz kalmayı önlemek için ürünle birlikte verilen belgelerdeki talimatları izleyin.
	ISO 7010	W012	Dikkat: elektrik çarpması riski Elektriksel tehlike. Potansiyel elektrik çarpması riski. Kişiler veya ekipmanın zarar görmesinden kaçınmak için ekli belgelerde sunulan talimatları izleyin.
	ISO 7010	W016	Uyarı: toksik madde Toksik tehlike. Uygun kimyasal muamele işlemleri prosedürleri uygulanmazsa, sağlıkla ilgili olası ciddi etki tehlikesi. Reaktifleri kullanırken eldiven ve koruyucu gözlük kullanın.
	ISO 7010	W017	Uyarı: sıcak yüzey Isı tehlikesi. Sıcak yüzeyler dokunulursa yanıklara neden olur. Bu sembolle tanımlanmış kısımlara dokunmaktan kaçının.
	ISO 7010	W020	Uyarı: Baş üzeri engel Baş üzeri engel. Baş üzeri engel nedeniyle darbe almaktan veya engele çarpmaktan kaçınmak için dikkatli olun.
	ISO 7010	W021	Uyarı: yanıcı madde Yanıcı madde tehlikesi. Yanıcı maddeler uygun önlemler alınmazsa tutuşabilir.

Sembol	Standart/Düzenleme	Referans	Açıklama
	ISO 7010	W022	Uyarı: Keskin parça Keskin parça. Keskin parçalar (örneğin iğneler, bıçaklar) nedeniyle yaralanmamak için dikkatli olun.
	ISO 7010	W023	Uyarı: aşındırıcı madde Aşındırıcı bir maddeden kaynaklanan kimyasal tehlike. Uygun önlemler alınmazsa sağlıkla ilgili ciddi etki tehlikesi vardır. Daima koruyucu giysiler ve eldivenler kullanın. Dökülmeleri standart laboratuvar uygulamasını kullanarak hemen temizleyin.
	ISO 7010	W024	Uyarı: ellerin ezilmesi Ezilme tehlikesi. Eller veya vücudun diğer bölümleri, ekipmanın mekanik parçalarının kapanma hareketiyle ezilebilir.
	ISO 7010	W072	Uyarı: Çevresel tehlike Çevresel tehlike. Çevresel bir tehlikeye neden olabilecek madde veya karışım.

Genel uyarılar

Uyarılar kişisel yaralanmaya yol açabilecek veya hasta örneklerini kaybetme, hasar verme veya yanlış tanımlama olasılığının bulunduğu tehlikeleri bildirir. Kişisel yaralanma, hasar, hasta örneklerinin kaybı veya yanlış tanımlanması ve ekipman hasarını önlemek için tüm güvenlik önlemlerine uyun.

Bu kılavuzdaki uyarılar siyah kenarları ve sarı arka planı olan semboller kullanılmıştır.

Genel BOND-PRIME uyarıları aşağıda verilmektedir. Diğer uyarılar el kitabının ilgili kısımlarında görülür.

Cihazın çalıştırılması



BOND-PRIME İşleme Modülünün doğru çalıştığından emin olmak için daima Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd içindeki onaylı talimatlara uyun. Talimatlara doğru şekilde uymazsanız performans düşük olabilir.



BOND-PRIME, çalışmak ve kullanım amacını yerine getirmek için ağ erişimi gerektirmez. Kötü amaçlı veya yetkisiz erişimi önlemek için BOND-PRIME kurulumunu ağınıza/altyapınıza herhangi bir bağlantı olmadan yapın.

Ağ bağlantısı istiyorsanız, tercih edilen yöntem BOND-PRIME ile güvenlik duvarlı bir Sanal Yerel Alan Ağı (VLAN) arasında bağlantı kurmaktır. Alternatif olarak, standart çalışma prosedürleriniz uyarınca kendi ağ güvenlik mekanizmalarınızı uygulayabilir ve doğrulayabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için *BOND 7+ Bilgi Sistemleri Kılavuzuna* (49.6539.811) bakın.



BOND-PRIME kontrolörüne kötü amaçlı yazılım bulaşması durumunda, işleme modüllerinin devre dışı kalması gibi beklenmeyen davranışlar oluşabilir. BOND-PRIME kontrolörüne takacağınız USB depolama cihazlarınızın virüs içermediğinden emin olun. Ayrıca Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd için önceden yüklenmiş bir anti-virüs yazılımı yoktur, bu yüzden kendi kurumunuzun anti-virüs ürününü kurmanızı öneriyoruz. Daha fazla bilgi için yerel Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd temsilcinizle iletişime geçin.

Elektriksel tehlikeler



Bu belgede belirtilmediği sürece işleme modülü kapaklarını çıkarmayın ve dahili bileşenlere erişmeye çalışmayın. İşleme modülünün içinde tehlikeli voltajlar vardır. Elektriksel işlemleri yalnızca Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd tarafından onaylanmış, yetkili servis teknisyenleri yapabilir.



İşleme modülünün çalışma voltajını değiştirmeyin. İşleme modülünü yanlış bir güç kaynağı voltajına bağlarsanız işleme modülünde hasar oluşabilir.

Ayarı değiştirmek gerekiyorsa müşteri desteğine bildirimde bulunun.



İşleme modülünü kolayca erişilebilen topraklanmış bir güç çıkışı soketine bağlamalısınız.



Sigortaları işlemez hale getirmeyin ve sigortalara kısa devre yapmayın.

Bir sigortayı değiştirmeden önce işleme modülündeki AC güç kaynağı anahtarını KAPALI olarak ayarlayın ve işleme modülünün arka kapağında güç kaynağı kablosunu ayırın.

Yalnızca onaylanmış yedek sigortaları kullanın. Sigortaları düzenli olarak değiştirmek gerekiyorsa müşteri desteğine bildirimde bulunun.

Kimyasal tehlikeler



Çıkarılabilir toplu kapların ve haznelerin üzerindeki kapakları doğru taktığınızdan emin olun.

İşleme modülünün yakınında alev veya başka tutuşma kaynakları olmasına izin vermeyin.

Toplu kaplar ve haznelerdeki bazı reaktifler alev alıcıdır.



Yangını önlemek için, işleme modülünün sıcak yüzeylerinin üzerine veya yakınına alev alıcı malzemeler koymayın.

Mekanik tehlikeler



Temizlik ve bakım görevleri için DI Water (DI Su) kaplarını ve Bulk/Hazardous Waste Container'larını (Toplu/Tehlikeli Atık Kabı) kaldırırken iki elinizi birden kullanın.



İşleme modülünü çalıştırmayı denemeden önce Kaputu kapatın. İşleme modülünde Kaput açıkken çalışmayı önleyen iç kilitler vardır. İç kilitleri işlemez hale getirmeye çalışmayın.

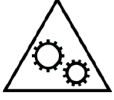


High-Speed Robot (Yüksek Hızlı Robot) Çalışma Yüzeyinin üzerindeki bir konumda takılırsa, robotu manuel olarak hareket ettirmeye çalışmayın. Bu sorun için Müşteri Desteği ile iletişime geçin.

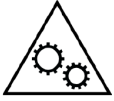


Kaputu kapattığınızda ellerinizin açıklıktan uzakta olmasına dikkat edin. Kaput ağırdır ve yaralanmaya neden olabilir.

İşleme modülü çalışırken, Kaput kapalı konumda kilitletir. Kaputu açmaya çalışmayın.



Kaput açıkken High-Speed Robot'un (Yüksek Hızlı Robot) ve Yıkama Robotlarının çalışmaya devam etmemesi gerekir. Çalışmaya devam ediyorsa derhal sorunu müşteri desteğine bildirin.



İşleme modülü çalışırken ellerinizi Reagent Platform (Reaktif Platformu) açıklığına koymayın. High-Speed Robot (Yüksek Hızlı Robot) çalışırken hızlı ve ani şekilde hareket eder.



İşleme modülünü uzak mesafedeki yeni bir konuma taşımanız gerekiyorsa müşteri desteğine bildirimde bulunun. İşleme modülü oldukça ağırdır. İşleme modülü yalnızca onaylı personel tarafından taşınmalıdır.

İşleme modülünün çalışması



Reaktiflerin ve lamların kontamine olmasını önlemek için, işleme modülünü yalnızca olabildiğince az toz ve partikül içeren temiz bir ortamda çalıştırın.



Kontaminasyonu ve düşük performansı önlemek için Toplu Kapları doğru taktığınızdan emin olun. Toplu Kap istasyonlarında renk kodlu isim etiketleri vardır.

Bkz. [1.7 Toplu Kaplar](#).

Genel dikkat edilecek hususlar

Dikkat edilecek hususlar, kişilere zarar vermeyecek şekilde BOND ekipman hasarına veya diğer istenmeyen sonuçlara neden olabilecek tehlikeleri bildirir.

Dikkat edilecek hususlarda siyah çerçeve ve beyaz arka plan kullanılır

Genel BOND-PRIME dikkat edilecek hususları ařađıda verilmektedir. Diđer dikkat edilecek hususlar kılavuzun ilgili kısımlarında görölr.

Kişisel Koruyucu Ekipmanlar (PPE)

Reaktifleri kullanmadan ve işleme modülünde işlem, bakım veya temizlik yapmadan önce gerekli minimum kişisel koruyucu ekipman kullanmanız gerekir:

- Laboratuvar eldivenleri
- Koruyucu gözlük
- Uygun şekilde koruyucu giysi, örneđin laboratuvar önlüğü

Kurulum tehlikeleri



İşleme modülünün arka kapađındaki havalandırma deliklerini tıkamayın.

Çalıştırma tehlikeleri



Lam etiketlerinin tüm kısımlarını, herhangi bir lam kenarına dokunmayacak şekilde konumlandırın. Açıkta kalan yapışkan yüzey, lam etiketinin (ve lamın) Covertile'a veya diđer ekipmana yapışmasına ve lamın hasar görmesine neden olabilir.



Lam etiketi alanında nem veya yapışkan kalıntı bırakmayın, aksi takdirde hasara neden olabilir.



Çıkarılabilir parçaları yalnızca elle temizlemeniz gerekir. Hasardan kaçınmak için, parçaları otomatik bulaşık makinesinde yıkamayın. Parçaları temizlemek için çözücüler veya sert ya da aşındırıcı malzemeler kullanmayın.



Toplu kapları takarken aşırı güç uygulamayın. Bu, kabın hasar görmesine yol açabilir.



Hasar görmüş lamları kullanmayın.

Reaktif tehlikeleri



Uyumlu olmayan toplu reaktifler, düşük performans veya işleme modülünde hasara yol açabilir.

Uyumlu toplu reaktifler hakkında bilgi için bkz. Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd.



BOND-PRIME İşleme Modüllerinde ksilen, kloroform, aseton, güçlü asitler (örneğin %20 HCl), güçlü bazlar (örneğin %20 NaOH) kullanmayın.

İşleme modülünün üzerine veya yakınına bu kimyasallar dökülürse, işleme modülü kapaklarının hasar görmesini önlemek için alanı derhal %70 etanol ile temizleyin.



BOND-PRIME İşleme modüllerinde yalnızca BOND-PRIME Dewax Solution, BOND-PRIME ER1, BOND-PRIME ER2 Çözeltileri ve BOND-PRIME Wash Solution Concentrate kullanın.

BOND-PRIME parçalarına hasar verebilecek ve sıvı sızıntılarına neden olabilecek ksilen, ksilen muadilleri ve diğer reaktifleri kullanmayın.

1

BOND-PRIME donanımı

Bu kısımda:

1.1 BOND-PRIME hakkında	24
1.2 BOND-PRIME İşleme Modülü	27
1.3 Kaput	29
1.4 Ön Yükleme ve Boşaltma Çekmeceleri	30
1.5 Lam Çekmecesi Parçaları, Atık Giderleri ve Karterleri ve Alım Filtresi	31
1.6 Reagent Platform (Reaktif Platformu)	34
1.7 Toplu Kaplar	35
1.8 Hazne Kabini	37
1.9 AC güç anahtarı	38
1.10 Reagent Tray'ler (Reaktif Tepsisi)	39
1.11 Çalışma Yüzeyi (Kaputun altında)	40
1.12 İşleme modülünü bağlama ve açma	51
1.13 İşleme modülünü ayırma	53
1.14 İşleme modülünü yeni bir konuma taşıma	55
1.15 İşleme modülünü hizmetten çıkarma ve atma	57

1.1 BOND-PRIME hakkında

BOND-PRIME için hedef kullanıcılar, uygun eğitimi görmüş laboratuvar personelidir.

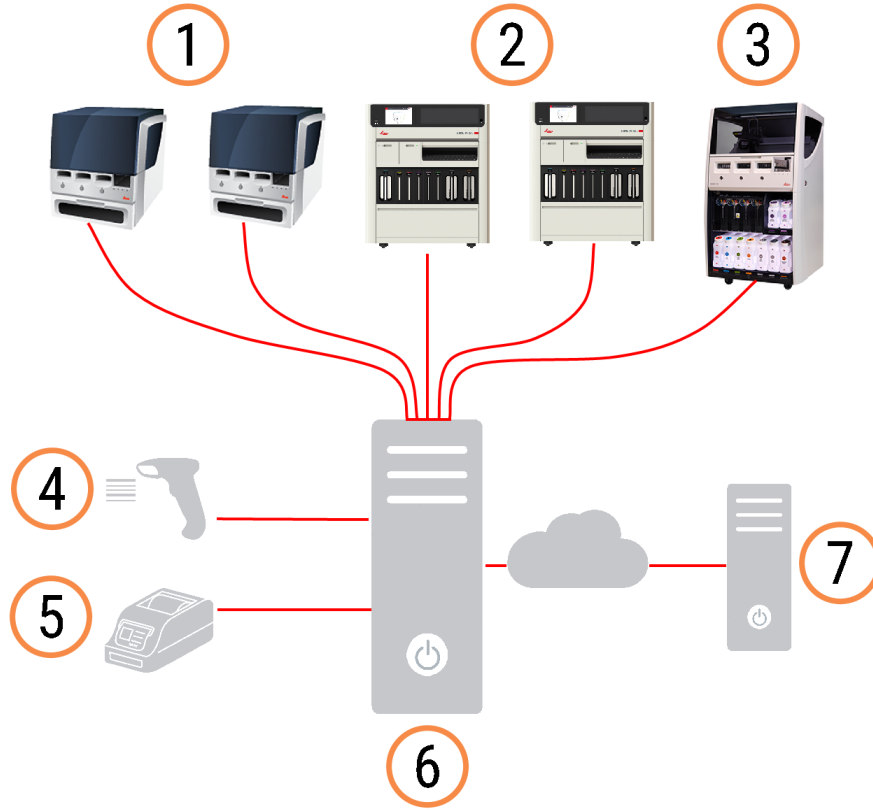
BOND-PRIME, şu birincil bileşenlere sahiptir:

- Bir veya daha fazla işleme modülü
- BOND Kontrolörü veya BOND-ADVANCE Kontrolörü.



BOND-ADVANCE Sisteminde ek olarak Terminaller vardır ve ikincil (yedek) Kontrolör mevcut olabilir.

- Bir veya daha fazla el tipi Barkod Tarayıcısı
- Bir veya daha fazla Lam Etiketleyici.



Açıklama

- | | | | |
|---|---------------------------|---|----------------------|
| 1 | BOND-MAX İşleme Modülü | 5 | Lam Etiketi Yazıcısı |
| 2 | BOND-PRIME İşleme Modülü | 6 | BOND Kontrolörü |
| 3 | BOND-III İşleme Modülü | 7 | LIS bağlantısı |
| 4 | El Tipi Barkod Tarayıcısı | | |

Her bir yeni BOND-PRIME İşleme Modülünde aşağıdakiler mevcuttur:

- Çıkarılabilir Ön Yükleme Lam Çekmecesi Parçası
- Çıkarılabilir Boşaltma Lam Çekmecesi Parçası
- Tekli reagent container (reaktif kabı) tepsileri
- Ethernet kablosu.

Diğer gerekli öğeler:

- BOND-PRIME Saptama Sistemleri
- BOND-PRIME Kullanıma Hazır (RTU) reaktifleri veya konsantreleri
- BOND-PRIME Açık Kapları.

Sarf malzemesi öğelerinin ve yedek parçalarının tam ve güncel listesi için bkz. www.leicabiosystems.com.

1.1.1 BOND-PRIME yardımcı malzemeleri ve sarf malzemesi öğeleri

Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd, BOND-PRIME İşleme Modülüyle kullanım için aşağıdaki yardımcı malzemeleri sağlar.

Hasarı önlemek ve en iyi boyama kalitesine sahip lamlar elde etmek için alternatif yardımcı malzemeler kullanmayın.

Yardımcı reaktifler

- BOND-PRIME Dewax Solution
- BOND-PRIME Wash Solution Concentrate
- BOND-PRIME Epitope Retrieval Solution 1
- BOND-PRIME Epitope Retrieval Solution 2
- BOND-PRIME Hematoxylin
- BOND-PRIME Cleaning Kit (BOND-PRIME Temizlik Kiti)

Sarf Malzemesi öğeleri

- BOND Plus Lamaları veya kabul edilebilir cam lamalar (bkz. [6.6 Mikroskop lamı teknik özellikleri](#))
- BOND Açık Kaplar (7 mL), 10'lu paket
- BOND Açık Kaplar (30 mL), 10'lu paket
- BOND Titrasyon Kiti, 10 kap, 50 parça
- BOND Lam Etiketleri ve Yazdırma Şeridi Kiti

- BOND-PRIME ARC Refresh Kit (BOND-PRIME ARC Yenileme Kiti):
 - 24 ARC Covertile
 - 1 Mixing Well Plate (Karıştırma Kuyucuğu Plakası)

Yedek Parçalar

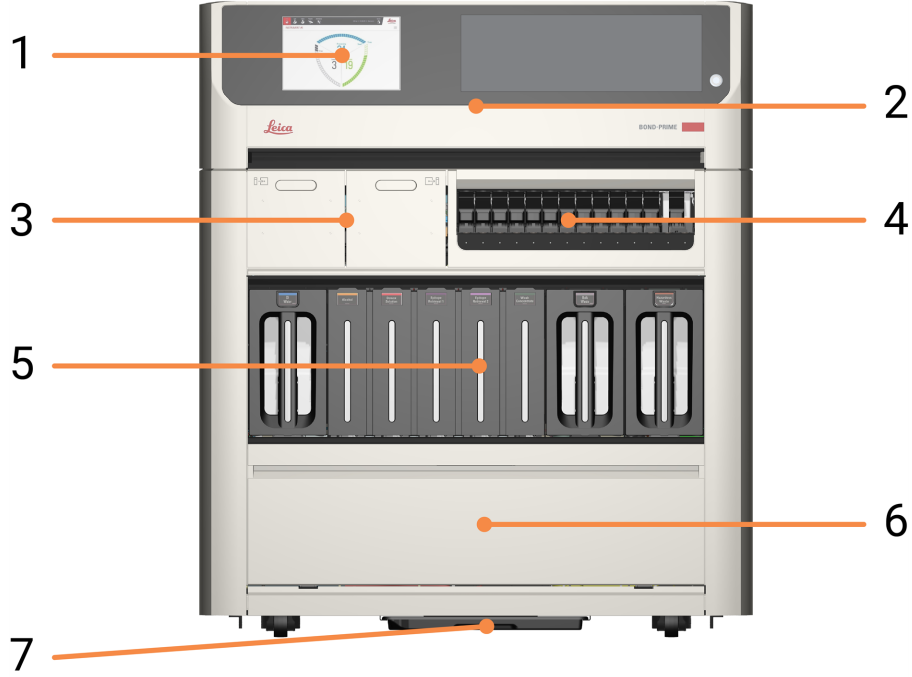
- BOND-PRIME Emme Kapları

Gerekli Reaktifler (Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd tarafından sağlanmayan)

- Reaktif sınıfı alcohol (alkol)
- DI water (DI su)

1.2 BOND-PRIME İşleme Modülü

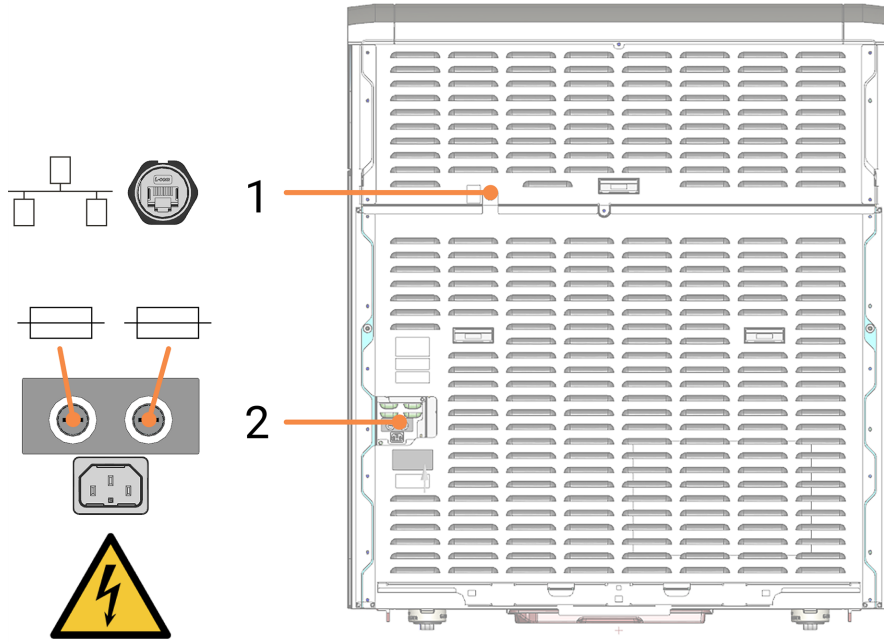
1.2.1 Önden görünüm



Açıklama

- | | | | |
|---|--|---|------------------|
| 1 | 2 Dokunmatik Ekran | 5 | 1.7 Toplu Kaplar |
| 2 | 1.3 Kaput | 6 | 1.8 Hazne Kabini |
| 3 | 1.4 Ön Yükleme ve Boşaltma Çekmeceleri | 7 | Karter Tepsisi |
| 4 | 1.6 Reagent Platform (Reaktif Platformu) | | |

1.2.2 Arkadan görünüm

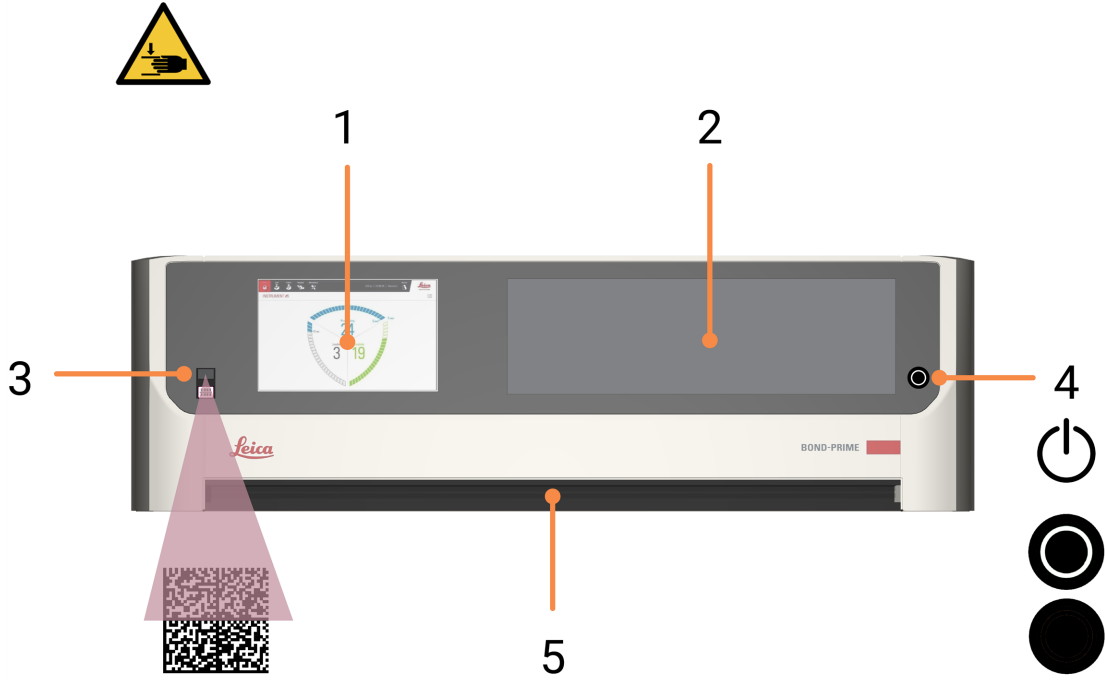


Açıklama

- 1 Ethernet bağlantısı
- 2 Sigortalar ve güç kaynağı bağlantısı



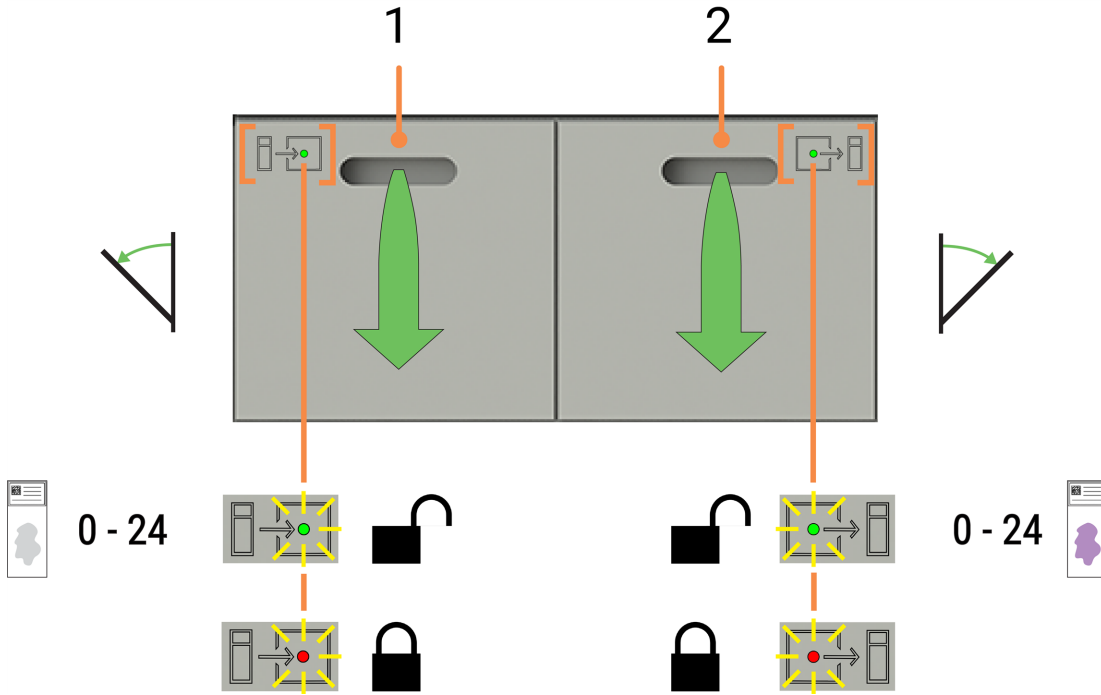
1.3 Kaput



Açıklama

- | | |
|---|---|
| <p>1 2 Dokunmatik Ekran</p> <p>2 Görüntüleme penceresi
İşleme modülü çalışırken Çalışma Yüzeyini görmenizi sağlar.</p> <p>3 Barkod Tarayıcısı
Toplu reaktif besleme şişelerini ve ARC Refresh Kit'i (ARC Yenileme Kiti) taramak için kullanılır.</p> | <p>4 Beyaz LED'li bekleme güç düğmesi
İşleme modülünün açık (beyaz ışık) veya kapalı (ışık yok) olduğunu belirtir.</p> <p>5 Tutamak
Kaputu açmak ve kapatmak için kullanılır.</p> |
|---|---|

1.4 Ön Yükleme ve Boşaltma Çekmeceleri



Açıklama

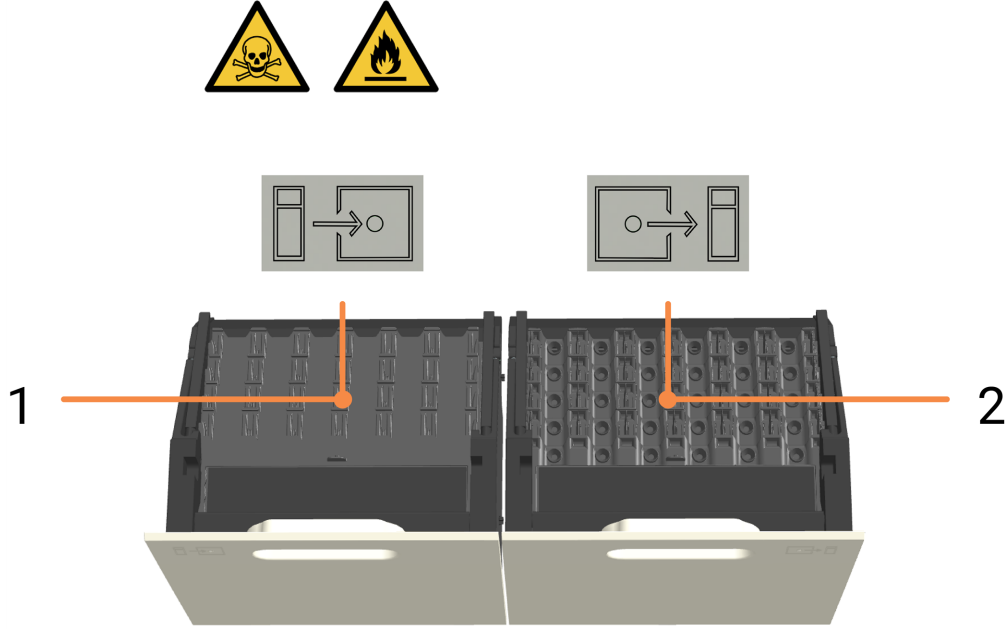
- 1 Preload Drawer (Ön Yükleme Çekmecesi)
- 2 Boşaltma Çekmecesi

Ayrıca bkz:

- [2.5 Lamları ön yükleme](#)
- [2.7 Lamları boşaltma](#)
- [4.12 Lam Çekmecesi Parçalarını, Atık Giderlerini ve Karterlerini ve Alım Filtresini temizleme](#)

1.5 Lam Çekmecesi Parçaları, Atık Giderleri ve Karterleri ve Alım Filtresi

1.5.1 Lam Çekmecesi Parçaları



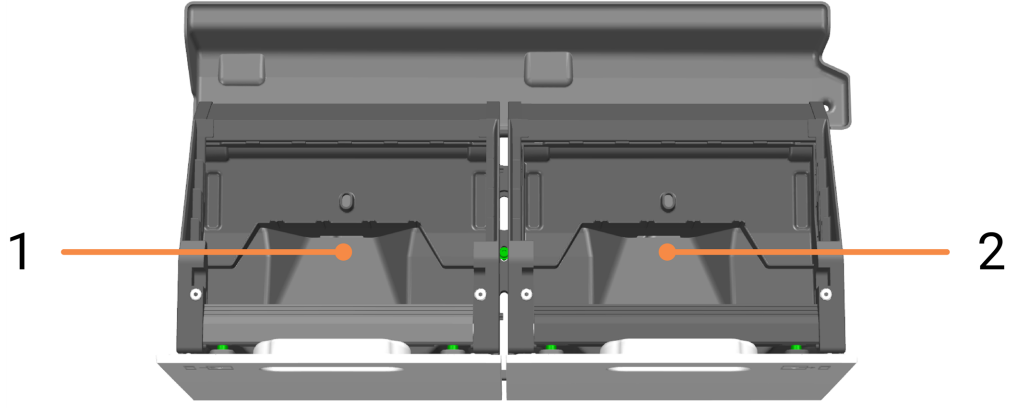
Açıklama

- 1 Ön Yükleme Lam Çekmecesi Parçası
- 2 Boşaltma Lam Çekmecesi Parçası

Ayrıca bkz:

- [2.5 Lamları ön yükleme](#)
- [2.7 Lamları boşaltma](#)
- [4.12 Lam Çekmecesi Parçalarını, Atık Giderlerini ve Karterlerini ve Alım Filtresini temizleme](#)

1.5.2 Atık Giderleri



Açıklama

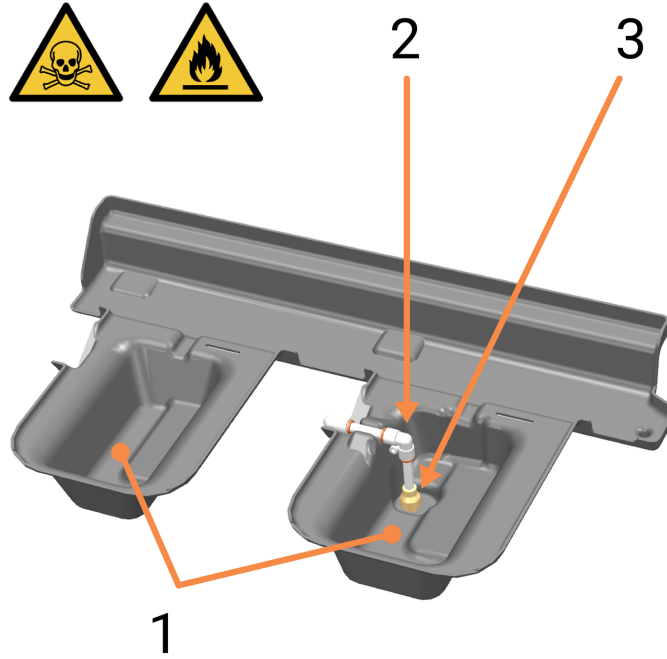
- 1 Ön Yükleme Atık Gideri
- 2 Boşaltma Atık Gideri

Açık çekmecelerden Lam Çekmecesi Parçaları çıkarıldıktan sonra Atık Giderlerine erişilebilir.

Ayrıca bkz:

- [4.12 Lam Çekmecesi Parçalarını, Atık Giderlerini ve Karterlerini ve Alım Filtresini temizleme](#)

1.5.3 Karterler ve Filtreli Alım Tümü



Açıklama

- 1 Karterler
- 2 Boşaltma Çekmecesine Alım Tüpü
- 3 Alım Filtresi

Karterler, Ön Yükleme ve Boşaltma Çekmecelerinin altında ve arkasında yer alır. Çekmeceler tam olarak açıldıktan sonra bunlara Çalışma Yüzeyi aracılığıyla erişilebilir.

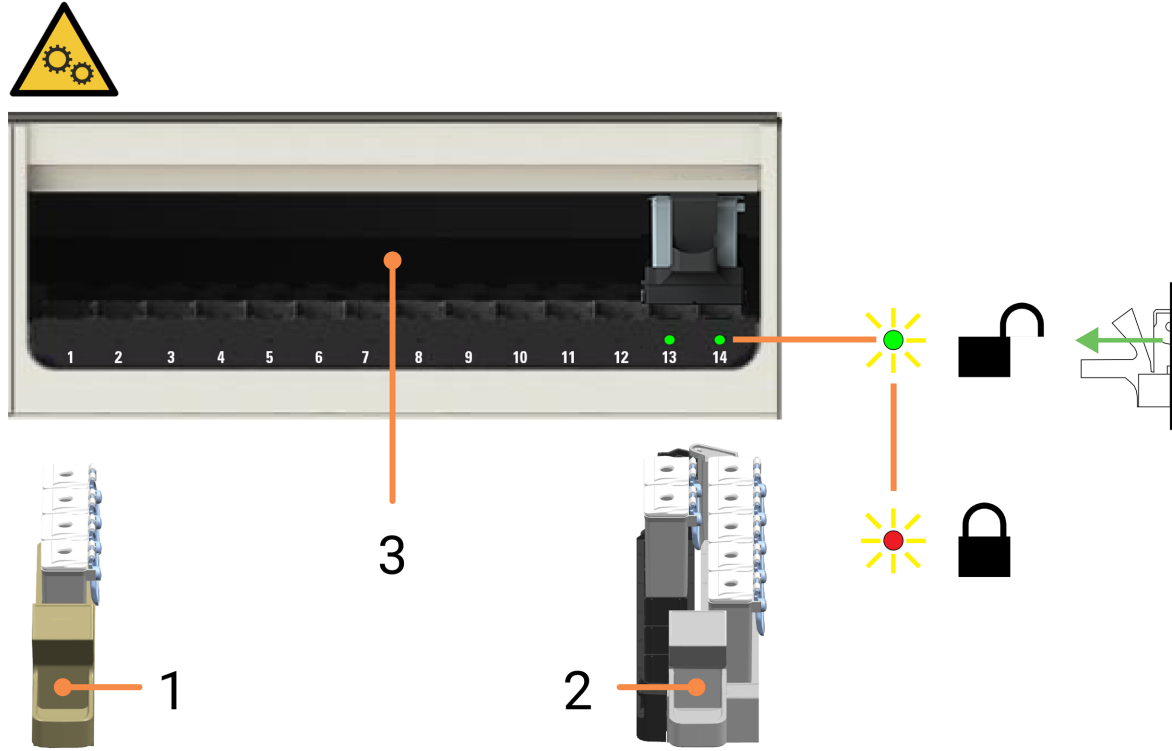
Boşaltma Çekmecesinin altındaki Karterde, Boşaltma Çekmecesine açıldığında ve kapatıldığında toplanan atık suyu çıkarmak için Alım Tüpü ve Filtresi kullanılır.

Karterde sıvı birikimi varsa, bunun nedeni Alım Filtresinin tıkanmış olması olabilir. Bkz. [4.12 Lam Çekmecesine Parçalarını, Atık Giderlerini ve Karterlerini ve Alım Filtresini temizleme](#).

Ayrıca bkz:

- [4.12 Lam Çekmecesine Parçalarını, Atık Giderlerini ve Karterlerini ve Alım Filtresini temizleme](#)

1.6 Reagent Platform (Reaktif Platformu)



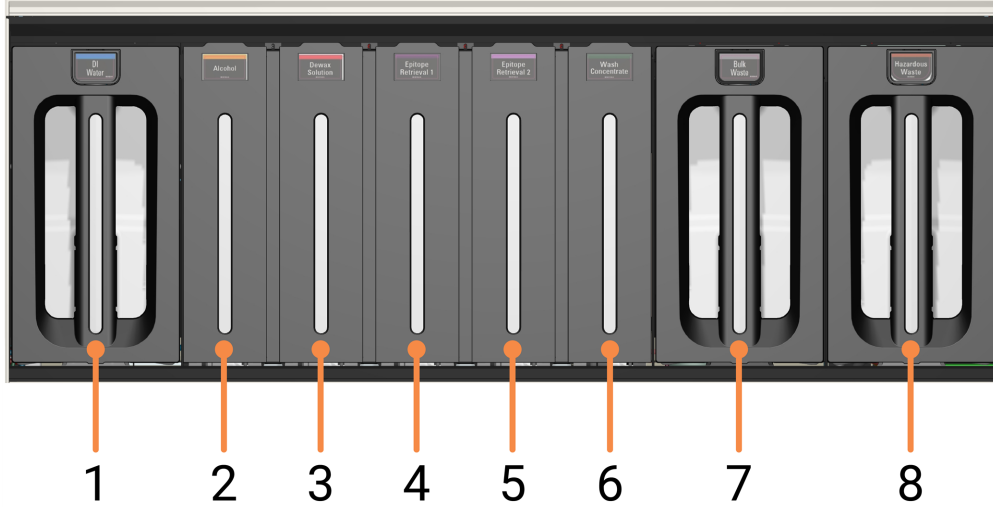
Açıklama

- | | |
|---|--|
| 1 Tekli Reaktif Tepsisi | 3 14 hatlı Reagent Platform (Reaktif Platformu)
(tekli veya ikili tepsilerin herhangi bir kombinasyonu ile toplam 70 reagent container (reaktif kabı) kapasitesi) |
| 2 Dual Reagent Tray (İkili Reaktif Tepsisi) | |









Ayrıca bkz:

- [1.10 Reagent Tray'ler \(Reaktif Tepsisi\)](#)
- [2.10.1 Reagent Container'ı \(Reaktif Kabı\) ve Reagent Tray'leri \(Reaktif Tepsisi\) Hazırlama](#)
- [2.10.2 Reagent Tray'leri \(Reaktif Tepsisi\) yükleme](#)
- [2.10.6 Reagent Tray'leri \(Reaktif Tepsisi\) boşaltma](#)
- [4.9 Reagent Platform \(Reaktif Platformu\) ve ARC Bank \(ARC Sırası\) yüzeylerini silme](#)

1.7 Toplu Kaplar



Açıklama

1		DI Water (DI Su)	5		BOND-PRIME Epitope Retrieval 2
2		Alcohol (Alkol)	6		BOND-PRIME Wash Solution Concentrate
3		BOND-PRIME Dewax Solution	7		Toplu Atık
4		BOND-PRIME Epitope Retrieval 1	8		Tehlikeli Atık

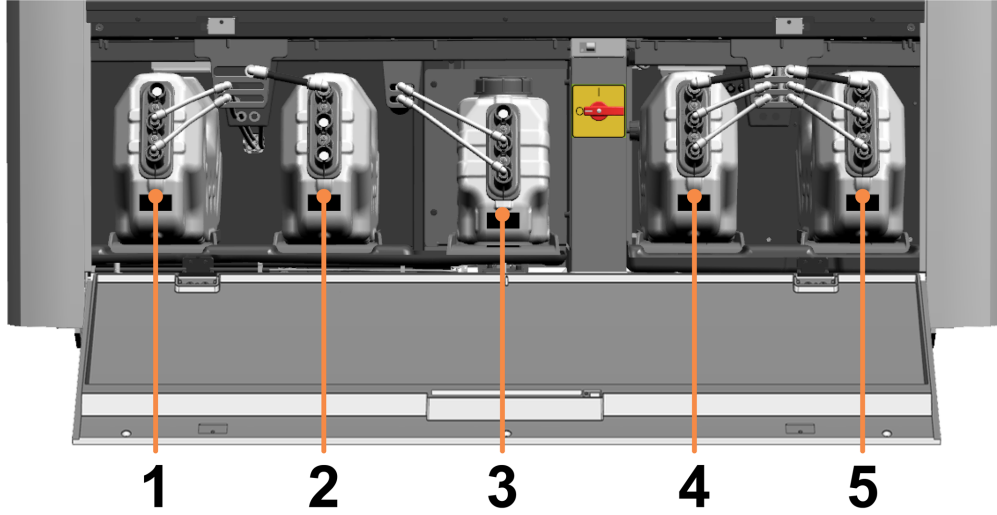


UYARI: Temizlik ve bakım görevleri için DI Water (DI Su) kaplarını ve Bulk/Hazardous Waste container'larını (Toplu/Tehlikeli Atık kabı) kaldırırken iki elinizi birden kullanın.

Ayrıca bkz:

- 4.2 DI Water (DI Su) Kabını yeniden doldurma
- 4.15 Bulk DI Water Container'ı (Toplu DI Su Kabı) temizleme
- 4.3 Alcohol (Alkol) Kabını yeniden doldurma
- 4.16 Kilitli Bulk Reagent Container'ları (Toplu Reaktif Kabı) Temizleme
- 4.4 Lotu Takip Edilen Toplu Kapları yeniden doldurma
- 4.17 Atık Kaplarını Temizleme
- 4.5 Atık Kaplarını boşaltma

1.8 Hazne Kabini



Açıklama

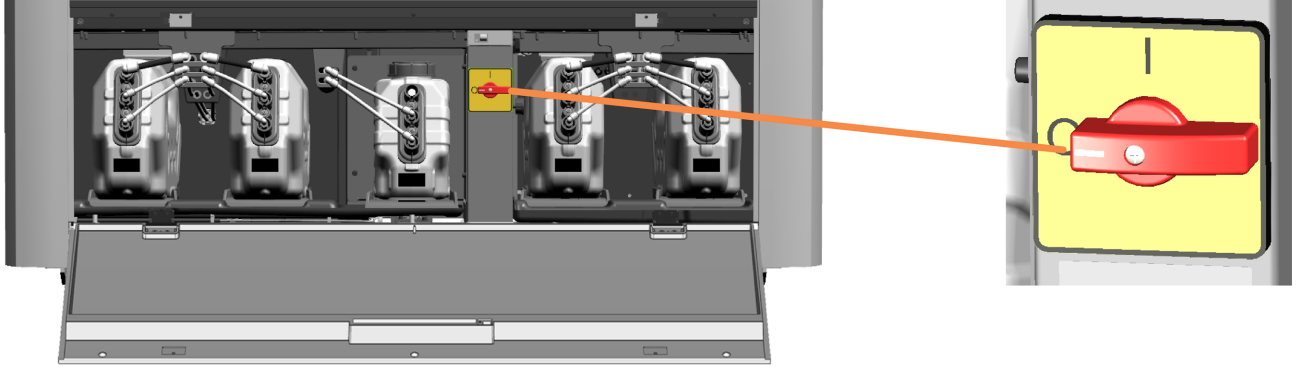
1	DI Water (DI Su) Haznesi	5L
2	Vakum Haznesi	
3	BOND-PRIME Wash Working Solution Haznesi	1L
4	Bulk Waste Reservoir (Toplu Atık Haznesi)	5L
5	Hazardous Waste Reservoir (Tehlikeli Atık Haznesi)	5L



UYARI: Açık konumda olduğunda Hazne Kabini kapısına takılmamaya dikkat edin.

1.9 AC güç anahtarı

AC güç anahtarı, Hazne Kabininin içinde yer alır.



Anahtar konumları

- I AÇIK
- O KAPALI

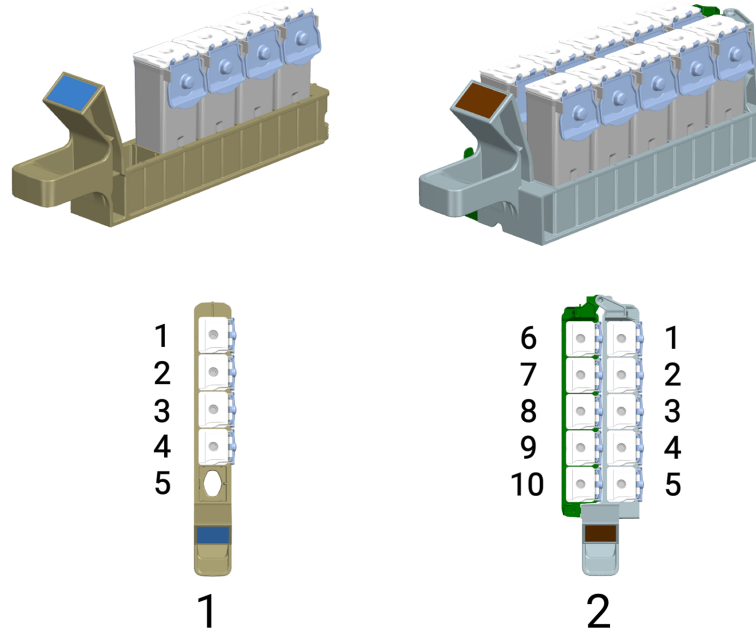


UYARI: Açık konumda olduğunda Hazne Kabini kapısına takılmamaya dikkat edin.

Ayrıca bkz:

- [1.12 İşleme modülünü bağlama ve açma](#)
- [1.13 İşleme modülünü ayırma](#)

1.10 Reagent Tray'ler (Reaktif Tepsisi)



Açıklama

- 1 **Tekli Reaktif Tepsisi**
5 adede kadar reagent container (reaktif kabı) tutabilir.
- 2 **Dual Reagent Tray (İkili Reaktif Tepsisi)**
10 adede kadar reagent container (reaktif kabı) tutabilir, ancak bazı reaktif sistemlerinde yalnızca 6 kap vardır. Boş konumlara ilave reagent container'lar (reaktif kabı) (örneğin yardımcı BOND-PRIME Hematoxylin (AR0096)) yerleştirebilirsiniz.

Tüm BOND reagent container'ları (reaktif kabı) ve BOND-PRIME reaktif sistemleri, kullanım öncesinde BOND Kontrolörüne kaydedilmelidir.

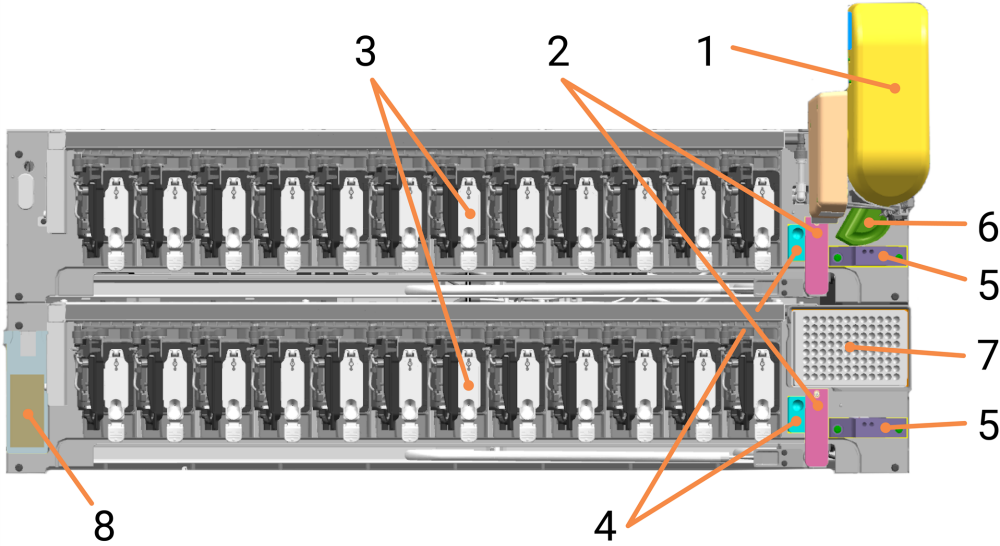
Ayrıca bkz:

- [1.6 Reagent Platform \(Reaktif Platformu\)](#)
- [2.10.1 Reagent Container'ı \(Reaktif Kabı\) ve Reagent Tray'leri \(Reaktif Tepsisi\) Hazırlama](#)
- [2.10.2 Reagent Tray'leri \(Reaktif Tepsisi\) yükleme](#)
- [2.10.6 Reagent Tray'leri \(Reaktif Tepsisi\) boşaltma](#)



BOND 7 Kullanım Kılavuzuna bakın.

1.11 Çalışma Yüzeyi (Kaputun altında)



Açıklama

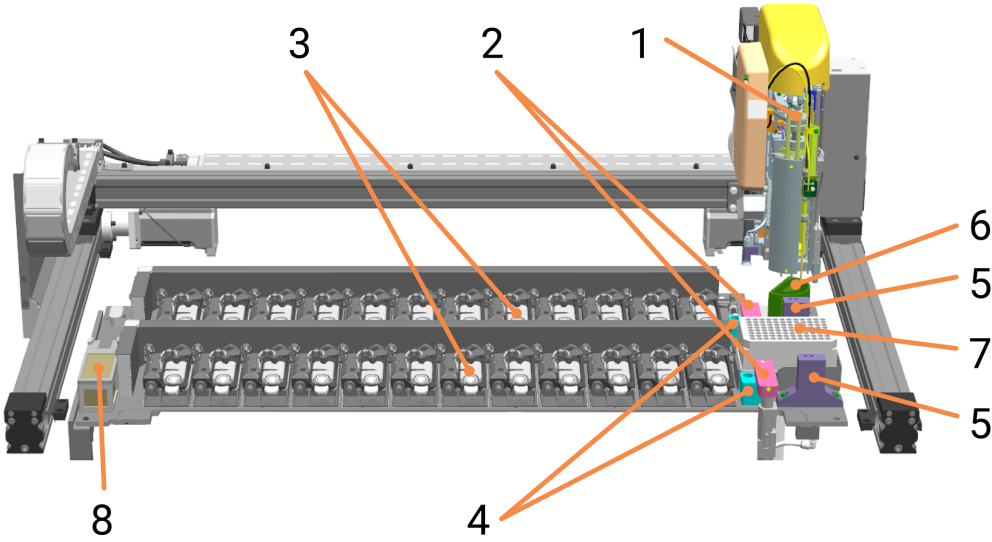
- 1 1.11.2 High-Speed Robot (Yüksek Hızlı Robot)
- 2 1.11.4 Yıkama Robotları (2)
- 3 1.11.5 ARC (Aktif Reaktif Kontrolü) Modülleri
 - Sıra A (arka), soldan sağa 1-12 olarak numaralandırılmıştır
 - Sıra B (ön), soldan sağa 1-12 olarak numaralandırılmıştır
- 4 1.11.6 Yıkama/Hazırlama İstasyonları
Yıkama İstasyonları (Yıkama Robotları için)

- 5 1.11.6 Yıkama/Hazırlama İstasyonları
High-Speed Robot (Yüksek Hızlı Robot) üzerindeki ARC Probe (ARC Probu) için:
 - Standard Wash Station (Standart Yıkama İstasyonu) (arka)
 - Hazardous Wash Station (Tehlikeli Yıkama İstasyonu) (ön)
- 6 1.11.6 Yıkama/Hazırlama İstasyonları
Hazırlama İstasyonu (Bulk Reagent Probe'lar (Toplu Reaktif Probu) için)
- 7 1.11.7 Mixing Well Plate (Karıştırma Kuyucuğu Plakası)
- 8 1.11.8 Lam Hazırlama İstasyonu

Ayrıca bkz:

- 4.14 BOND-PRIME ARC Refresh Kit (BOND-PRIME ARC Yenileme Kiti) kullanma
- 4.7 Bakımı Başlatma
- 5.3.3 Lamları manuel olarak ARC Module'lerden (ARC Modülü) geri alma
- 4.8 ARC Module'lerin (ARC Modülü) iç yüzeyini silme
- 4.9 Reagent Platform (Reaktif Platformu) ve ARC Bank (ARC Sırası) yüzeylerini silme
- 4.13 Yıkama/Hazırlama İstasyonlarını temizleme

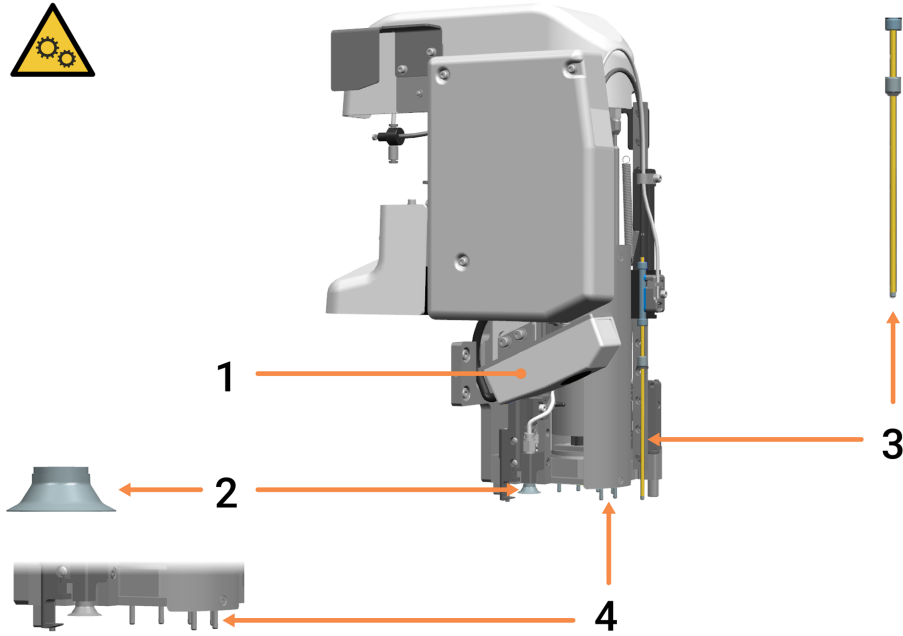
1.11.1 Çalışma Yüzeyi (önden görünüm)



Açıklama

- | | | | |
|---|--|---|--|
| 1 | 1.11.2 High-Speed Robot (Yüksek Hızlı Robot) | 5 | 1.11.6 Yıkama/Hazırlama İstasyonları |
| 2 | 1.11.4 Yıkama Robotları (2) | | High-Speed Robot (Yüksek Hızlı Robot) üzerindeki ARC Probe (ARC Probu) için: |
| 3 | 1.11.5 ARC (Aktif Reaktif Kontrolü) Modülleri | | Standard Wash Station (Standart Yıkama İstasyonu) (arka) ve |
| | Sıra A (arka), soldan sağa 1-12 olarak numaralandırılmıştır. | | Hazardous Wash Station (Tehlikeli Yıkama İstasyonu) (ön) |
| | Sıra B (ön), soldan sağa 13-24 olarak numaralandırılmıştır | 6 | 1.11.6 Yıkama/Hazırlama İstasyonları |
| 4 | 1.11.6 Yıkama/Hazırlama İstasyonları | | Hazırlama İstasyonu (Bulk Reagent Probe'lar (Toplu Reaktif Probu) için) |
| | Yıkama İstasyonları (Yıkama Robotları için) | 7 | 1.11.7 Mixing Well Plate (Karıştırma Kuyucuğu Plakası) |
| | | 8 | 1.11.8 Lam Hazırlama İstasyonu |

1.11.2 High-Speed Robot (Yüksek Hızlı Robot)



Açıklama

- | | |
|--|---|
| <p>1 ID Tarayıcı</p> <p>2 Emme Kabi
Lamları Preload Drawer'dan (Ön Yükleme Çekmecesi) ARC Module'lere (ARC Modülü) ve oradan Boşaltma Çekmecesine taşımak içindir.
Bkz. 1.4 Ön Yükleme ve Boşaltma Çekmeceleri ve 1.11.5 ARC (Aktif Reaktif Kontrolü) Modülleri.</p> | <p>3 ARC Probe (ARC Probu)
Aşağıdakilerden alınan reaktifleri ARC Module'lere (ARC Modülü) dağıtır:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reagent Platform'a (Reaktif Platformu) yüklenmiş kaplar Bkz. 1.6 Reagent Platform (Reaktif Platformu). • Mixing Well Plate'ten (Karıştırma Kuyucuğu Plakası) alınan karıştırılmış reaktifler. Bkz. 1.11.7 Mixing Well Plate (Karıştırma Kuyucuğu Plakası). <p>4 Bulk Reagent Probe'lar (Toplu Reaktif Probu) (ayrıca sonraki sayfaya bakın)
Bulk reagent container'lardaki (toplu reaktif kabı) toplu reaktifleri ARC Module'lere (ARC Modülü) dağıtır. Bkz. 1.7 Toplu Kaplar.</p> |
|--|---|

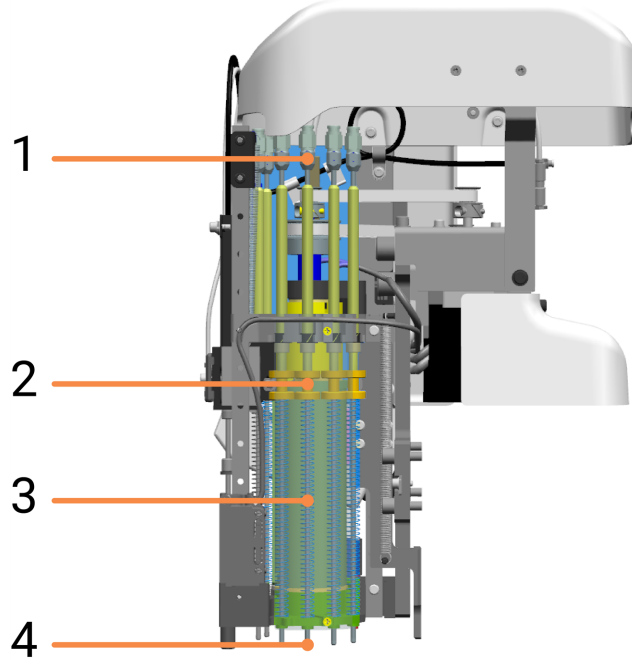


UYARI: High-Speed Robot (Yüksek Hızlı Robot) Çalışma Yüzeyinin üzerindeki bir konumda takılırsa, robotu manuel olarak hareket ettirmeye çalışmayın. Bu sorun için Müşteri Desteği ile iletişime geçin.

Ayrıca bkz:

- 4.10 Emme Kabını temizleme
- 4.11 Emme Kabını deęiřtirme

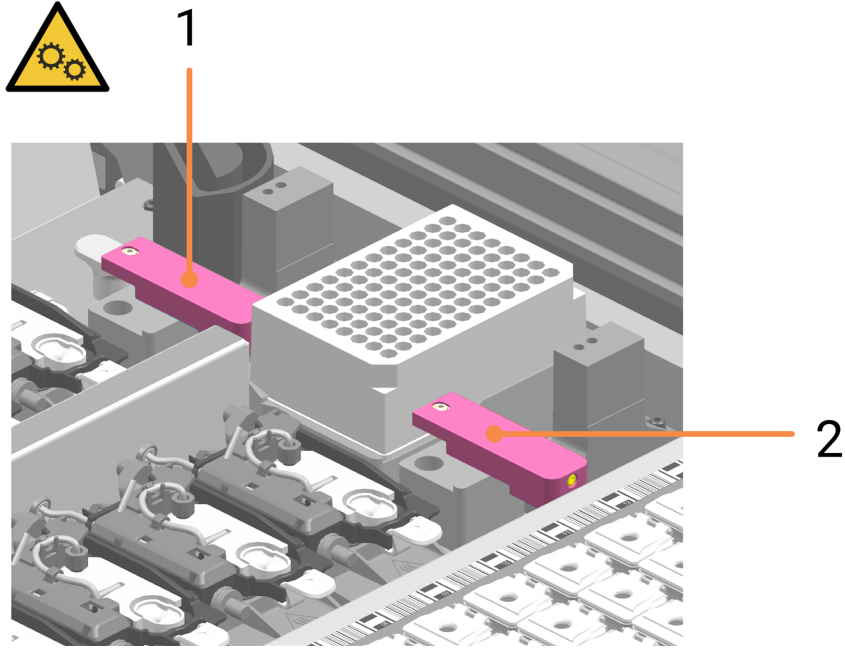
1.11.3 Probe Selector (Prob Seęici)



Açıklama

- | | | | |
|---|--|---|--|
| 1 | Tüp konektörleri | 3 | Sıkıştırma Yayıları |
| 2 | Bulk Reagent Probe (Toplu Reaktif Probu) Halkaları | 4 | Bulk Reagent Probe'lar (Toplu Reaktif Probu)
Bulk Reagent Probe'lar (Toplu Reaktif Probu), Robot Kafasındaki Probe Selector'a (Prob Seęici) takılıdır. Probe Selector (Prob Seęici) karuseli, gerekli probu ARC Module (ARC Modülü) üzerine konumlandırmak için döner. |

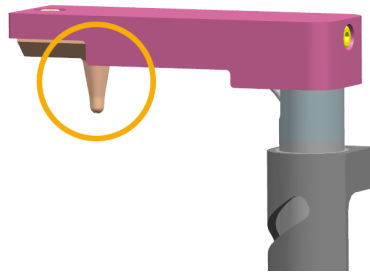
1.11.4 Yıkama Robotları



Açıklama

- 1 Yıkama Robotu (ARC Module'ler (ARC Modülü) - Sıra A için)
- 2 Yıkama Robotu (ARC Module'ler (ARC Modülü) - Sıra B için)

Yıkama Robotu Probu



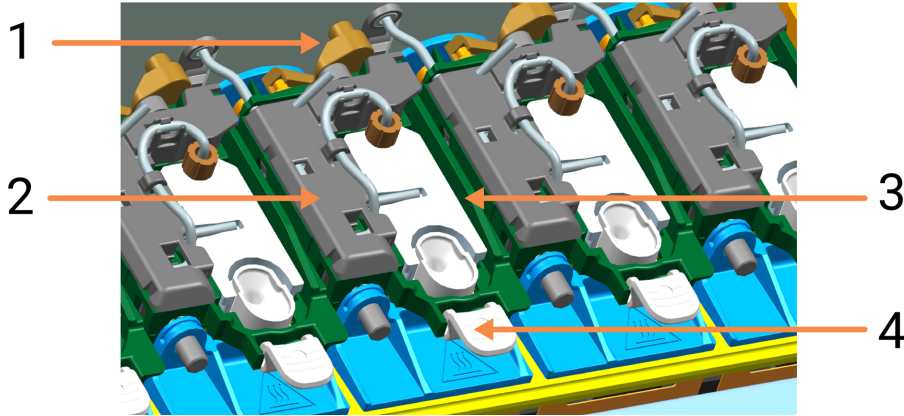
Bakım sırasında ARC Module'lere (ARC Modülü) daha kolay erişmek için Yıkama Robotlarını manuel olarak hareket ettirebilirsiniz.

Yıkama Robotu, Çalışma Yüzeyinin üzerindeki bir konumda takılırsa, artık robotu manuel olarak hareket ettirmeye çalışmayın. Bu sorun için Müşteri Desteği ile iletişime geçin

1.11.5 ARC (Aktif Reaktif Kontrolü) Modülleri

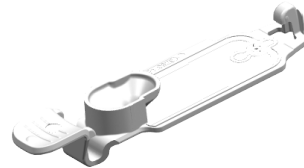
İki ARC Bank'e (ARC Sırası) monte edilmiş yirmi dört ARC Module (ARC Modülü), boyama sırasında lamları tutar. Bunlara bir bütün olarak ARC Array (ARC Dizisi) adı verilir. Reaktifler, Bulk Reagent Probe'lar (Toplu Reaktif Probu) ve Robot Kafasındaki ARC Probe (ARC Probu) tarafından dağıtılır. ARC Module'ler (ARC Modülü), Yıkama Robotları tarafından dağıtılan DI Water (DI Su) ve BOND-PRIME Wash Working Solution ile temizlenir.

ARC Module'lerin (ARC Modülü) atığı, Hazardous Waste Reservoir'a (Tehlikeli Atık Haznesi) yönlendirilir.



Açıklama

- | | | | |
|---|---------------------------------------|---|---|
| 1 | ARC Module Latch (ARC Modülü Mandalı) | 3 | ARC Module Lid (ARC Modülü Başlığı) Tertibatı |
| 2 | ARC Module Cover (ARC Modülü Kapağı) | 4 | ARC Covertile: |



İşlem Sırasında (bkz. [70, sayfa İşlem Sırası ve Uyarı Başlığı](#)) ARC Module'ün (ARC Modülü) arızalı olduğu belirtiliyorsa, modülde Covertile bulunduğunu kontrol edin.

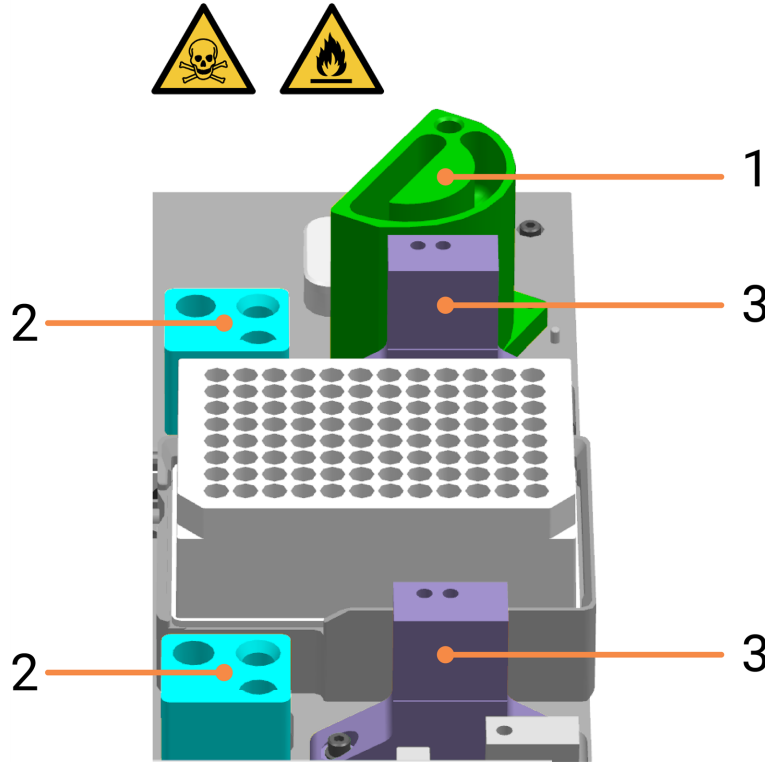
ARC Module (ARC Modülü) sızıntı yapıyorsa:

- Covertile'in ve Covertile contasının durumunu kontrol edin ve gerekirse Covertile'ı değiştirin.
- ARC Module'ü (ARC Modülü) birikinti bakımından kontrol edin ve gerekirse temizleyin ([129, sayfa ARC Module'lerin \(ARC Modülü\) iç yüzeyini silme](#)).

Ayrıca bkz:

- 4.8 ARC Module'lerin (ARC Modülü) iç yüzeyini silme
- 4.14 BOND-PRIME ARC Refresh Kit (BOND-PRIME ARC Yenileme Kiti) kullanma
- 5.3.3 Lamları manuel olarak ARC Module'lerden (ARC Modülü) geri alma

1.11.6 Yıkama/Hazırlama İstasyonları



Açıklama

- | | |
|---|---|
| <p>1 Bulk Probe Prime Station (Toplu Prob Hazırlama İstasyonu)</p> <p>2 Yıkama Robotu Yıkama İstasyonları
Sağdaki port, yıkama için kullanılır.</p> | <p>3 ARC Probe Wash Station'ları (ARC Probu Yıkama İstasyonu)
Sağdaki port, yıkama için kullanılır.</p> |
|---|---|

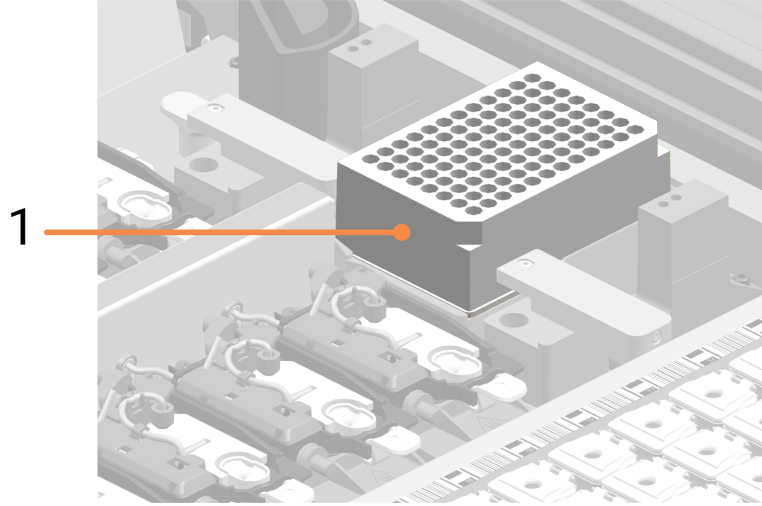
Atık sıvıların yönlendirilmesi:

- Sıra A'daki (arka) ARC Probe Wash Station'ların (ARC Probu Yıkama İstasyonu) atık sıvısı Bulk Waste Reservoir'a (Toplu Atık Haznesi) yönlendirilir
- Sıra B'deki (ön) ARC Probe Wash Station'ların (ARC Probu Yıkama İstasyonu) atık sıvısı Hazardous Waste Reservoir'a (Tehlikeli Atık Haznesi) yönlendirilir
- Her iki Yıkama Robotu İstasyonunun atık sıvısı Hazardous Waste Reservoir'a (Tehlikeli Atık Haznesine) yönlendirilir.

Ayrıca bkz:

- [4.13 Yıkama/Hazırlama İstasyonlarını temizleme](#)

1.11.7 Mixing Well Plate (Karıřtırma Kuyucuęu Plakası)



Açıklama

- Mixing Well Plate (Karıřtırma Kuyucuęu Plakası)**
ARC Probe (ARC Probu) tarafından ARC Module'ler (ARC Modülü) içerisindeki lamlara dağıtılmadan önce, kromojen reaktiflerinin karıřtırıldıęı yerdir.
Bkz. [1.11.5 ARC \(Aktif Reaktif Kontrolü\) Modülleri](#) ve [1.11.2 High-Speed Robot \(Yüksek Hızlı Robot\)](#).

Mixing Well Plate'in (Karıřtırma Kuyucuęu Plakası) Mixing Block'a (Karıřtırma Bloęu) yerleřtirilme yönü önemli deęildir, ancak tutucunun iine doęru řekilde oturtulması gerekir.

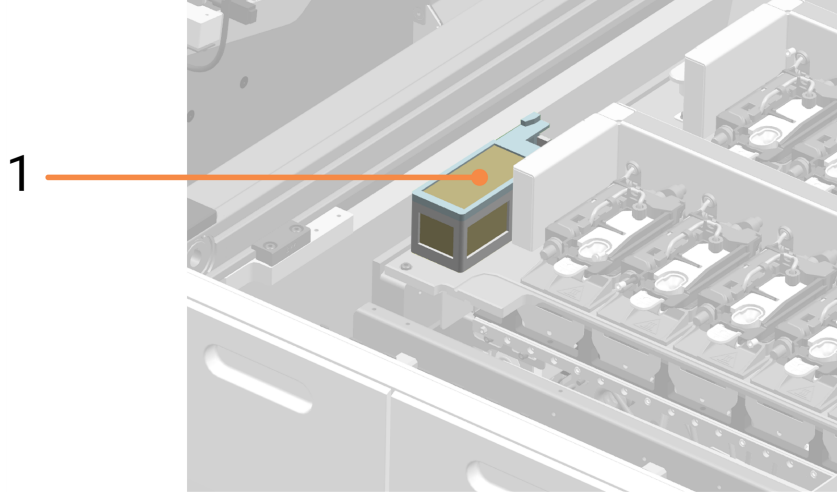


Takılı Mixing Well Plate (Karıřtırma Kuyucuęu Plakası) yoksa iřleme modülü bařlatma iřlemini tamamlamayacaktır.

Ayrıca bkz:

- [4.14 BOND-PRIME ARC Refresh Kit \(BOND-PRIME ARC Yenileme Kiti\) kullanma](#)

1.11.8 Lam Hazırlama İstasyonu



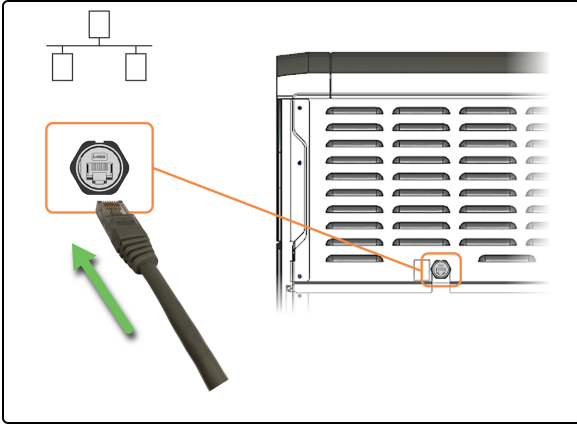
Açıklama

1 Lam Hazırlama İstasyonu



İşlenmek için ARC Module'e (ARC Modülü) aktarılacak her bir lam, Lam Hazırlama İstasyonunda sıkıştırılmış hava jetleriyle temizlenir. Bu tasarımın amacı istenmeyen partikülleri, özellikle de cam partiküllerini lam yüzeyinden gidermek ve böylece boyama işlemindeki riski azaltmaktır.

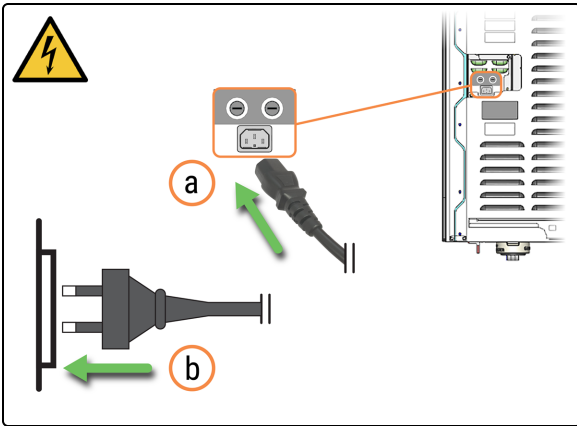
1.12 İşleme modülünü bağlama ve açma



1. Ethernet kablosunu laboratuvar ağı portuna bağlayın.



Arka panel konektörlerine daha kolay erişmek için işleme modülünü hareket ettirmeniz gerekebilir.

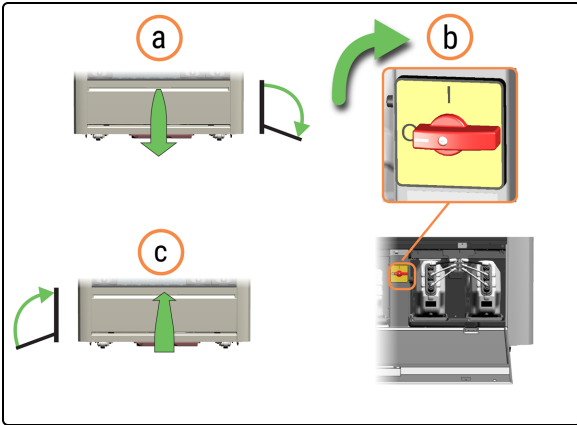


2. Şebeke güç kablosunu takın.

- a. Şebeke güç kablosunu işleme modülünün arkasına takın.
- b. Şebeke güç kablosunu duvar soketine takın.



Arka panel konektörlerine daha kolay erişmek için işleme modülünü hareket ettirmeniz gerekebilir.

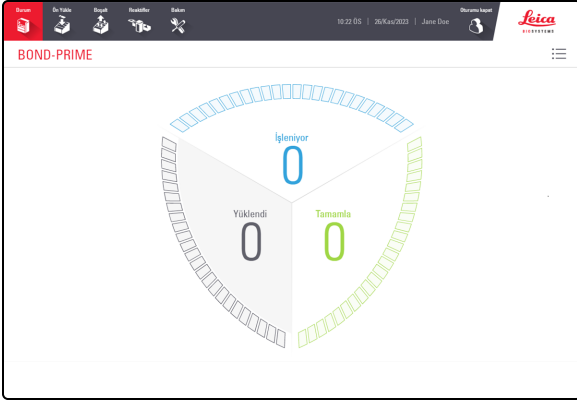


3. İşleme modülünün gücünü açın.

- a. Hazne Kabini kapısını açın.
- b. AC güç anahtarını saat yönüne doğru çevirin.
- c. Hazne Kabini kapısını kapatın.



4. İşleme modülü etkinleştirildiğinde, Oturum Açma Ekranı görüntülenmeden önce bir başlatma işlemi gerçekleşir. Bu işlem 8 ila 15 dakika sürer. İşleme modülü başlatılamazsa bkz. **5.1 Başlatılamadı**.



Durum ekranı görüntülenir.

1.13 İşleme modülünü ayırma

Aşağıdakilerden önce işleme modülünü kapatmanız ve ayırmanız gerekir:

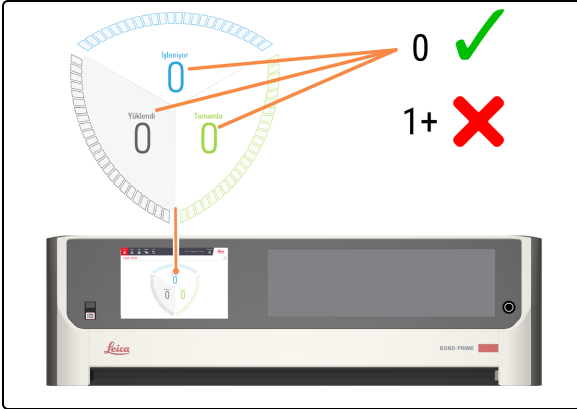
- İşleme modülünü yeni bir konuma taşımadan önce
- İşleme modülünü hizmetten çıkarmadan önce



Bu prosedüre başlamadan önce işleme modülünde oturum açtığınızdan emin olun. Bkz. [2.1 Oturum açma ve kapatma](#).



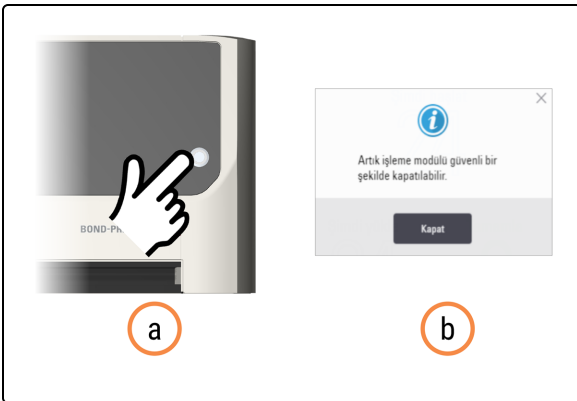
1. Durum öğesine dokunun.



2. Aşağıdaki durumları doğrulamak için Durum ekranına bakın:

- İşlenmekte olan (İşleniyor) lam yok
- Preload Drawer'da (Ön Yükleme) (Yüklendi) ve Boşaltma Çekmecesinde (Tamamlandı) lam yok.

Bkz. [2.3 Durum Ekranı](#).

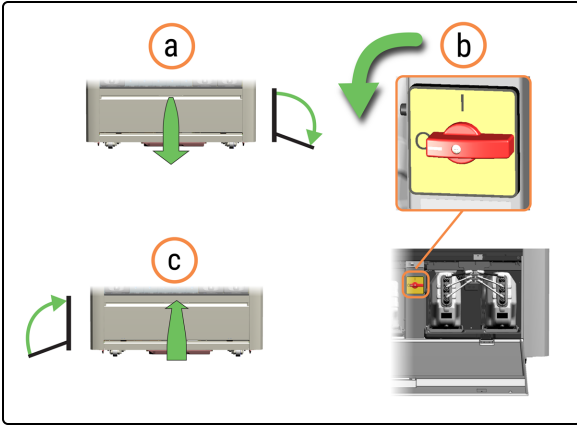


3. İşleme modülünün gücünü kapatın.

a. Bekleme güç düğmesine basın.

Açılır pencereyle işleme modülünü kapatmanın güvenli olduğu belirtilir.

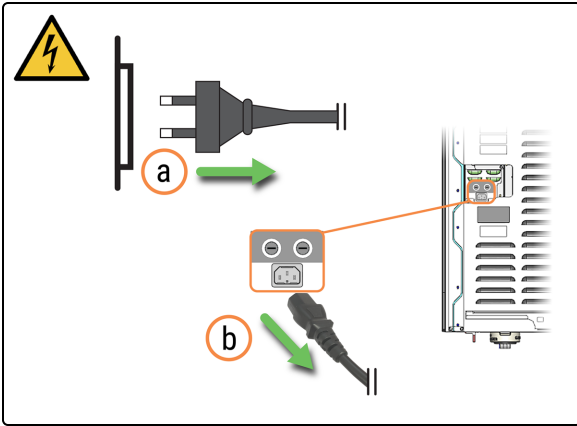
b. **Kapat** öğesine dokunun.



4. İşleme modülünün gücünü kapatın.
- Hazne Kabini kapısını açın.
 - AC güç anahtarını saat yönünün tersine doğru çevirin.
 - Hazne Kabini kapısını kapatın.



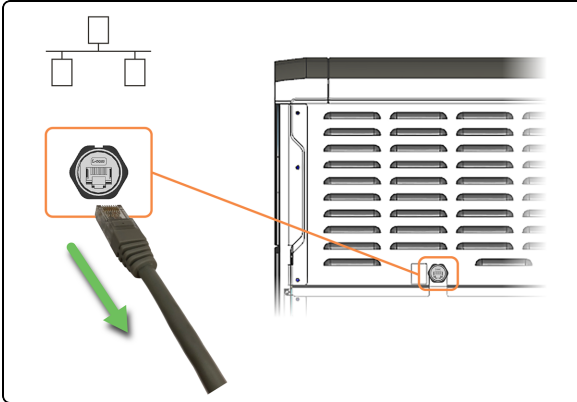
UYARI: Açık konumda olduğunda Hazne Kabini kapısına takılmamaya dikkat edin.



5. Şebeke güç kablosunu çıkarın.
- Şebeke güç kablosunu duvar soketinden çıkarın.
 - Şebeke güç kablosunu işleme modülünün arkasından çıkarın.



Arka panel konektörlerine daha kolay erişmek için işleme modülünü hareket ettirmeniz gerekebilir.



6. Ethernet kablosunu işleme modülünün arkasından ayırın.

1.14 İşleme modülünü yeni bir konuma taşıma



UYARI: İşleme modülünü uzak mesafedeki yeni bir konuma taşımanız gerekiyorsa müşteri desteğine bildirimde bulunun. İşleme modülü oldukça ağırdır. İşleme modülü yalnızca onaylı personel tarafından taşınmalıdır.



DİKKAT: İşleme modülünün arka kapağındaki havalandırma deliklerini tıkamayın. Yeni konumda yeterli hava akışı olduğundan emin olun.



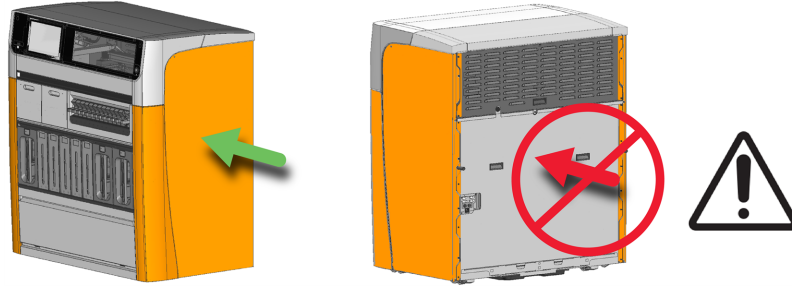
DİKKAT: BOND-PRIME İşleme Modülünü kaldırmak için forklift kullanmayın.

İşleme modülünü kısa mesafedeki yeni bir konuma taşımak gerekiyorsa:

- İşleme modülünü ayırın. Bkz. [1.13 İşleme modülünü ayırma](#).
- Atık kaplarını boşaltın. Bkz. [4.5 Atık Kaplarını boşaltma](#).
- Karter Tepsisini çıkarın ve temizleyin. Bkz. [4.18 Karter Tepsisini temizleme](#).
- BOND-PRIME İşleme Modülünü taşımayı denemeden önce, İngiliz anahtarı kullanarak dört tekerlek tertibatındaki turuncu dişlileri döndürün. İşleme modülünün tekerlekleri üzerinde serbestçe hareket edebilmesi için ortadaki ayağı yükseltin.



- **Yalnızca** turuncu renkle vurgulanmış izin verilen itme alanlarından itin.



- Düz yüzeye sahip olması gereken yeni konumda, işleme modülü tekerlekleri üzerinde serbestçe hareket edemeyene kadar turuncu dışlıleri döndürerek ortadaki ayağı alçaltın.
- İşleme modülünün tüm yönlerde düz olmasını sağlamak için tekerlek tertibatlarındaki ayağın yüksekliğini ayarlayın. Kılavuz olarak kaputun üzerine yerleştirilmiş bir düzeç kullanın.
- Zeminin yeterince kuvvetli olduğundan emin olun. Tüm yerel ve geçerli prosedürlere uyun. İşleme modülünün boyutlarını ve ağırlığını öğrenmek için bkz. **6 Teknik Özellikler**.
- Yalnızca onaylanmış güç kaynağı kablosunu kullanın. Duvar soketine erişiminiz olduğundan emin olun.
- İşleme modülünü çalıştırmadan önce elektromanyetik ortamı parazit bakımından değerlendirin.



DİKKAT: BOND-PRIME İşleme Modülünü güçlü elektromanyetik radyasyon kaynaklarının yakınında çalıştırmayın. Korumasız kasıtlı RF kaynakları gibi elektromanyetik kaynaklar düzgün çalışmayı engelleyebilir.

1.15 İşleme modülünü hizmetten çıkarma ve atma

İşleme modülü ve kullanılan parçaları ile ilgili aksesuarları, geçerli yerel prosedürlere ve düzenlemelere uygun şekilde atılmalıdır. İşleme modülüyle kullanılan tüm reaktifleri, reaktif üreticisinin önerilerine uygun şekilde atın.

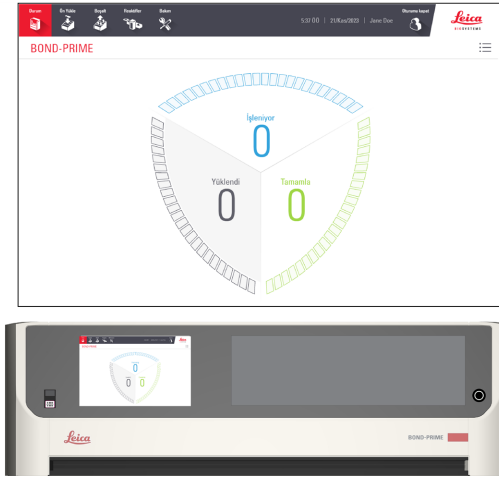
İşleme modülü veya parçaları ve aksesuarları, geri göndermeden ya da atmadan önce yerel prosedürlere ve düzenlemelere uygun şekilde temizleyin ve dekontamine edin.

AB'de tüm elektronik atıklar Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar (2012/19/EU) uyarınca atılmalıdır. AB dışındaki bölgelerde elektronik atıkları atmak için yerel prosedürlere ve düzenlemelere uyun.

Yardım gerekiyorsa yerel Leica Biosystems temsilcinizle iletişime geçin.

2

Dokunmatik Ekran



Bu kısımda:

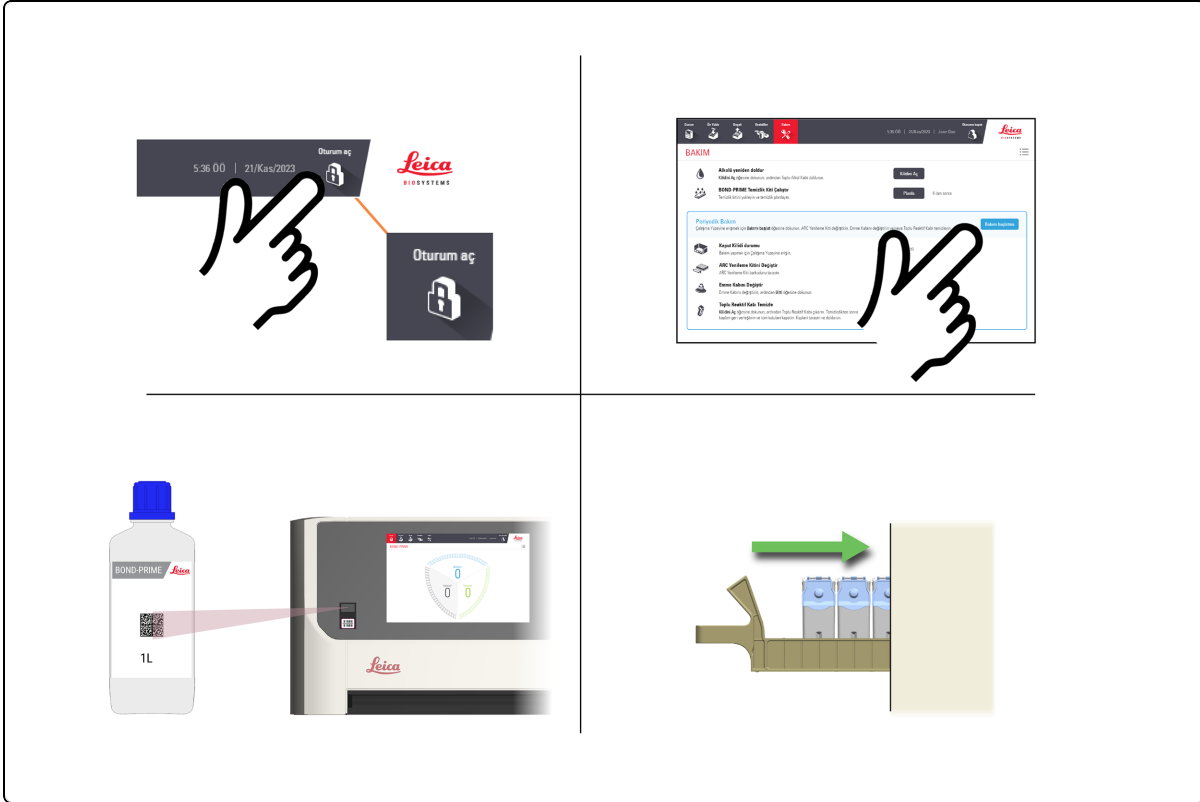
2.1 Oturum açma ve kapatma	59
2.2 Gezinme Çubuğu	61
2.3 Durum Ekranı	62
2.4 İşlem Sırası ve Uyarı Başlığı	70
2.5 Lamları ön yükleme	73
2.6 Ön Yükleme Ekranı	75
2.7 Lamları boşaltma	80
2.8 Boşaltma Ekranı	82
2.9 Ayrıntılı vaka ve lam bilgileri	86
2.10 Reaktifler Ekranı	90
2.11 Bakım Ekranı	98

2.1 Oturum açma ve kapatma

2.1.1 Oturum açma

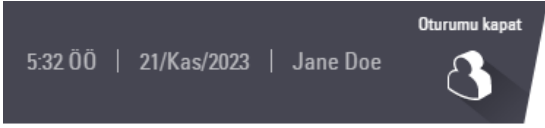
Kimse oturum açmadıysa, çeşitli işlemler **Oturum aç** iletişiminin görünmesine neden olacaktır, örneğin:

- **Oturum aç** düğmesine dokunmak
- **Bakım** ekranında **Bakımı başlat** düğmesine dokunmak
- toplu reaktif besleme şişesindeki barkodu taramak
- Reagent Platform'a (Reaktif Platformu) Reagent Tray (Reaktif Tepsisi) yüklemek



1. Dokunmatik ekranda oturum açın.
 - a. **Oturum Aç** Ekranında kullanıcı adınıza dokununuz.
 - b. PIN'inizi girin.

Başarıyla oturum açtığınızda, adınız tarihin yanında görüntülenecektir.

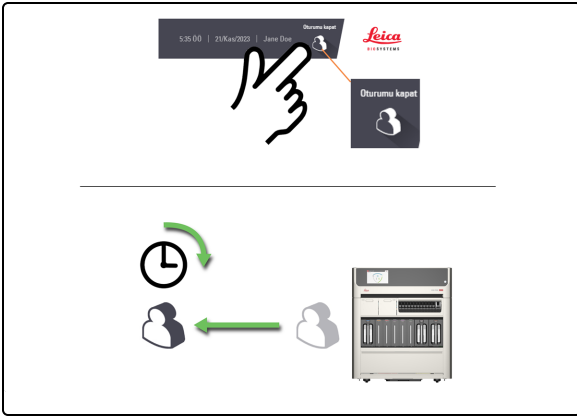


PIN belirlemek veya değiştirmek hakkında daha fazla bilgi için *BOND Kullanım Kılavuzuna* bakın.



Hasta Sağlığı Bilgileri GUI'da oturum açıkken görünür, oturum açık değilken gizlenir.

2.1.2 Oturumu kapatma



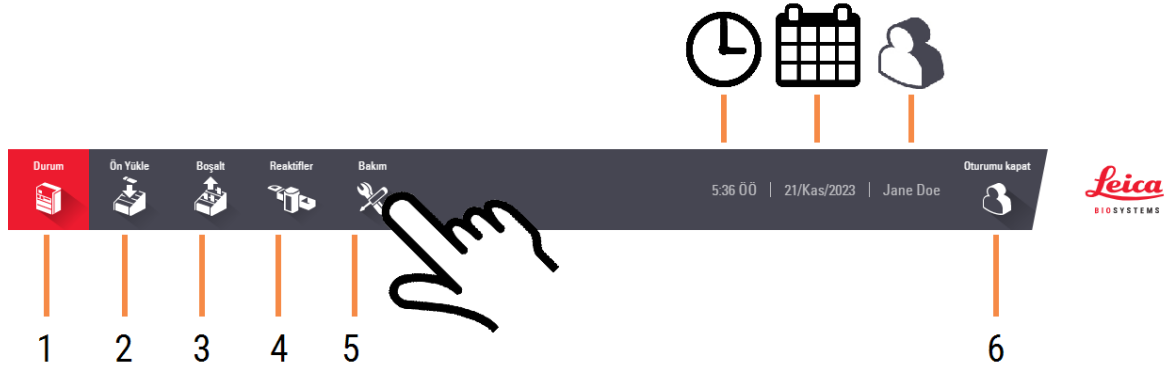
1. Oturumu Kapat düğmesine dokununuz.

Alternatif olarak, önceden belirlenmiş bir süre boyunca işleme modülüyle etkileşimde bulunmadığınızda oturumunuz otomatik olarak kapatılır.



Bu süreyi BOND Kontrolörünün Yönetim İstemcisinde değiştirebilirsiniz. *BOND 7 Kullanım Kılavuzuna* bakın.

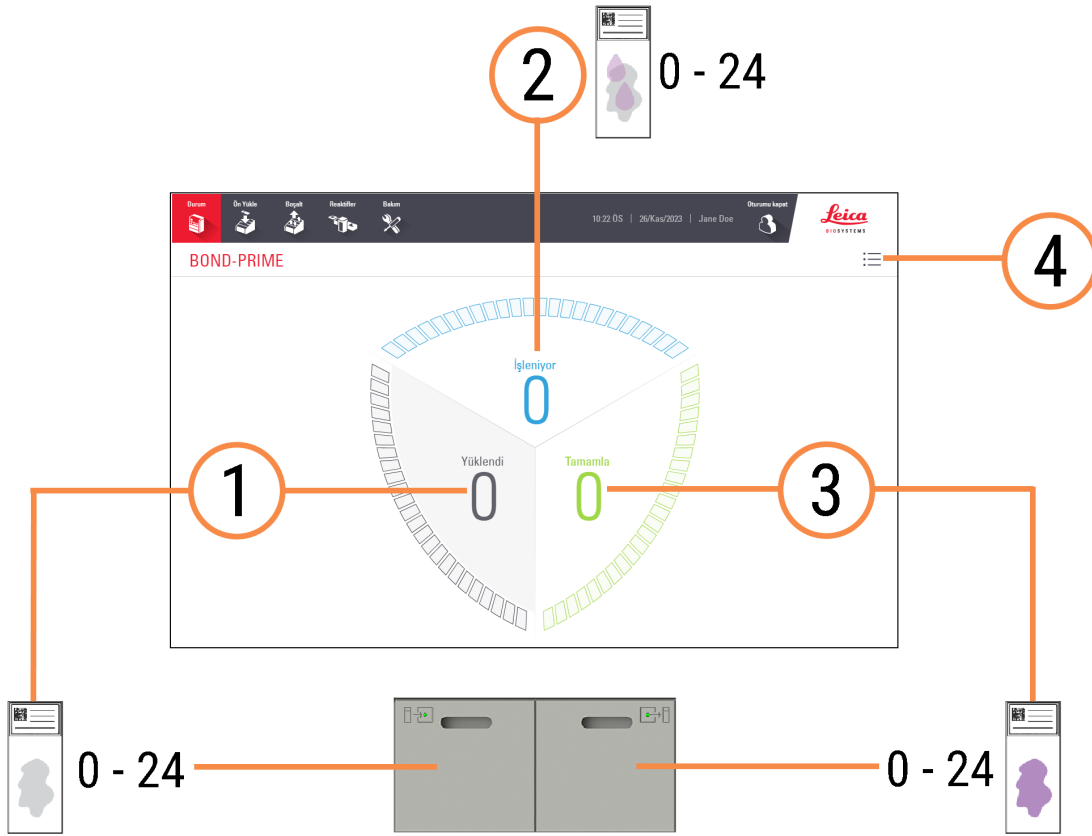
2.2 Gezinme Çubuğu



Açıklama

- | | | | |
|---|-----------------------|---|--|
| 1 | 2.3 Durum Ekranı | 4 | 2.10 Reaktifler Ekranı |
| 2 | 2.6 Ön Yükleme Ekranı | 5 | 2.11 Bakım Ekranı |
| 3 | 2.8 Boşaltma Ekranı | 6 | Oturum Aç/Oturumu Kapat - bkz.
2.1 Oturum açma ve kapatma |

2.3 Durum Ekranı



Açıklama

- 1 2.3.1 Yüklene Lam Bölümü
- 2 2.3.2 Lamlar İşleniyor Bölümü
- 3 2.3.3 Lamların İşlenmesi Tamamlandı Bölümü
- 4 İşlem Sırası düğmesi.
Bkz. 2.4 İşlem Sırası ve Uyarı Başlığı

2.3.1 Yüklene Lam Bölümü

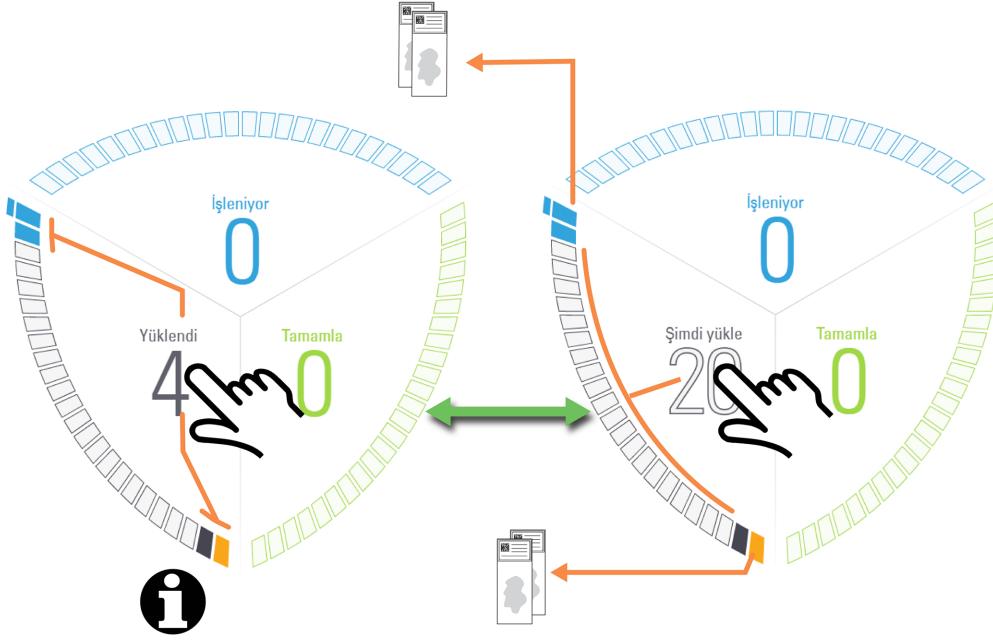
Değişimli olarak **Yüklü** ve **Şimdi yükle** lam sayısını göstermek için görüntülenen değere dokununuz.

Yeni lamlar Preload Drawer'dan (Ön Yükleme Çekmecesi) yüklendikten sonra, ilk başta bölümün altında gözükürler ve gri renkli olurlar. Lamlar kabul edildiğinde bölümün üstüne taşınır ve en erken olanı ilk olmak üzere maviye döner. Kabul edilmeyen lamlar bölümün altında kalır.



Yüklenen Lam Bölümü ile Preload Drawer'daki (Ön Yükleme Çekmecesi) lam konumları arasında bir ilişki yoktur.

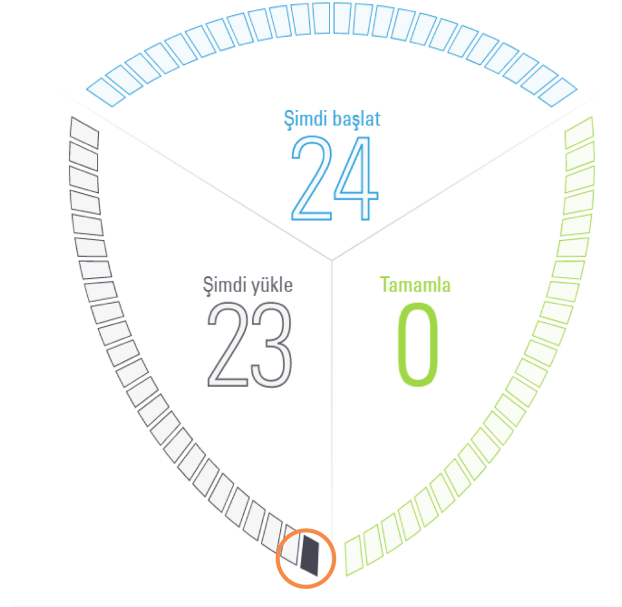
Ayrıca bkz. [2.3.4 Daha fazla lam bilgisi görüntüleme](#)



Simge	Açıklama
	Lam konumu kullanılabilir.
	Lam tanımlandı.
	Bir vakadaki son lam (yüklenen lamlar için). Son lam kabul edildikten sonra bu simge maviye döner.
	Lam kabul edildi. Kabul edilmeyen lamlar bölümün altında kalır. Ayrıca bkz. 2.3.1.1 Kabul edilmeyen lamlar .
	Reddedilen, süresi kritik lam veya "Uyarı" durumlu lam.
	Reddedilen lam veya "Dikkat" durumlu lam.

2.3.1.1 Kabul edilmeyen lamlar

Nadir görülen durumlarda işleme modülü yüklenen lamı değerlendirmede ve kabul etmede başarısız olabilir.



Böyle olduğunda lam uzun bir süre boyunca bölümün altında kalır.

Bu durumu düzeltmek için şunları yapmalısınız:

- 1 Lamı Preload Drawer'dan (Ön Yükleme Çekmecesi) çıkarın, ardından çekmeceyi kapatın.
- 2 İşleme modülünün çekmeceyi taramasını ve Durum ekranını güncellemesini bekleyin.
- 3 Lamı Preload Drawer'a (Ön Yükleme Çekmecesi) geri yükleyin. İşleme modülü artık lamı tanımlayabilmeli ve işleme için kabul edebilmelidir.

2.3.2 Lamlar İşleniyor Bölümü

Değişimli olarak **İşleniyor** ve **Şimdi başlat** lam sayısını göstermek için görüntülenen değere dokunun.

Lamlar işleme için ARC Module'lere (ARC Modülü) aktarıldığında, en erken olanı ilk olacak şekilde bölümün sağında gözükür.

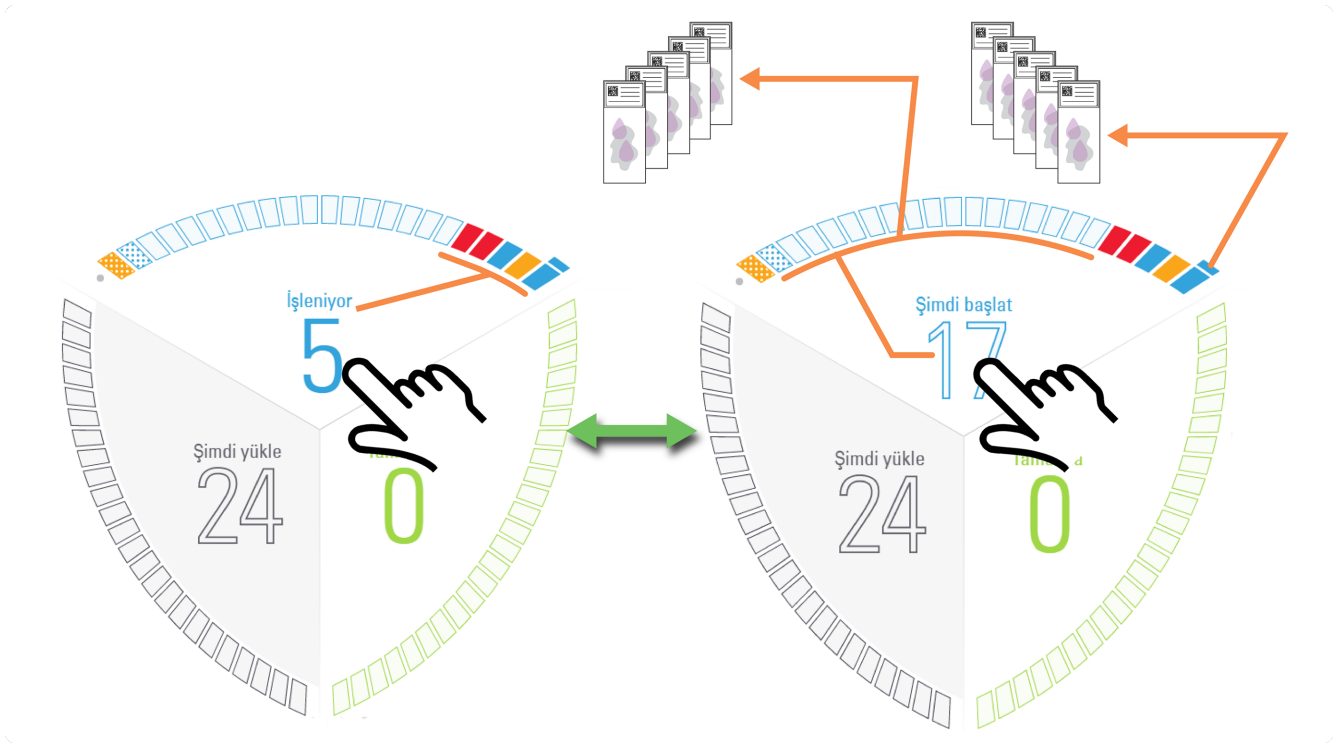
Lamlar İşleniyor Bölümündeki ile ARC Module'lerdeki (ARC Modülü) lam konumları arasında bir ilişki yoktur.

Ayrıca bkz. [2.3.4 Daha fazla lam bilgisi görüntüleme](#).

Durum Ekranı güncellemeleri

İşleme modülü her zaman lamları yüklemeye öncelik vermeyebilir. Bunun nedeni, işleme modülünün lam işlemleri arasında her bir ARC Module'de (ARC Modülü) otomatik olarak temel temizlik yapmasıdır.

Temel temizlik işlemi, işlenen her lam için yüksek seviyede boyama kalitesinin korunmasına yardımcı olur.



Simge	Açıklama
	Lam konumu kullanılabilir
	"Dikkat" durumu olan lam. Bkz. 2.3.5 İşleme sırasında beklenmeyen olaylar .
	Bir vakadaki son lam
	Lam işleme devam ediyor
	Lam tamamlandı
	Arızalı veya devre dışı ARC Module (ARC Modülü). Bkz. 1.11.5 ARC (Aktif Reaktif Kontrolü) Modülleri
	BOND-PRIME Cleaning Kit (BOND-PRIME Temizlik Kiti) şu anda uygulanıyor veya lamlar arasında temel temizlik yapılıyor.
	ARC Module (ARC Modülü) kullanım sayısına ulaşıldı. BOND-PRIME Cleaning Kit (BOND-PRIME Temizlik Kiti) uygulanana kadar ARC Module (ARC Modülü) devre dışı kalacak.
	Terk edilmiş veya iptal edilmiş lam veya "Uyarı" durumlu lam. Terk edilmiş lamlar ARC Module'de (ARC Modülü) kalır ve bunların manuel olarak geri alınması gerekir. Bkz. 5.3.3 Lamları manuel olarak ARC Module'lerden (ARC Modülü) geri alma . İptal edilmiş lamlar Boşaltma Çekmecesine aktarılır.

2.3.3 Lamların İşlenmesi Tamamlandı Bölümü

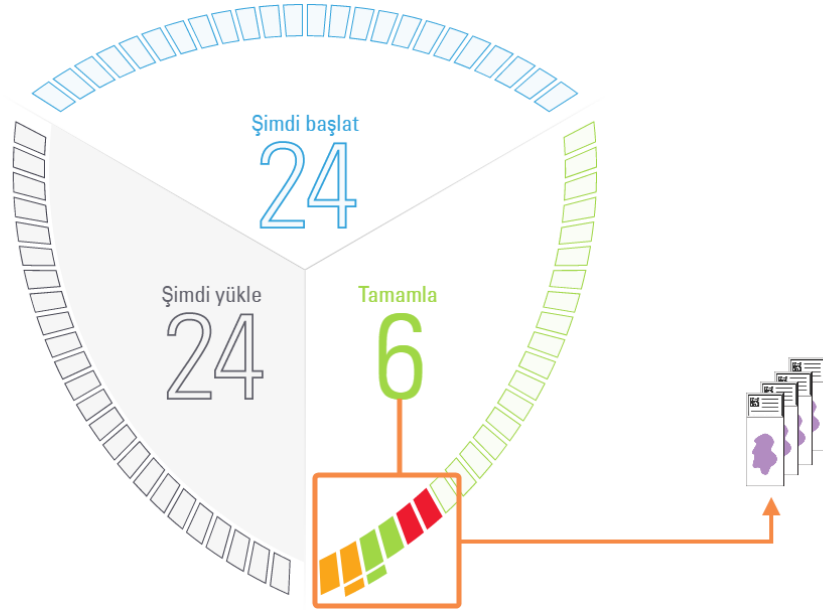
Tamamlanmış lamlar ARC Module'lerden (ARC Modülü) Boşaltma Çekmecesine aktarıldığında, en erken olanı ilk olacak şekilde bölümün altında gözükür.

Boşaltma Çekmecesine doluyorsa, Lamların İşlenmesi Tamamlandı Bölümüne aktarılanlara kadar, Lamlar İşleniyor Bölümünde "lam tamamlandı" simgeleri görünür.



Lamların İşlenmesi Tamamlandı Bölümündeki ile Boşaltma Çekmecesindeki lam konumları arasında bir ilişki yoktur.

Ayrıca bkz. [2.3.4 Daha fazla lam bilgisi görüntüleme](#).



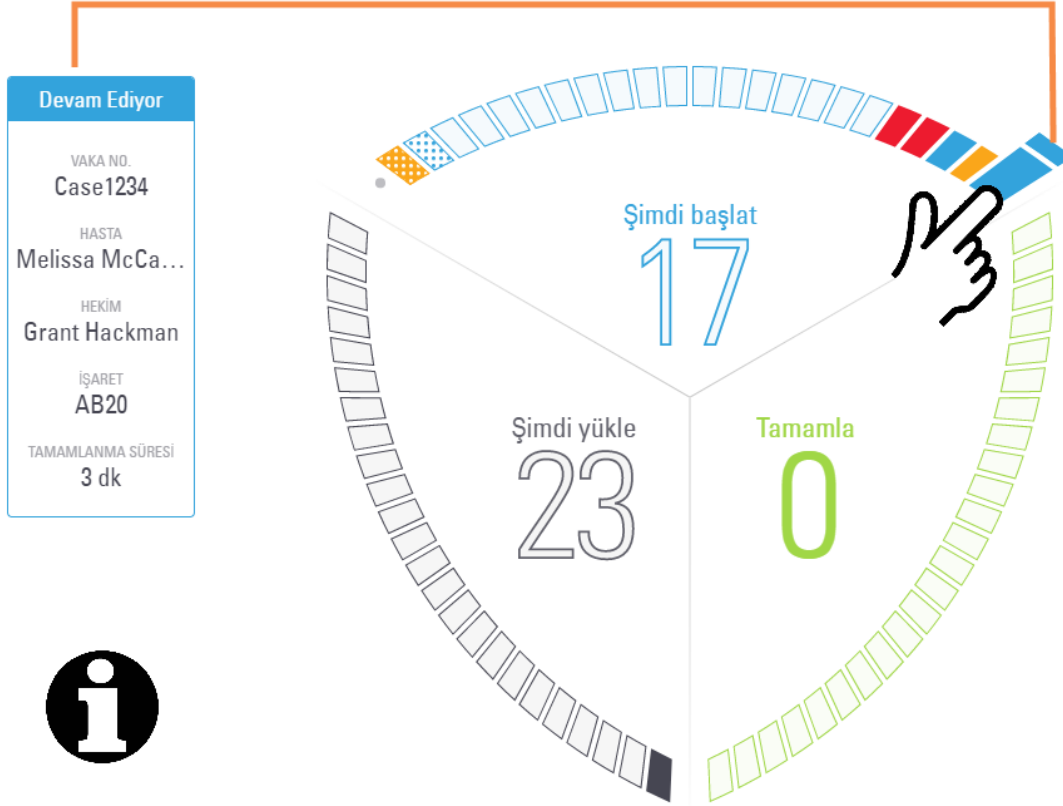
Simge	Açıklama
	Lam konumu kullanılabilir
	Lam tamamlandı
	Bir vakadaki tamamlanmış son lam
	İptal edilmiş lam veya "Uyarı" durumlu lam
	"Dikkat" durumu olan lam Ayrıca bkz. 2.3.5 İşleme sırasında beklenmeyen olaylar

2.3.4 Daha fazla lam bilgisi görüntüleme

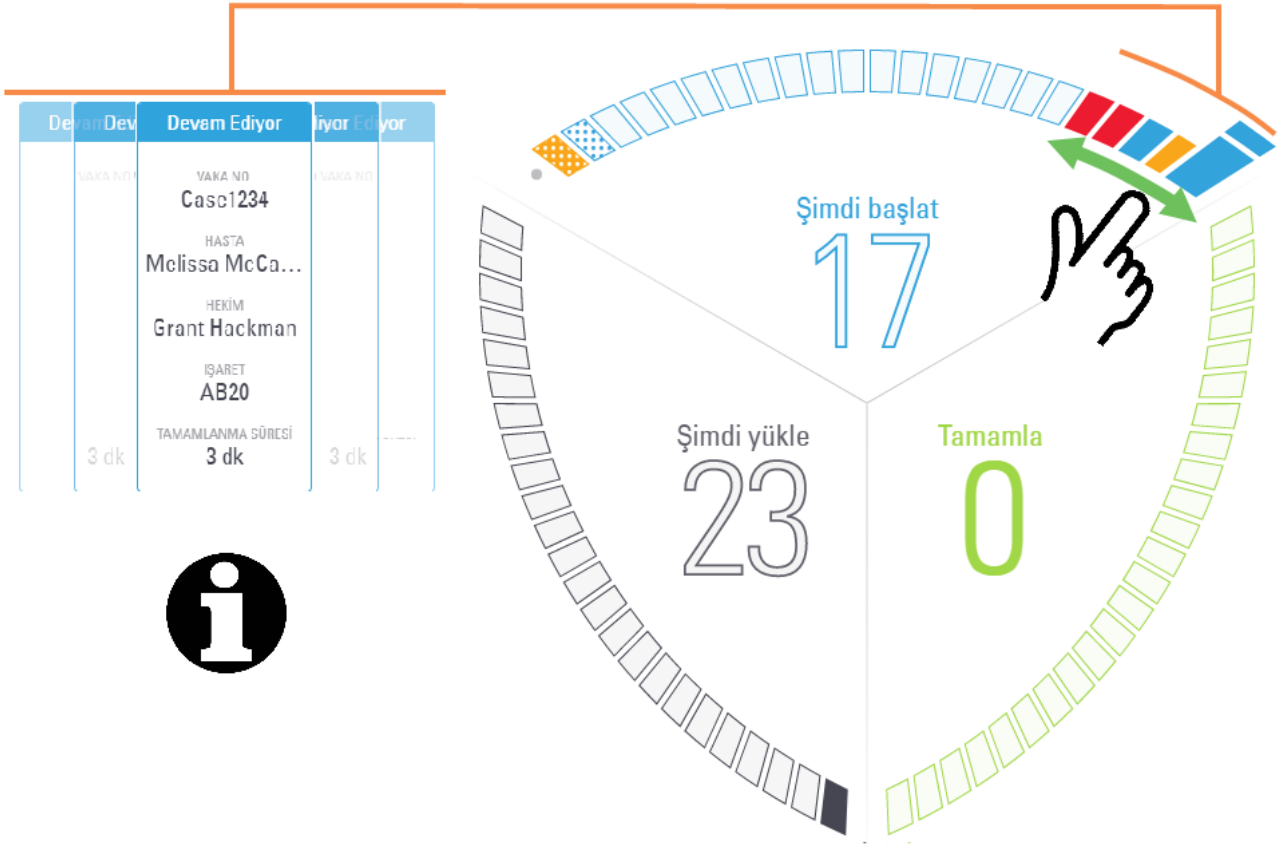
“Korunan” vakayı ve lam bilgilerini görüntülemek için oturum açmanız gerekir.

Bkz. [2.1 Oturum açma ve kapatma](#)

İlgili lam bilgilerini görüntülemek için bölümdeki bir lama dokununuz. Vaka penceresini açmak ve ilgili vaka bilgilerini görüntülemek için sunulan lam görüntüsüne dokununuz.



Görüntülenen bilgileri devamlı olarak güncellemek için parmağınızı lamdan lama sürükleyin.



Lam özellikler, başlatma/bitirme zamanları ve vaka özellikleri ile ilgili ilave bilgiler için ayrıca bkz. [2.9 Ayrıntılı vaka ve lam bilgileri](#).

2.3.5 İşleme sırasında beklenmeyen olaylar

İşleme sırasında gerçekleşen beklenmeyen bir olayla ilgili İşlem Sırası Ögesi (AQI) görürseniz, işaretlenen lamın tanıtıl kullanım için uygun olduğunu doğrulamak üzere ilave işlemler yapmanız gerekir.

Bu bildirim, boyamanın herhangi bir şekilde yeterli olmadığını belirtmez, ancak sistem kullanıcısı veya laboratuvar denetçisi aşağıdakileri yapmalıdır:

- 1 BOND Kontrolöründe **Lam geçmiş**i ekranını inceleyin (bkz. *BOND 7 Kullanım Kılavuzu*).
- 2 **Bitti (olaylar var)** durumuna sahip olan ve BOND-PRIME İşleme Modülünden çıkarılan, işaretlenmiş bir lamla aynı **Lam ID'si** olan bir lam arayın.
- 3 Bu lamı seçip **Çalışma olayları** düğmesine tıklayarak Çalışma Olayları Raporu oluşturun.

Bildirime neden olan tüm olaylar **Kalın** yazı tipli metinle görüntülenir. Bu olaylar, lam bildirim olaylarının iç yüzü hakkında önemli ayrıntılar sağladığı için sistem kullanıcısı veya laboratuvar denetçisi, listelenen bildirim olaylarını dikkatlice değerlendirmelidir.

- 4 Varsa kontrol lamalarını dikkatlice inceleyin.
- 5 Boyanan dokuyu dikkatlice inceleyin.

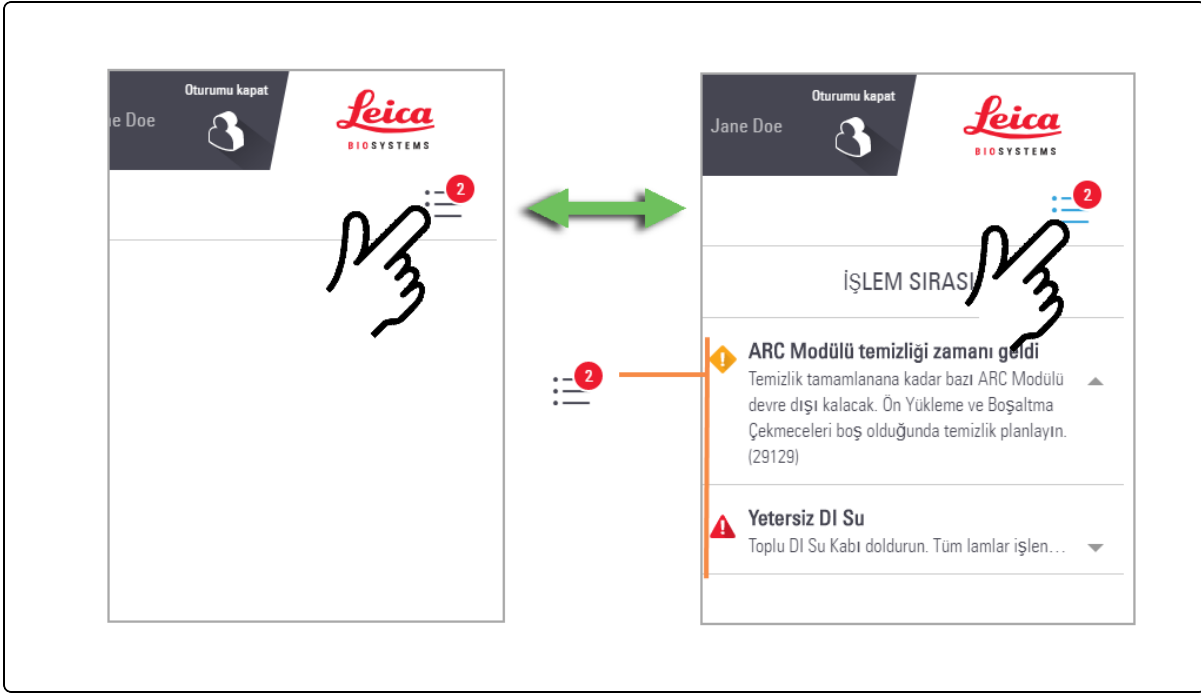
Laboratuvar boyama kalitesini doğrulayamıyorsa, patoloji uzmanı bilgilendirilmelidir veya test yeniden yapılmalıdır. Bir Çalışma Olayları Raporunda birden fazla bildirim olabilir. Lam **Bitti (olaylar var)** durumuyla tamamlanırsa raporun tamamının incelendiğinden emin olun. Durum **Bitti (Tamam)** ise, raporu incelemeye gerek yoktur.

2.4 İşlem Sırası ve Uyarı Başlığı

2.4.1 İşlem Sırasını gösterme ve gizleme

İşlem Sırası; işleme modülünün, reaktiflerin ve/veya lamların durumuyla ilgili önemli mesajların bir listesidir. Bu mesajlar işleme modülü hakkında bilgi veya bir bakım görevini tamamlama talimatı sağlayabilir.

Yeni bir İşlem Sırası Ögesi (AQI) olduğunda, Dokunmatik Ekranın altında Uyarı Başlığı görüntülenir. X ögesine basarak Uyarı Başlığını gizleyebilirsiniz (bkz. [2.4.3 Uyarı Başlığını manuel olarak gizleme](#)).



- 1 İşlem Sırasını göstermek veya gizlemek için İşlem Sırası düğmesine dokunun.
- 2 İşlem Sırasındaki her bir öge hakkında daha fazla veya daha az bilgi görüntülemek için öğenin yanındaki oka dokunun.

Her bir İşlem Sırası ögesinin önem seviyesi bir simgeyle belirtilmektedir:

	Uyarı: Derhal eyleme geçin.
	Dikkat: Fırsat olduğunda eyleme geçin.
	Bilgi: Bilgi sağlar.

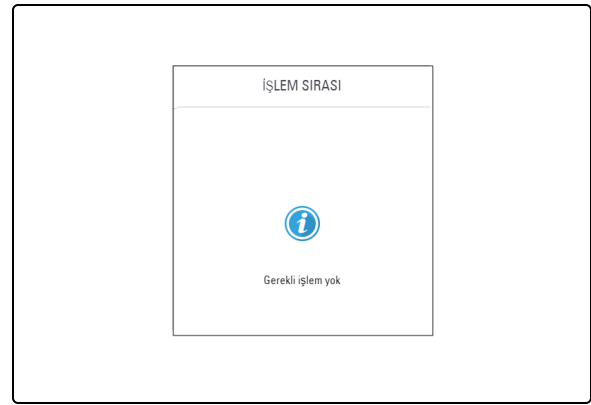
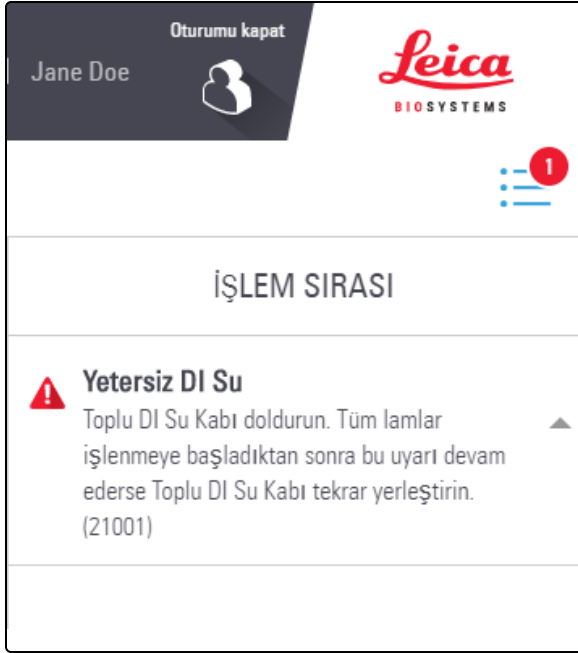
İşlem Sırası düğmesindeki sayı yalnızca Uyarıların ve Dikkat ibarelerinin sayısını belirtir.

2.4.2 İşlem Sırası Öğesinde önerilen bir görevi tamamlama

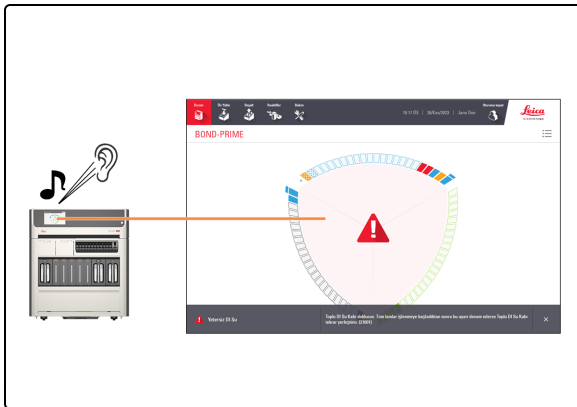
İşlem Sırası Öğesinde belirtilen bir görevi tamamladığınızda, öğe otomatik olarak İşlem Sırasından kaldırılır ve Uyarı Başlığı kapatılır.

Bir lam hakkında bilgi sağlayan İşlem Sırası Öğeleri, lamın çalışılması tamamlanana ve işleme modülünden çıkarılmasına kadar İşlem Sırasında kalacaktır.

Bakımla ilgili görevler için bkz. [4 Temizlik ve bakım](#).



2.4.3 Uyarı Başlığını manuel olarak gizleme



Uyarı Başlığı görüntülediğinde, derhal eyleme geçilmesi gerekiyorsa sesli bir uyarı sesi verilecektir.



1. Ekranın altındaki başlıkta X ögesine dokunun.



BOND-PRIME yazılımı Uyarı Başlığının manuel olarak gizlenmesine izin verse bile Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd, mümkünse önerilen görevi tamamlamanızı tavsiye eder.

Bkz. 2.4.2 İşlem Sırası Öğesinde önerilen bir görevi tamamlama.

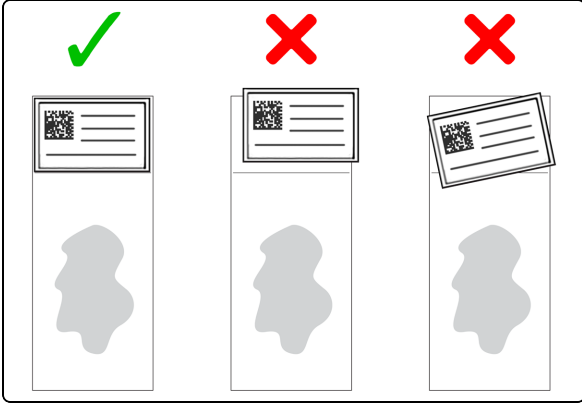
2.5 Lamları ön yükleme



UYARI: Reaktifleri kullanmadan veya işleme modülünü çalıştırmadan önce gerekli minimum kişisel koruyucu ekipmanı (PPE) kullanmanız gerekir. Bkz. **Genel dikkat edilecek hususlar**.



Bu prosedüre başlamadan önce işleme modülünde oturum açtığınızdan emin olun. Bkz. **2.1 Oturum açma ve kapatma**.

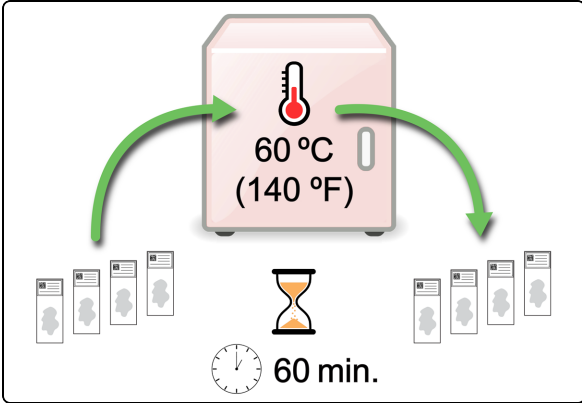


Lam etiketlerinin lama doğru iliştiirildiğini ve tam olarak konumlandırıldığını doğrulayın.

Bir lama ikiden fazla etiket yapıştırmayın.

Lamlarda şunlar olmamalıdır:

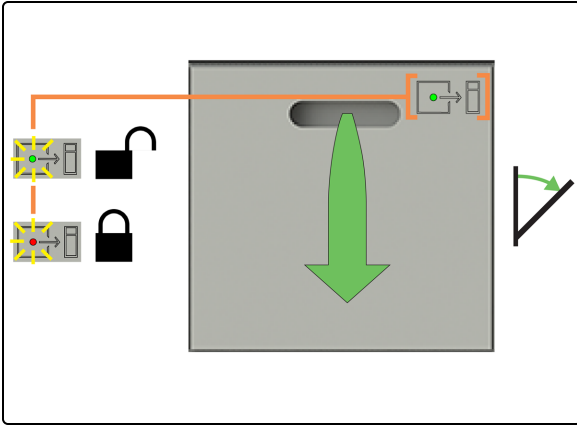
- aşırı nem veya kir, örneğin toz, vaks ve cam parçacıkları.
- çıkartılan/yeniden yapıştırılan etiketler nedeniyle yapışkan kalıntı.



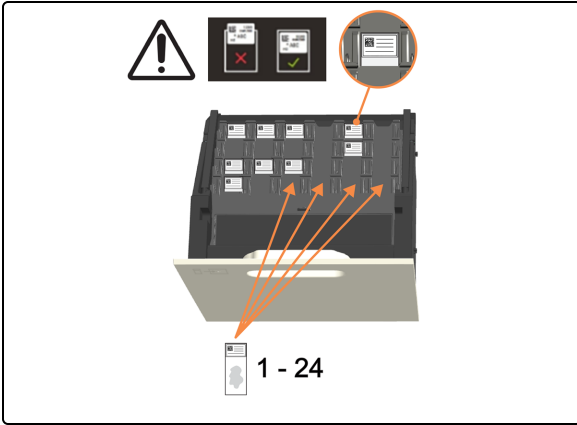
1. Doku yapışmasını iyileştirmek için lamları 60 °C'de (140 °F) 60 dakika boyunca fırınlayın.



Preload Drawer (Ön Yükleme Çekmecesesi) sol çekmecedir.



2. Preload Drawer'ı (Ön Yükleme Çekmecesesi) durum LED'inin yeşil olduğunu kontrol edin, ardından çekmeceyi açmak için tutamağı çekin.



3. 1 - 24 lamı etiket tarafı yukarıda olacak şekilde boş konumlara ön yükleyin. Hiçbir etiketin sarkmadığından emin olun.

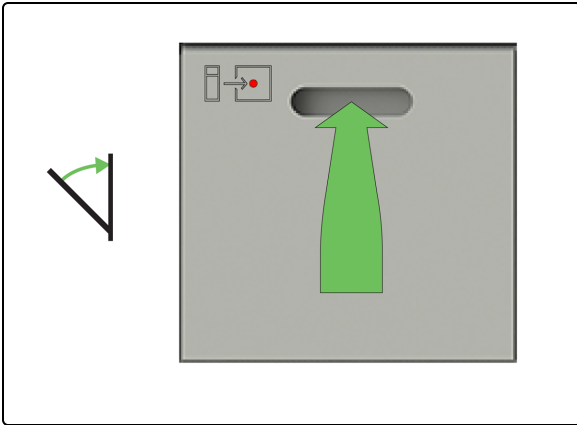
Öncelikli lam varsa önce onları ön yükleyin, ardından Preload Drawer'ı (Ön Yükleme Çekmecesesi) kapatın.



Altı adede kadar vaksı giderilmiş lam ön yükleyebilirsiniz. Vaksı giderilmiş lamlar "kabul edilebilir başlama süresi" içerisinde işlenmeye başlamalıdır, aksi takdirde dokunmatik ekranda bir uyarı oluşur.



Birlikte taranan lamlar birlikte planlanır.



4. Tüm lamların doğru şekilde Lam Çekmecesesi Parçasında bulunduğunu doğrulayın, ardından Preload Drawer'ı (Ön Yükleme Çekmecesesi) kapatın.

2.6 Ön Yükleme Ekranı

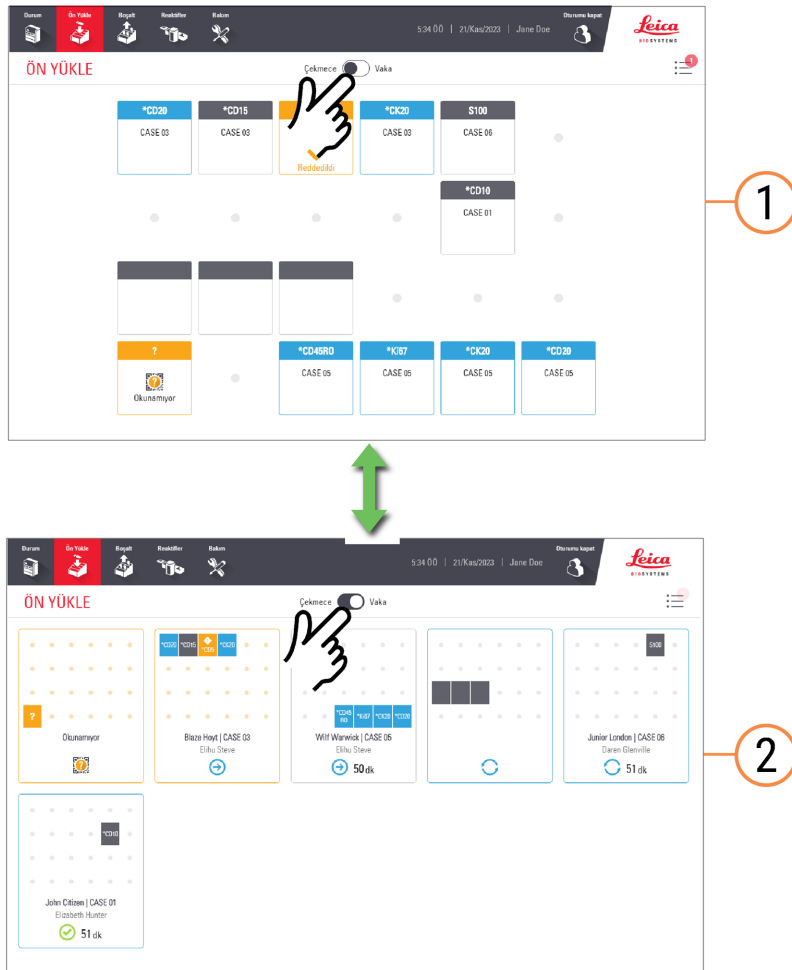
Ön Yükleme Ekranında aşağıdaki görünümeler vardır:

- **Preload Drawer (Ön Yükleme Çekmecesini) görünümü** – Preload Drawer’da (Ön Yükleme Çekmecesini) lamların fiziksel konumunu görüntüler
- **Ön Yükleme Vaka görünümü**– Preload Drawer’da (Ön Yükleme Çekmecesini) her bir vakadaki her bir lamın fiziksel konumunu görüntüler.

Ekranın üstündeki geçiş düğmesiyle görünümeler arasında geçiş yapabilirsiniz.



Lamlar birlikte yüklendiğinde birlikte taranır ve önceliklendirilir. Bu, işleme modülünün en son lamı olabildiğince verimli şekilde tamamlamasına olanak tanır.



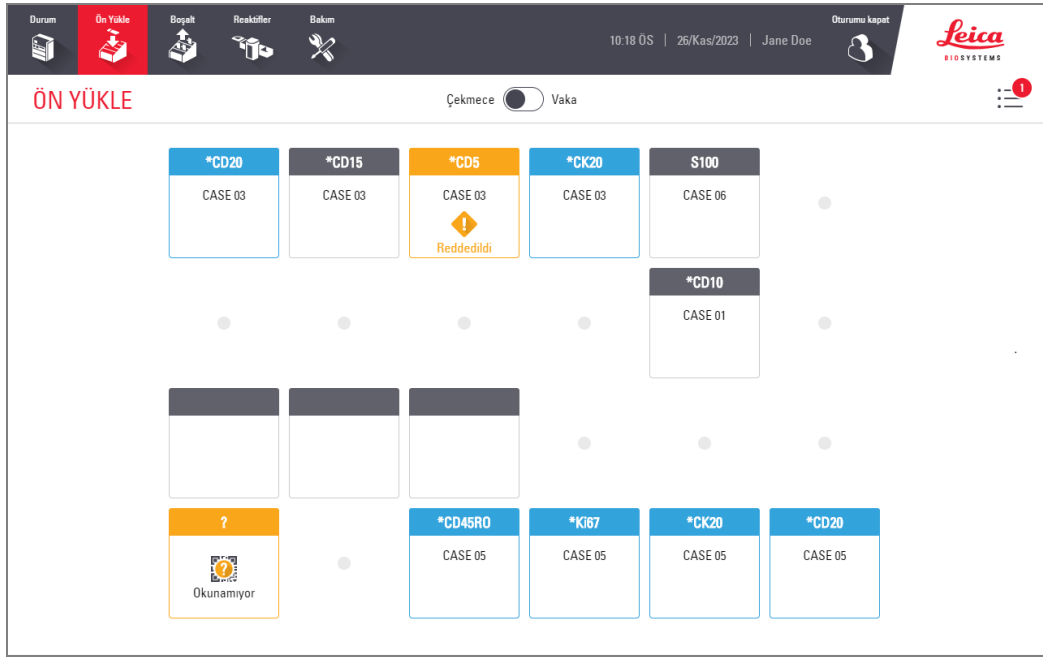
Açıklama

- 1 2.6.1 Preload Drawer (Ön Yükleme Çekmecesini) görünümü
- 2 2.6.2 Ön Yükleme Vaka görünümü

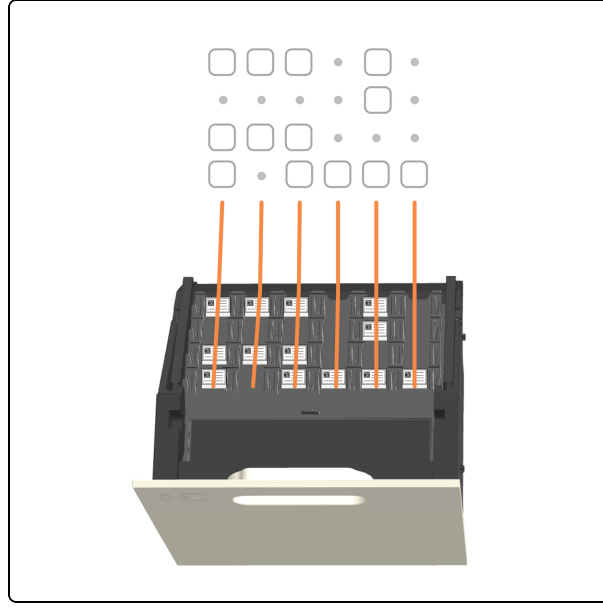
2.6.1 Preload Drawer (Ön Yükleme Çekmecesi) görünümü

Preload Drawer (Ön Yükleme Çekmecesi) görünümü, ekranda gösterilen lam konumları ile bunların Preload Drawer (Ön Yükleme Çekmecesi) içindeki gerçek konumları arasındaki ilişkiyi gösterir. Değerlendirilmekte olan lamlar için değerlendirme işlemi tamamlanana kadar ayrıntı gösterilmez.

Preload Drawer (Ön Yükleme Çekmecesi) görünümünde lam konumları



Preload Drawer'da (Ön Yükleme Çekmecesi) lam konumları

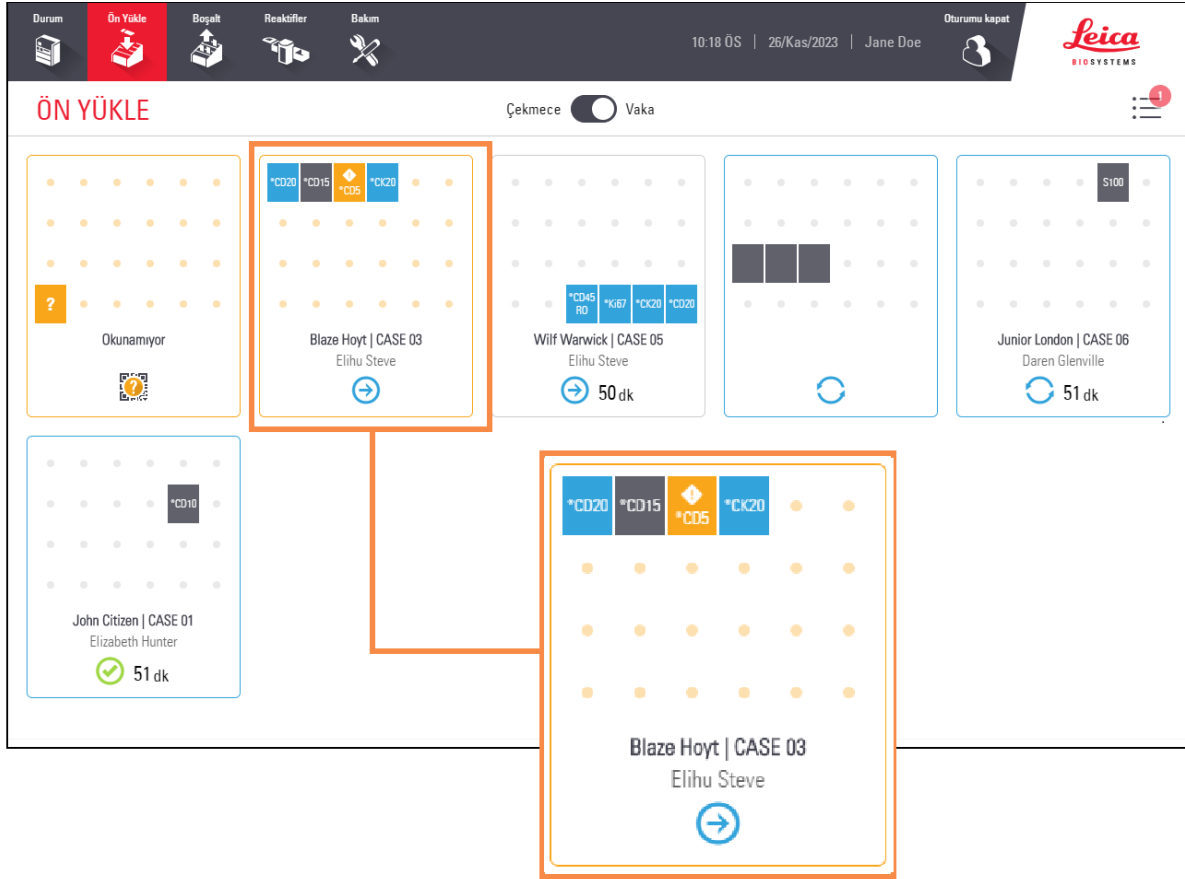


Ayrıca bkz:







- [2.5 Lamları ön yükleme](#)
- [2.9 Ayrıntılı vaka ve lam bilgileri](#)

2.6.2 Ön Yükleme Vaka görünümü

Ön Yükleme Vaka görünümünde lam konumları



Simge	Açıklama
	Algılanan lam
	Okunamayan lam
	Tanımlanan lam
	Kabul edilen lam
	"Dikkat" durumu olan lam

Simge	Açıklama
	Reddedilen lam
	Reddedilen, süresi kritik lam
	Bu vakadaki bir veya daha fazla lam tamamlanmış, terk edilmiş veya iptal edilmiş
	"Uyarı" durumu olan lam
	Bu vakadaki lamlar kabul edilmiş veya değerlendiriliyor
	Bu vakadaki lamların işlemleri devam ediyor

Ayrıca bkz:

- [2.5 Lamları ön yükleme](#)
- [2.9 Ayrıntılı vaka ve lam bilgileri](#)

2.7 Lamları boşaltma



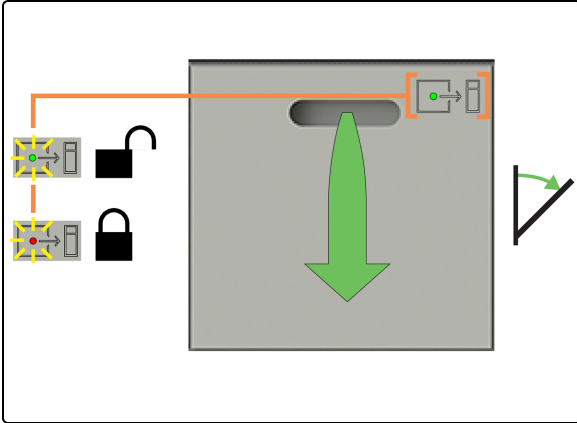
UYARI: Reaktifleri kullanmadan veya işleme modülünü çalıştırmadan önce gerekli minimum kişisel koruyucu ekipmanı (PPE) kullanmanız gerekir. Bkz. [Genel dikkat edilecek hususlar](#).



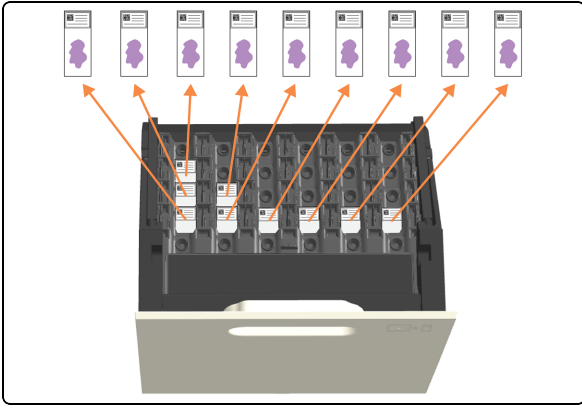
Bu prosedüre başlamadan önce işleme modülünde oturum açtığınızdan emin olun. Bkz. [2.1 Oturum açma ve kapatma](#).



1. Boşaltma Çekmecesesi sağ çekmececiğidir.

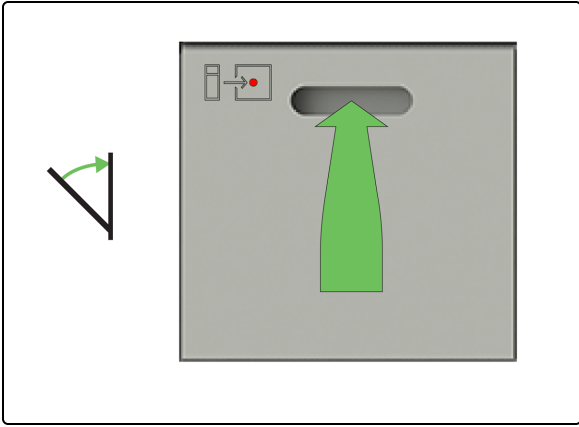


2. Boşaltma Çekmecesesi durum LED'inin yeşil olduğunu kontrol edin, ardından çekmeceyi açmak için tutamağı çekin.



3. Çekmeceyi kapatmadan önce **tüm** lamları boşaltın, aksi takdirde "Beklenmeyen lam" uyarısını görürsünüz.

Tüm lamları boşaltmazsanız, bunlar artık sulandırılmış olmaz ve boyama kalitesi riske girebilir.



4. Boşaltma Çekmecesini kapatın.

2.8 Boşaltma Ekranı

Boşaltma Ekranında aşağıdaki görünümeler vardır:

- **Boşaltma Çekmecesini görünümü** – Boşaltma Çekmecesinde lamaların fiziksel konumunu görüntüler
- **Boşaltma vaka görünümü**– Boşaltma Çekmecesinde her bir vakadaki her bir lamın fiziksel konumunu görüntüler.

Ekranın üstündeki geçiş düğmesiyle görünümeler arasında geçiş yapabilirsiniz.



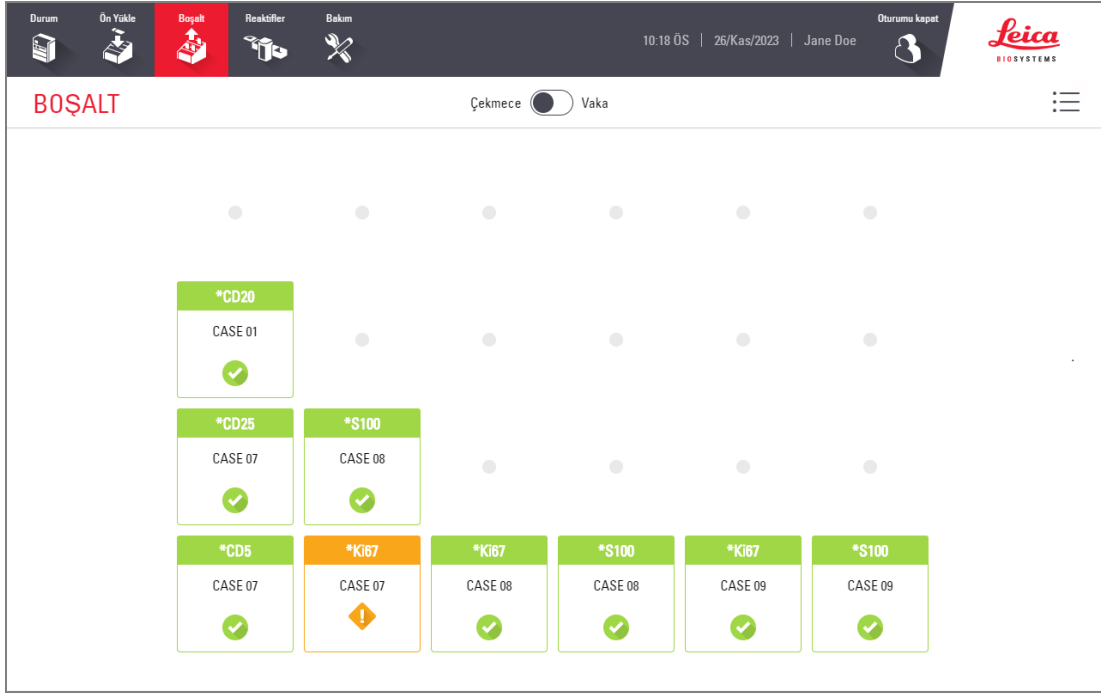
Açıklama

- 1 2.8.1 Boşaltma Çekmecesini görünümü
- 2 2.8.2 Boşaltma vaka görünümü

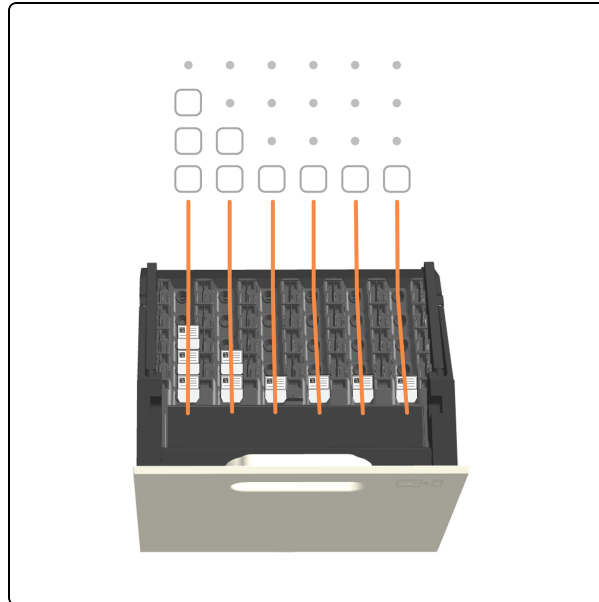
2.8.1 Boşaltma Çekmecesini görünümü

Boşaltma Çekmecesini görünümü, ekranda gösterilen lam konumları ile bunların Boşaltma Çekmecesini içindeki gerçek konumları arasındaki ilişkiyi gösterir.

Boşaltma Çekmecesini görünümünde lam konumları



Boşaltma Çekmecesinde lam konumları

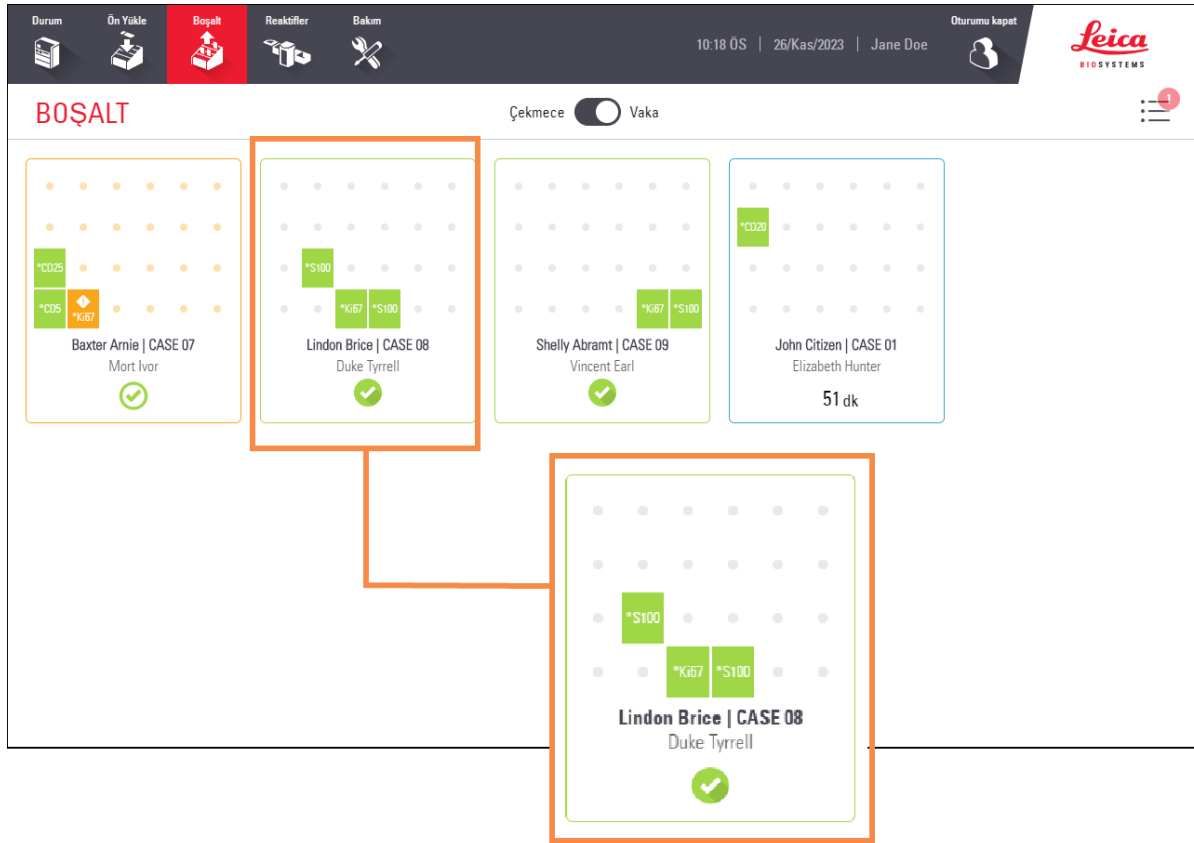



Ayrıca bkz:






- 2.7 Lamaları boşaltma
- 2.9 Ayrıntılı vaka ve lam bilgileri
- 2.3.5 İşleme sırasında beklenmeyen olaylar ("Dikkat" durumu olan lamlar)

2.8.2 Boşaltma vaka görünümü

Boşaltma vaka görünümünde lam konumları



Simge	Açıklama
	Tamamlanmış lam
	"Dikkat" durumu olan lam
	İptal edilmiş veya "Uyarı" durumlu lam

Simge	Açıklama
	Bu vakadaki lamlar işlenecek
	Bu vakadaki lamların işlemleri devam ediyor
	Bu vakadaki bazı lamların işlenmesi başarıyla tamamlandı
	Bu vakadaki tüm lamların işlenmesi başarıyla tamamlandı
	Beklenmeyen lam - bkz. 2.7 Lamları boşaltma

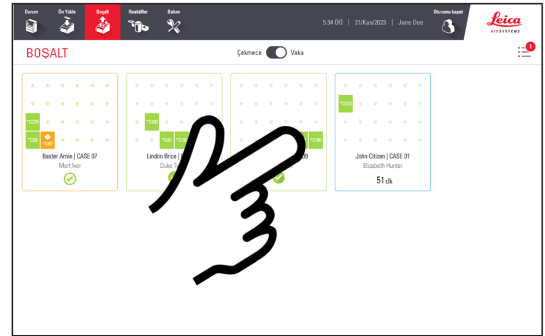
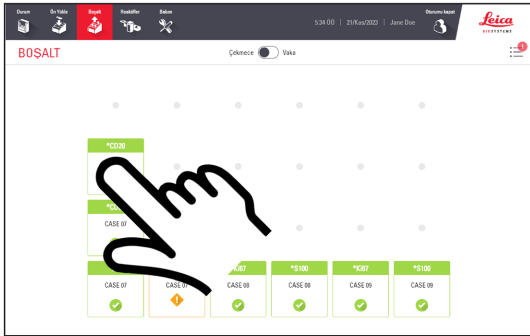
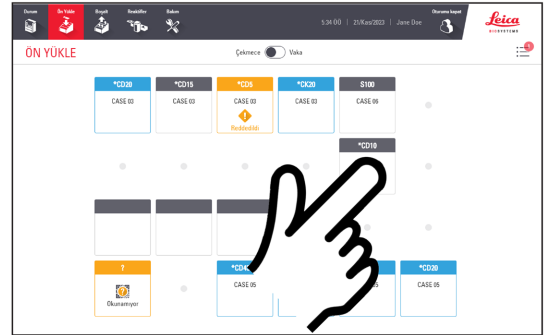
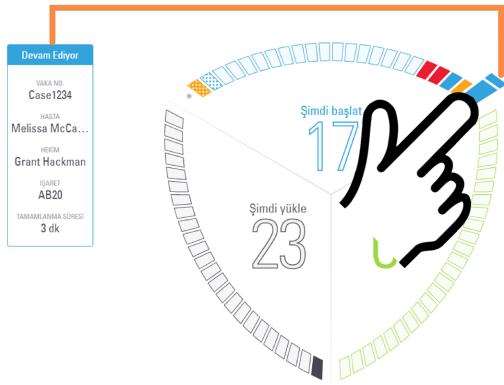
Ayrıca bkz:

- [2.7 Lamları boşaltma](#)
- [2.9 Ayrıntılı vaka ve lam bilgileri](#)
- [2.3.5 İşleme sırasında beklenmeyen olaylar](#) ("Dikkat" durumu olan lamlar)

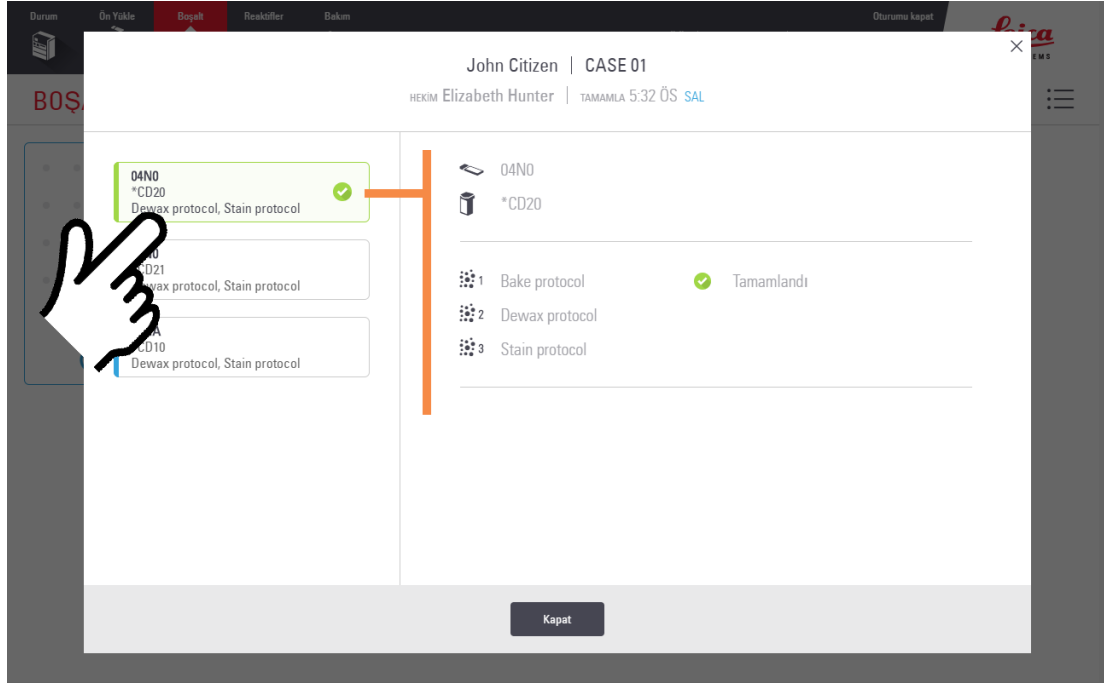
2.9 Ayrıntılı vaka ve lam bilgileri

Daha ayrıntılı vaka ve lam özelliklerini görüntülemek için aşağıdakilere dokunabilirsiniz:

- Durum ekranında temel lam bilgileri
- Ön Yükleme veya Boşaltma ekranındaki lam simgesi (çekmece veya vaka görünümünde) - seçilen lam, görüntülenen bilgi penceresinde vurgulanır
- Ön Yükleme veya Boşaltma ekranındaki vaka kutucuğu (vaka görünümünde) - vakadaki ilk lam, görüntülenen bilgi penceresinde vurgulanır



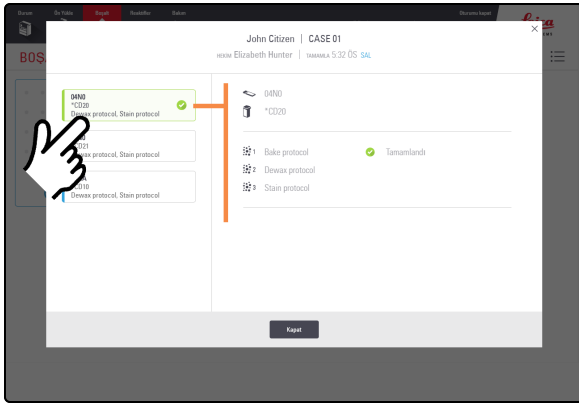
1 Bilgi penceresinde ayrıntılarını görüntülemek istediğiniz bir lama dokununuz.



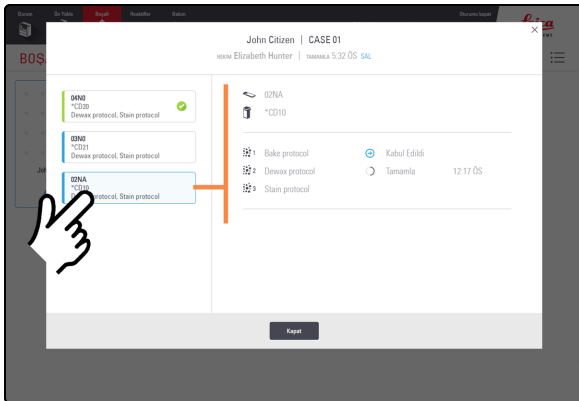
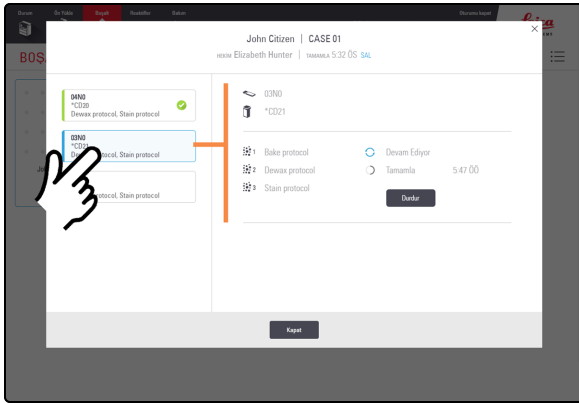
Ayrıca bkz:

- 2.9.1 Bir vakadaki her bir lamı görüntüleme
- 2.9.2 Devam eden bir lamı durdurma

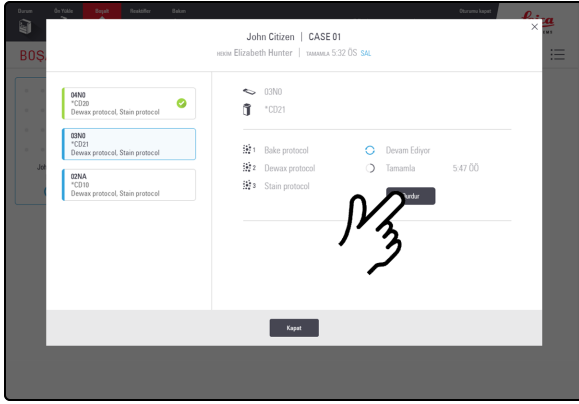
2.9.1 Bir vakadaki her bir lamı görüntüleme



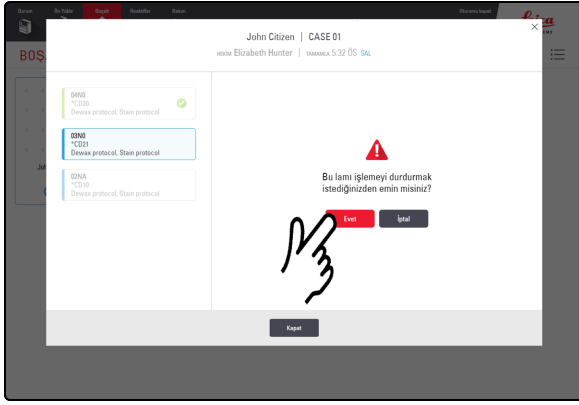
1. Bir lamın ayrıntılarını görüntülemek için lama dokununuz.



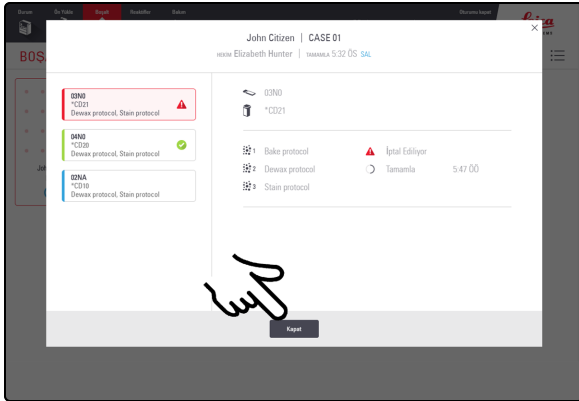
2.9.2 Devam eden bir lamı durdurma



1. Vaka Ayrıntıları ekranında lamı seçin ve **Durdur** ögesine dokununuz.



2. **Evet** ögesine dokununuz.



3. **Kapat** ögesine dokununuz.

İptal edilen lam Boşaltma Çekmecesine aktarılacak ve kırmızı renkle gösterilecektir.



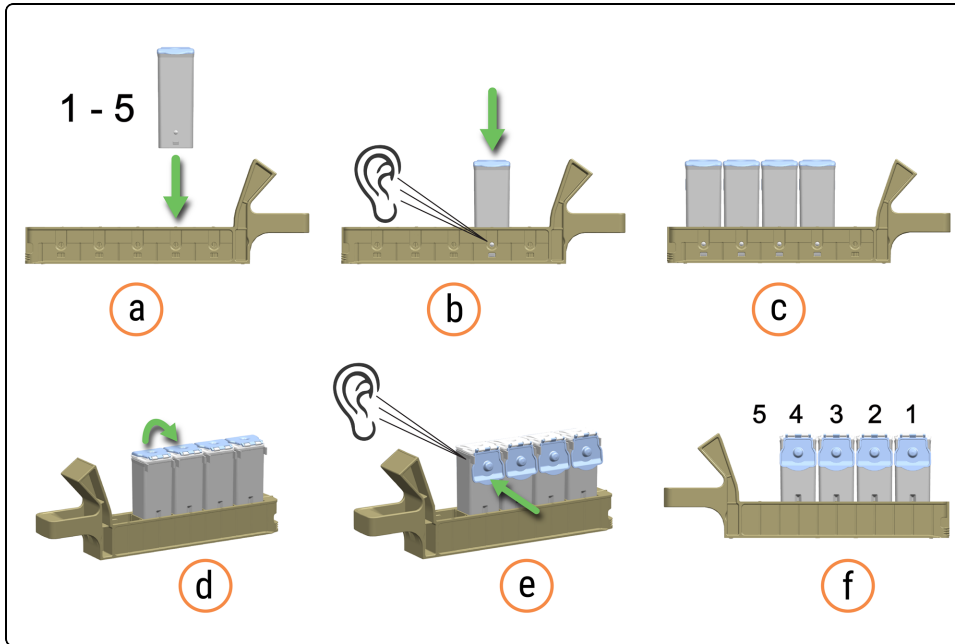
2.10 Reaktifler Ekranı

2.10.1 Reagent Container'ı (Reaktif Kabı) ve Reagent Tray'leri (Reaktif Tepsisi) Hazırlama



UYARI: Reaktifleri kullanmadan veya işleme modülünü çalıştırmadan önce gerekli minimum kişisel koruyucu ekipmanı (PPE) kullanmanız gerekir. Bkz. [Genel dikkat edilecek hususlar](#).

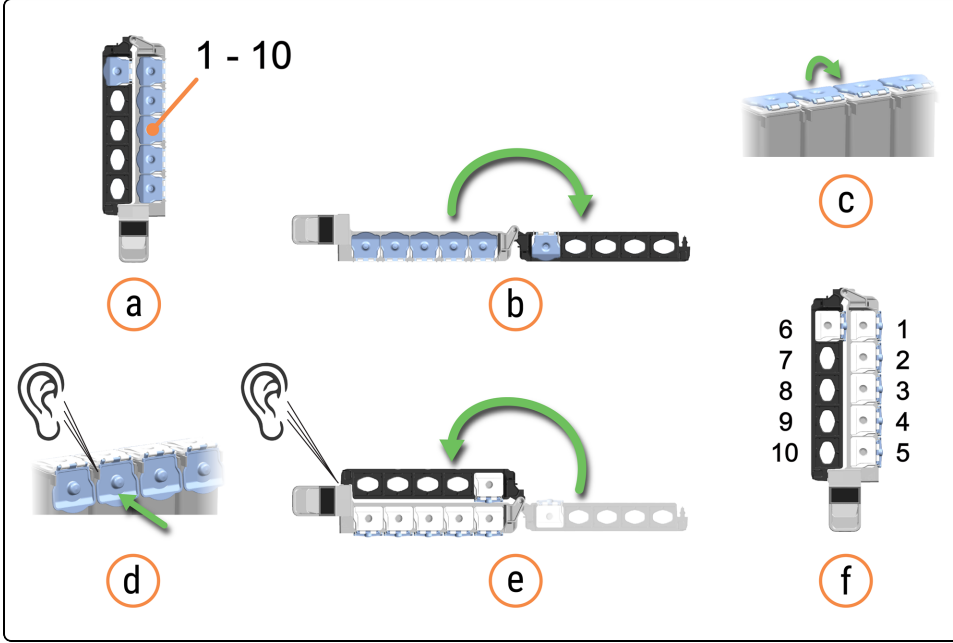
Tekli Reaktif Tepsisi



Dual Reagent Tray (İkili Reaktif Tepsisi)



UYARI: Dual Reagent Tray'i (İkili Reaktif Tepsisi) kapatırken sıkışma tehlikesi.



Reagent Container'ı (Reaktif Kabı) Reagent Tray'e (Reaktif Tepsisi) tam olarak yerleştirdiğinizde bir klik sesi duyacaksınız. Reagent Container (Reaktif Kabı) başlıklarının kabin arkasındaki tırnaklara tam olarak oturduğundan emin olun. Bunu yapmazsanız, başlıklar yandaki Reagent Lane'lerde (Reaktif Hattı) reagent container'ların (reaktif kabı) hizalanmasını engelleyebilir.

Dual Reagent Tray'i (İkili Reaktif Tepsisi) tam olarak kapattığınızda da bir klik sesi duyulur.

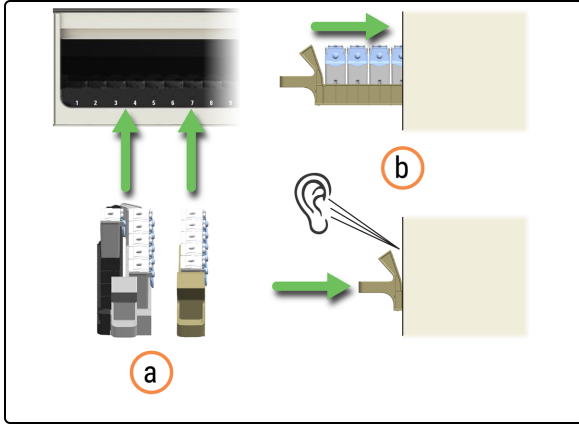
Üst barkod etiketlerinin kaplara tam olarak yapıştığından emin olun ve çıkmaya başlayan etiketleri bastırın.

Üst barkod etiketinde nem veya yoğuşma varsa silin.

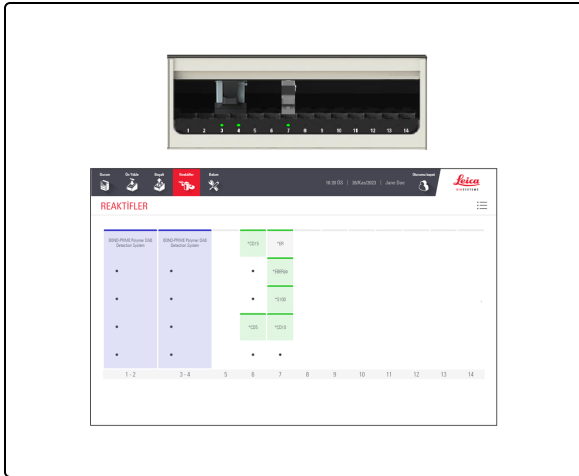
2.10.2 Reagent Tray'leri (Reaktif Tepsisi) yükleme



UYARI: Reaktifleri kullanmadan veya işleme modülünü çalıştırmadan önce gerekli minimum kişisel koruyucu ekipmanı (PPE) kullanmanız gerekir. Bkz. [Genel dikkat edilecek hususlar](#).



1. Her iki Reagent Tray'i (Reaktif Tepsisi) de işleme modülüne yükleyin.
 - a. Reagent Tray'i (Reaktif Tepsisi) Reagent Platform'un (Reaktif Platformu) içine yerleştirin.
 - b. Klik sesi duyana kadar Reagent Tray'i (Reaktif Tepsisi) itin.



Reaktifler ekranında yüklü reaktifler ve saptama sistemi görüntülenir.

Reagent Tray (Reaktif Tepsisi) yüklerken potansiyel reaktif dökülmesini ve kontaminasyonu önlemek için yavaş hareket edin. Reagent Tray'i (Reaktif Tepsisi) Reagent Platform'a (Reaktif Platformu) tam olarak yerleştirdiğinizde bir klik sesi duyacaksınız.

Ekrandaki simgenin arka plan rengi, yüklü reaktif sisteminin veya kabının içeriğiyle ilişkilidir. Ayrıca reaktif sistemi veya kabı bir veya daha fazla lama tahsis edilirse arka plan rengi değişir. Reagent Tray (Reaktif Tepsisi) veya Reagent Container (Reaktif Kabi) tahsis edilmemişse, simgenin arka plan rengi açık gridir.

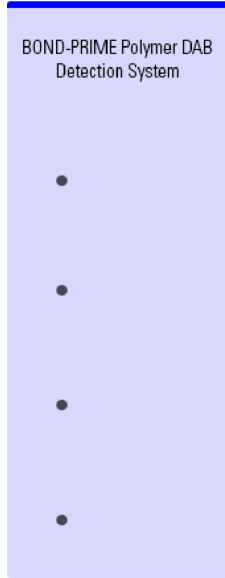
Simgenin üstündeki koyu renkli yatay çubuk, kalan reaktif hacmini temsil eder. Çubuğun daha kısa olması, hacmin azaldığı anlamına gelir.

Reagent Tray'in (Reaktif Tepsisi) kullanımda ve kilitli olacağı süre (saat ve dakika), Reagent Lane'lerin (Reaktif Hattı) altında görüntülenir. Ayrıca Reagent Platform'da (Reaktif Platformu) o hat için kırmızı LED vardır.

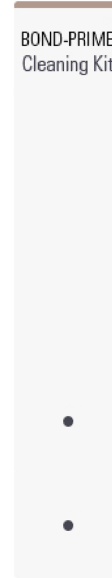
Birkaç dakika geçtikten sonra reaktif kaydedilmiyorsa, reaktif taramalarını yeniden tetiklemek için Reagent Tray'i (Reaktif Tepsisi) çıkarın ve farklı bir Reagent Lane'e (Reaktif Hattı) yerleştirin.

2.10.3 Reaktif sistemi simgelerine örnekler

Tahsis edilmiş BOND-PRIME Polymer DAB Detection System (Dual Reagent Tray (İkili Reaktif Tepsisi))



Tahsis edilmemiş BOND-PRIME Cleaning Kit (BOND-PRIME Temizlik Kiti) (Tekli Reaktif Tepsisi)



2.10.4 Reagent Container (Reaktif Kabı) simgelerine örnekler



Boş Reagent Tray (Reaktif Tepsisi) konumu



Tahsis Edilmemiş Reagent Container (Reaktif Kabı)



Tahsis Edilmiş Reagent Container (Reaktif Kabı)



Tanınmamış Reagent Container (Reaktif Kabı)



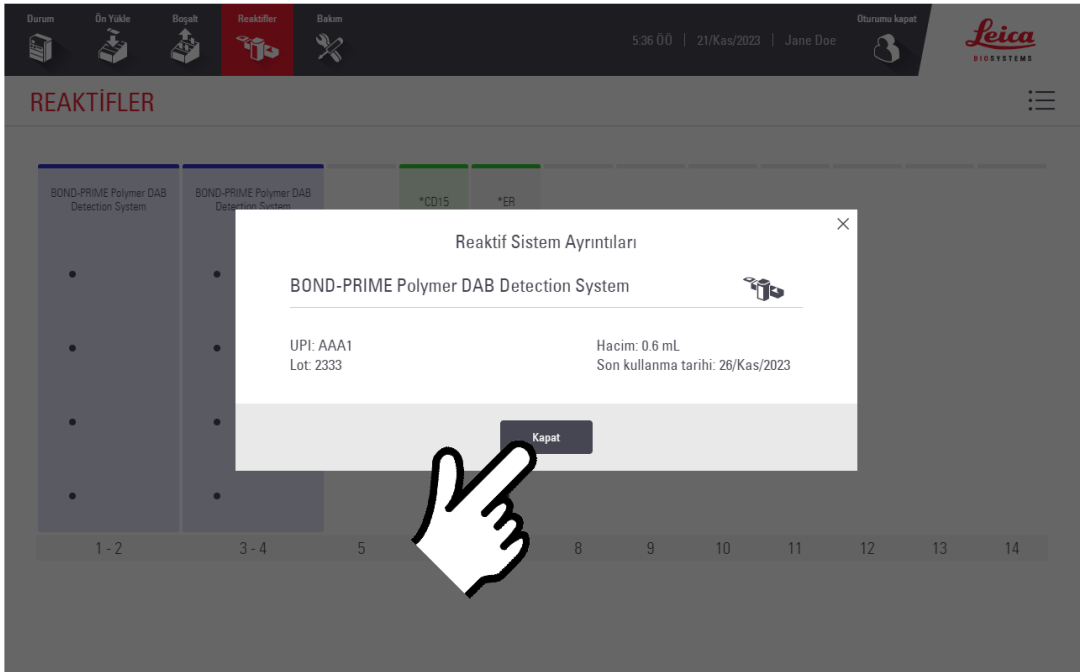
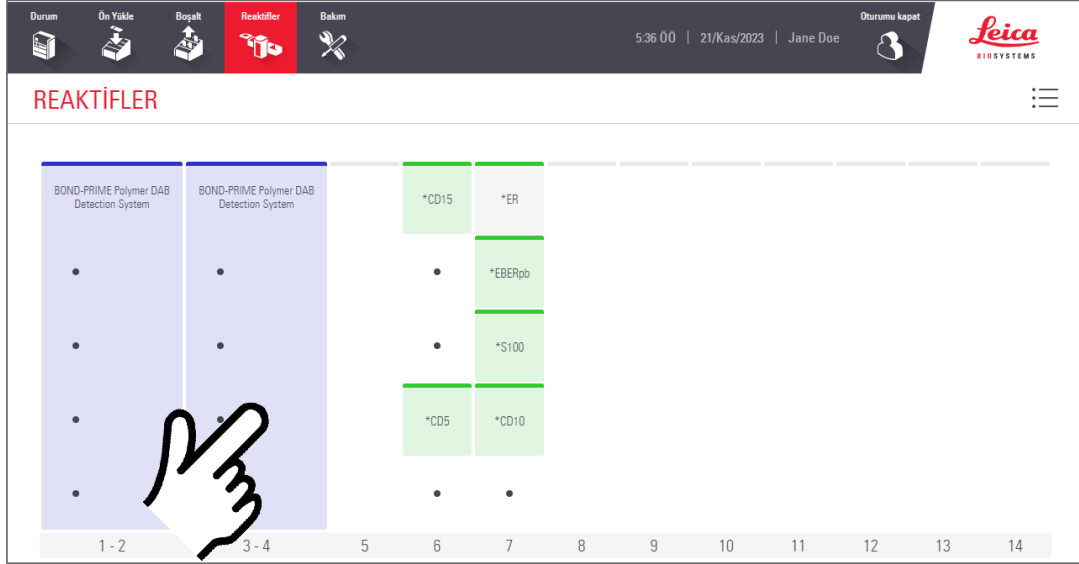
Geçersiz veya tarihi geçmiş Reagent Container (Reaktif Kabı) (veya reaktif sistemi)



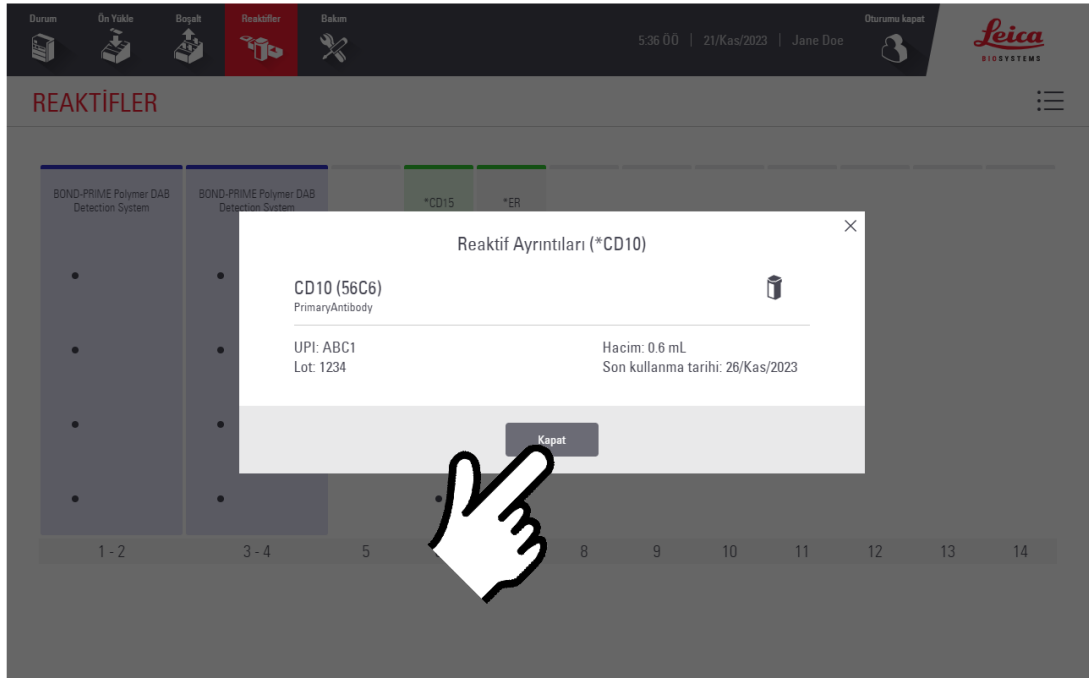
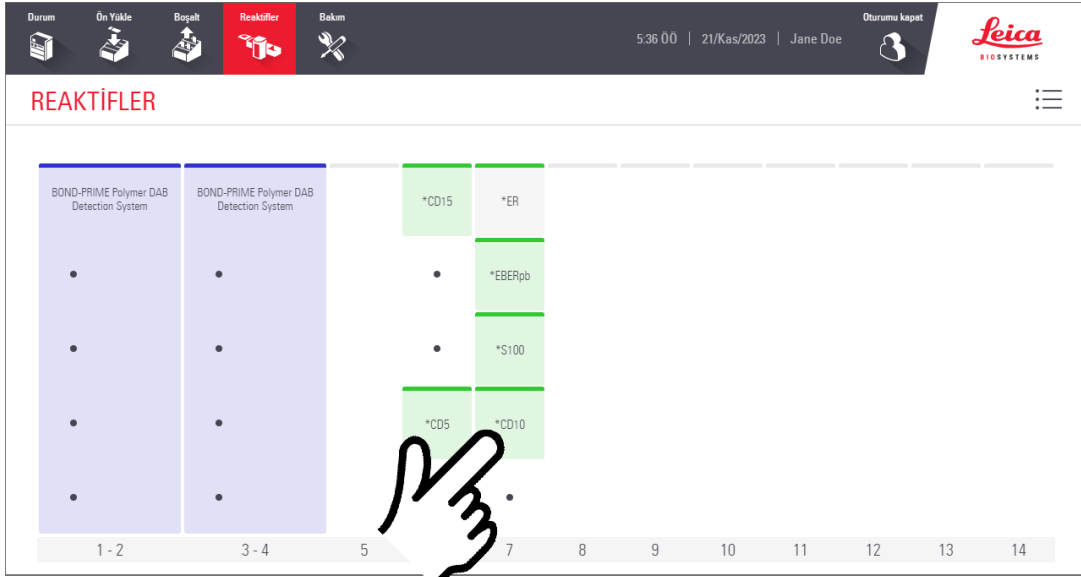
Reaktif kaydedilmedi

2.10.5 Reaktif sistemi ve Reagent Container (Reaktif Kabı) ayrıntılarını görüntüleme

Reaktif Sistem Ayrıntıları



Reaktif Ayrintıları

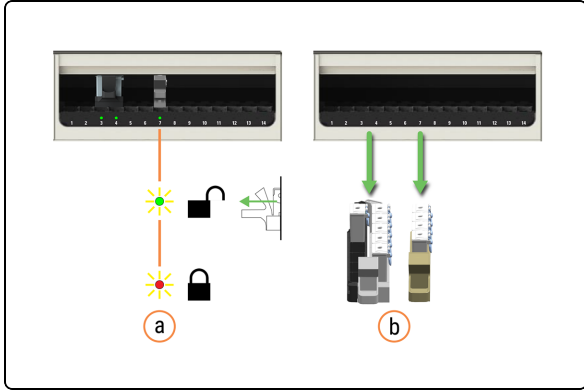


2.10.6 Reagent Tray'leri (Reaktif Tepsisi) boşaltma



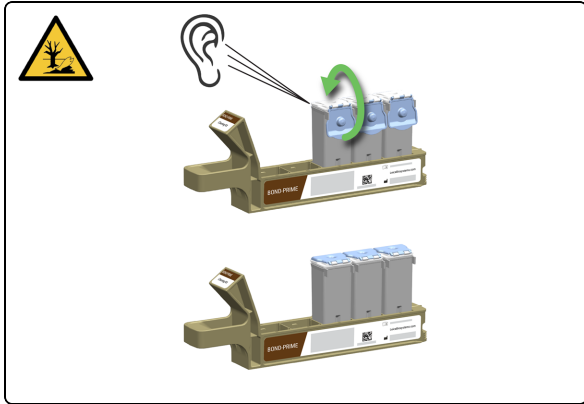
UYARI: Reaktifleri kullanmadan veya işleme modülünü çalıştırmadan önce gerekli minimum kişisel koruyucu ekipmanı (PPE) kullanmanız gerekir. Bkz. [Genel dikkat edilecek hususlar](#).

Reagent Tray'in (Reaktif Tepsisi) kullanımında olmasının beklendiği süre Reaktifler Ekranında görüntülenir. Artık kullanımda olmadığı anda tepsiyi çıkarabilirsiniz.



1. Reagent Tray'leri (Reaktif Tepsisi) işleme modülünden çıkarın.

- Reagent Lane (Reaktif Hattı) LED'inin yeşil olmasını bekleyin.
- Reagent Tray'leri (Reaktif Tepsileri) Reagent Platform'dan (Reaktif Platformu) çıkarın.



2. Reaktif buharlaşmasını önlemek için Reagent Container (Reaktif Kabı) başlıklarını sıkıca kapatın. Başlığı tam olarak kapattığınızda bir klik sesi duyacaksınız.

Hemen reaktifleri etikette veya reaktif veri sayfasında belirtildiği şekilde saklayın.

2.11 Bakım Ekranı

The screenshot shows the 'BAKIM' (Maintenance) screen with the following elements:

- Top Bar:** Includes navigation icons for 'Durum', 'Ön Yükle', 'Boşalt', 'Reaktifler', and 'Bakım'. It also displays the time '10:19 ÖS', date '26/Kas/2023', user name 'Jane Doe', and the Leica Biosystems logo.
- BAKIM Section:** Contains several maintenance tasks:
 - Alkolü yeniden doldur:** 'Kilidini Aç' button (1).
 - BOND-PRIME Temizlik Kiti Çalıştır:** 'Planla' button (2).
 - Periyodik Bakım:** 'Bakımı başlatma' button (3).
 - Kaput Kilidi durumu:** 'Kilitli' status.
 - ARC Yenileme Kitini Değiştir:** 'Kilidini Aç' button (4).
 - Emme Kabını Değiştir:** 'Bitti' button (5).
 - Toplu Reaktif Kabı Temizle:** 'Kilidini Aç' button (6).

Açıklama

- | | |
|--|--|
| <p>1 Kilidini Aç
4.3 Alkol (Alkol) Kabını yeniden doldurma</p> <p>2 Planla
4.6 BOND-PRIME Cleaning Kit'i (BOND-PRIME Temizlik Kiti) kullanma</p> <p>3 Bakımı başlat
4.7 Bakımı Başlatma</p> | <p>4 ARC Refresh Kit (ARC Yenileme Kitini) Değiştir
4.14 BOND-PRIME ARC Refresh Kit (BOND-PRIME ARC Yenileme Kiti) kullanma</p> <p>5 Emme Kabını Değiştir
4.11 Emme Kabını değiştirme</p> <p>6 Bulk Reagent Container'ları (Toplu Reaktif Kabı) Temizle
4.16 Kilitli Bulk Reagent Container'ları (Toplu Reaktif Kabı) Temizleme</p> |
|--|--|

3

Hızlı başlangıç



UYARI: Reaktifleri kullanmadan veya işleme modülünü çalıştırmadan önce gerekli minimum kişisel koruyucu ekipmanı (PPE) kullanmanız gerekir. Bkz. [Genel dikkat edilecek hususlar](#).

Bu kısımda:

3.1 Giriş	100
3.2 İşleme modülünü başlatma	101
3.3 Reagent Tray'i (Reaktif Tepsisi) ve DS9824 Saptama Sistemini Yükleme	103
3.4 Lamları ön yükleme, işleme ve boşaltma	105

3.1 Giriş

Bu bölümde BOND-PRIME İşleme Modülünde nasıl örnek çalışma yapılacağı gösterilmektedir.

Bir numune vakası oluşturacak ve dört lamı yapılandırıp işleyeceksiniz.

İşlemede dört BOND kullanıma hazır birincil antikor kullanılır:

- *CD5
- *CD3
- *CD10
- *Bcl-6

Bu işlemede, bu antikorların varsayılan protokolü ve saptama sistemi kullanılır:

- *IHC Protocol F
- BOND-PRIME Polymer DAB Detection System (DS9824)

İşlemede yardımcı BOND-PRIME Hematoxylin (AR0096) kullanılır.

Prosedür aynı zamanda ISH problemleri ve protokolleri için de geçerlidir.

Bir probun antikorunu değiştirebilir ve IHC protokollerini ISH protokolleriyle değiştirebilirsiniz.

Aşağıdaki ön görevlerin ayrıntıları için *BOND 7 Kullanım Kılavuzunda* Hızlı Başlangıç bölümüne bakın:

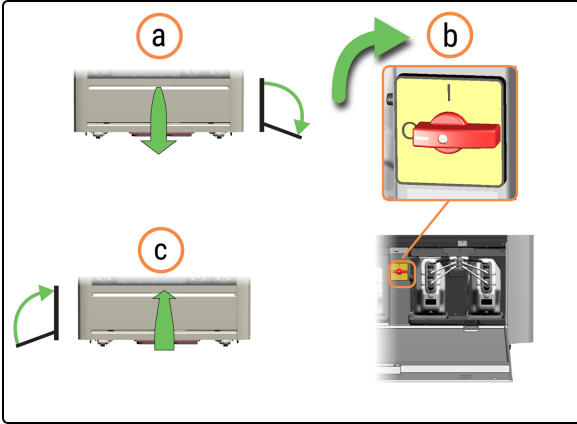
- Ön Kontroller ve Başlangıç*
- Protokol ve Reaktif Kontrolleri
- Lamaların Hazırlanması (lamaların etiketlenmesi ve öncesindeki işlemler dahil)



Doku yapışmasını iyileştirmek için, lamaları yüklemeye başlamadan önce daha uzun süre fırınlamayı deneyin.

* yalnızca Lam Etiketleyici ve BOND Kontrolörü (ve BOND-ADVANCE için Terminal) ile ilgilidir

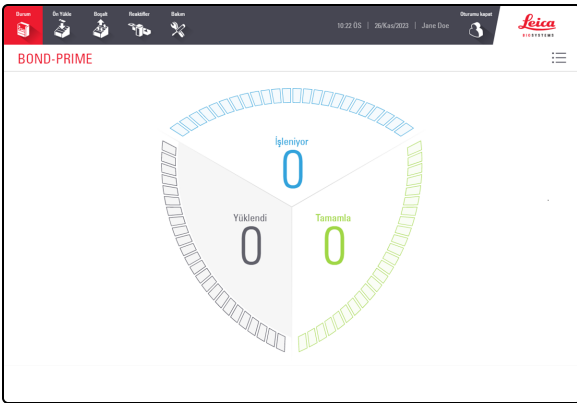
3.2 İşleme modülünü başlatma



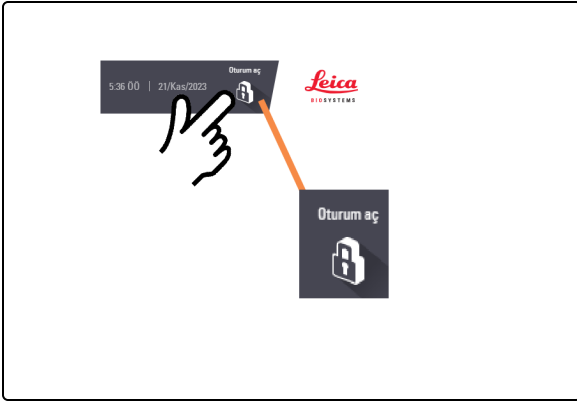
1. İşleme modülünün gücünü açın.
 - a. Hazne Kabini kapısını açın.
 - b. AC güç anahtarını saat yönüne doğru çevirin.
 - c. Hazne Kabini kapısını kapatın.



2. İşleme modülü etkinleştirildiğinde, Oturum Açma Ekranı görüntülenmeden önce bir başlatma işlemi gerçekleşir. Bu işlem 8 ila 15 dakika sürer. İşleme modülü başlatılamazsa bkz. [5.1 Başlatılamadı](#).



Durum ekranı görüntülenir.



3. İşleme modülü başlatıldığında **Oturum Aç** öğesine dokununuz.



4. Dokunmatik ekranda oturum açın.
- Oturum Aç** Ekranında kullanıcı adınıza dokununuz.
 - PIN'inizi girin.



5. İşlem gerektirdiği belirtilen İşlem Sırası görevleri varsa bunları tamamlayın.

İşlem Sırasında belirtilen işlem bakımla ilgiliyse, bkz. **4 Temizlik ve bakım**

İşlem Sırası Ögesi durum simgesi:



Uyarı: Derhal eyleme geçin.



Dikkat: Fırsat olduğunda eyleme geçin.



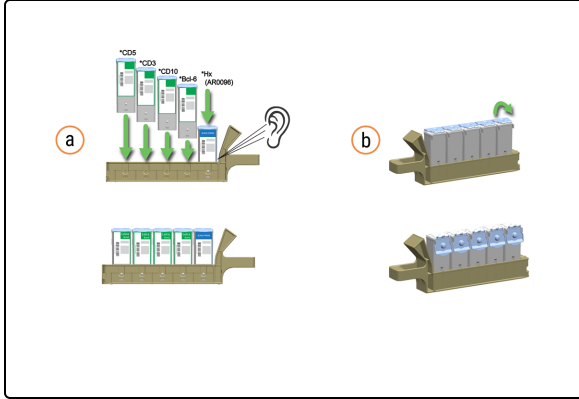
Bilgi: Bilgi sağlar.



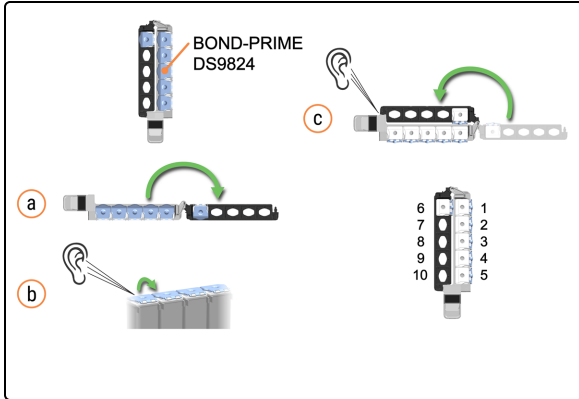
İşleme modülü başlamazsa bkz. **5.1 Başlatılmadı.**

3.3 Reagent Tray'i (Reaktif Tepsisi) ve DS9824 Saptama Sistemini Yükleme

Hacim kontrollerine süre tanımak için çalışma başlangıcında (lamları yüklemeyen önce) reaktifleri yükleyin.



1. Reagent Tray'i (Reaktif Tepsisi) yükleyin.
 - a. Reagent Container'ları (Reaktif Kabı) Reagent Tray'e (Reaktif Tepsisi) yerleştirin. Kabinin tam olarak yerleştirildiğini doğrulamak için klik sesi duymaya çalışın.
 - b. Tüm kap başlıklarını açın.

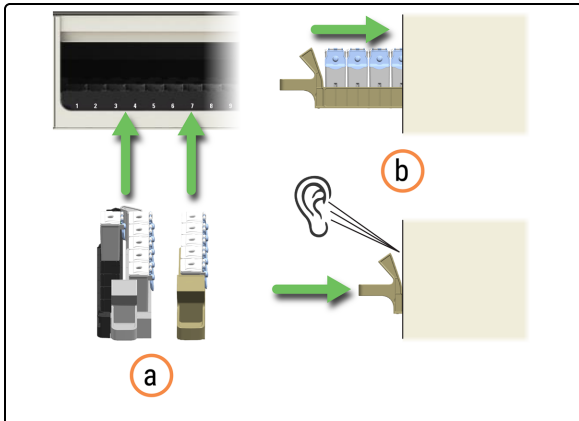


2. BOND Polymer DAB Detection System'i (DS9824) yükleyin.
 - a. Saptama Sistemini açın.
 - b. Tüm kap başlıklarını açın.
 - c. Saptama Sistemini kapatın.

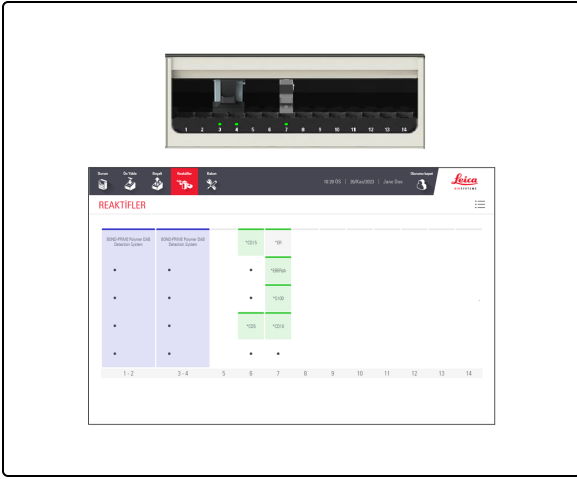


DS9824'te yalnızca 6 kap vardır:

- Peroxide Block
- Post Primary
- Polymer
- DAB Part 1
- DAB Part B x 2

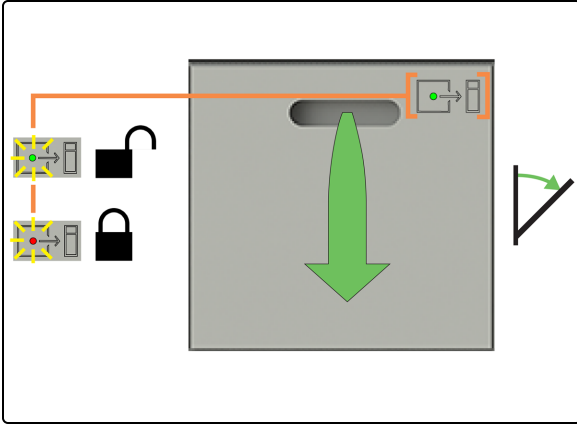


3. Her iki Reagent Tray'i (Reaktif Tepsisi) de işleme modülüne yükleyin.
 - a. Reagent Tray'i (Reaktif Tepsisi) Reagent Platform'un (Reaktif Platformu) içine yerleştirin.
 - b. Klik sesi duyana kadar Reagent Tray'i (Reaktif Tepsisi) itin.

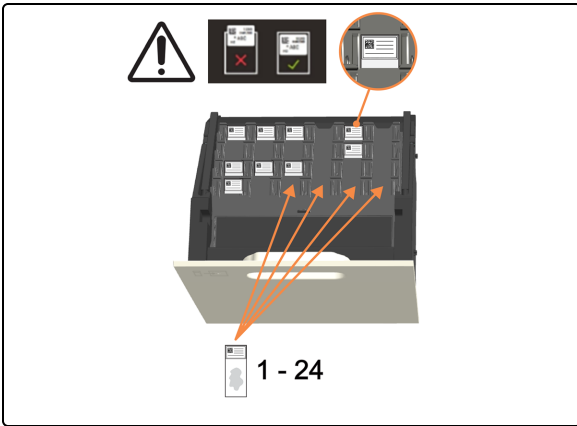


Reaktifler ekranında yüklü reaktifler ve saptama sistemi görüntülenir.

3.4 Lamları ön yükleme, işleme ve boşaltma



1. Preload Drawer'ı (Ön Yükleme Çekmecesesi) durum LED'inin yeşil olduğunu kontrol edin, ardından çekmeceyi açmak için tutamağı çekin.



2. 1 - 24 lamı etiket tarafı yukarıda olacak şekilde boş konumlara ön yükleyin. Hiçbir etiketin sarkmadığından emin olun.

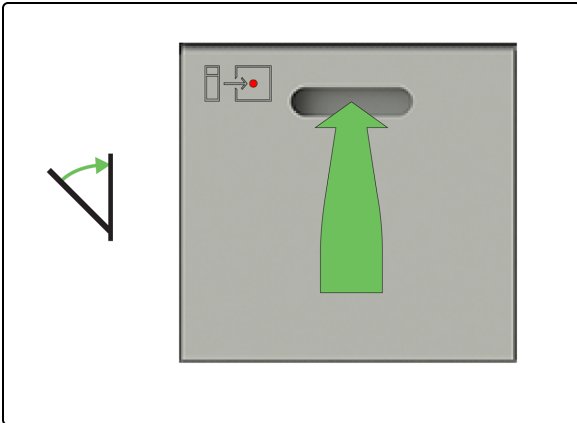
Öncelikli lam varsa önce onları ön yükleyin, ardından Preload Drawer'ı (Ön Yükleme Çekmecesesi) kapatın.



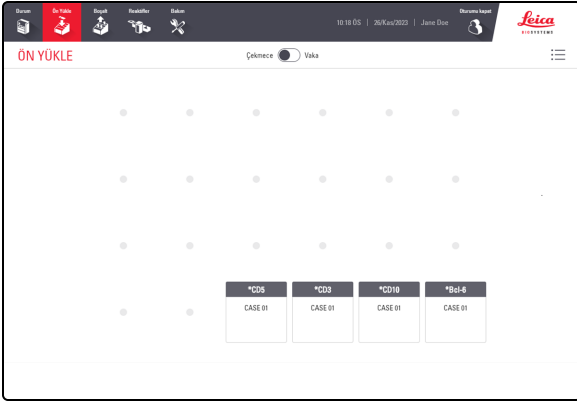
Altı adede kadar vaksı giderilmiş lam ön yükleyebilirsiniz. Vaksı giderilmiş lamlar "kabul edilebilir başlama süresi" içerisinde işlenmeye başlamalıdır, aksi takdirde dokunmatik ekranda bir uyarı oluşur.



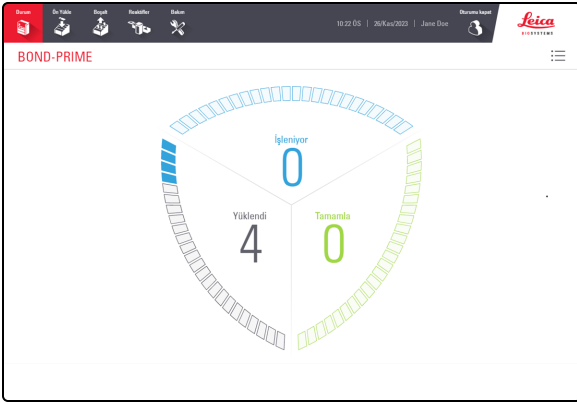
Birlikte taranan lamlar birlikte planlanır.



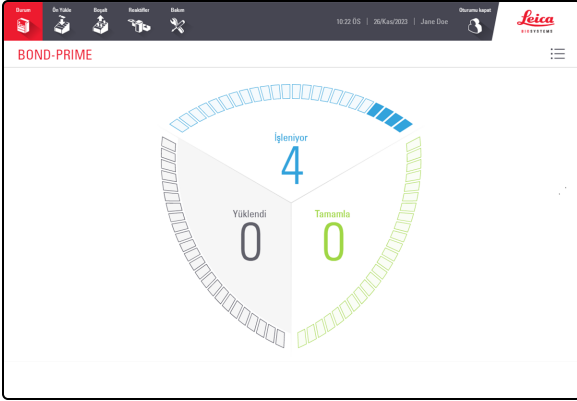
3. Tüm lamların doğru şekilde Lam Çekmecesesi Parçasında bulunduğunu doğrulayın, ardından Preload Drawer'ı (Ön Yükleme Çekmecesesi) kapatın.



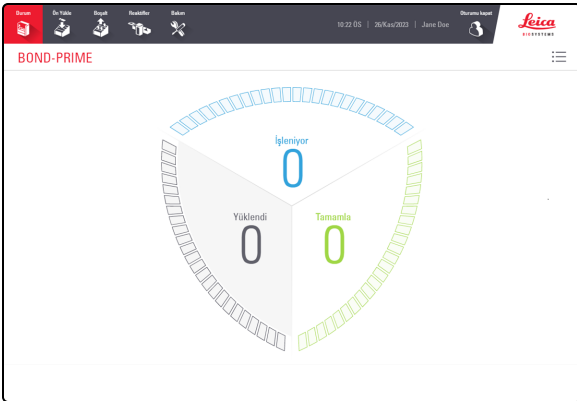
Preload Drawer (Ön Yükleme Çekmecesi) açıldığında otomatik olarak Ön Yükleme ekranı görüntülenir.



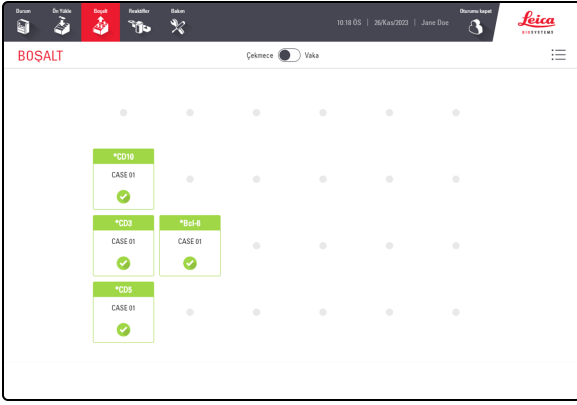
4. Lam işleme durumunu görüntülemek için **Durum** ögesine dokununuz. Lamlar Preload Drawer (Ön Yükleme Çekmecesi) içinde olduğunda ekranın Yüklendi alanında görüntülenir.



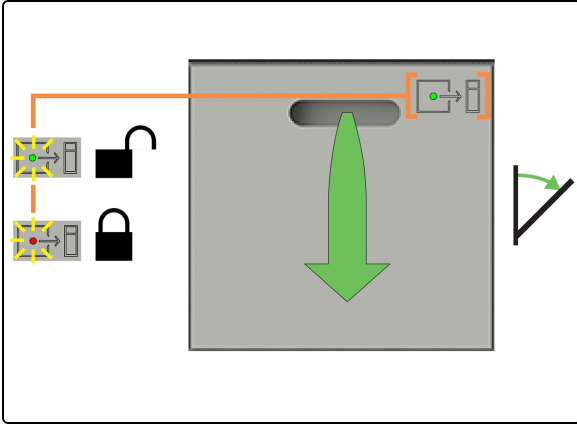
Lamlar Çalışma Yüzeyi üzerinde işlenirken, ekranın İşleniyor alanında görüntülenir.



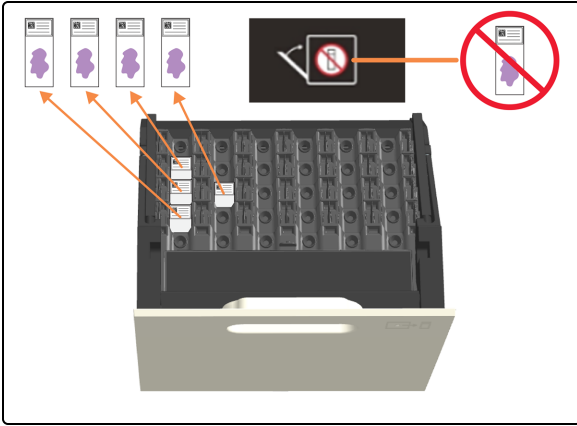
Lamlar Boşaltma Çekmecesindeyken, ekranın Tamamlandı alanında görüntülenir.



5. Boşaltma Çekmecesindeki her bir lamın konumunu görüntülemek için **Boşalt** ögesine dokununuz.

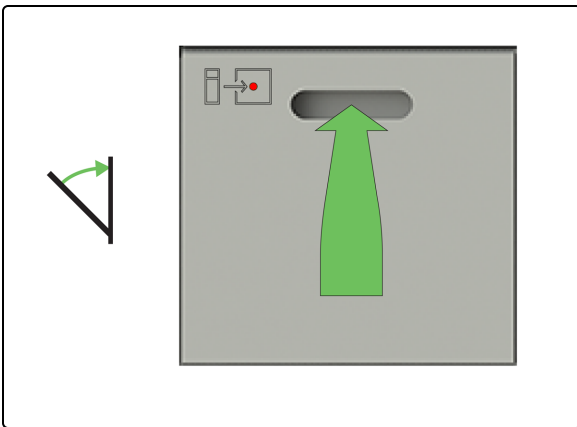


6. Boşaltma Çekmecesini durum LED'inin yeşil olduğunu kontrol edin, ardından çekmeceyi açmak için tutamağı çekin.



7. Boşaltma Çekmecesindeki tüm lamları çıkarın.

Sık sık **tüm** tamamlanmış lamları boşaltın. Boşaltma Çekmecesini kapasitesinin dolması işlemeyi aksatarak Tahmini Tamamlanma Süresini uzatabilir. Boşaltma Çekmecesini kapattığınızda içinde herhangi bir lam bulunmamalıdır.



8. Boşaltma Çekmecesini kapatın.



Lamları boşaltmayı tamamladığınızda artık kullanılması gerekmeyen reaktif olup olmadığını belirlemek için Reaktifler ekranına bakın. Varsa, reaktifleri boşaltın ve reaktif buharlaşmasını önlemek için Reagent Container (Reaktif Kabı) başlıklarını sıkıca kapatın. Hemen reaktifleri etikette veya reaktif veri sayfasında belirtildiği şekilde saklayın.

4

Temizlik ve bakım



UYARI: İşleme modülüne bakım yapmadan önce gerekli minimum kişisel koruyucu ekipmanı kullanmanız gerekir. Bkz. **Genel dikkat edilecek hususlar.**

Bu kısımda:

4.1 Bakım planları	110
4.2 DI Water (DI Su) Kabını yeniden doldurma	113
4.3 Alcohol (Alkol) Kabını yeniden doldurma	115
4.4 Lotu Takip Edilen Toplu Kapları yeniden doldurma	118
4.5 Atık Kaplarını boşaltma	121
4.6 BOND-PRIME Cleaning Kit'i (BOND-PRIME Temizlik Kiti) kullanma	123
4.7 Bakımı Başlatma	127
4.8 ARC Module'lerin (ARC Modülü) iç yüzeyini silme	129
4.9 Reagent Platform (Reaktif Platformu) ve ARC Bank (ARC Sırası) yüzeylerini silme	133
4.10 Emme Kabını temizleme	137
4.11 Emme Kabını değiştirme	141
4.12 Lam Çekmecesi Parçalarını, Atık Giderlerini ve Karterlerini ve Alım Filtresini temizleme	145
4.13 Yıkama/Hazırlama İstasyonlarını temizleme	154
4.14 BOND-PRIME ARC Refresh Kit (BOND-PRIME ARC Yenileme Kiti) kullanma	158
4.15 Bulk DI Water Container'ı (Toplu DI Su Kabı) temizleme	164
4.16 Kilitli Bulk Reagent Container'ları (Toplu Reaktif Kabı) Temizleme	167
4.17 Atık Kaplarını Temizleme	177
4.18 Karter Tepsisini temizleme	180
4.19 Bakımı durdurma	182
4.20 İşleme modülünü kapatma	184
4.21 Güç kaynağı sigortalarını değiştirme	186

4.1 Bakım planları

4.1.1 Önleyici servis hatırlatması

BOND-PRIME İşleme Modülünü kullanırken sızıntılar ve aşınmış veya hasarlı parçalar bakımından kontrol edin. Bu kullanım kılavuzu, bazı parçaların nasıl temizleneceğini ya da değiştirileceğini anlatan talimatlar içermektedir. Diğer parçaları onarmak veya değiştirmek gerekiyorsa müşteri desteğine bildirimde bulunun.

Bir Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd servis mühendisi tarafından BOND-PRIME İşleme Modülüne düzenli olarak önleyici bakım yapılmalıdır.

Yılda bir veya 20.000 lamda bir (hangisi önce gerçekleşirse) önleyici bakım yaptırın.

4.1.2 Temizlik ve bakım planı

Her bir işleme modülünde haftada yaklaşık 300 lam boyuyorsanız bu planı kullanın. Bundan daha fazla lam kullanıyorsanız müşteri desteğine danışın. Size özelleştirilmiş bir plan sağlayabilirler. Ayrıca bkz. [4 Temizlik ve bakım](#).



Haftada 300'den fazla lam boyuyorsanız aşağıda yıldızla işaretlenmiş görevleri daha sık yerine getirin.

Her Gün

- **Durum Ekranı** bölümündeki **İşlem Sırası ve Uyarı Başlığı** ögesini inceleyin ve gerekli **Temizlik ve bakım** işlemlerini yapın. Bunu iş günü boyunca işleme modülüne döndüğünüz her seferde tekrarlamalısınız.

Gerektiğinde (işleme modülünün BOND Kontrolörüne bağlı olduğundan emin olun)

- Bulk DI Water Container'ı (Toplu DI Su Kabı) yeniden doldurma
- Bulk Alcohol Container'ı (Toplu Alkol Kabı) yeniden doldurma
- Bulk Reagent Container'ları (Toplu Reaktif Kabı) yeniden doldurma
- Atık Kaplarını boşaltma

Haftada Bir

- ARC Module'lerin (ARC Modülü) iç yüzeyini silme
- Reagent Platform (Reaktif Platformu) ve ARC Bank (ARC Sırası) yüzeylerini silme
- Emme Kabını temizleme

2 Ayda Bir

- Emme Kabını deęiřtirme (3400 lam)
- Lam Çekmecesi Parçalarını, Atık Giderlerini ve Karterlerini ve Bořaltma Çekmecesi Alım Filtresini temizleme*
- Yıkama/Hazırlama İstasyonlarını temizleme*
- Karter Tepsisini temizleme*
- Dıř yüzeyleri toz alıcıyla veya bezle silme
- Barkod Tarayıcısını (Kaputtaki) hav bırakmayan ve DI water (DI su) ile nemlendirilmiş bir bezle temizleme

6 Ayda Bir (veya işleme modülü 14 günden uzun süredir beklemedeyse)

- Atık kapları da dahil olmak üzere tüm toplu kapları temizleme
- El tipi barkod tarayıcısını (BOND Kontrolörüne baęlı olan) hav bırakmayan ve DI water (DI su) ile nemlendirilmiş bir bezle temizleme

8 Ayda Bir/7500 lam

- BOND-PRIME ARC Refresh Kit'i (BOND-PRIME ARC Yenileme Kiti) kullanma (Mixing Well Plate'i (Karıřtırma Kuyucuęu Plakası) ve ARC Covertile'ları deęiřtirme)

İřlem Sırasında bildirim gördüğünüzde

- BOND-PRIME Cleaning Kit'i (BOND-PRIME Temizlik Kiti) kullanma



Kullanım sayısı 17 ile 23 arasında olduęunda ARC Module'ler (ARC Modülü) temizlenmelidir.

Temizlik ve bakım görevlerinin tam listesi için bkz. [4 Temizlik ve bakım](#).



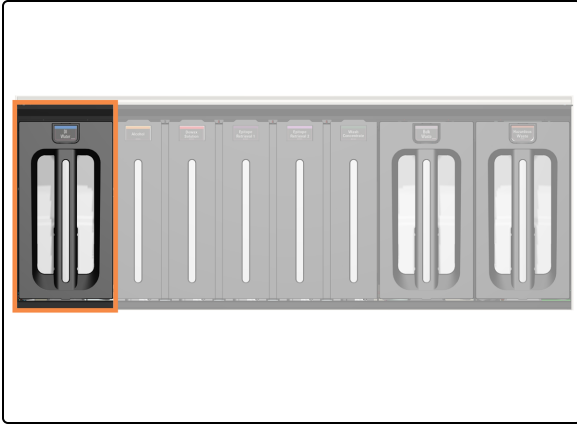
Sonraki sayfayı yazdırıp kontrol listesi olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca BOND-PRIME Wash Solution Concentrate, ER1, ER2 ve Dewax Solution lot numaralarını kaydedebilirsiniz.

4.1.3 Temizlik ve bakım kontrol listesi

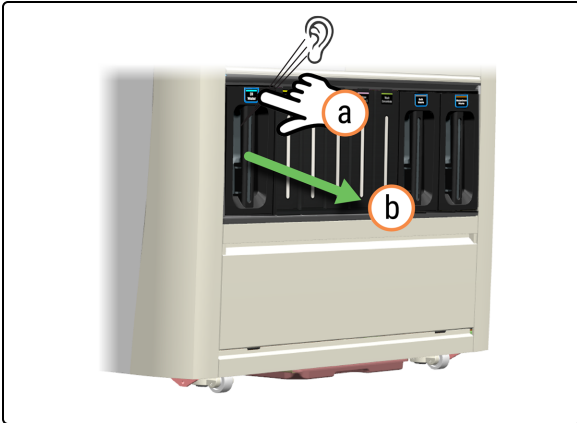
GÜNLÜK/GEREKTİĞİNDE	Pzt	Salı	Çar	Per	Cum	Cmt	Paz
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
İşlem Sırasını ve Uyarı Başlığını inceleme							
Gerektiğinde toplu kapları doldurma/boşaltma							
BOND-PRIME Wash Solution Concentrate lot numarası							
ER1 lot numarası							
ER2 lot numarası							
Dewax Solution lot numarası							
HAFTADA BİR							
ARC Module'lerin (ARC Modülü) iç yüzeyini silme	<input type="checkbox"/>						
Reagent Platform (Reaktif Platformu) ve ARC Bank (ARC Sırası) yüzeylerini silme	<input type="checkbox"/>						
Emme Kabını temizleme	<input type="checkbox"/>						
2 AYDA BİR							
Emme Kabını değiştirme (3400 lam)	<input type="checkbox"/>						
Lam Çekmecesi Parçalarını, Atık Giderlerini ve Karterlerini ve Boşaltma Çekmecesi Alım Filtresini temizleme*	<input type="checkbox"/>						
Yıkama/Hazırlama İstasyonlarını temizleme*	<input type="checkbox"/>						
Karter Tepsisini temizleme*	<input type="checkbox"/>						
Dış yüzeyleri temizleme	<input type="checkbox"/>						
Barkod Tarayıcısını (Kaputtaki) temizleme	<input type="checkbox"/>						
6 AYDA BİR							
Tüm toplu kapları ve atık kaplarını temizleme	<input type="checkbox"/>						
El tipi barkod tarayıcısını (BOND Kontrolöründeki) temizleme	<input type="checkbox"/>						
8 AYDA BİR/7500 lam							
BOND-PRIME ARC Refresh Kit (BOND PRIME ARC Yenileme Kiti) kullanma	<input type="checkbox"/>						
BİLDİRİM							
BOND-PRIME Cleaning Kit'i (BOND-PRIME Temizlik Kiti) kullanma	<input type="checkbox"/>						* Gerekirse bu görevleri daha sık yerine getirin.

_____ tarihinde başlayan ve _____ tarihinde biten hafta, _____ ayı

4.2 DI Water (DI Su) Kabını yeniden doldurma



DI Water (DI Su) Kabı, Toplu Kap Kabininin solunda yer alır.



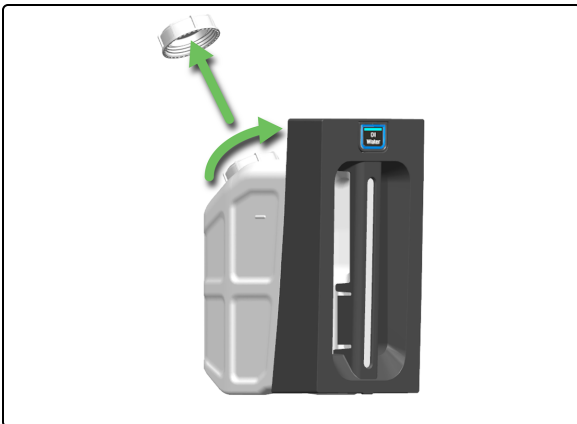
1. DI Water (DI Su) Kabını çıkarın.
 - a. DI Water (DI Su) düğmesine basın.
 - b. Kabı işleme modülünden çekerek çıkarın.



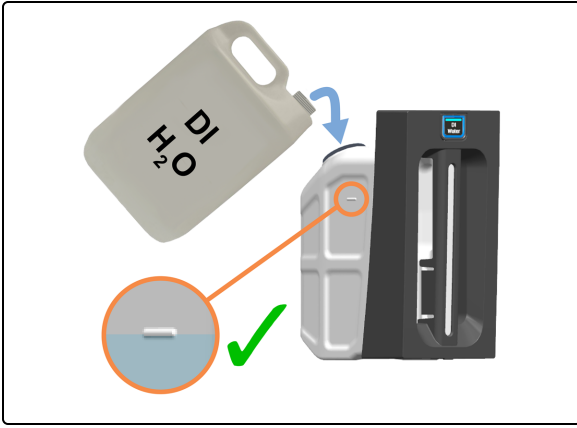
UYARI: DI Water (DI Su) Kabını kaldırırken iki elinizi birden kullanın.



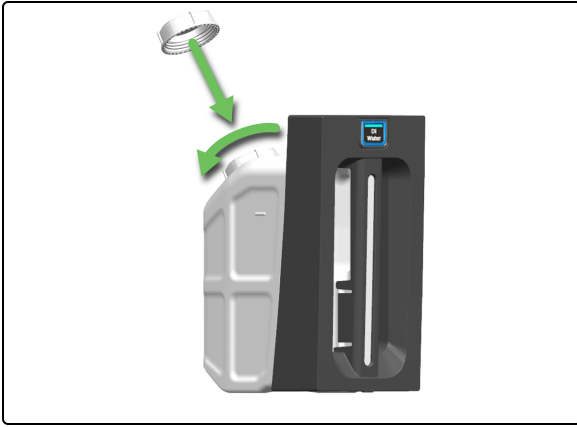
DI Water (DI Su) kullanılabilmesi için kabı hızlıca geri yerleştirin.



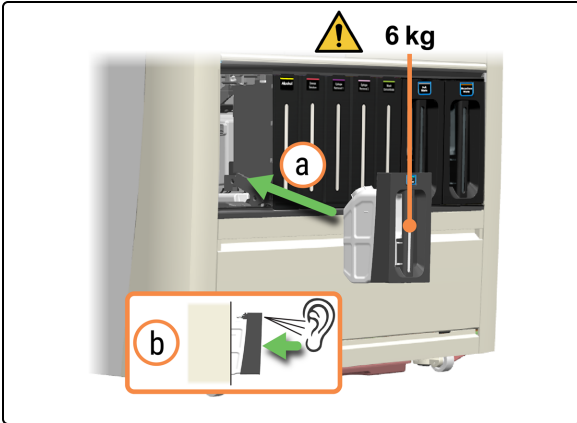
2. DI Water (DI Su) Kabının kapağını çıkarın.



3. Dolu DI Water (DI Su) Kabını yerine yerleştirin.



4. DI Water (DI Su) Kabının kapağını yerine takın.



5. Dolu DI Water (DI Su) Kabını yerine yerleştirin.
- İki elinizi birden kullanarak DI Water (DI Su) Kabını işleme modülünün içindeki yerine yerleştirin.
 - Kabın yerine kilitlendiğini doğrulamak için klik sesi duymaya çalışın.

Kabın tam olarak yerleştirildiğinden emin olun. Bunun yapılmaması Preload Drawer'da (Ön Yükleme Çekmecesi) lamaların reddedilmesine neden olabilir.

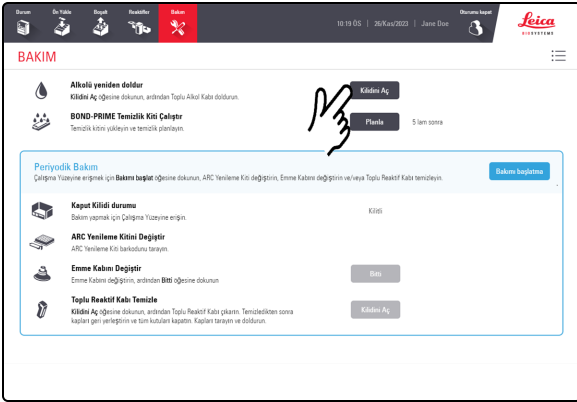
4.3 Alcohol (Alkol) Kabını yeniden doldurma



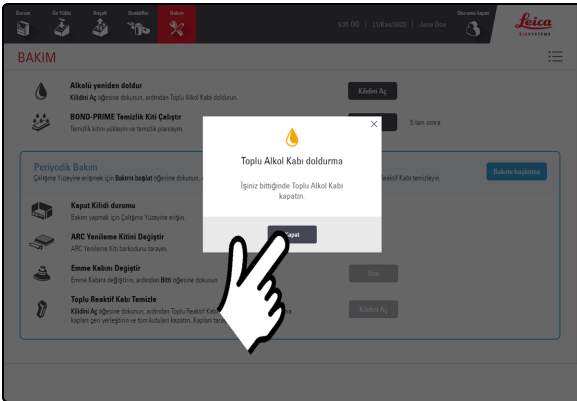
Bu prosedüre başlamadan önce işleme modülünde oturum açtığınızdan emin olun. Bkz. [2.1 Oturum açma ve kapatma](#).



1. Bakım öğesine dokununuz.



2. Alkolü yeniden doldur öğesinin yanındaki Kilidini Aç düğmesine dokununuz.



Bulk Alcohol Container'ı (Toplu Alkol Kabı) doldurmanızı isteyen bir açılır pencere görüntülenecektir.



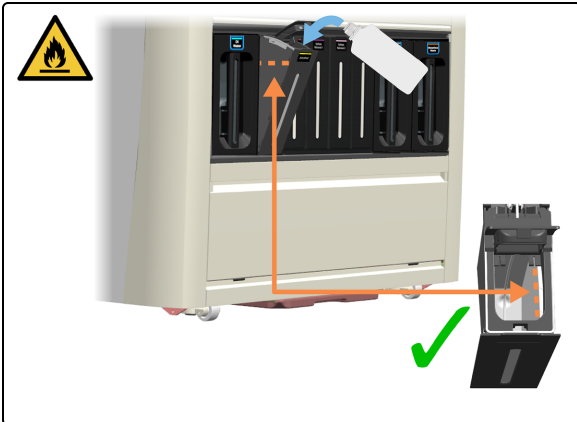
Kabın kilidi açıldığında bir klik sesi duyacaksınız. Yalnızca 30 saniye boyunca kilidi açık kalacaktır.



3. Kabın üstünü kendinize doğru çekin.



4. Kap başlığını açın.



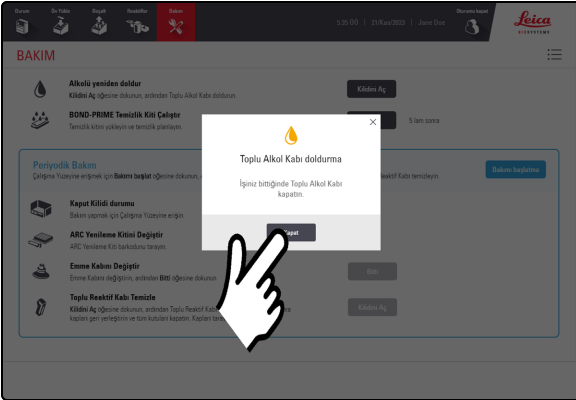
5. Alcohol'u (alkol) toplu kabın maksimum dolun çizgisine kadar doldurun.



6. Kap başlığını kapatın.



7. Kabi işleme modülünün içine itin.

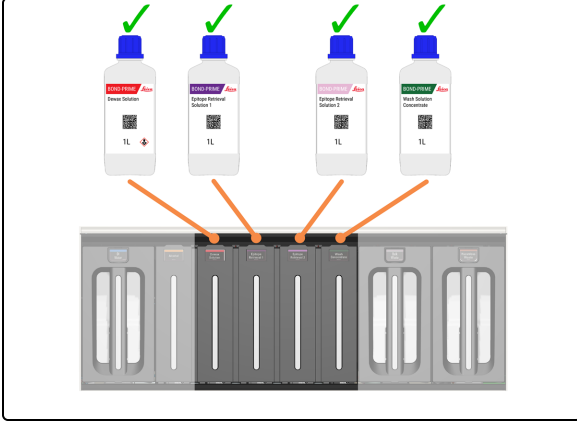


8. Kapat öğesine dokunun.

4.4 Lotu Takip Edilen Toplu Kapları yeniden doldurma

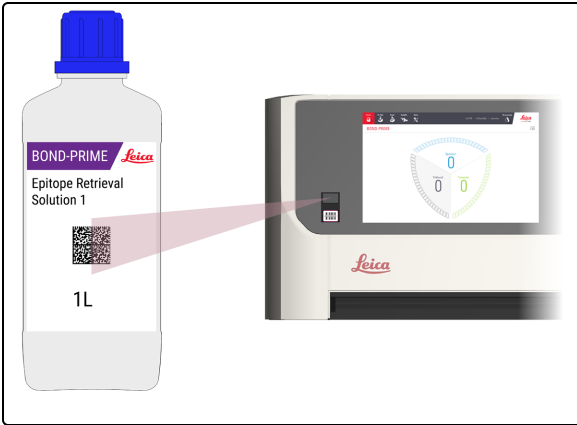


Bu prosedüre başlamadan önce işleme modülünde oturum açtığınızdan emin olun. Bkz. [2.1 Oturum açma ve kapatma](#).



BOND-PRIME şu Lotu Takip Edilen Toplu Kaplara sahiptir:

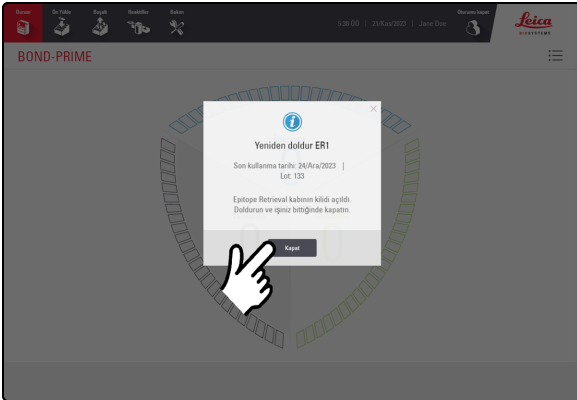
- Dewax Solution
- ER1
- ER2
- Wash Concentrate (Wash Konsantresi)



1. Lot numarası takibinin gerçekleşmesi için besleme şişesindeki barkodu tarayın.



Lazeri etkinleştirmek için elinizi tarayıcının önünde sallayın. Lazeri şişe üzerindeki 2D barkodun üzerine konumlandırmak için şişenin yansımalarını da (Kaputta) kullanabilirsiniz.



2. Kapat öğesine dokununuz.



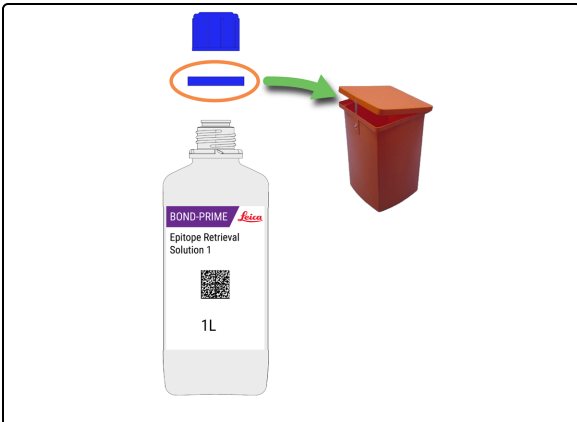
Kabin kilidi açıldığında bir klik sesi duyacaksınız. Yalnızca 30 saniye boyunca kilidi açık kalacaktır.



3. Kabin üstünü kendinize doğru çekin.



4. Kap başlığını açın.



5. Şişeyi açın ve laboratuvar prosedürlerine uygun şekilde kurcalama önleyici conta halkasını atın.



6. Çözeltiyi toplu kapların maksimum dolun çizgisine kadar doldurun.



Herhangi bir reaktifi suyla **SEYRELTMEYİN**.



UYARI: Dökülmeyi önlemek için, işleme modülünden uzaktayken Bulk Reagent Container'ları (Toplu Reaktif Kabı) **YENİDEN DOLDURMAYIN**.



7. Kap başlığını kapatın.

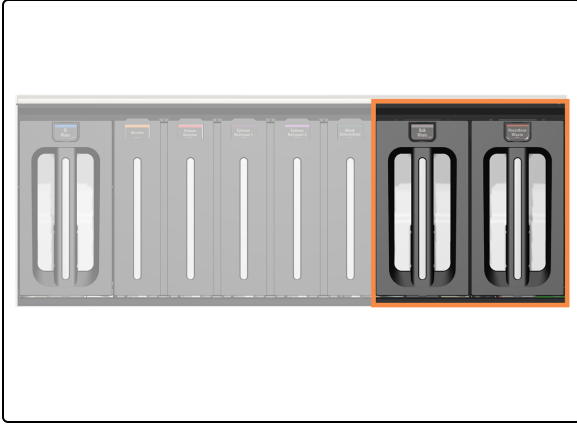


8. Kutuyu tekrar işleme modülünün içine itin.

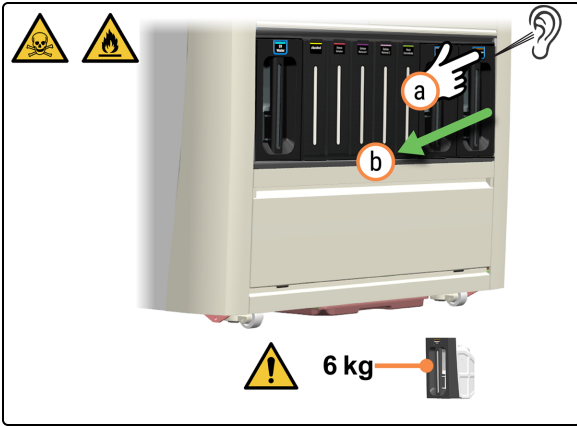
4.5 Atık Kaplarını boşaltma



UYARI: İşleme modülüne bakım yapmadan önce gerekli minimum kişisel koruyucu ekipmanı kullanmanız gerekir. Bkz. **Genel dikkat edilecek hususlar.**



Atık Kapları, Toplu Kap Kabininin sağında yer alır.



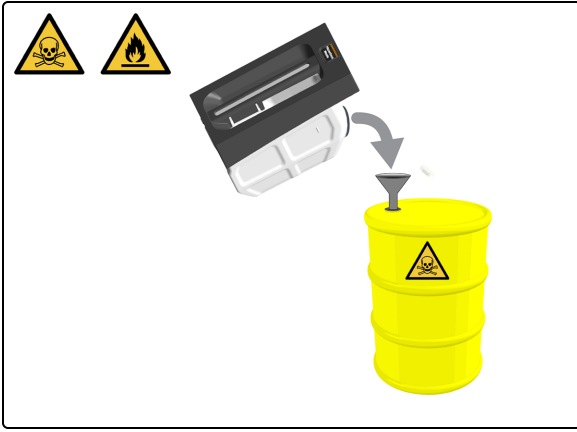
1. Atık kabını çıkarın.
 - a. Atık düğmesine basın.
 - b. Kabı işleme modülünden çekerek çıkarın.



UYARI: Atık kaplarını kaldırırken iki elinizi birden kullanın.



2. Atık Kabinin kapağını çıkarın.



3. Kabın içeriğini laboratuvar prosedürlerinize uygun şekilde boşaltın. Atık kapasitesi olması için kabı hızlıca işleme modülüne geri yerleştirin.



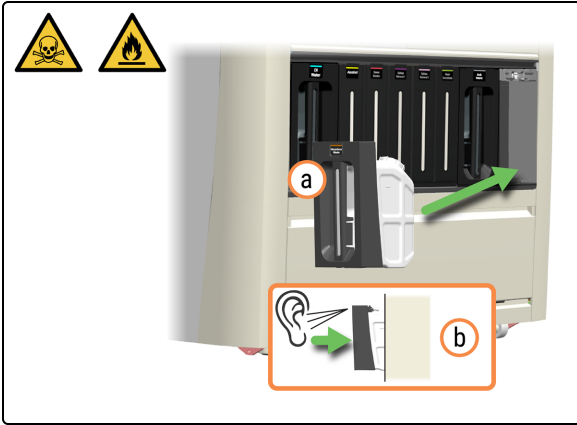
Tehlikeli atık örneği gösterilmektedir.



UYARI: Atığı laboratuvar tesisi için geçerli olan tüm prosedürlere ve devlet düzenlemelerine uygun şekilde atın.



4. Atık Kabı kapağını yerine takın.



5. Atık Kabını yerine yerleştirin.
- Atık Kabını işleme modülündeki yerine yerleştirin.
 - Kabın yerine kilitlendiğini doğrulamak için klik sesi duymaya çalışın.

Kabın tam olarak yerleştirildiğinden emin olun. Bunun yapılmaması Preload Drawer'da (Ön Yükleme Çekmecesi) lamların reddedilmesine neden olabilir.

4.6 BOND-PRIME Cleaning Kit'i (BOND-PRIME Temizlik Kiti) kullanma

Gerekirse:

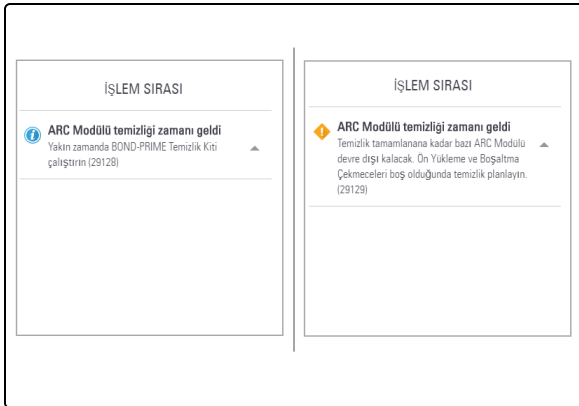
- 4.2 DI Water (DI Su) Kabını yeniden doldurma
- 4.3 Alcohol (Alkol) Kabını yeniden doldurma
- 4.4 Lotu Takip Edilen Toplu Kapları yeniden doldurma
- 4.5 Atık Kaplarını boşaltma



BOND-PRIME Cleaning Kit (BOND-PRIME Temizlik Kiti) önceden planlanamaz.



Bu prosedüre başlamadan önce işleme modülünde oturum açtığınızdan emin olun. Bkz. [2.1 Oturum açma ve kapatma](#).



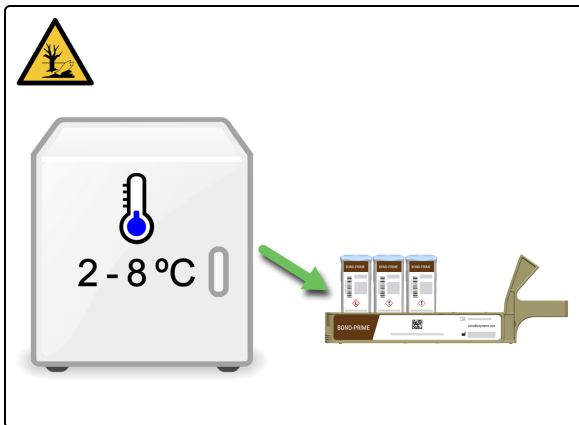
BOND-PRIME Cleaning Kit (BOND-PRIME Temizlik Kiti) çalıştırma vakti geldiğinde İşlem Sırasında bir mesaj görüntülenir. Kullanım sayısı 17 ile 23 arasında olduğunda ARC Module'ler (ARC Modülü) temizlenmelidir.

BOND-PRIME Cleaning Kit (BOND-PRIME Temizlik Kiti) BOND Kontrolöre kaydedilmelidir (*BOND 7 Kullanım Kılavuzuna* bakın).

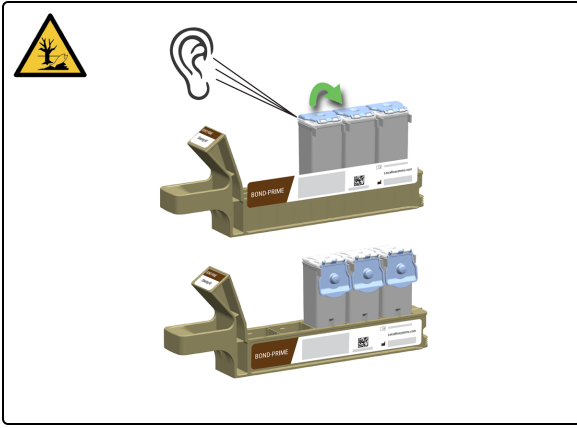
Temizlik tamamlanana kadar bazı ARC Module'ler (ARC Modülü) devre dışı kalacak.



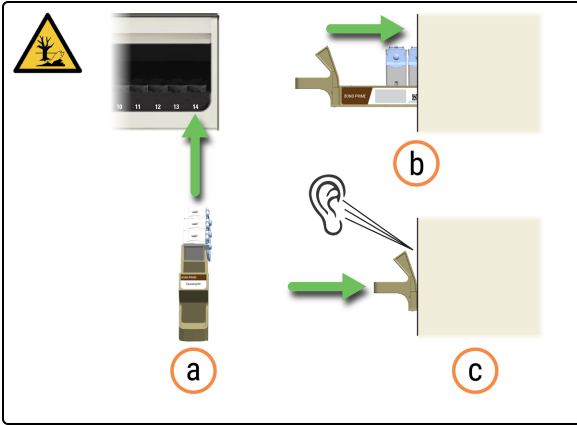
Temizlik başlatmadan önce Preload Drawer'da (Ön Yükleme Çekmecesine) ve Boşaltma Çekmecesinde lam olmadığından emin olun.



1. BOND-PRIME Cleaning Kit'i (BOND-PRIME Temizlik Kiti) içeren Reagent Tray'i (Reaktif Tepsisi) alın.



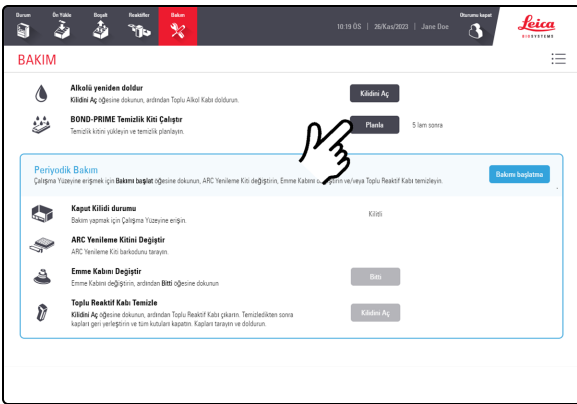
2. Reagent Container (Reaktif Kabı) Başlığını açın. Başlık açıldığında bir klik sesi duyacaksınız.



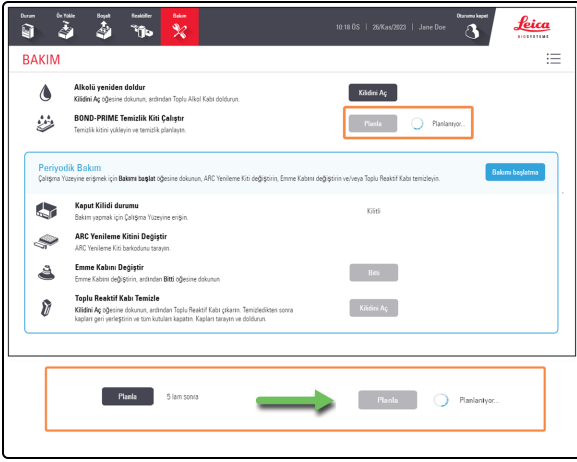
3. Reagent Tray'i (Reaktif Tepsisi) işleme modülüne yerleştirin.
- Reagent Tray'i (Reaktif Tepsisi) işleme modülüne götürün.
 - Reagent Tray'i (Reaktif Tepsisi) Reagent Platform'un (Reaktif Platformu) içine itin.
 - Tepsinin doğru yerleştirildiğini doğrulamak için klik sesi duymaya çalışın.



BOND-PRIME Cleaning Kit (BOND-PRIME Temizlik Kiti), Reaktif ekranında görüntülenir.



4. BOND-PRIME Cleaning Kit (BOND-PRIME Temizlik Kiti) Çalıştır öğesinin yanındaki **Planla** öğesine dokununuz.

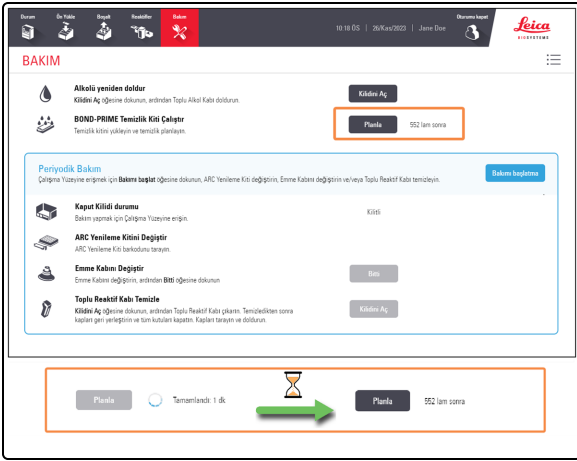


Planla düğmesi devre dışı bırakılır ve düğmenin yanındaki durum simgesi planlamanın sürmekte olduğunu belirtir.

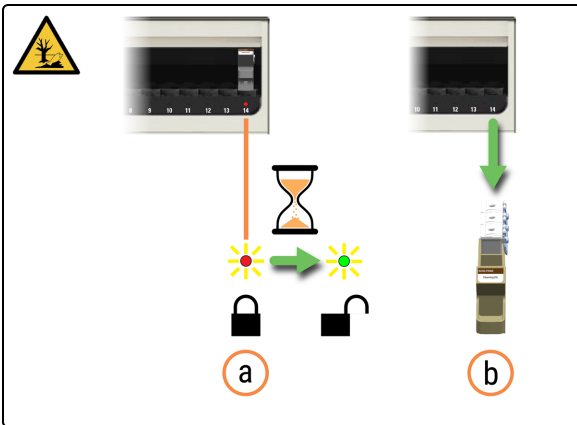
Planla düğmesi devre dışı kalıp dönen tekerlek görünür hale geldikten sonra yeni lamaları Preload Drawer'a (Ön Yükleme Çekmecesi) yükleyebilirsiniz.



Temizlik işleminin bitmesine kalan süre dakika cinsinden gösterilir.

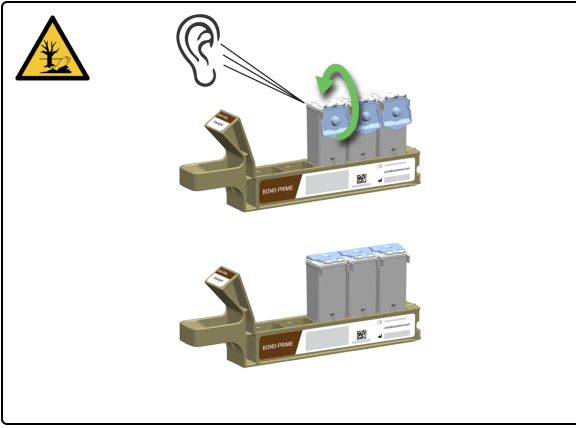


BOND-PRIME Cleaning Kit (BOND-PRIME Temizlik Kiti) tamamlandığında **Planla** düğmesi etkinleşir ve kitin tekrar tamamlanması gerekene kadar kaç lam işlenebileceği görüntülenir.

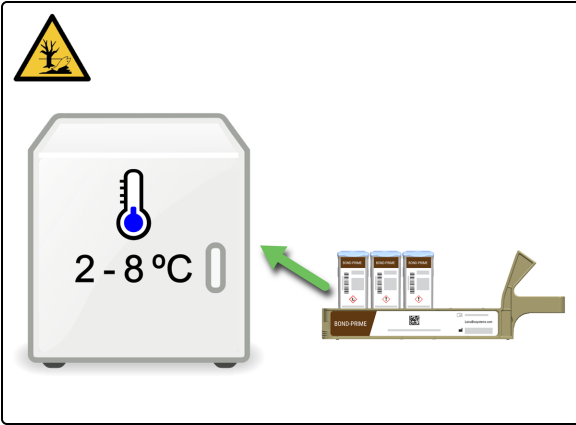


5. Reagent Tray'i (Reaktif Tepsisi) çıkarın.

- Reagent Lane (Reaktif Hattı) LED'inin kırmızı yandığını (artık kullanımda olmadığını belirtir) kontrol edin.
- Reagent Tray'i (Reaktif Tepsisi) Reagent Platform'dan (Reaktif Platformu) çıkarın.



6. Reagent Container (Reaktif Kabı) Başlığını kapatın. Başlık sabitlendiğinde bir klik sesi duyacaksınız.



7. Reagent Container'ları (Reaktif Kabı) 2°C - 8°C'de saklayın.

4.7 Bakımı Başlatma

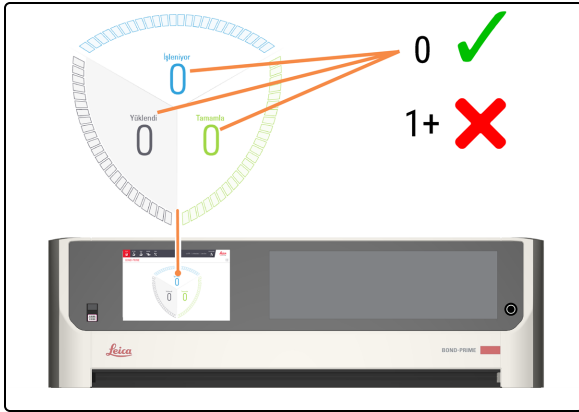
Çalışma Yüzeyine erişmek, Bulk Reagent Container'ları (Toplu Reaktif Kabı) temizlemek, Emme Kabını değiştirmek veya BOND-PRIME ARC Refresh Kit (BOND-PRIME ARC Yenileme Kiti) kullanmak için **Bakımı başlatma** prosedürünü kullanın.



Bu prosedüre başlamadan önce işleme modülünde oturum açtığınızdan emin olun. Bkz. [2.1 Oturum açma ve kapatma](#).



1. Durum öğesine dokunun.



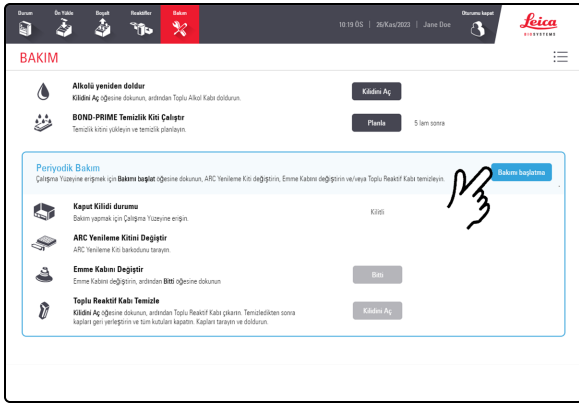
2. Aşağıdaki durumları doğrulamak için Durum ekranına bakın:

- İşlenmekte olan (İşleniyor) lam yok
- Preload Drawer'da (Ön Yükleme) (Yüklendi) ve Boşaltma Çekmecesinde (Tamamlandı) lam yok.

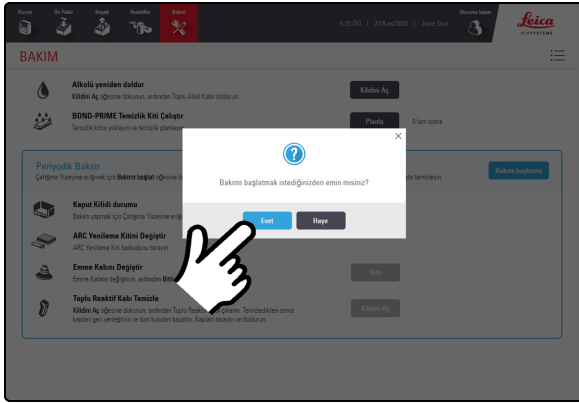
Bkz. [2.3 Durum Ekranı](#).



3. Bakım öğesine dokunun.



4. Bakımı Başlat öğesine dokununuz.



5. Evet öğesine dokununuz.

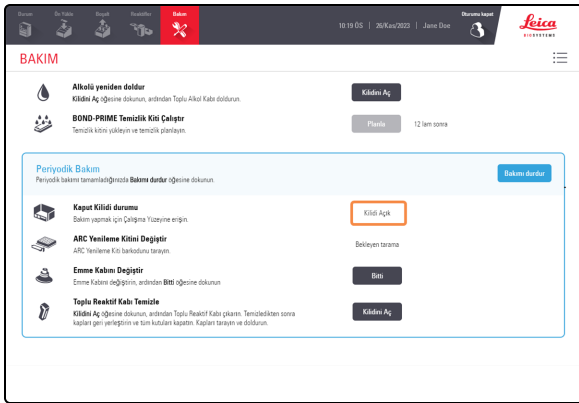
Evett öğesine dokunduktan sonra, işleme modülü Çalışma Yüzeyini bakım için hazırlarken ve Kaputun kilidini açarken bir bekleme süresi olacaktır.



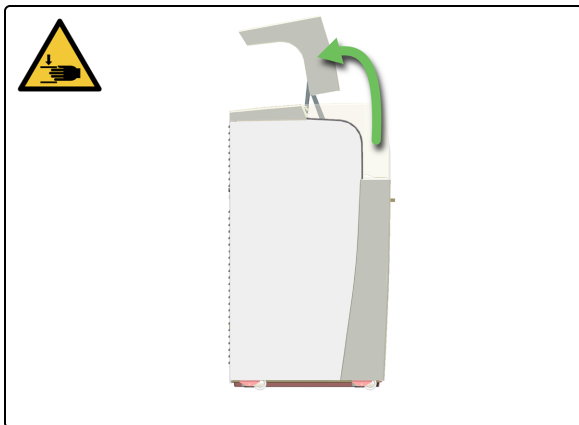
Bakım başlatıldığında işleme modülü otomatik olarak tüm ARC Module'leri (ARC Modülü) açar.



Kaputun kilidi açıldığında, Bakım ekranındaki **Kaput Kilidi Durumu Kilidi Açık** olarak değişecektir.



6. Kaputu açın.



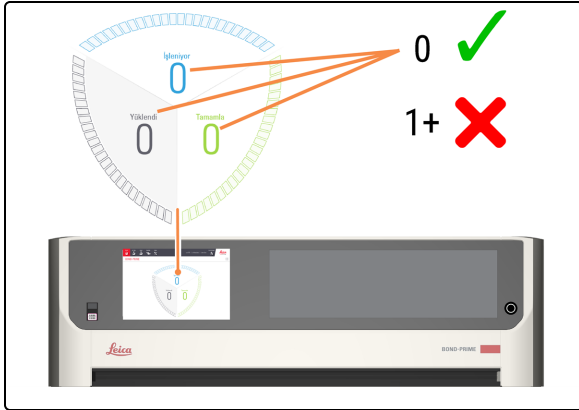
4.8 ARC Module'lerin (ARC Modülü) iç yüzeyini silme



UYARI: İşleme modülüne bakım yapmadan önce gerekli minimum kişisel koruyucu ekipmanı kullanmanız gerekir. Bkz. [Genel dikkat edilecek hususlar](#).



1. Durum öğesine dokununuz.



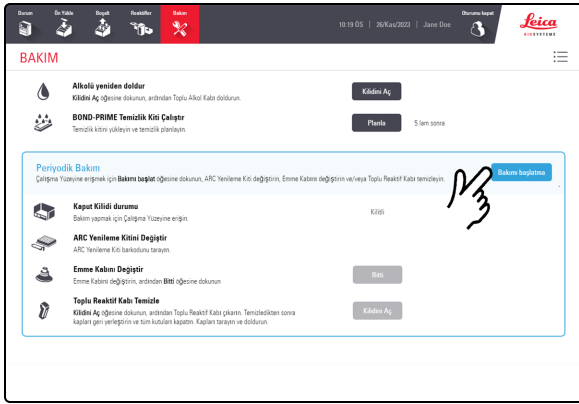
2. Aşağıdaki durumları doğrulamak için Durum ekranına bakın:

- İşlenmekte olan (İşleniyor) lam yok
- Preload Drawer'da (Ön Yükleme) (Yüklendi) ve Boşaltma Çekmecesinde (Tamamlandı) lam yok.

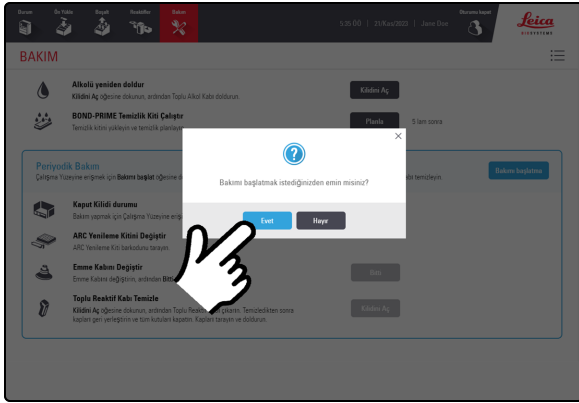
Bkz. [2.3 Durum Ekranı](#).



3. Bakım öğesine dokununuz.



4. Bakımı Başlat öğesine dokununuz.

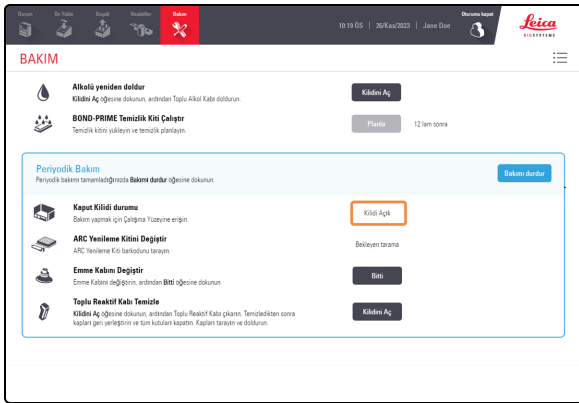


5. Evet öğesine dokununuz.

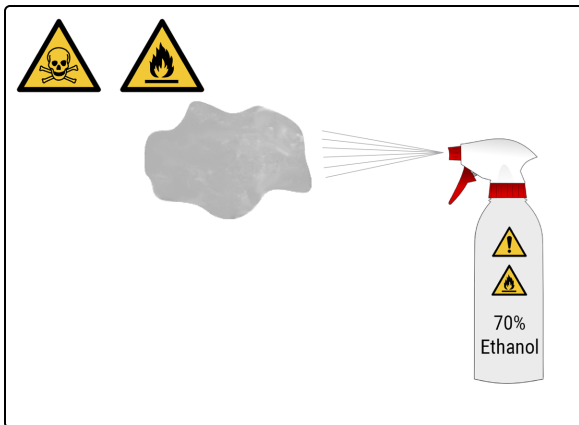
Evet öğesine dokunduktan sonra, işleme modülü Çalışma Yüzeyini bakım için hazırlarken ve Kaputun kilidini açarken bir bekleme süresi olacaktır.



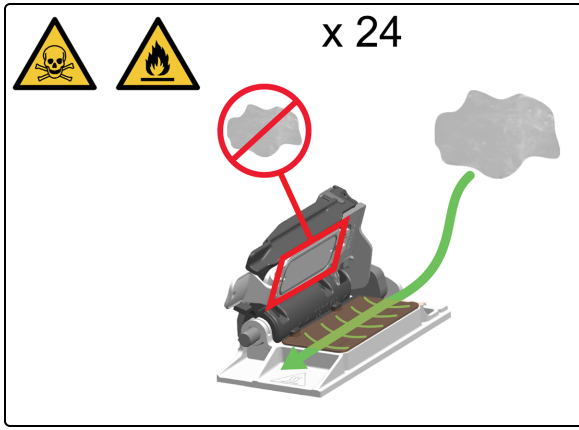
Bakım başlatıldığında işleme modülü otomatik olarak tüm ARC Module'leri (ARC Modülü) açar.



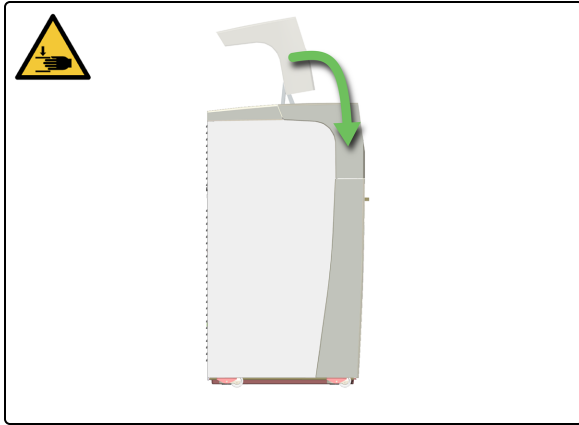
Kaputun kilidi açıldığında, Bakım ekranındaki **Kapat Kilidi Durumu Kilidi Açık** olarak değişecektir.



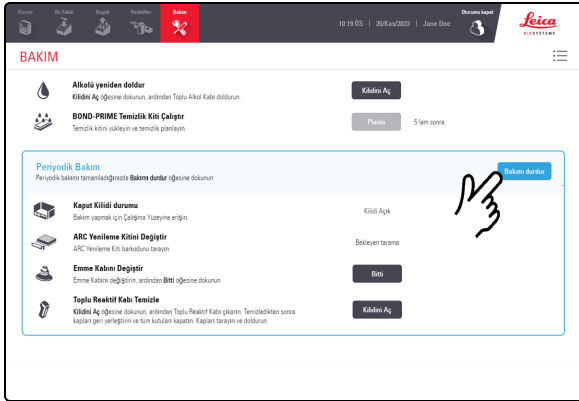
6. Temiz, hav bırakmayan bir bezi %70 etanol çözeltisiyle nemlendirin.



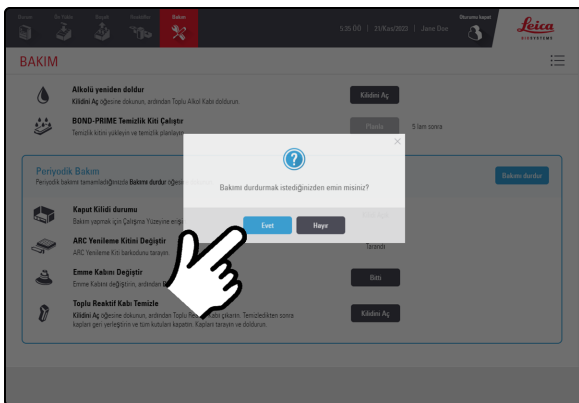
Partikülleri veya kalıntıyı gidermek için ARC Module'ü (ARC Modülü) arkadan öne doğru silin. Covertile'ı silmeyin, aksi takdirde Covertile Contası hasar görebilir.



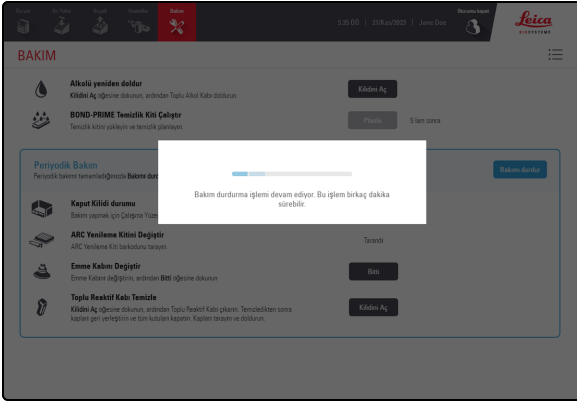
7. Artık Çalışma Yüzeyine erişmeniz gerekmiyorsa Kaputu kapatın ve bu prosedüre devam edin.



8. Bakımı durdur öğesine dokununuz.



9. Evet öğesine dokununuz.



İşleme modülü klinik çalışmaya dönmeye hazırlanırken bir bekleme süresi vardır.

Bakımı durdurduğunuzda işleme modülü otomatik olarak ARC Module'leri (ARC Modülü) kapatır ve Kaputu kilitler.

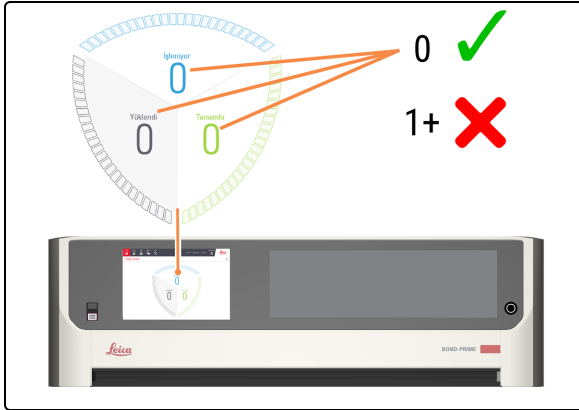
4.9 Reagent Platform (Reaktif Platformu) ve ARC Bank (ARC Sırası) yüzeylerini silme



UYARI: İşleme modülüne bakım yapmadan önce gerekli minimum kişisel koruyucu ekipmanı kullanmanız gerekir. Bkz. [Genel dikkat edilecek hususlar](#).



1. Durum öğesine dokunun.



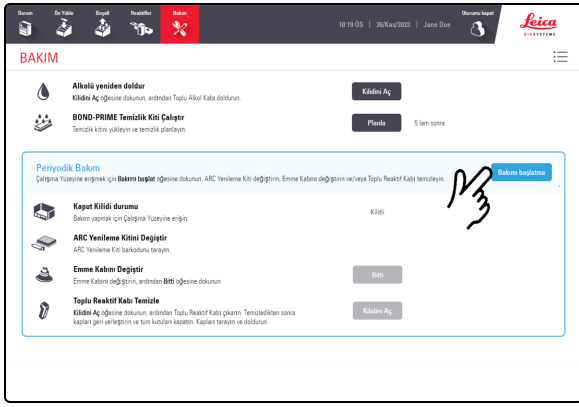
2. Aşağıdaki durumları doğrulamak için Durum ekranına bakın:

- İşlenmekte olan (İşleniyor) lam yok
- Preload Drawer'da (Ön Yükleme) (Yüklendi) ve Boşaltma Çekmecesinde (Tamamlandı) lam yok.

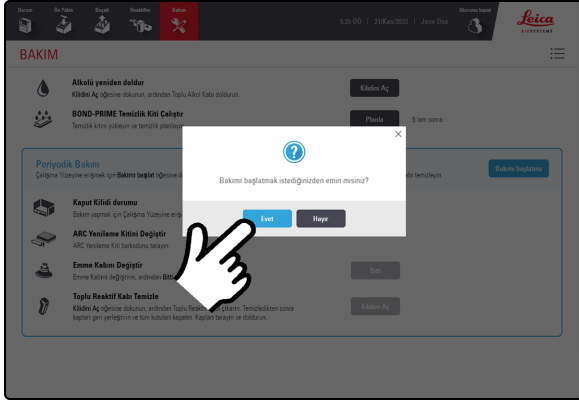
Bkz. [2.3 Durum Ekranı](#).



3. Bakım öğesine dokunun.



4. Bakımı Başlat öğesine dokununuz.



5. Evet öğesine dokununuz.

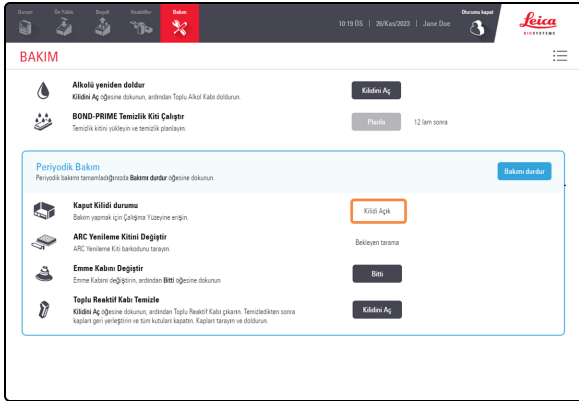
Evett öğesine dokunduktan sonra, işleme modülü Çalışma Yüzeyini bakım için hazırlarken ve Kaputun kilidini açarken bir bekleme süresi olacaktır.



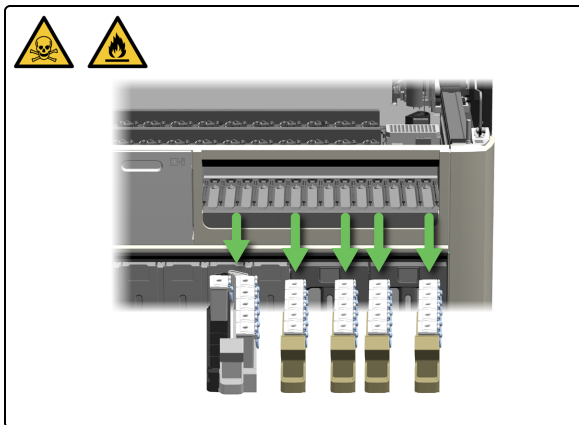
Bakım başlatıldığında işleme modülü otomatik olarak tüm ARC Module'leri (ARC Modülü) açar.

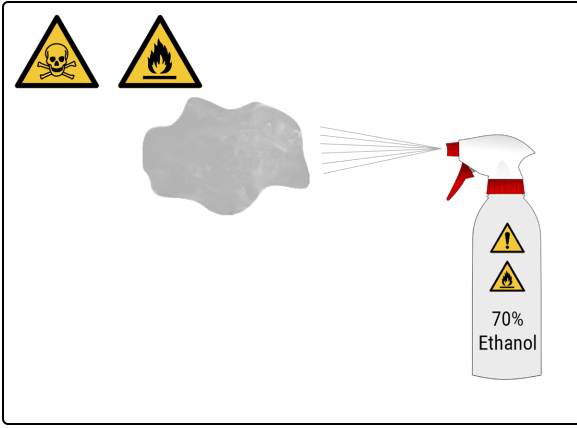


Kaputun kilidi açıldığında, Bakım ekranındaki **Kaput Kilidi Durumu Kilidi Açık** olarak değişecektir.

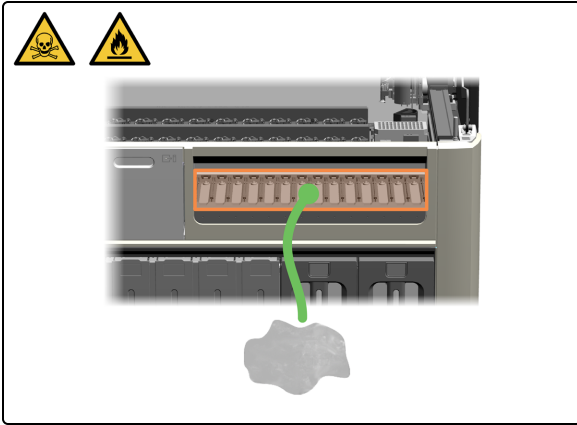


6. Tüm reagent tray'leri (reaktif tepsi) Reagent Platform'dan (Reaktif Platformu) çıkarınız.

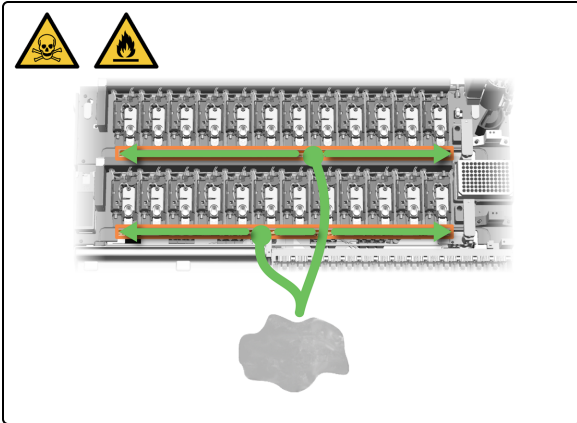




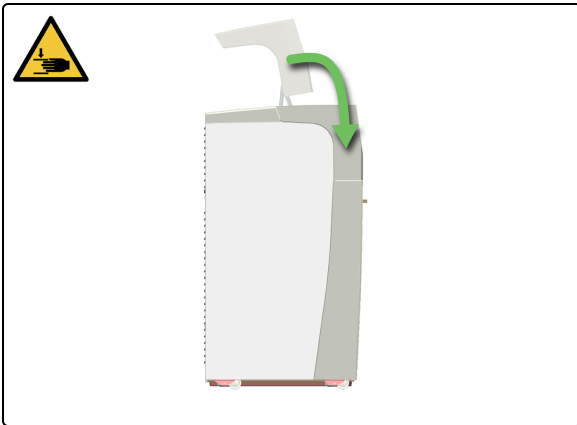
7. Temiz, hav bırakmayan bir bezi %70 etanol çözeltisiyle nemlendirin.



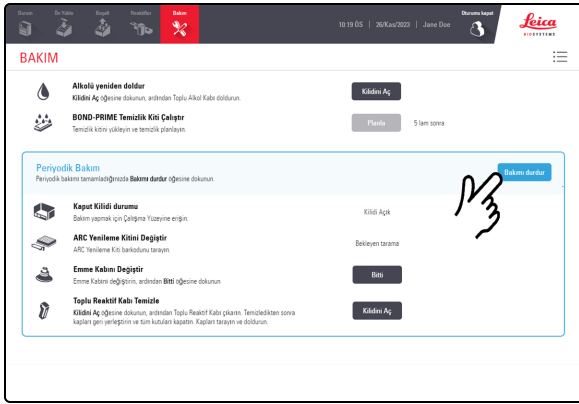
8. Reagent Platform (Reaktif Platformu) üzerindeki her bir hattın yüzeyini hav bırakmayan bir bezle silin.



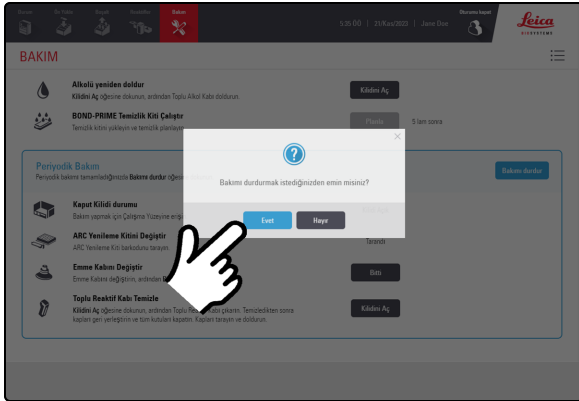
9. Her iki Yıkama Robotunun da raylarını silin.



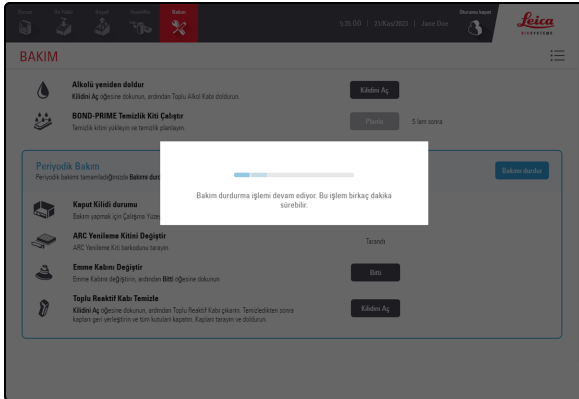
10. Artık Çalışma Yüzeyine erişmeniz gerekmiyorsa Kaputu kapatın ve bu prosedüre devam edin.



11. Bakımı durdur öğesine dokununuz.



12. Evet öğesine dokununuz.



İşleme modülü klinik çalışmaya dönmeye hazırlanırken bir bekleme süresi vardır.

Bakımı durdurduğunuzda işleme modülü otomatik olarak ARC Module'leri (ARC Modülü) kapatır ve Kaputu kilitler.

4.10 Emme Kabını temizleme



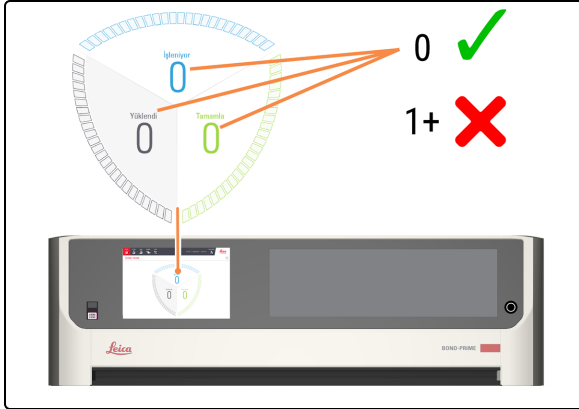
UYARI: İşleme modülüne bakım yapmadan önce gerekli minimum kişisel koruyucu ekipmanı kullanmanız gerekir. Bkz. [Genel dikkat edilecek hususlar](#).



Bu prosedüre başlamadan önce işleme modülünde oturum açtığınızdan emin olun. Bkz. [2.1 Oturum açma ve kapatma](#).



1. **Durum** öğesine dokunun.



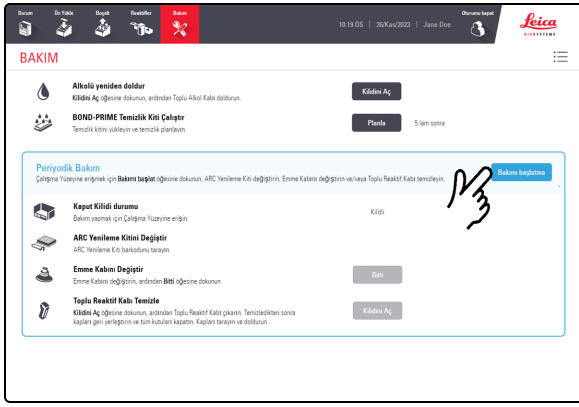
2. Aşağıdaki durumları doğrulamak için Durum ekranına bakın:

- İşlenmekte olan (İşleniyor) lam yok
- Preload Drawer'da (Ön Yükleme) (Yüklendi) ve Boşaltma Çekmecesinde (Tamamlandı) lam yok.

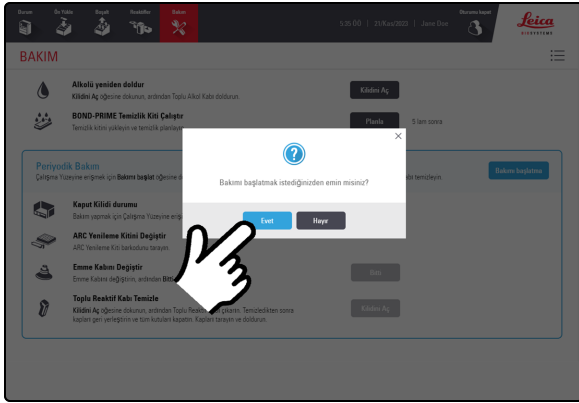
Bkz. [2.3 Durum Ekranı](#).



3. **Bakım** öğesine dokunun.



4. Bakımı Başlat öğesine dokununuz.



5. Evet öğesine dokununuz.

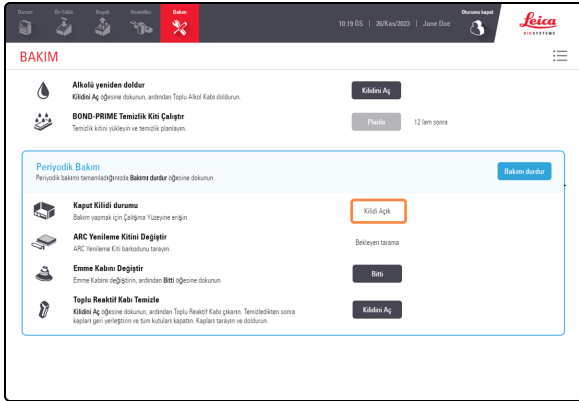
Evet öğesine dokunduktan sonra, işleme modülü Çalışma Yüzeyini bakım için hazırlarken ve Kaputun kilidini açarken bir bekleme süresi olacaktır.



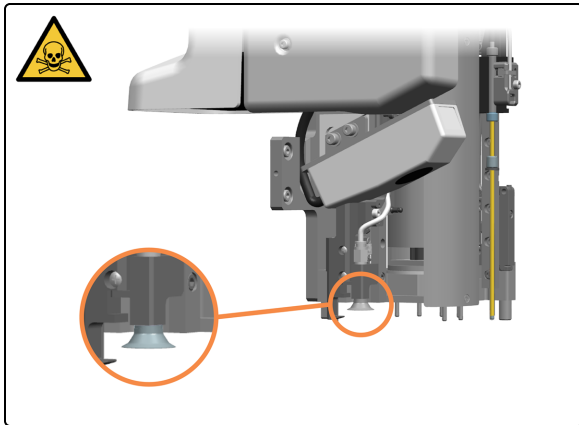
Bakım başlatıldığında işleme modülü otomatik olarak tüm ARC Module'leri (ARC Modülü) açar.



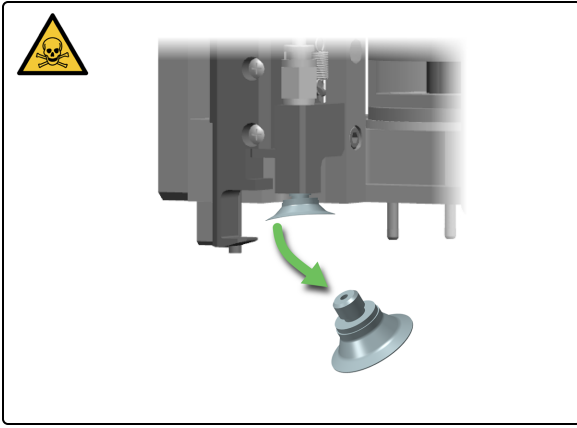
Kaputun kilidi açıldığında, Bakım ekranındaki **Kaput Kilidi Durumu Kilidi Açık** olarak değişecektir.



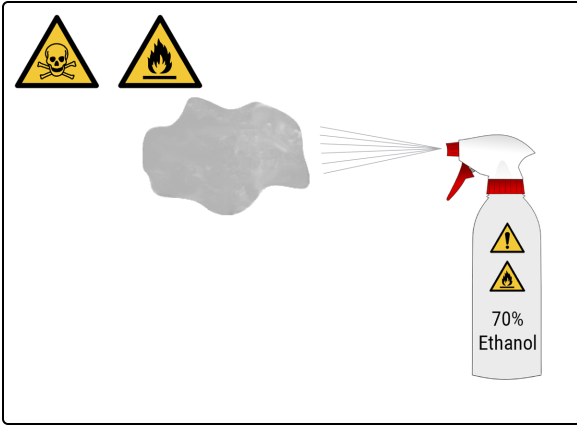
6. Robot Kafasının üzerindeki Emme Kabını bulun.



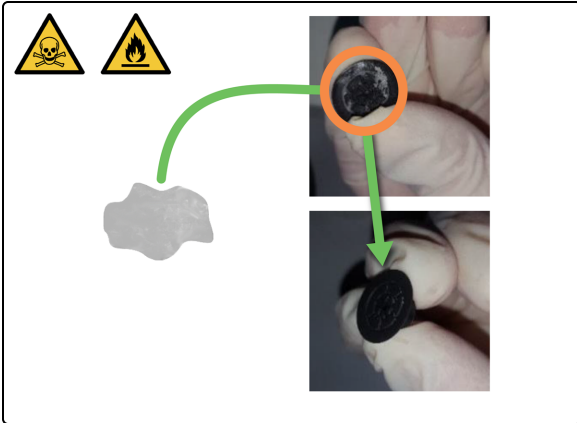
DİKKAT: Emme Kabının işleme modülünün içine düşmesini önlemek için High-Speed Robot'u (Yüksek Hızlı Robot) Reagent Platform'un (Reaktif Platformu) üzerinden dikkatlice hareket ettirin.



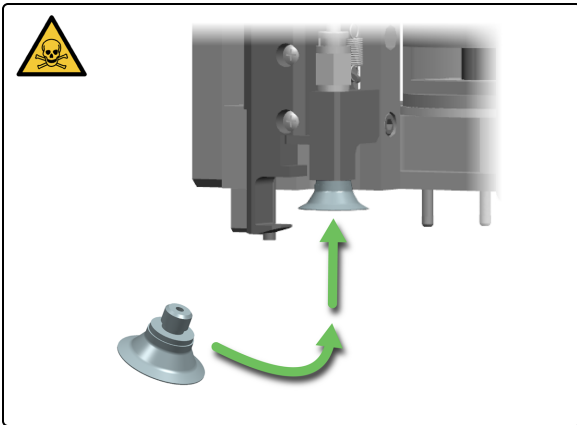
7. Emme Kabını Robot Kafasından çıkarın.



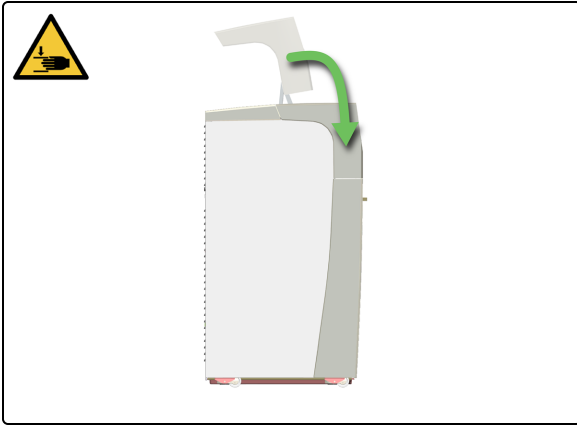
8. Temiz, hav bırakmayan bir bezi %70 etanol çözeltisiyle nemlendirin.



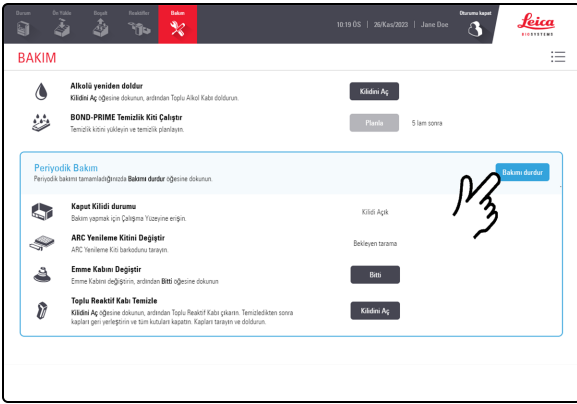
9. Kalıntı vaksı gidermek için Emme Kabını esnetin, ardından vaks kalıntısı kalmayana kadar hav bırakmayan bezle temizleyin. Küçük delikte herhangi bir tıkanıklık olmadığından emin olun.



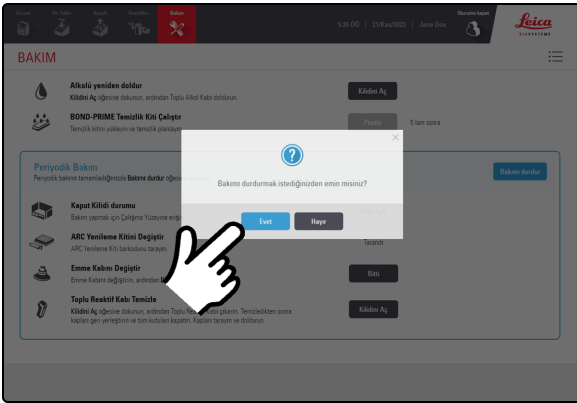
10. Emme Kabını Robot Kafasına yerleştirin.



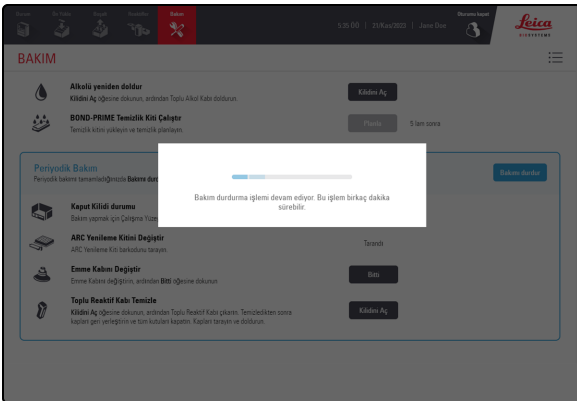
11. Artık Çalışma Yüzeyine erişmeniz gerekmiyorsa Kaputu kapatın ve bu prosedüre devam edin.



12. Bakımı durdur öğesine dokununuz.



13. Evet öğesine dokununuz.



İşleme modülü klinik çalışmaya dönmeye hazırlanırken bir bekleme süresi vardır.

Bakımı durdurduğunuzda işleme modülü otomatik olarak ARC Module'leri (ARC Modülü) kapatır ve Kaputu kilitlet.

4.11 Emme Kabını deęiřtirme

Her 3400 lamda bir veya 2 ayda bir (hangisi önce gerekleřirse) Emme Kabını deęiřtirin.

Emme Kabının iřleme modülünün iine düşmesini önlemek için High-Speed Robot'u (Yüksek Hızlı Robot) Reagent Platform'un (Reaktif Platformu) üzerinden dikkatlice hareket ettirin.



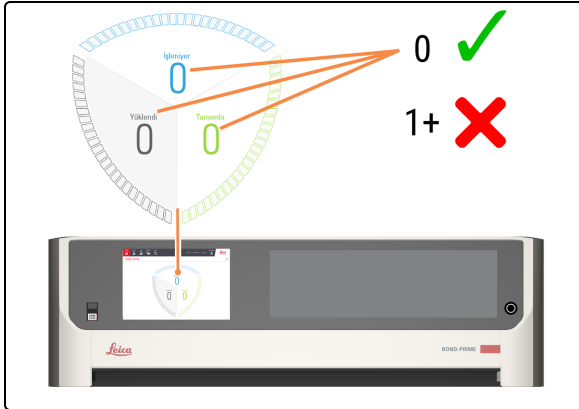
UYARI: İřleme modülüne bakım yapmadan önce gerekli minimum kişisel koruyucu ekipmanı kullanmanız gerekir. Bkz. [Genel dikkat edilecek hususlar](#).



Bu prosedüre başlamadan önce iřleme modülünde oturum açtıđınızdan emin olun. Bkz. [2.1 Oturum açma ve kapatma](#).



1. Durum öğesine dokununuz.



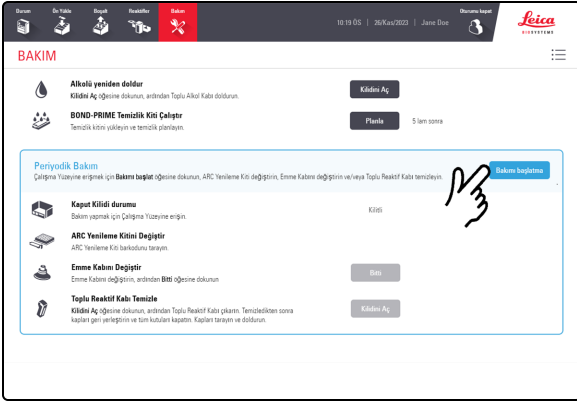
2. Ařađıdaki durumları dođrulamak için Durum ekranına bakınız:

- İřlenmekte olan (İřleniyor) lam yok
- Preload Drawer'da (Ön Yükleme) (Yüklendi) ve Bořaltma Çekmecesinde (Tamamlandı) lam yok.

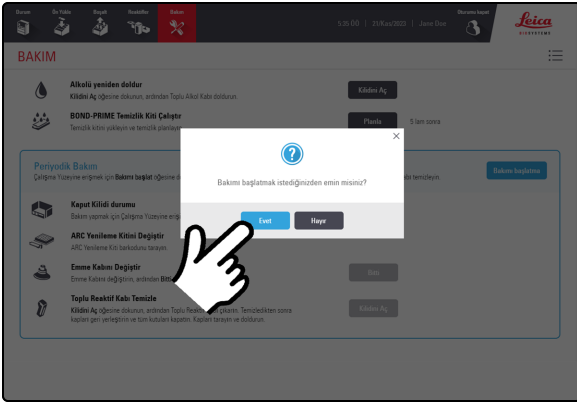
Bkz. [2.3 Durum Ekranı](#).



3. Bakım öğesine dokunun.



4. Bakımı Başlat öğesine dokunun.



5. Evet öğesine dokunun.

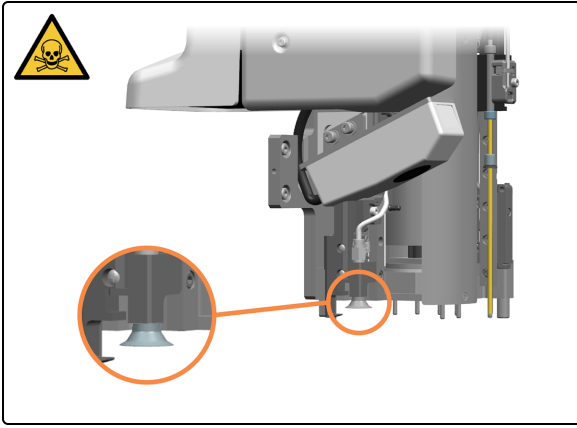
Evet öğesine dokunduktan sonra, işleme modülü Çalışma Yüzeyini bakım için hazırlarken ve Kaputun kilidini açarken bir bekleme süresi olacaktır.



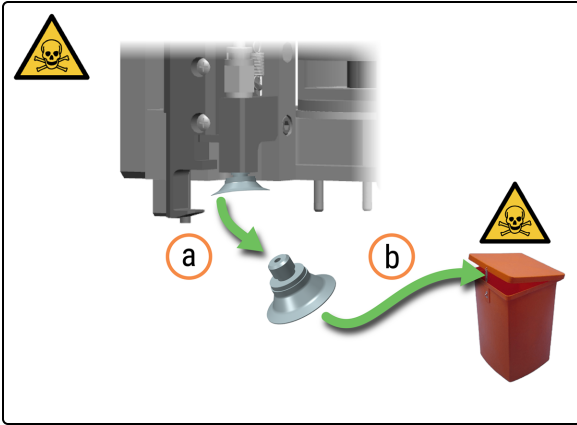
Bakım başlatıldığında işleme modülü otomatik olarak tüm ARC Module'leri (ARC Modülü) açar.



Kaputun kilidi açıldığında, Bakım ekranındaki **Kaput Kilidi Durumu Kilidi Açık** olarak değişecektir.

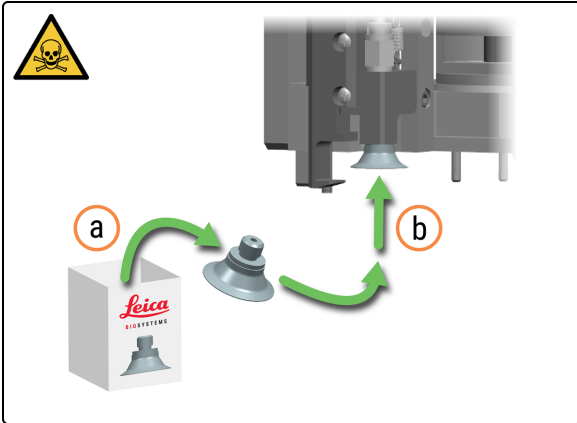


6. Emme Kabını bulun.



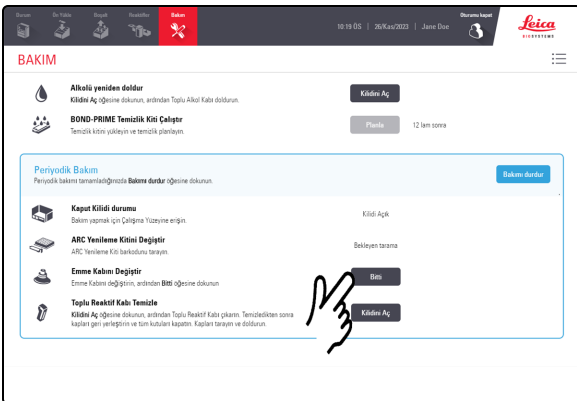
7. Emme Kabını çıkarın.

- Emme Kabını Robot Kafasından ayırın.
- Emme Kabını laboratuvar prosedürlerine uygun şekilde atın.

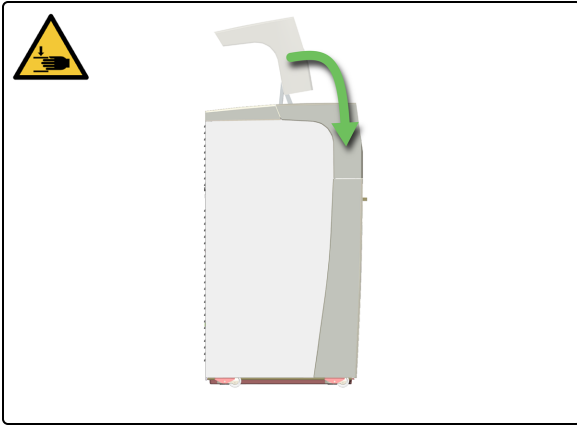


8. Yeni Emme Kabını takın.

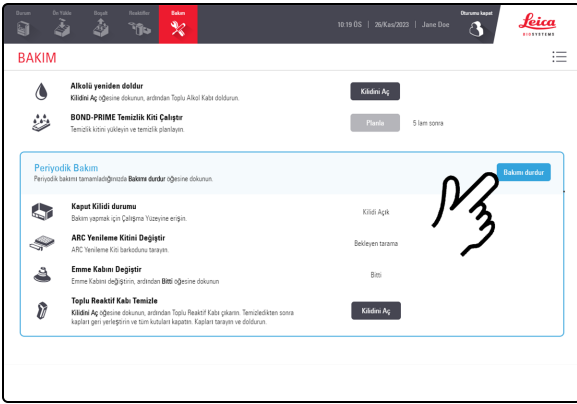
- Emme Kabını ambalajından çıkarın.
- Emme Kabını Robot Kafasına takın.



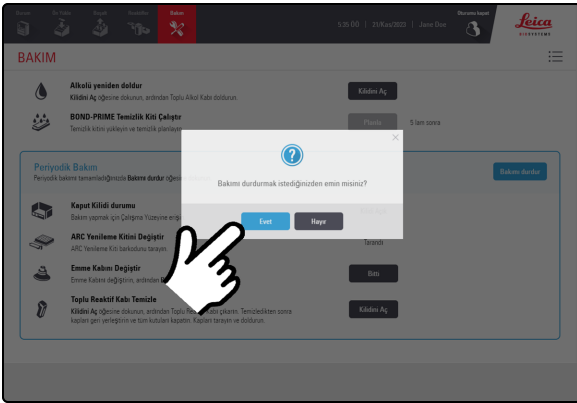
9. Emme Kabını Değiştir öğesinin yanındaki **Bitti** öğesine dokunun.



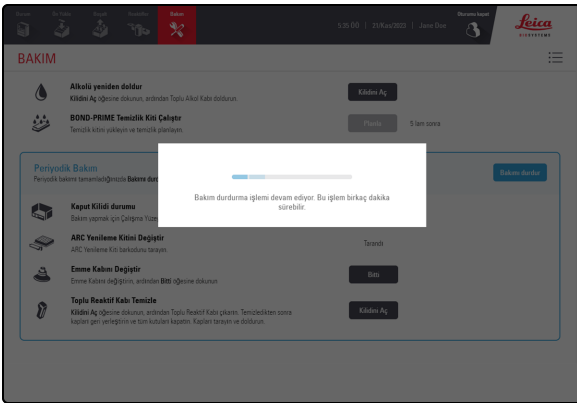
10. Artık Çalışma Yüzeyine erişmeniz gerekmiyorsa Kaputu kapatın ve bu prosedüre devam edin.



11. Bakımı durdur öğesine dokununuz.



12. Evet öğesine dokununuz.



İşleme modülü klinik çalışmaya dönmeye hazırlanırken bir bekleme süresi vardır.

Bakımı durdurduğunuzda işleme modülü otomatik olarak ARC Module'leri (ARC Modülü) kapatır ve Kaputu kilitletler.

4.12 Lam Çekmecesi Parçalarını, Atık Giderlerini ve Karterlerini ve Alım Filtresini temizleme



UYARI: İşleme modülüne bakım yapmadan önce gerekli minimum kişisel koruyucu ekipmanı kullanmanız gerekir. Bkz. [Genel dikkat edilecek hususlar](#).

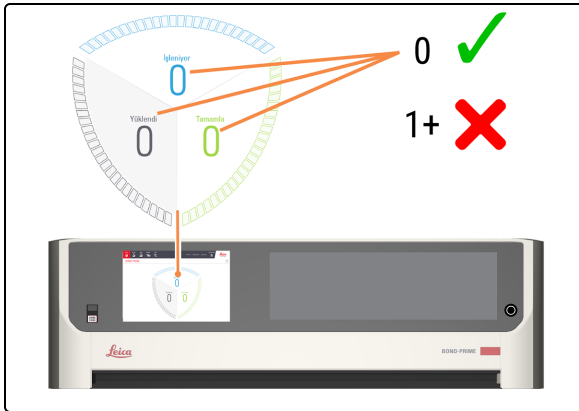


Bu prosedüre başlamadan önce işleme modülünde oturum açtığınızdan emin olun. Bkz. [2.1 Oturum açma ve kapatma](#).

Lam Çekmecesi Parçalarını Temizleme



1. Durum öğesine dokunun.



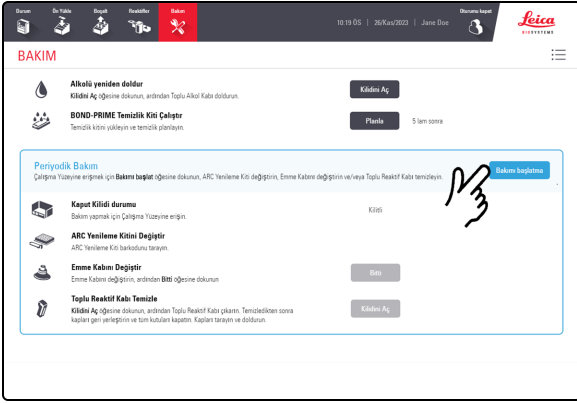
2. Aşağıdaki durumları doğrulamak için Durum ekranına bakın:

- İşlenmekte olan (İşleniyor) lam yok
- Preload Drawer'da (Ön Yükleme) (Yüklendi) ve Boşaltma Çekmecesinde (Tamamlandı) lam yok.

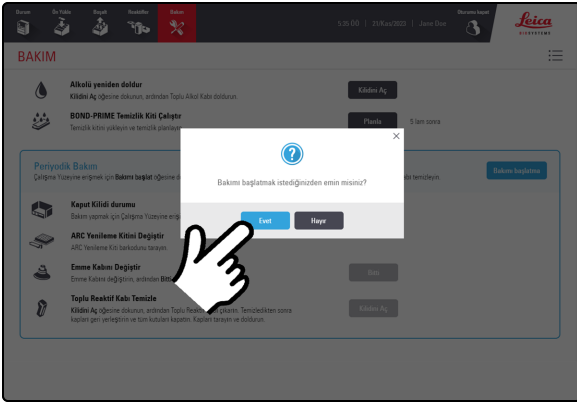
Bkz. [2.3 Durum Ekranı](#).



3. Bakım öğesine dokunun.



4. Bakımı Başlat öğesine dokunun.



5. Evet öğesine dokunun.

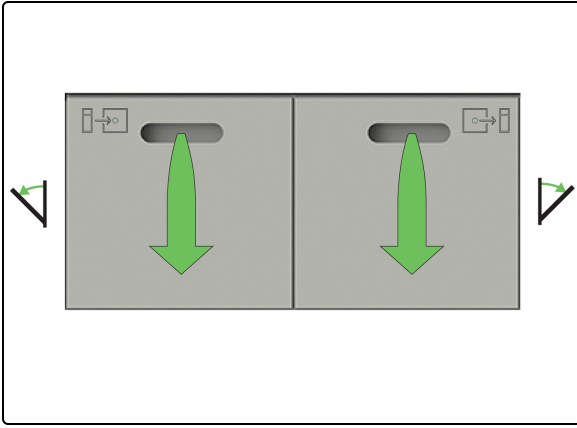
Evett öğesine dokunduktan sonra, işleme modülü Çalışma Yüzeyini bakım için hazırlarken ve Kaputun kilidini açarken bir bekleme süresi olacaktır.



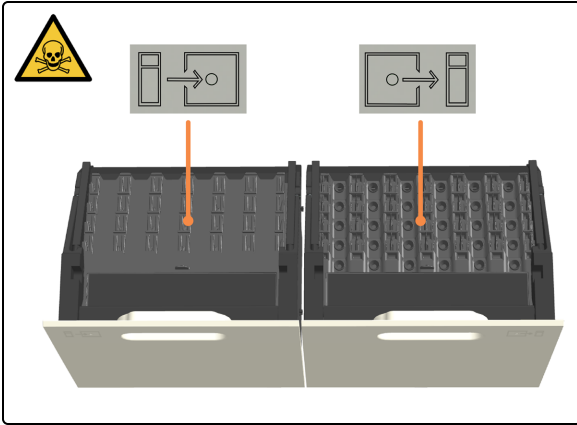
Bakım başlatıldığında işleme modülü otomatik olarak tüm ARC Module'leri (ARC Modülü) açar.



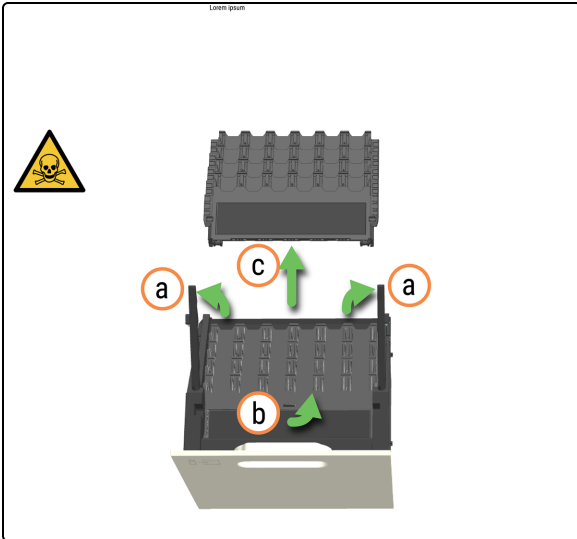
Kaputun kilidi açıldığında, Bakım ekranındaki **Kaput Kilidi Durumu Kilidi Açık** olarak değişecektir.



6. Lam Ön Yükleme ve Boşaltma Çekmecelerini açın.

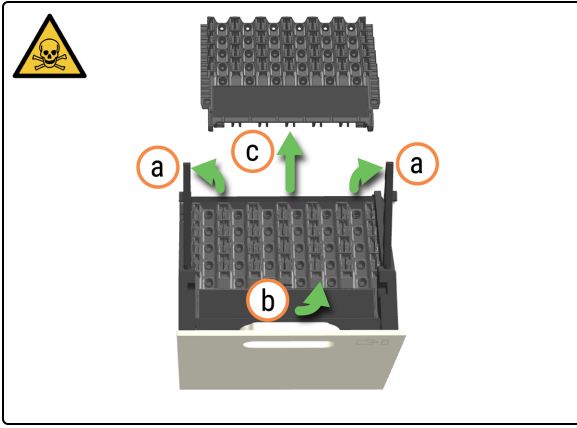


Lam Çekmecesi Parçalarına erişilebilir.

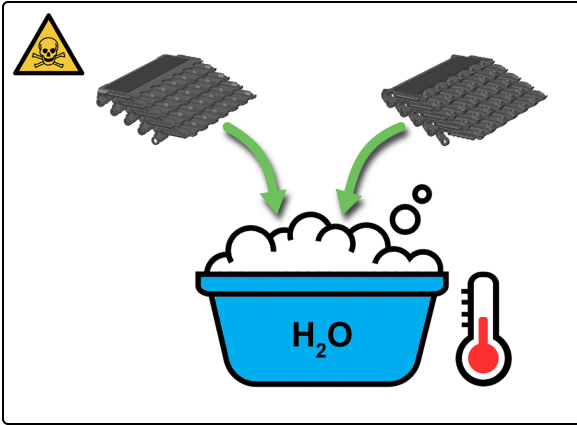


7. Lam Çekmecesi Parçalarını Preload Drawer'dan (Ön Yükleme Çekmecesi) çıkarın.

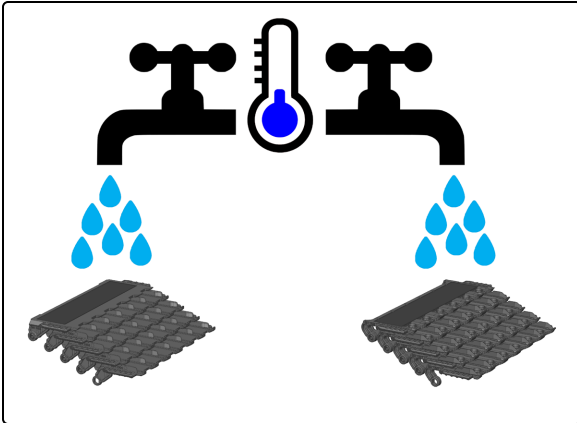
- Kilitleme kollarını yukarı çekin.
- Parçayı çekmecedan kaldırarak çıkarmayı kolaylaştırmak için ön paneldeki tırnak çıkıntısını kullanın.
- Lam Çekmecesi Parçasını Preload Drawer'dan (Ön Yükleme Çekmecesi) çıkarın.



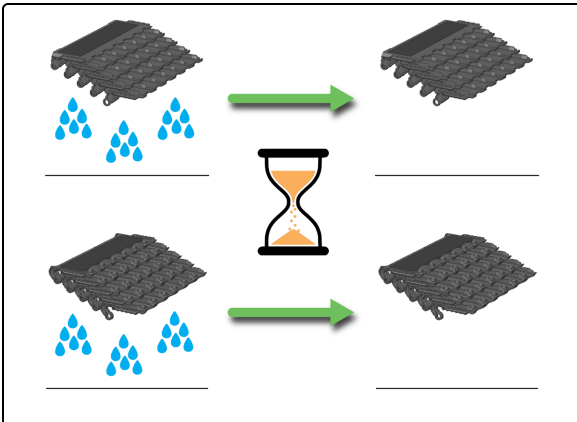
8. Lam Çekmecesi Parçasını Boşaltma Çekmecesinden çıkarın.
- a. Kilitleme kollarını yukarı çekin.
 - b. Parçayı çekmeceden kaldırarak çıkarmayı kolaylaştırmak için ön panelde bulunan tırnak çıkıntısını kullanın.
 - c. Lam Çekmecesi Parçasını Boşaltma Çekmecesinden çıkarın.



9. Parçaları ılık sabunlu suyla yıkayın.

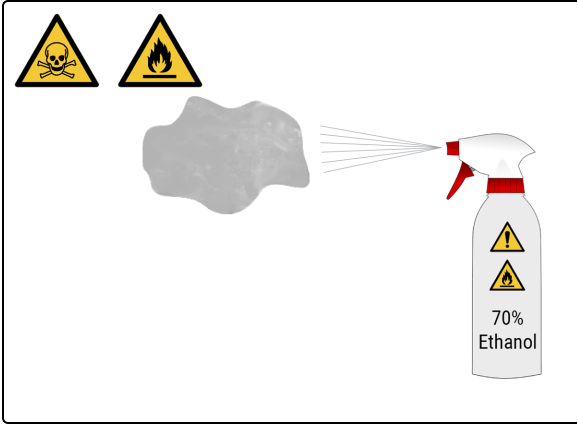


10. Akan suyla iyice durulayın.

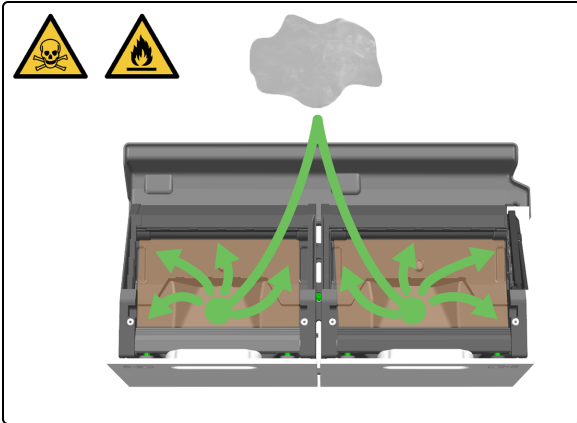


11. Aynı işleme modülüne geri takmadan önce tamamen kurumalarını bekleyin.

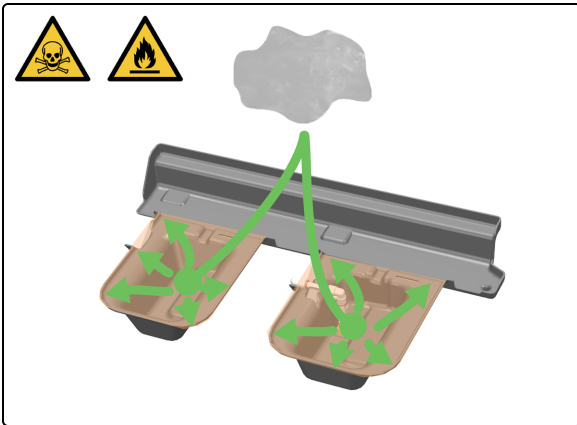
Atık Giderlerini ve Karterlerini Temizleme



12. Temiz, hav bırakmayan bir bezi %70 etanol çözeltisiyle nemlendirin.

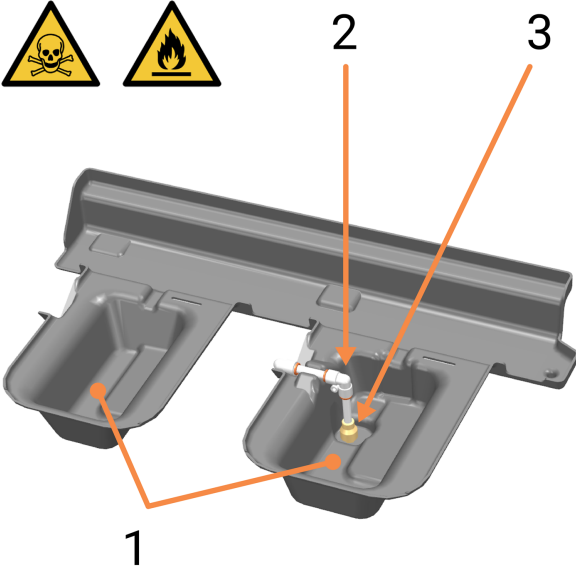


13. Atık Giderlerini hav bırakmayan bir bezle silin. Açılan çekmecelerden Lam Çekmecesi Parçaları çıkarılarak Atık Giderlerine erişilebilir.



14. Karterleri hav bırakmayan bir bezle silin. Karterler, Ön Yükleme ve Boşaltma Çekmecelerinin altında ve arkasında yer alır. Çekmeceler tam olarak açıldıktan sonra bunlara Çalışma Yüzeyi aracılığıyla erişilebilir.

Alım Tüpünü ve Filtresini temizleme



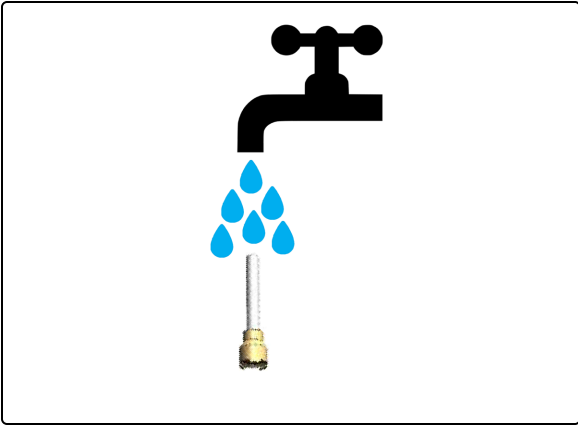
- 1 Karterler
- 2 Boşaltma Çekmecesini Alım Tüpü
- 3 Alım Filtresi



15. Filtreli Alım Tüpünü dirsekten döndürün.



16. Turuncu manşonu bastırarak Alım Tüpünü ve Filtresini çıkarın.



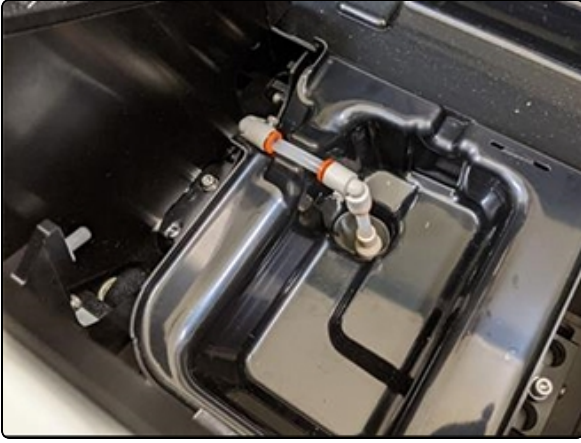
17. Gerekirse Alım Tüpünü ve Filtresini temiz suyla yıkayın.



18. Filtrede kit olmadığını doğrulayın.

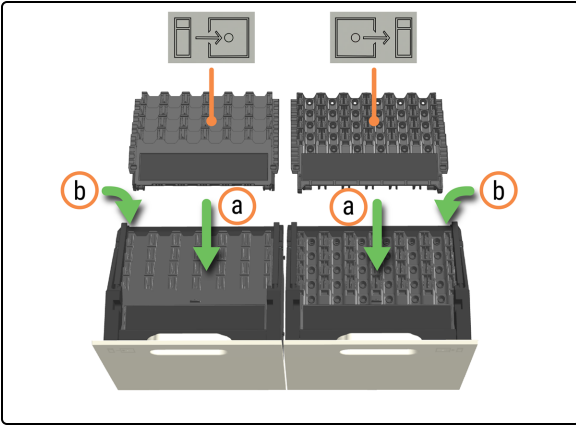


19. Filtreli Alım Tüpünü turuncu manşonun içine geri takın ve tam olarak içeri ittiğinizden emin olun.



20. Filtreli Alım Tüpünü asıl konumuna döndürün.

Boşaltma Çekmecesindeki Lam Çekmecesine Parçasının hizalanmasına engel olmaması için Alım Tüpünün doğru takıldığından emin olun.

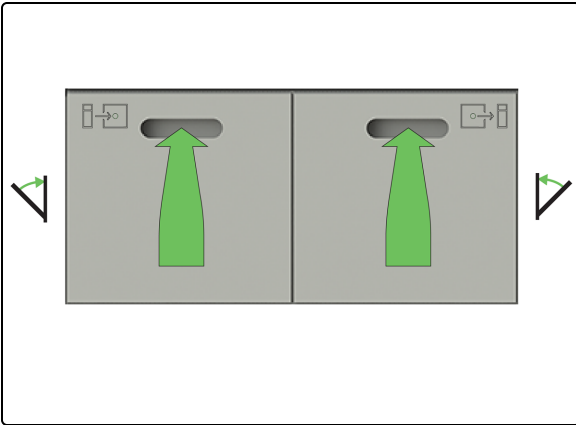


21. Lam Çekmecesine Parçalarını yerine takın.

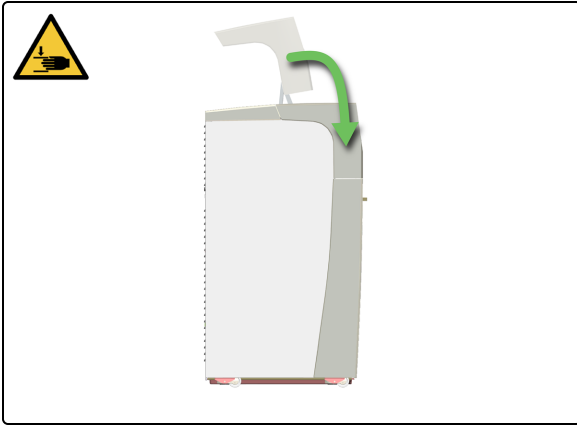
- Her bir Lam Çekmecesine Parçasını takın ve sıkışmadan girtilere tam olarak yerleştirildiklerinden emin olun.
- Parçaları otomatik olarak hizalamak ve iyi uymalarını sağlamak için parçaları taktıktan sonra kilitleme kolunu kapatın.



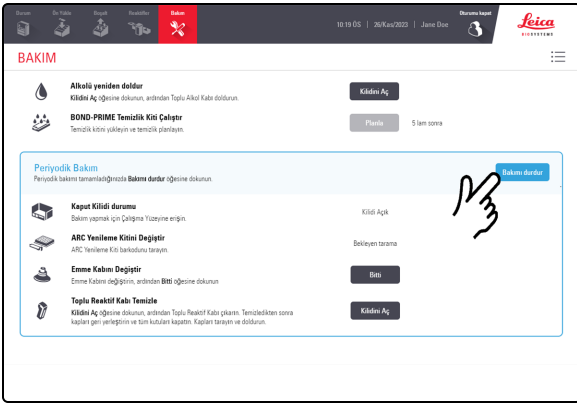
DİKKAT: Birden fazla parçayı temizliyorsanız, doğru parçanın doğru çekmeceye ve doğru işleme modülüne yerleştirildiğinden emin olun. Parçaları işleme modülleri arasında değiştiremezsiniz.



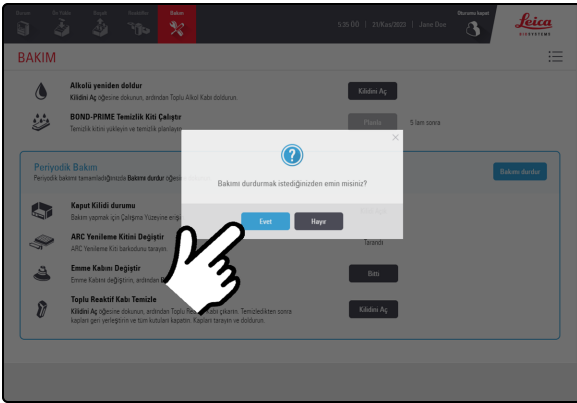
22. Lam Ön Yükleme ve Boşaltma Çekmecelerini kapatın.



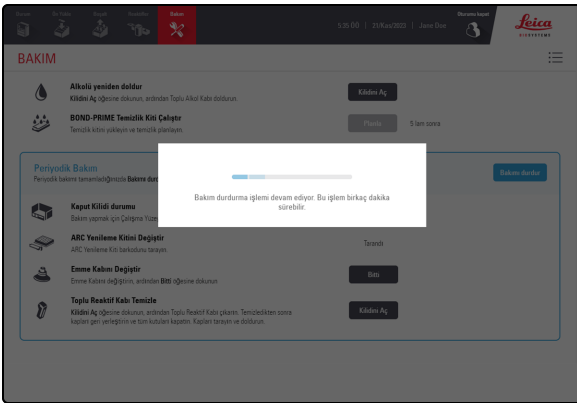
23. Artık Çalışma Yüzeyine erişmeniz gerekmiyorsa Kaputu kapatın ve bu prosedüre devam edin.



24. Bakımı durdur öğesine dokununuz.



25. Evet öğesine dokununuz.



İşleme modülü klinik çalışmaya dönmeye hazırlanırken bir bekleme süresi vardır.

Bakımı durdurduğunuzda işleme modülü otomatik olarak ARC Module'leri (ARC Modülü) kapatır ve Kaputu kilitlet.

4.13 Yıkama/Hazırlama İstasyonlarını temizleme



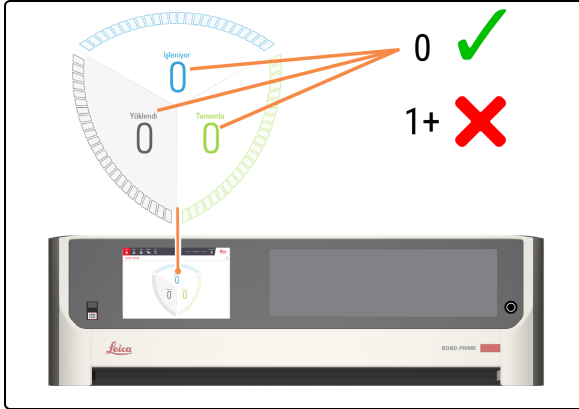
UYARI: İşleme modülüne bakım yapmadan önce gerekli minimum kişisel koruyucu ekipmanı kullanmanız gerekir. Bkz. [Genel dikkat edilecek hususlar](#).



Bu prosedüre başlamadan önce işleme modülünde oturum açtığınızdan emin olun. Bkz. [2.1 Oturum açma ve kapatma](#).



1. **Durum** öğesine dokunun.



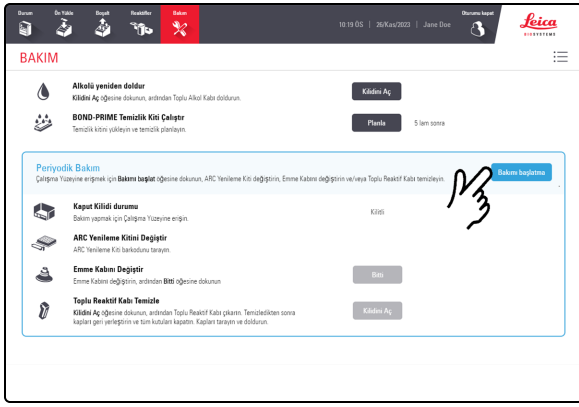
2. Aşağıdaki durumları doğrulamak için Durum ekranına bakın:

- İşlenmekte olan (İşleniyor) lam yok
- Preload Drawer'da (Ön Yükleme) (Yüklendi) ve Boşaltma Çekmecesinde (Tamamlandı) lam yok.

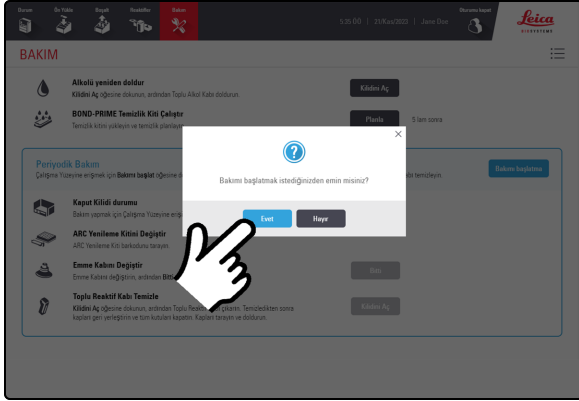
Bkz. [2.3 Durum Ekranı](#).



3. **Bakım** öğesine dokunun.



4. Bakımı Başlat öğesine dokununuz.

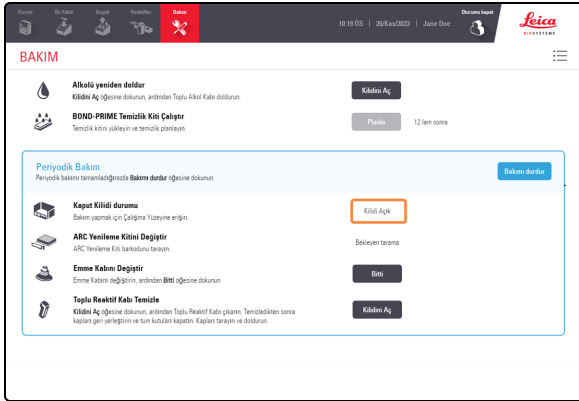


5. Evet öğesine dokununuz.

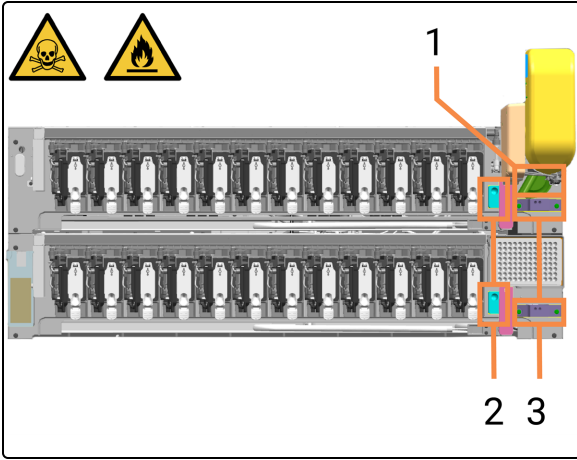
Evnet öğesine dokunduktan sonra, işleme modülü Çalışma Yüzeyini bakım için hazırlarken ve Kaputun kilidini açarken bir bekleme süresi olacaktır.



Bakım başlatıldığında işleme modülü otomatik olarak tüm ARC Module'leri (ARC Modülü) açar.



Kaputun kilidi açıldığında, Bakım ekranındaki **Kapat Kilidi Durumu Kilidi Açık** olarak değişecektir.

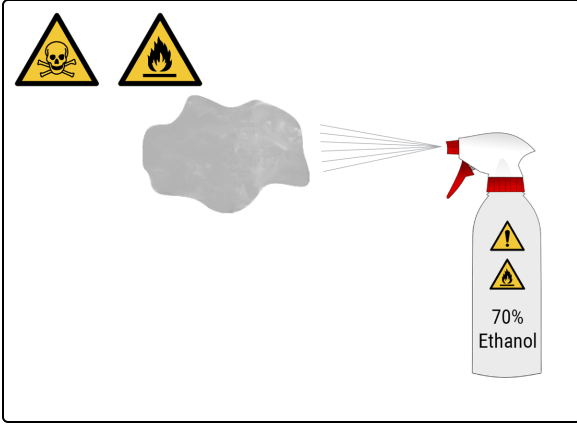


6. Çalışma Yüzeyi üzerindeki Yıkama/Hazırlama İstasyonu konumlarını (1, 2 ve 3) bulun.

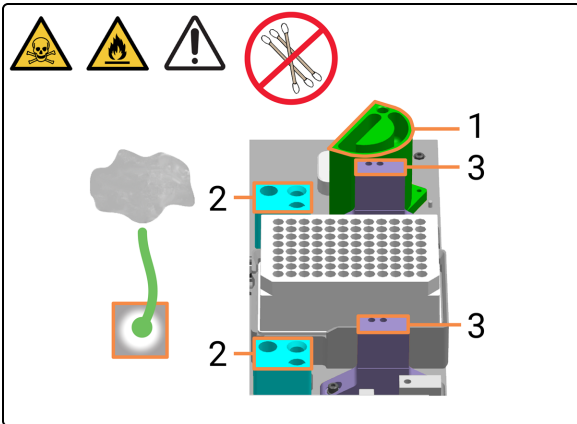


High-Speed Robot (Yüksek Hızlı Robot) veya Yıkama Robotları sizi engelliyorsa, Yıkama/Hazırlama İstasyonlarına daha kolay erişmek için bunları nazikçe hareket ettirebilirsiniz.

- 1 Bulk Probe Prime Station (Toplu Prob Hazırlama İstasyonu)
- 2 Yıkama Robotu Yıkama İstasyonları
- 3 ARC Probe Wash Station'ları (ARC Probu Yıkama İstasyonu)



7. Temiz, hav bırakmayan bir bezi %70 etanol çözeltisiyle nemlendirin.

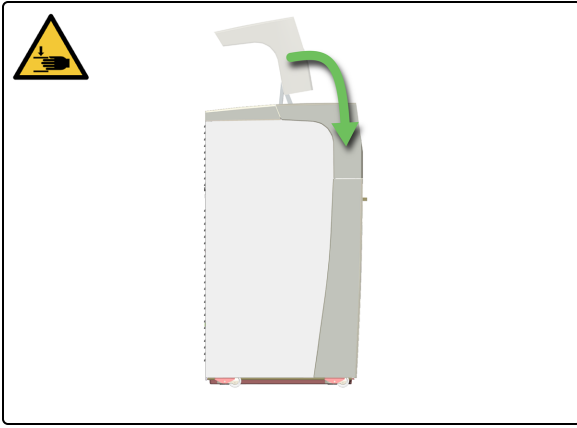


8. Hav bırakmayan bir bezle Yıkama/Hazırlama İstasyonlarının **yalnızca** üst yüzeylerini temizleyin.

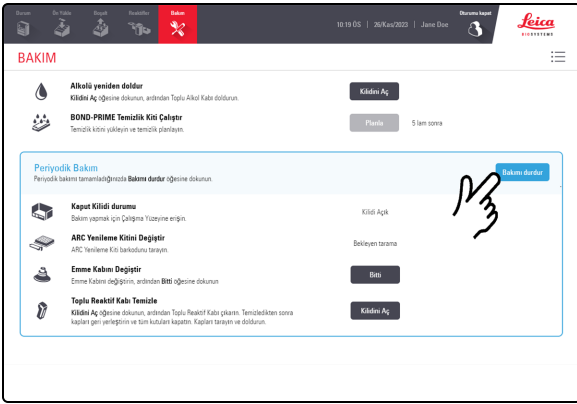


DİKKAT: Pamuklu çubuk kullanmayın.

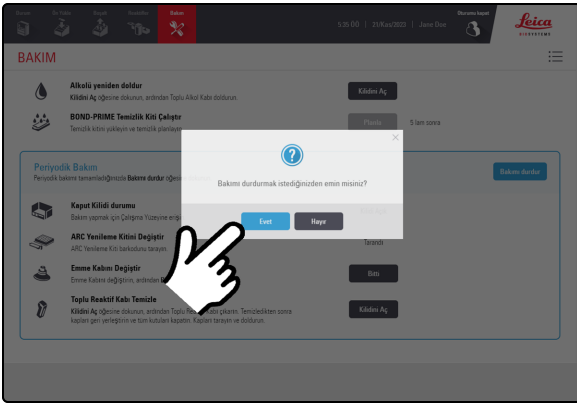
- 1 Bulk Probe Prime Station (Toplu Prob Hazırlama İstasyonu)
- 2 Yıkama Robotu Yıkama İstasyonları
- 3 ARC Probe Wash Station'ları (ARC Probu Yıkama İstasyonu)



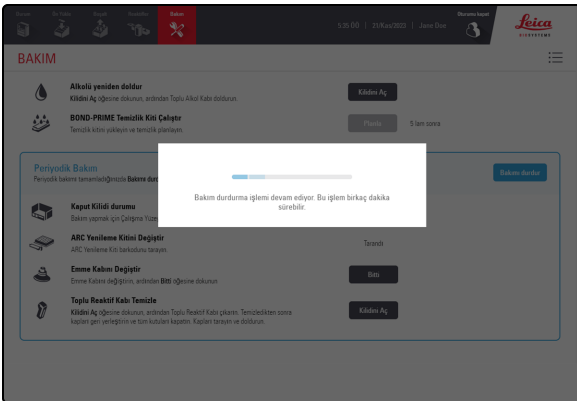
9. Artık Çalışma Yüzeyine erişmeniz gerekmiyorsa Kaputu kapatın ve bu prosedüre devam edin.



10. Bakımı durdur öğesine dokununuz.



11. Evet öğesine dokununuz.



İşleme modülü klinik çalışmaya dönmeye hazırlanırken bir bekleme süresi vardır.

Bakımı durdurduğunuzda işleme modülü otomatik olarak ARC Module'leri (ARC Modülü) kapatır ve Kaputu kilitlet.

4.14 BOND-PRIME ARC Refresh Kit (BOND-PRIME ARC Yenileme Kiti) kullanma

BOND-PRIME ARC Refresh Kit (BOND-PRIME ARC Yenileme Kiti) aşağıdakilerin yenisini içerir:

- Covertile'lar
- Mixing Well Plate (Karıştırma Kuyucuğu Plakası).

Her 7500 lamda bir veya 8 ayda bir (hangisi önce gerçekleşirse) ARC Refresh Kit (ARC Yenileme Kiti) kullanın. Her bir IHC tekli boyaması, Covertile kullanım ömrü için bir kullanım olarak sayılır. Her bir ISH hibridizasyonu iki kullanım olarak sayılır. Lam başına maksimum kullanım iki ile sınırlandırılmıştır. Aşağıdaki tabloda lam tipi için lam sayımı eşdeğeri belirtilmektedir.

Lam tipi	Lam sayımı eşdeğeri
IHC lamı	1
ISH lamı	2
Multiplex 2 ila 6	2



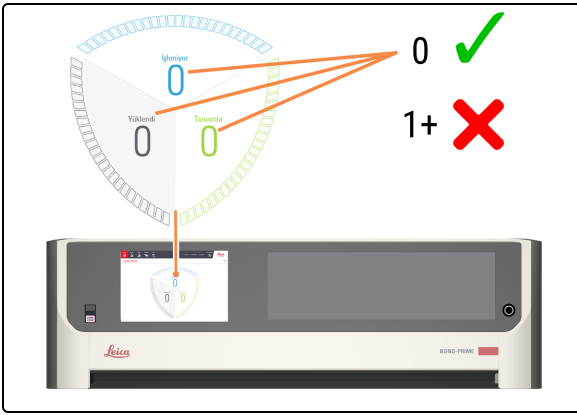
UYARI: İşleme modülüne bakım yapmadan önce gerekli minimum kişisel koruyucu ekipmanı kullanmanız gerekir. Bkz. [Genel dikkat edilecek hususlar](#).



Bu prosedüre başlamadan önce işleme modülünde oturum açtığınızdan emin olun. Bkz. [2.1 Oturum açma ve kapatma](#).



1. Durum ögesine dokununuz.



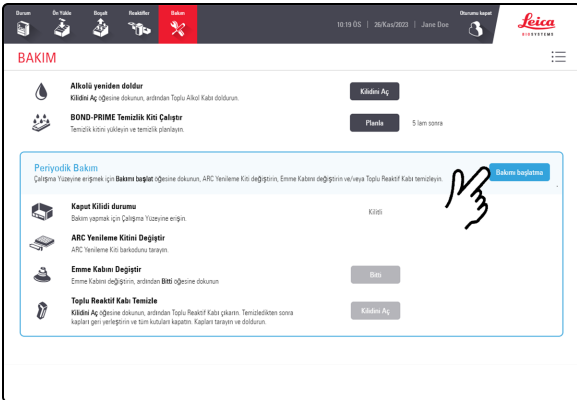
2. Aşağıdaki durumları doğrulamak için Durum ekranına bakın:

- İşlenmekte olan (İşleniyor) lam yok
- Preload Drawer'da (Ön Yükleme) (Yüklendi) ve Boşaltma Çekmecesinde (Tamamlandı) lam yok.

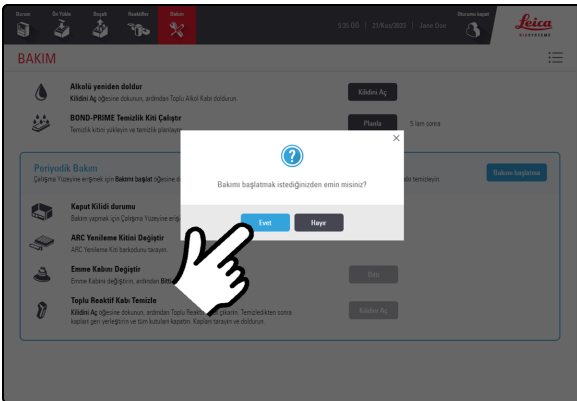
Bkz. 2.3 Durum Ekranı.



3. Bakım öğesine dokunun.



4. Bakımı Başlat öğesine dokunun.

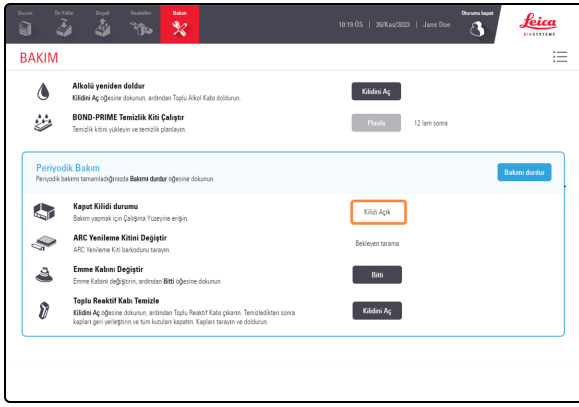


5. Evet öğesine dokunun.

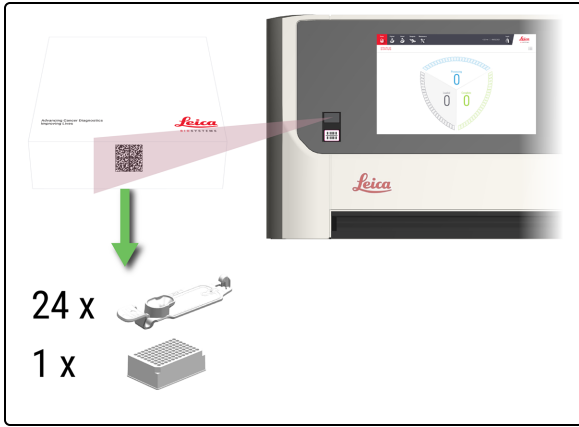
Evet öğesine dokunduktan sonra, işleme modülü Çalışma Yüzeyini bakım için hazırlarken ve Kaputun kilidini açarken bir bekleme süresi olacaktır.



Bakım başlatıldığında işleme modülü otomatik olarak tüm ARC Module'leri (ARC Modülü) açar.



Kaputun kilidi açıldığında, Bakım ekranındaki **Kaput Kilidi Durumu Kilidi Açık** olarak değişecektir.



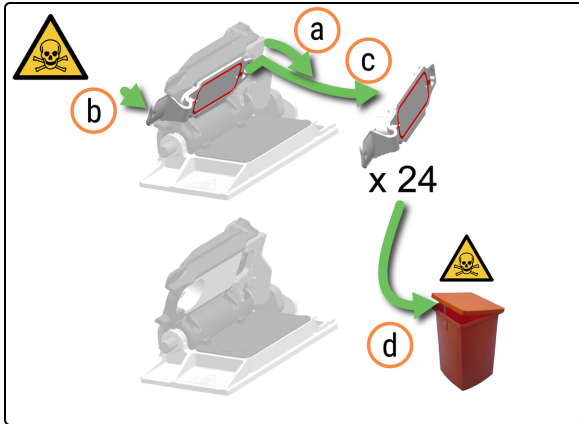
6. ARC Refresh Kit (ARC Yenileme Kiti) barkodunu tarayın.



Tarama yalnızca Bakım Modunda kabul edilir.

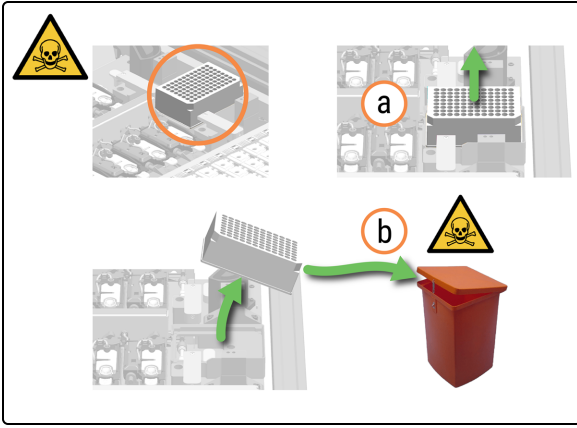


ARC Refresh Kit'in (ARC Yenileme Kiti) taranması, boyama başlamadan önce Covertile'ların DI Water (DI Su) ve BOND-PRIME Wash Working Solution ile temizlenmesini sağlar.



7. Covertile'ları çıkarın.

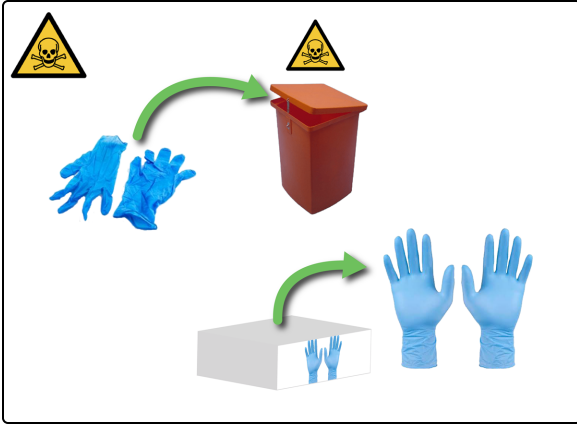
- ARC Module Latch'i (ARC Modülü Mandalı) aşağı iterek Covertile'a erişimi kolaylaştırın.
- Covertile Başparmak Yerini nazikçe ileriye ve ARC Module lid'inin (ARC Modülü başlığı) sağına doğru çekin.
- Covertile kancasını çıkarın ve Covertile'ı ARC Module'den (ARC Modülü) çıkarın.
- Covertile'ı laboratuvar prosedürlerine uygun şekilde atın.



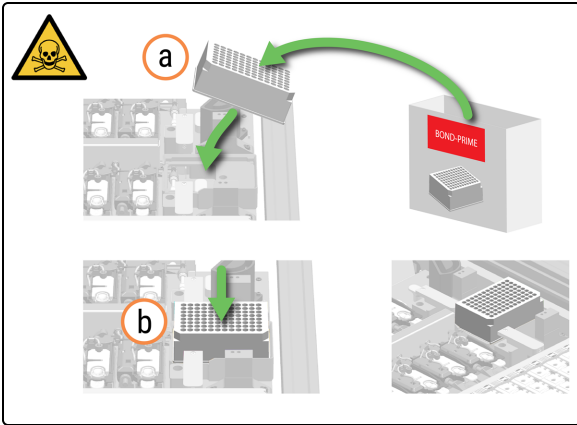
8. Mixing Well Plate'i (Karıştırma Kuyucuğu Plakası) çıkarın.
- Mixing Well Plate'i (Karıştırma Kuyucuğu Plakası) yukarı kaldırın.
 - Mixing Well Plate'i (Karıştırma Kuyucuğu Plakası) laboratuvar prosedürlerine uygun şekilde atın.



UYARI: Mixing Well Plate'i (Karıştırma Kuyucuğu Plakası) çıkarırken ve atarken sıvı dökülmesini önlemeye dikkat edin.

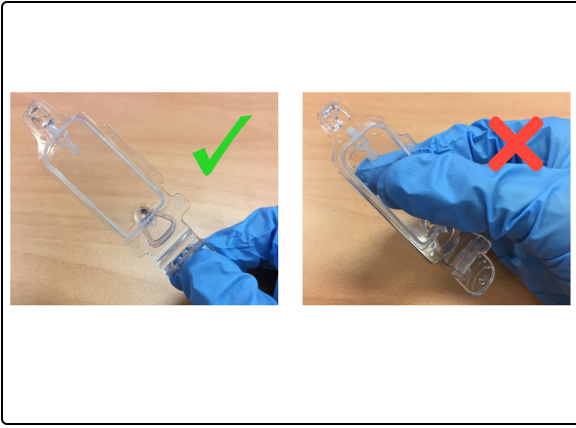


9. Eldivenlerinizi çıkarın ve laboratuvar prosedürlerine uygun şekilde atın. Yeni eldivenler takın.

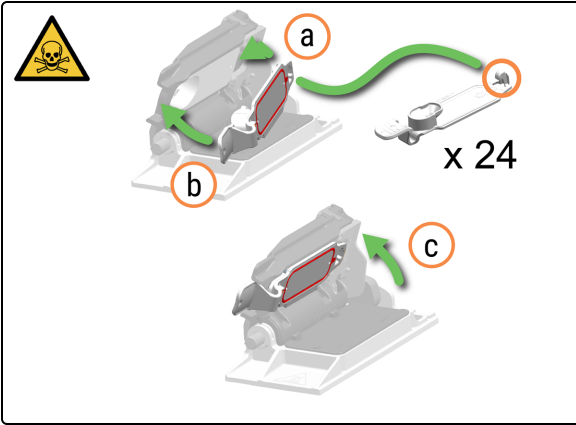


10. Yeni Mixing Well Plate'i (Karıştırma Kuyucuğu Plakası) takın.
- Mixing Well Plate'i (Karıştırma Kuyucuğu Plakası) ambalajından çıkarın.
 - Mixing Well Plate'i (Karıştırma Kuyucuğu Plakası) Mixing Block'a (Karıştırma Bloğu) yerleştirin.

Tutucu içerisine düz oturduğu sürece, Mixing Well Plate'in (Karıştırma Kuyucuğu Plakası) Mixing Block'a (Karıştırma Bloğu) yerleştirilme yönü önemlidir.

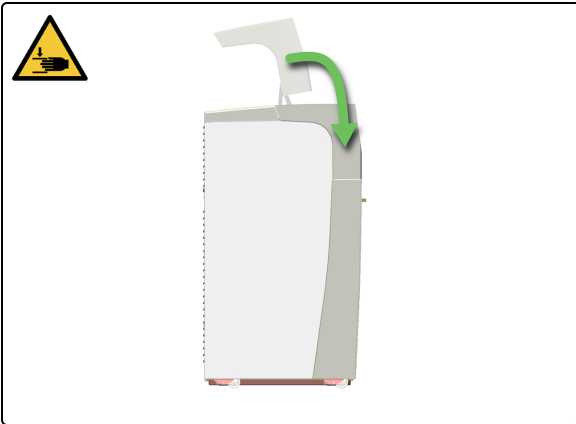


Covertile'ı tutmak için başparmak yerini kullanın. Parmağınızı üst plakanın üzerine temas ETTİRMEYİN.

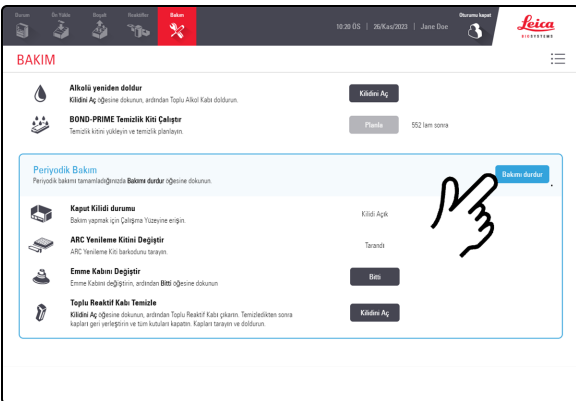


11. Yeni Covertile'ları takın.

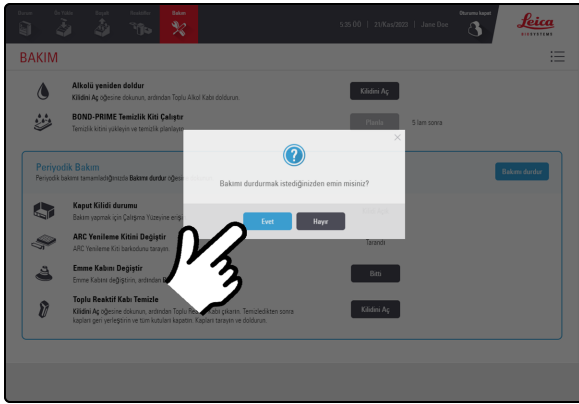
- Covertile Kancasını ARC Module'ün (ARC Modülü) arkasına takın.
- Covertile ARC Module (ARC Modülü) içine oturana kadar Covertile Başparmak Yerini nazıkçe itin.
- ARC Module Latch'i (ARC Modülü Mandalı) yukarıya itin.



12. Kaputu kapatın.



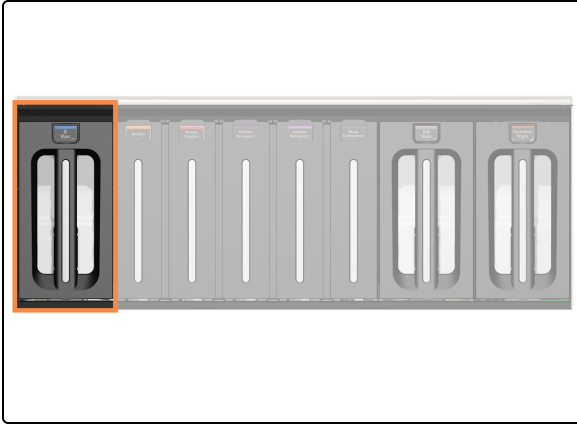
13. Bakımı durdur öğesine dokununuz.



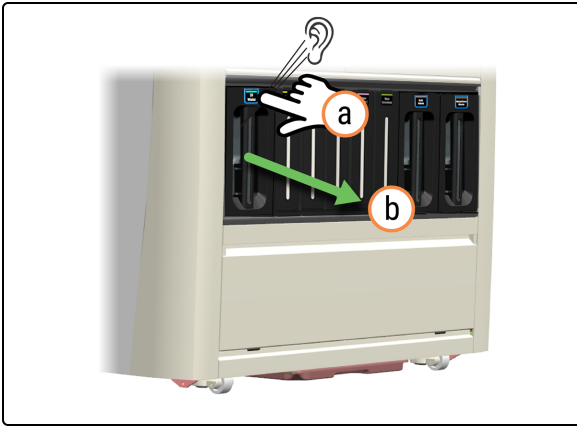
14. Evet ögesine dokununuz.

Bakımı durdurduğunuzda işleme modülü otomatik olarak ARC Module'leri (ARC Modülü) kapatır.

4.15 Bulk DI Water Container'ı (Toplu DI Su Kabı) temizleme



DI Water (DI Su) Kabı, Toplu Kap Kabininin solunda yer alır.



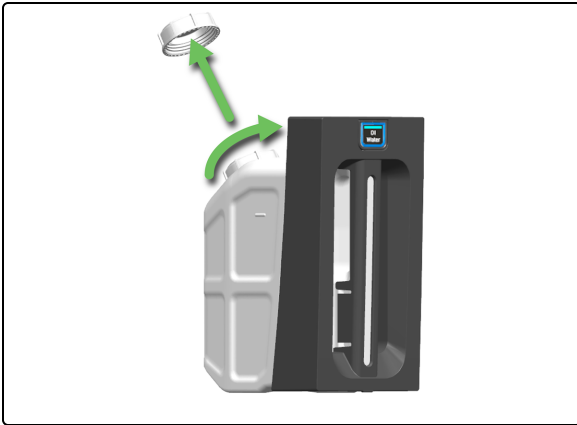
1. DI Water (DI Su) Kabını çıkarın.
 - a. DI Water (DI Su) düğmesine basın.
 - b. Kabı işleme modülünden çekerek çıkarın.



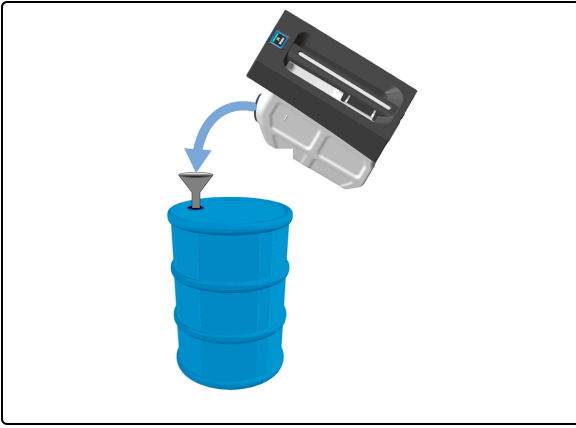
UYARI: DI Water (DI Su) Kabını kaldırırken iki elinizi birden kullanın.



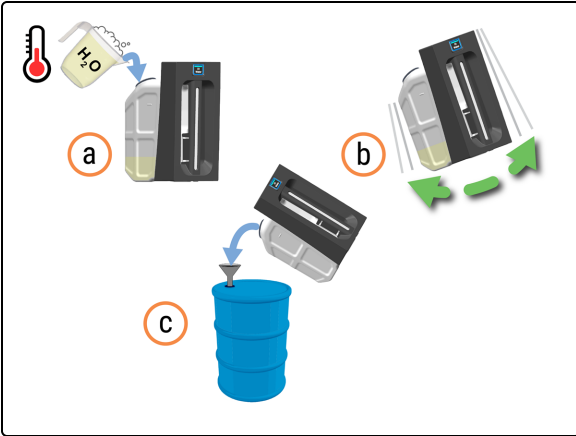
DI Water (DI Su) kullanılabilmesi için kabı hızlıca geri yerleştirin.



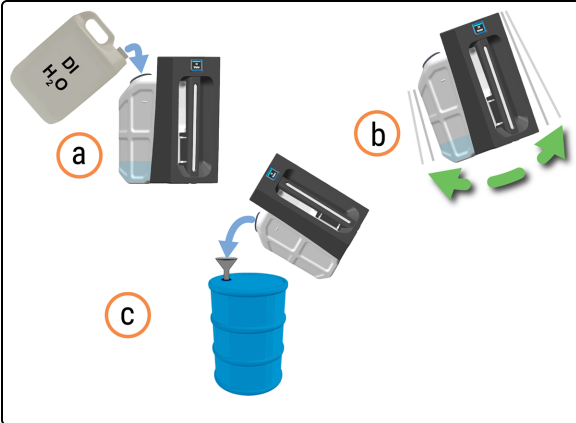
2. DI Water (DI Su) Kabının kapağını çıkarın.



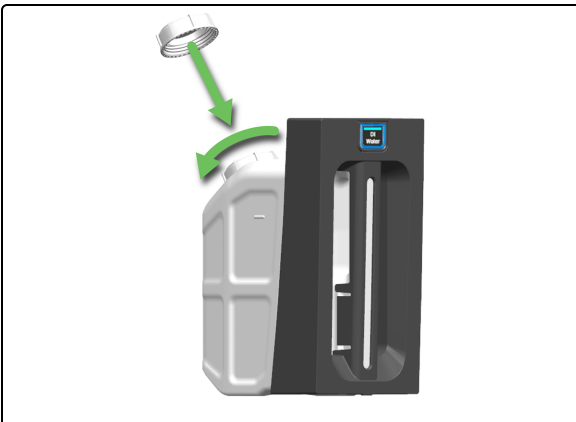
3. İ içeriğini laboratuvar tesisi için geçerli olan tüm prosedürlere ve devlet düzenlemelerine uygun şekilde atın.



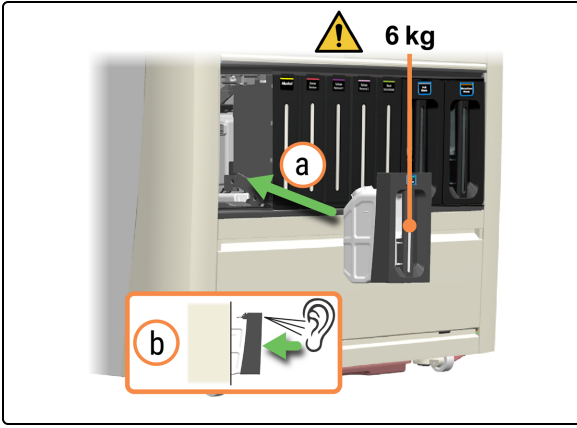
4. DI Water (DI Su) Kabını temizleyin.
- DI Water (DI Su) Kabını çeyreğine kadar ılık sabunlu suyla doldurun.
 - Kaba başlığı takın ve kısa bir süre kabı çalkalayın.
 - Kabın içeriğini laboratuvar prosedürlerinize uygun şekilde boşaltın.



5. Deterjanı gidermek için DI Water (DI Su) Kabını durulayın.
- DI Water (DI Su) Kabını çeyreğine kadar DI Water (DI Su) ile doldurun.
 - Kaba başlığı takın ve kısa bir süre kabı çalkalayın.
 - Kabın içeriğini laboratuvar prosedürlerinize uygun şekilde boşaltın.



6. DI Water (DI Su) Kabını doldurun ve DI Water (DI Su) Kabının kapağını takın.



7. Dolu DI Water (DI Su) Kabını yerine yerleştirin.
 - a. İki elinizi birden kullanarak DI Water (DI Su) Kabını işleme modülünün içindeki yerine yerleştirin.
 - b. Kabın yerine kilitlendiğini doğrulamak için klik sesi duymaya çalışın.

Kabın tam olarak yerleştirildiğinden emin olun. Bunun yapılmaması Preload Drawer'da (Ön Yükleme Çekmecesi) lampların reddedilmesine neden olabilir.

4.16 Kilitli Bulk Reagent Container'ları (Toplu Reaktif Kabı) Temizleme



UYARI: İşleme modülüne bakım yapmadan önce gerekli minimum kişisel koruyucu ekipmanı kullanmanız gerekir. Bkz. [Genel dikkat edilecek hususlar](#).



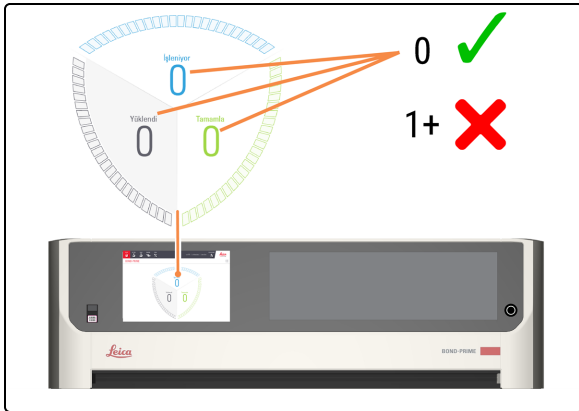
UYARI: Açık olan Toplu Kap Çekmecelerine çarpmamaya dikkat edin.



Bu prosedüre başlamadan önce işleme modülünde oturum açtığınızdan emin olun. Bkz. [2.1 Oturum açma ve kapatma](#).



1. Durum öğesine dokununuz.



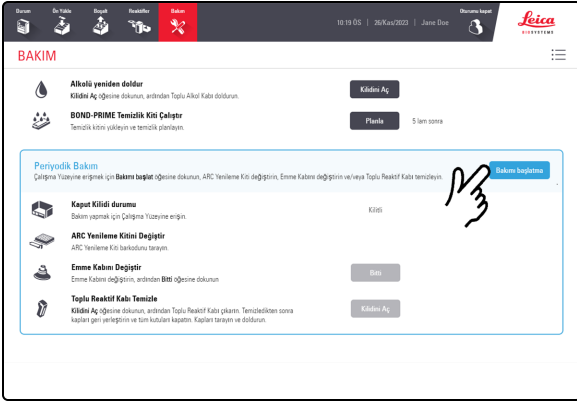
2. Aşağıdaki durumları doğrulamak için Durum ekranına bakın:

- İşlenmekte olan (İşleniyor) lam yok
- Preload Drawer'da (Ön Yükleme) (Yüklendi) ve Boşaltma Çekmecesinde (Tamamlandı) lam yok.

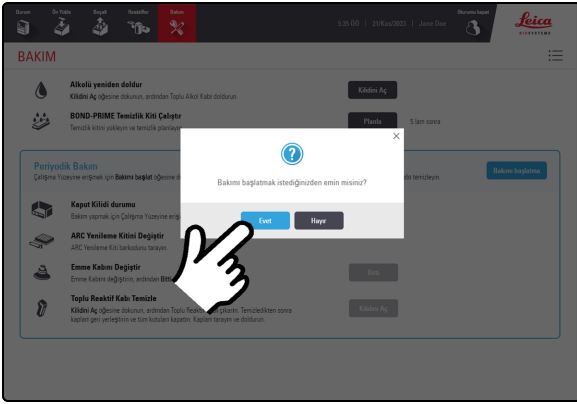
Bkz. [2.3 Durum Ekranı](#).



3. Bakım öğesine dokunun.



4. Bakımı Başlat öğesine dokunun.



5. Evet öğesine dokunun.

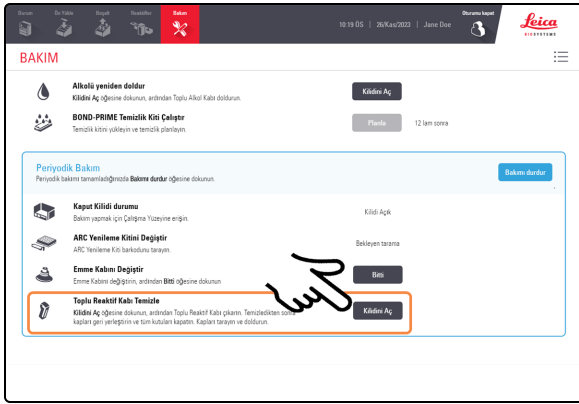
Evet öğesine dokunduktan sonra, işleme modülü Çalışma Yüzeyini bakım için hazırlarken ve Kaputun kilidini açarken bir bekleme süresi olacaktır.



Bakım başlatıldığında işleme modülü otomatik olarak tüm ARC Module'leri (ARC Modülü) açar.



Kaputun kilidi açıldığında, Bakım ekranındaki **Kaput Kilidi Durumu Kilidi Açık** olarak değişecektir.



6. Temiz Toplu Reaktif Kapları öğesinin yanındaki **Kilidini Aç** öğesine dokununuz.



Reagent Container (Reaktif Kabı) Kutularının kilidi 30 saniye boyunca açık kalır, bu sayede **tüm** çekmeceleri bakım konumuna getirmek için yeterli süreniz olur.

Hepsini 30 saniye içinde açmaya zamanınız yoksa **Kilidini Aç** düğmesine tekrar dokunabilirsiniz.



7. Kilitli Reaktif Kabı Kutularını açmak için öne doğru çekin.

Alcohol (Alkol) ve Dewax Solution Kapları için



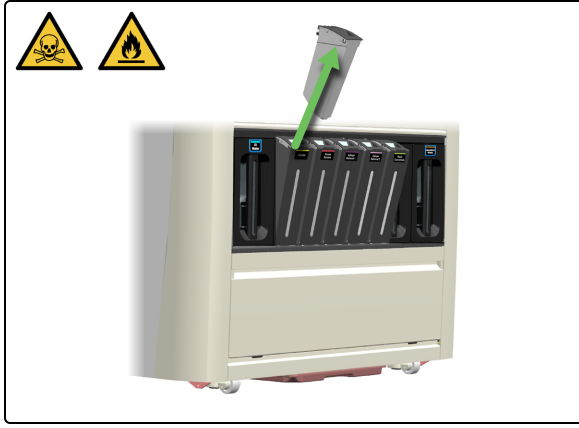
Soldaki iki kilitli kap, Alcohol (Alkol) ve Dewax Solution Kaplarıdır.



Kaplar düz yüzeyde dik duramadığı için kapları teker teker temizleyip geri takın.



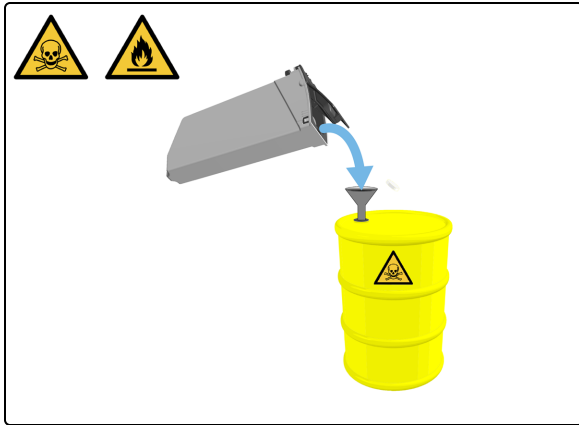
8. Tüp konektörünün arkasındaki kutu serbest bırakma koluna basın. Klik sesi duymanız gerekir.



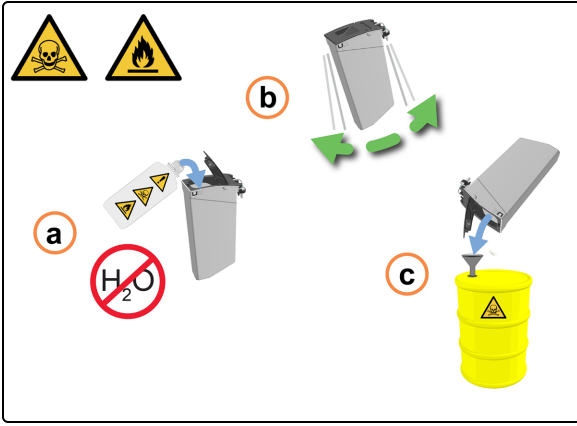
9. Kabı kutudan yukarı ve dışarı kaydırın.



UYARI: Dökülmeyi önlemek için, işleme modülünden uzaktayken Bulk Reagent Container'ları (Toplu Reaktif Kabı) **YENİDEN DOLDURMAYIN.**



10. Kabı tehlikeli atık variline boşaltın.



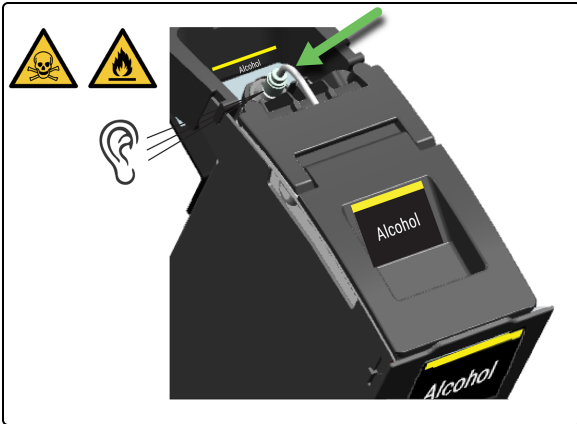
DİKKAT: Alcohol (Alkol) veya Dewax (Vaks Giderme) Kaplarını temizlemek için su veya deterjan **KULLANMAYIN**.

11. Kabı dekontamine edin:

- Kabı az miktarda yeni Alcohol (Alkol) ile durulayarak var olabilecek kontaminantları giderin.
- Kabı nazikçe çalkalayın.
- Tamamladığınızda kabı boşaltın.



12. Başlığı kapatın ve kabı kutusuna geri yerleştirin.



13. Klik sesi duyana kadar kabı aşağı itin.



14. Kutuyu kapatın.



15. Dewax Solution Kabı için adım 8 ile adım 14 işlemlerini tekrarlayın.

Başka herhangi bir Reagent Container'ı (Reaktif Kabı) temizlemeniz gerekmiyorsa, bkz. **Bakımı durdurma**.

ER1, ER2 ve BOND-PRIME Wash Solution Concentrate Container'lar (Wash Solution Concentrate Kabı) için



Sağdaki 3 kap; ER1, ER2 ve BOND-PRIME Wash Solution Concentrate Container'lardır (Wash Solution Concentrate Kabı).



Kaplar düz yüzeyde dik duramadığı için kapları teker teker temizleyip geri takın.



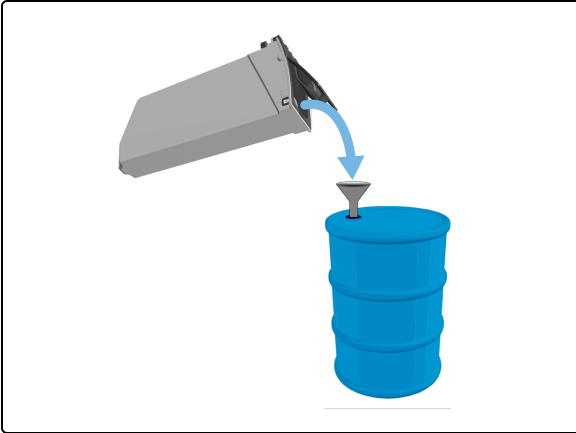
16. Tüp konektörünün arkasındaki kutu serbest bırakma koluna basın. Klik sesi duymanız gerekir.



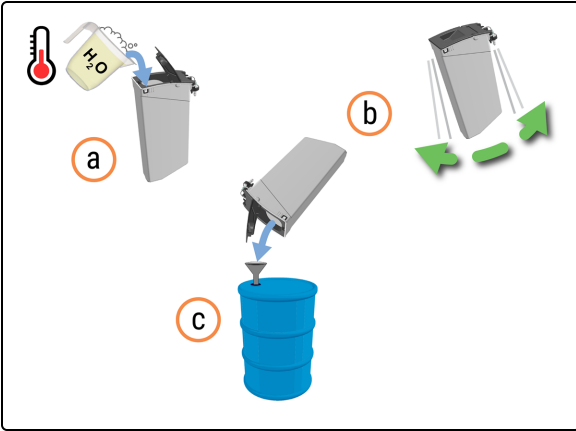
17. Kabı kutudan yukarı ve dışarı kaydırın.



UYARI: Dökülmeyi önlemek için, işleme modülünden uzaktayken Bulk Reagent Container'ları (Toplu Reaktif Kabı) **YENİDEN DOLDURMAYIN.**

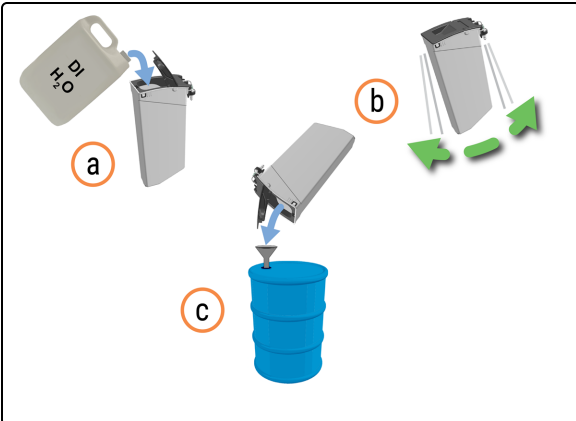


18. Kabı laboratuvar prosedürlerine uygun şekilde boşaltın.



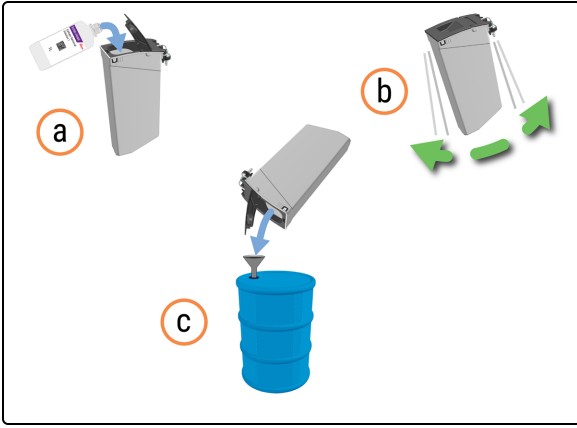
19. Kabı temizleyin:

- Ilık musluk suyu ve endüstri tipi deterjan çözeltisiyle kabı çeyreğine kadar doldurun.
- Kabı nazikçe çalkalayın.
- Kabı laboratuvar prosedürlerine uygun şekilde boşaltın



20. Kabı durulayın:

- Kabı DI Water (DI Su) ile iyice durulayın.
- Kabı nazikçe çalkalayın.
- Kabı laboratuvar prosedürlerine uygun şekilde boşaltın



21. Kabı dekontamine edin:

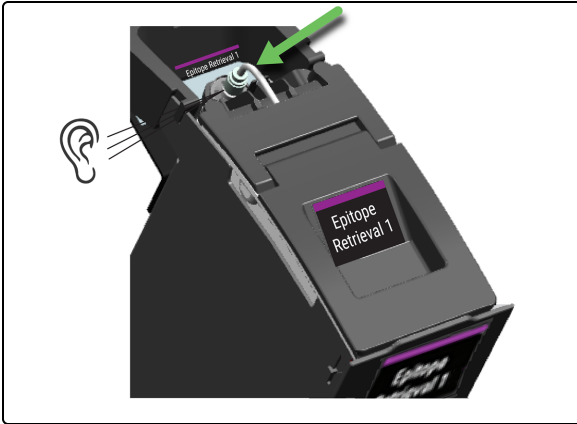
- Kabı az miktarda yeni ER1 ile durulayarak var olabilecek kontaminantları giderin.
- Kabı nazikçe çalkalayın.
- Kabı laboratuvar prosedürlerine uygun şekilde boşaltın.



22. Başlığı kapatın ve kabı kutusuna geri yerleştirin.



Henüz kabı yeniden doldurmayın.



23. Klik sesi duyana kadar kabı aşağı itin.

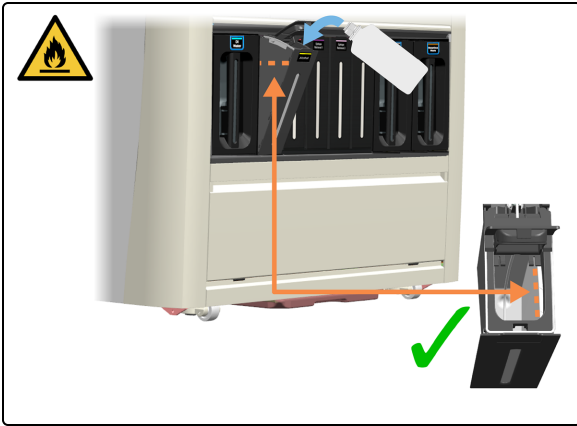


24. Kutuyu kapatın.



25. Kalan Kilitli Reaktif Kapları için **adım 16** ila **adım 24** işlemlerini tekrarlayın.

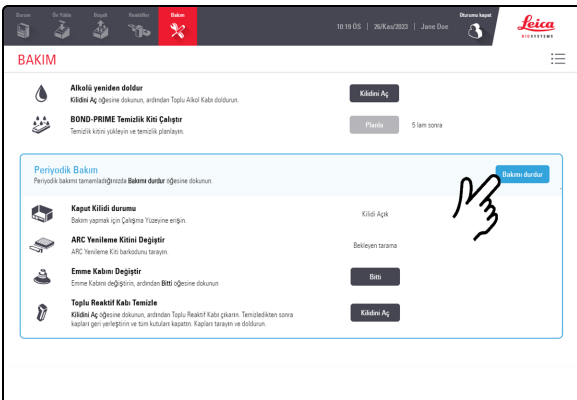
Bulk Reagent Container'ları (Toplu Reaktif Kabı) yeniden doldurma



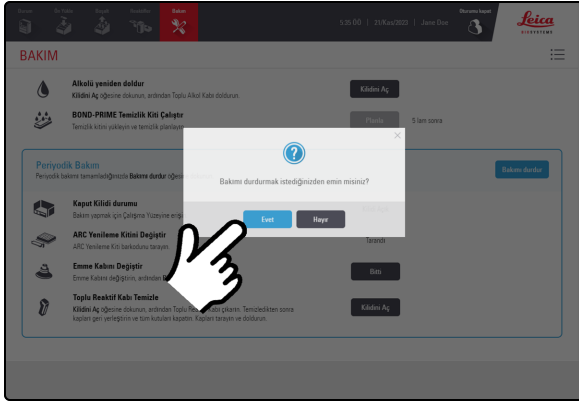
26. Kapları yeniden doldurun:

- 4.3 Alcohol (Alkol) Kabını yeniden doldurma
- 4.4 Lotu Takip Edilen Toplu Kapları yeniden doldurma

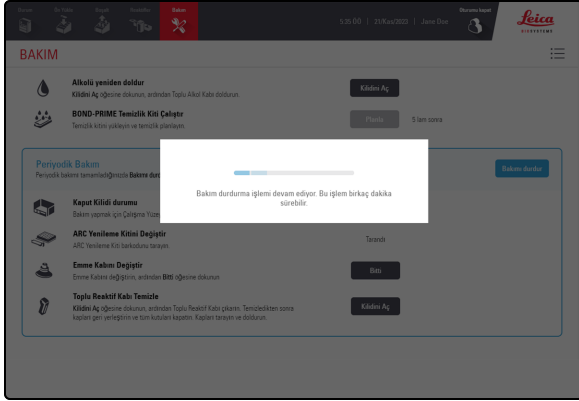
Bakımı durdurma



27. Bakımı durdur öğesine dokununuz.



28. Evet öğesine dokununuz.



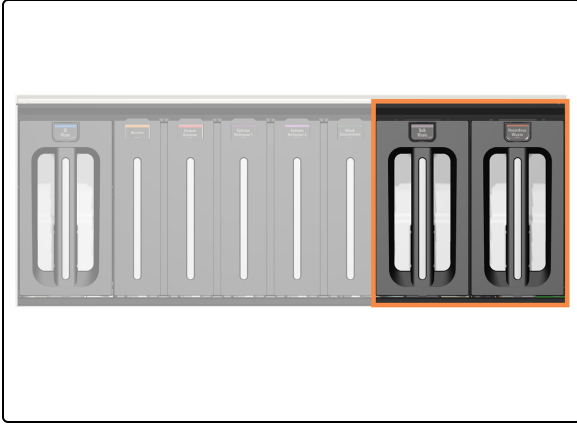
İşleme modülü klinik çalışmaya dönmeye hazırlanırken bir bekleme süresi vardır.

Bakımı durdurduğunuzda işleme modülü otomatik olarak ARC Module'leri (ARC Modülü) kapatır ve Kaputu kilitletler.

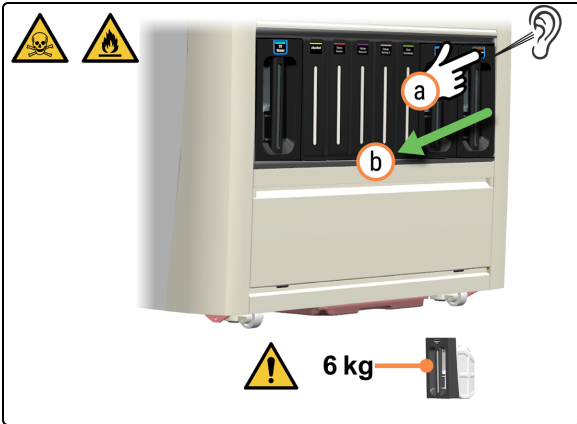
4.17 Atık Kaplarını Temizleme



UYARI: İşleme modülüne bakım yapmadan önce gerekli minimum kişisel koruyucu ekipmanı kullanmanız gerekir. Bkz. **Genel dikkat edilecek hususlar.**



Atık Kapları, Toplu Kap Kabininin sağında yer alır.



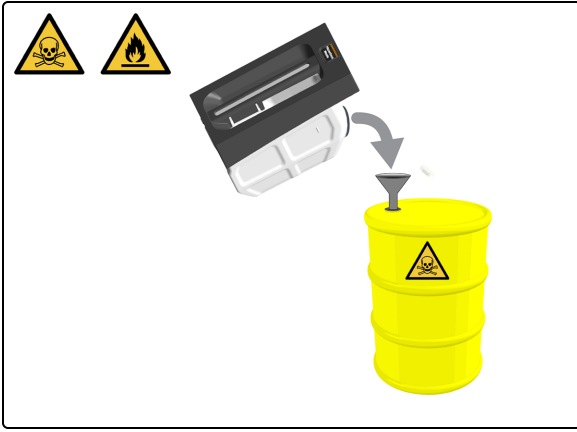
1. Atık kabını çıkarın.
 - a. Atık düğmesine basın.
 - b. Kabı işleme modülünden çekerek çıkarın.



UYARI: Bulk/Hazardous Waste container'larını (Toplu/Tehlikeli Atık kabı) kaldırırken iki elinizi birden kullanın.



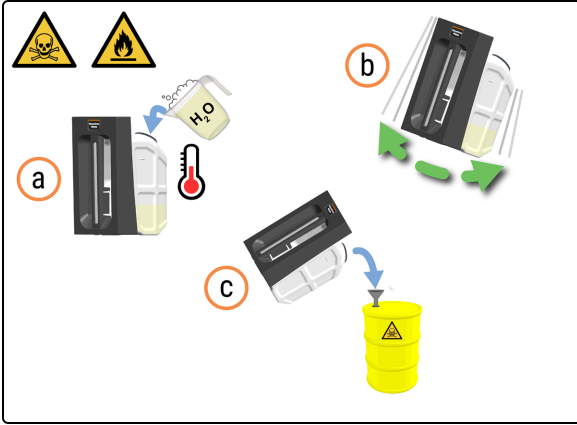
2. Atık Kabinin kapağını çıkarın.



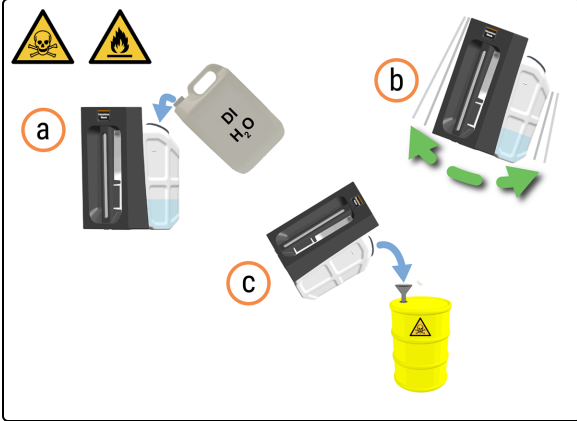
3. İçeriğini laboratuvar tesisi için geçerli olan tüm prosedürlere ve devlet düzenlemelerine uygun şekilde atın.



Tehlikeli atık örneği gösterilmektedir.



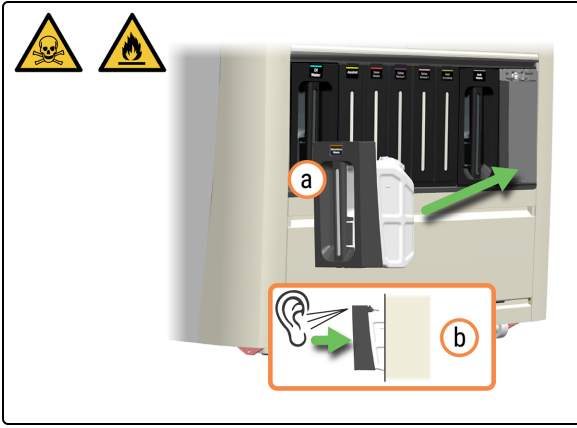
4. Atık Kabını temizleyin.
- Ilık su ve endüstri tipi deterjan çözeltisiyle atık kabını çeyreğine kadar doldurun.
 - Kaba başlığı takın ve kısa bir süre kabı çalkalayın.
 - Kabın içeriğini laboratuvar prosedürlerinize uygun şekilde boşaltın.



5. Atık Kabını durulayın.
- Atık Kabını çeyreğine kadar DI Water (DI Su) ile doldurun.
 - Kaba başlığı takın ve kısa bir süre kabı çalkalayın.
 - Kabın içeriğini laboratuvar prosedürlerinize uygun şekilde boşaltın.



6. Atık Kabı kapağını yerine takın.



7. Atık Kabını yerine yerleştirin.

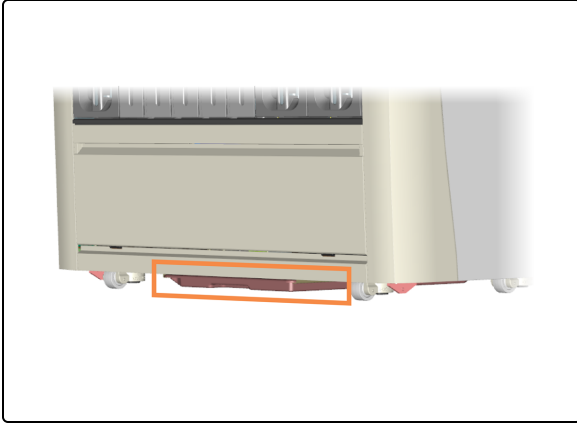
- a. Atık Kabını işleme modülündeki yerine yerleştirin.
- b. Kabin yerine kilitlendiğini doğrulamak için klik sesi duymaya çalışın.

Kabın tam olarak yerleştirildiğinden emin olun. Bunun yapılmaması Preload Drawer'da (Ön Yükleme Çekmecesi) lampların reddedilmesine neden olabilir.

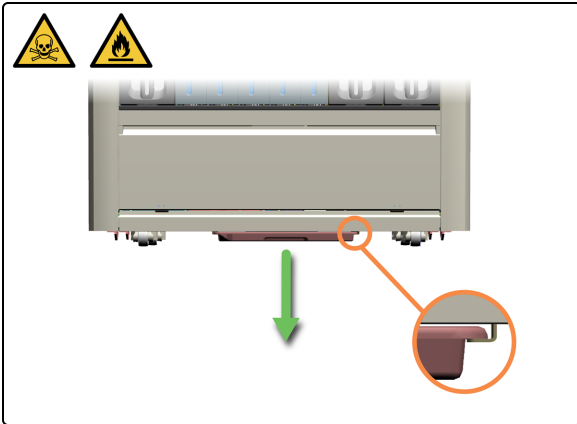
4.18 Karter Tepsisini temizleme



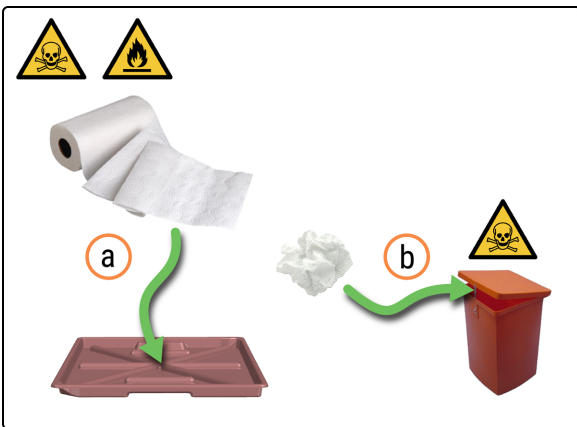
UYARI: İşleme modülüne bakım yapmadan önce gerekli minimum kişisel koruyucu ekipmanı kullanmanız gerekir. Bkz. **Genel dikkat edilecek hususlar.**



1. Karter Tepsisini bulun.



2. Karter Tepsisinin yanında durun ve dökülmeyi engellemek için iki elinizi birden kullanarak çıkarın. Gerekirse, laboratuvar tesisi için geçerli olan dökülme yönetimi prosedürlerini izleyin.

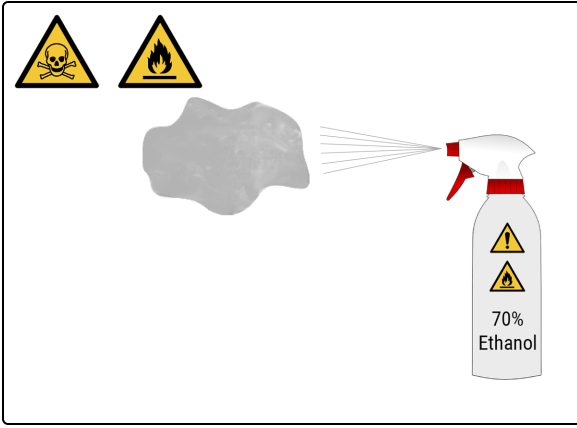


3. Atık reaktif fazlalığını emdirerek giderin.

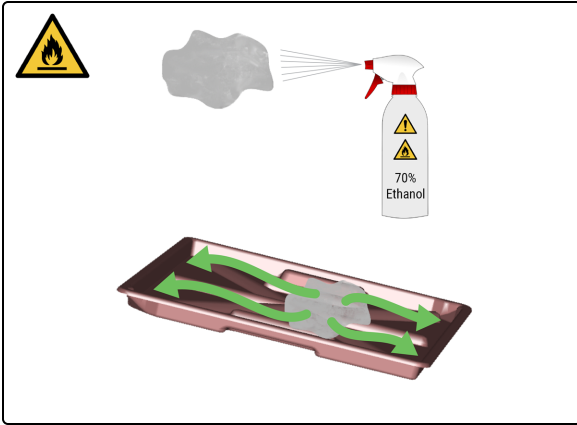
- Atık reaktifin çoğunluğunu kağıt havlu kullanarak emdirin.
- Kağıt havluları laboratuvar prosedürlerine uygun şekilde atın. Karter Tepsisindeki atığı daima tehlikeli olarak değerlendirin.



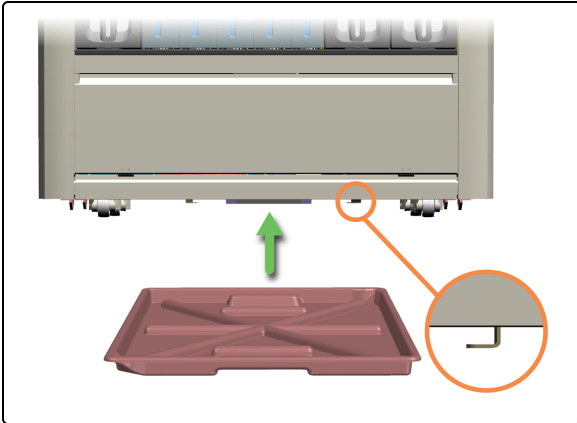
Karter Tepsisinde aşırı miktarda atık varsa, Leica Biosystems Desteğiyle iletişime geçin.



4. Temiz, hav bırakmayan bir bezi %70 etanol çözeltisiyle nemlendirin.



5. Karter Tepsisini hav bırakmayan bir bezle silin.



6. Karter Tepsisini işleme modülüne yerleştirin.

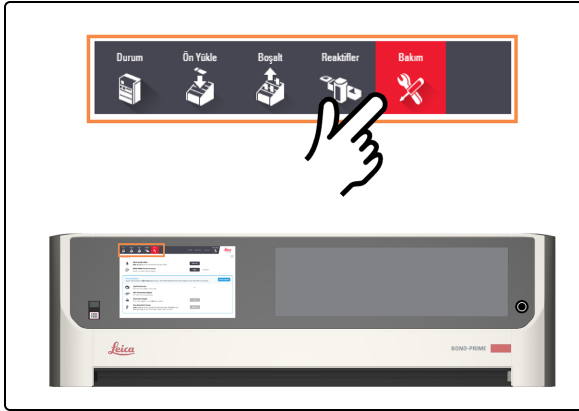
4.19 Bakımı durdurma

Bakımı durdurmadan önce aşağıdakilerden emin olun:

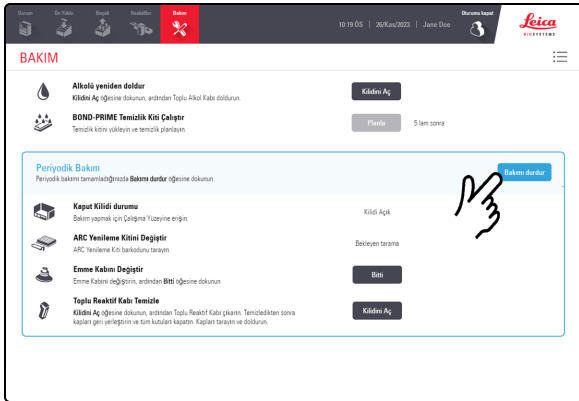
- Covertile'lar mevcut
- Mixing Well Plate (Karıştırma Kuyucuğu Plakası) mevcut (bkz. [4.14 BOND-PRIME ARC Refresh Kit \(BOND-PRIME ARC Yenileme Kiti\) kullanma](#))
- Bulk Reagent Container'lar (Toplu Reaktif Kabı) yeterli hacme sahip (bkz. [4.4 Lotu Takip Edilen Toplu Kapları yeniden doldurma](#) ve [4.3 Alcohol \(Alkol\) Kabını yeniden doldurma](#))
- Lam içeren ARC Module (ARC Modülü) yok (bkz. [5.3.3 Lamaları manuel olarak ARC Module'lerden \(ARC Modülü\) geri alma](#))
- Kaput kapalı



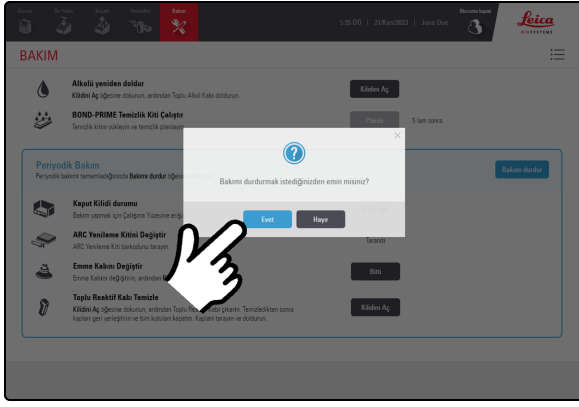
Bu prosedüre başlamadan önce işleme modülünde oturum açtığınızdan emin olun. Bkz. [2.1 Oturum açma ve kapatma](#).



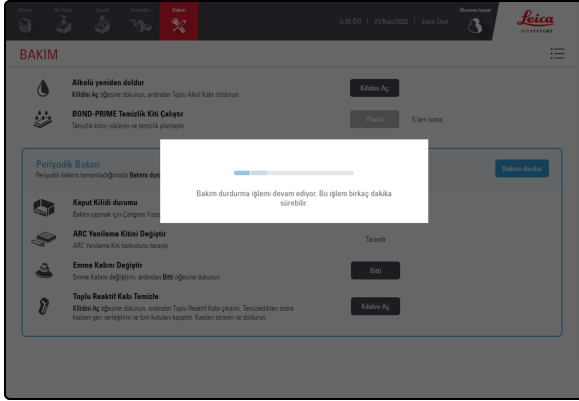
1. Bakım öğesine dokununuz.



2. Bakımı durdur öğesine dokununuz.



3. **Evet** öğesine dokununuz.



İşleme modülü klinik çalışmaya dönmeye hazırlanırken bir bekleme süresi vardır.

Bakımı durdurduğunuzda işleme modülü otomatik olarak ARC Module'leri (ARC Modülü) kapatır ve Kaputu kilitlet.

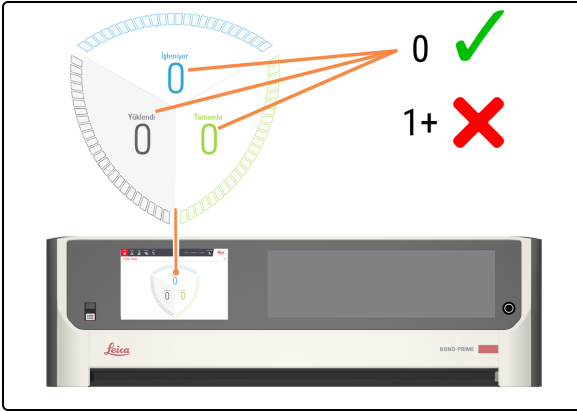
4.20 İşleme modülünü kapatma



Bu prosedüre başlamadan önce işleme modülünde oturum açtığınızdan emin olun. Bkz. [2.1 Oturum açma ve kapatma](#).



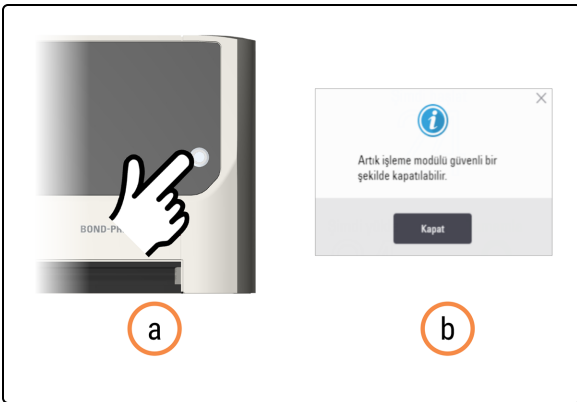
1. Durum öğesine dokunun.



2. Aşağıdaki durumları doğrulamak için Durum ekranına bakın:

- İşlenmekte olan (İşleniyor) lam yok
- Preload Drawer'da (Ön Yükleme) (Yüklendi) ve Boşaltma Çekmecesinde (Tamamlandı) lam yok.

Bkz. [2.3 Durum Ekranı](#).

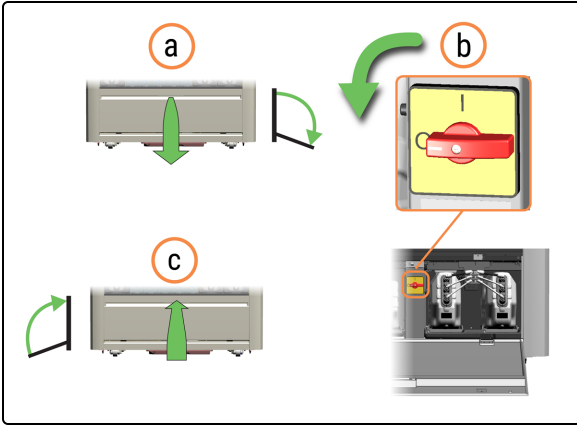


3. İşleme modülünün gücünü kapatın.

a. Bekleme güç düğmesine basın.

Açılır pencereyle işleme modülünü kapatmanın güvenli olduğu belirtilir.

b. **Kapat** öğesine dokunun.



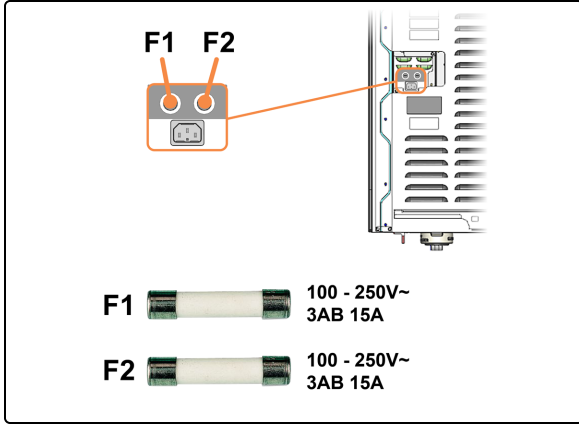
4. İşleme modülünün gücünü kapatın.

- a. Hazne Kabini kapısını açın.
- b. AC güç anahtarını saat yönünün tersine doğru çevirin.
- c. Hazne Kabini kapısını kapatın.



UYARI: Açık konumda olduğunda Hazne Kabini kapısına takılmamaya dikkat edin.

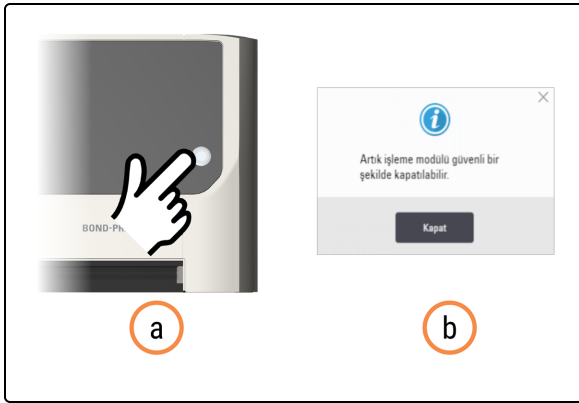
4.21 Güç kaynağı sigortalarını deęiřtirme



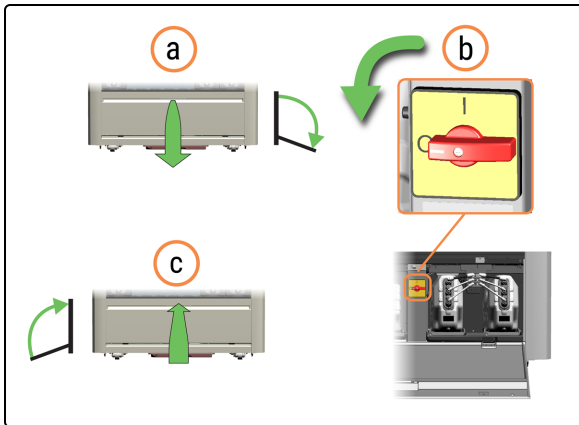
1. Doğru sigortalara (F1, F2) sahip olduğunuzdan emin olun. Sigortalar işleme modülünün arkasında yer alır.



Sigortalara ve arka paneldeki şebeke gücü konektörüne daha kolay erişmek için işleme modülünü hareket ettirmeniz gerekebilir.



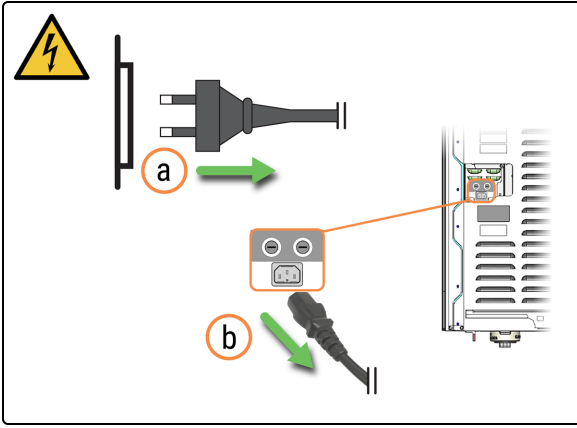
2. İşleme modülünün gücünü kapatın.
 - a. Bekleme güç düğmesine basın.
Açılır pencereyle işleme modülünü kapatmanın güvenli olduğu belirtilir.
 - b. **Kapat** öğesine dokunun.



3. İşleme modülünün gücünü kapatın.
 - a. Hazne Kabini kapısını açın.
 - b. AC güç anahtarını saat yönünün tersine doğru çevirin.
 - c. Hazne Kabini kapısını kapatın.



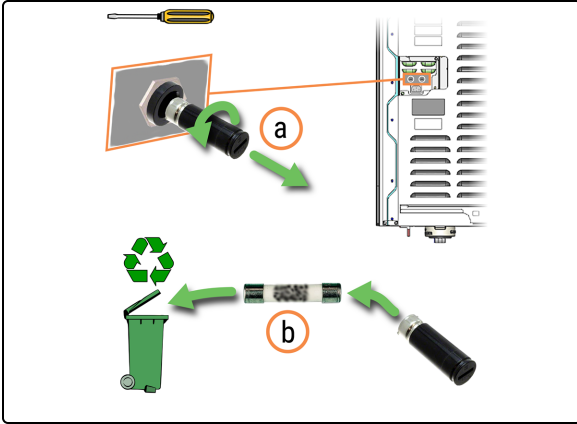
UYARI: Açık konumda olduğunda Hazne Kabini kapısına takılmamaya dikkat edin.



4. Şebeke güç kablosunu çıkarın.
 - a. Şebeke güç kablosunu duvar soketinden çıkarın.
 - b. Şebeke güç kablosunu işleme modülünün arkasından çıkarın.



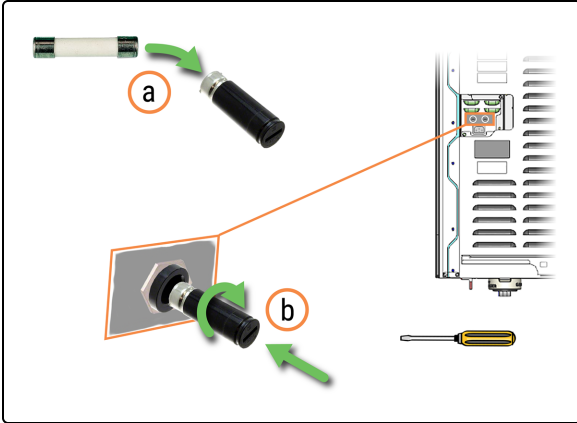
Arka panel konektörlerine daha kolay erişmek için işleme modülünü hareket ettirmeniz gerekebilir.



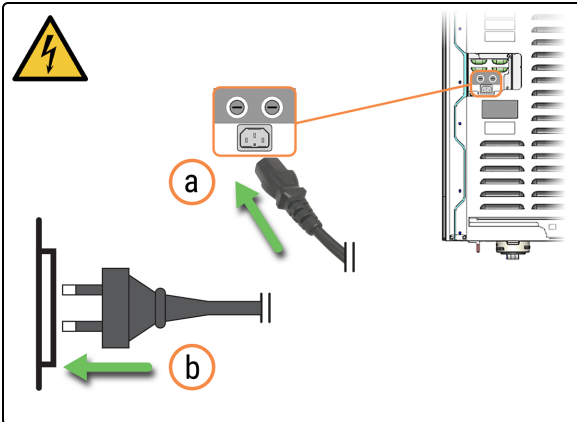
5. Sigortayı atın.
 - a. Sigorta tutucuyu düz tornavida kullanarak saat yönünün tersine çevirin ve işleme modülünden çıkarın.
 - b. Sigortayı geri dönüşüm kutusuna atın.



Eski sigortaları normal çöpe atmayın. Mümkünse geri dönüştürün.



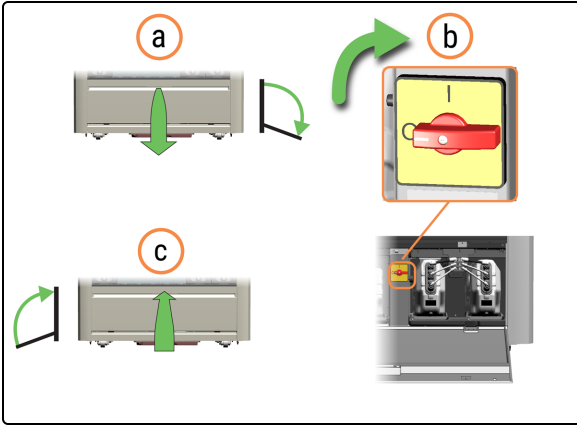
6. Yeni sigortayı takın.
 - a. Yeni sigortayı ambalajından çıkarın.
 - b. Sigorta tutucuyu işleme modülünün içine yerleştirin, ardından düz tornavida kullanarak sigorta tutucuyu saat yönüne doğru, sıkı olana kadar çevirin.



7. Şebeke güç kablosunu takın.
 - a. Şebeke güç kablosunu işleme modülünün arkasına takın.
 - b. Şebeke güç kablosunu duvar soketine takın.



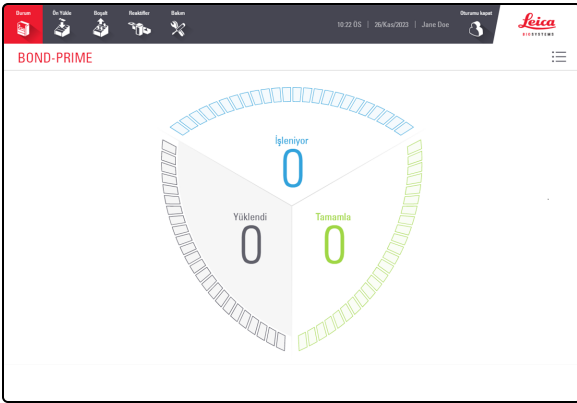
Arka panel konektörlerine daha kolay erişmek için işleme modülünü hareket ettirmeniz gerekebilir.



8. İşleme modülünün gücünü açın.
- a. Hazne Kabini kapısını açın.
 - b. AC güç anahtarını saat yönüne doğru çevirin.
 - c. Hazne Kabini kapısını kapatın.



9. İşleme modülü etkinleştirildiğinde, Oturum Açma Ekranı görüntülenmeden önce bir başlatma işlemi gerçekleşir. Bu işlem 8 ila 15 dakika sürer. İşleme modülü başlatılmazsa bkz. **5.1 Başlatılamadı**.



Durum ekranı görüntülenir.

5

Sorun Giderme

Bu kısımda:

5.1 Başlatılmadı	190
5.2 Ağ bağlantısı hatası	190
5.3 Lamları işleme modülünden manuel olarak geri alma	190
5.4 ARC Module'den (ARC Modülü) lam parçasını çıkarma	199

5.1 Başlatılmadı

İşleme modülünün başlatılmamasının bir çok nedeni vardır. Bunlara aşağıdakiler dahildir:

- Covertile ARC Module'e (ARC Modülü) doğru şekilde takılmadı – bkz. [4.14 BOND-PRIME ARC Refresh Kit \(BOND-PRIME ARC Yenileme Kiti\) kullanma](#)
- Robotların serbestçe hareket etmesi engellendi veya önlendi – bkz. [4.20 İşleme modülünü kapatma](#)
- Çalışma Yüzeyinin arkasında kalmış lamlar var – bkz. [5.3.2 Lamları Çalışma Yüzeyinden manuel olarak geri alma](#)
- Mixing Well Plate (Karıştırma Kuyucuğu Plakası) yok – bkz. [4.14 BOND-PRIME ARC Refresh Kit \(BOND-PRIME ARC Yenileme Kiti\) kullanma](#)
- Bir veya daha fazla Bulk Reagent Container (Toplu Reaktif Kabı) boş veya işleme modülündeki yerine doğru şekilde yerleştirilmemiş – bkz. [4.4 Lotu Takip Edilen Toplu Kapları yeniden doldurma](#)
- Ağ bağlantısı sorunları – bkz. [5.2 Ağ bağlantısı hatası](#)

Sorun devam ederse müşteri desteğiyle iletişime geçin.

5.2 Ağ bağlantısı hatası

- 1 İşleme modülünün BOND Kontrolörüne bağlı olduğunu ve tüm ağ kablolarının takılı olduğunu kontrol edin.



İşleme modülleri bağlanmadan önce BOND Kontrolörü çalışıyor olmalıdır.

- 2 İşleme modülünü yeniden başlatın.

5.3 Lamları işleme modülünden manuel olarak geri alma

İşleme modülü bazen lam işlemenin devam edemeyeceğini ve lamları manuel olarak geri almanız gerektiğini belirtebilir. Lamları aşağıdaki konumlardan geri alabilirsiniz:

- Preload Drawer (Ön Yükleme Çekmecesi) – bkz. [5.3.1 Lamları manuel olarak Ön Yükleme ve Boşaltma Çekmecelerinden geri alma](#)
- Boşaltma Çekmecesi – bkz. [5.3.1 Lamları manuel olarak Ön Yükleme ve Boşaltma Çekmecelerinden geri alma](#)
- Çalışma Yüzeyi – bkz. [5.3.2 Lamları Çalışma Yüzeyinden manuel olarak geri alma](#)
- ARC Module'ler (ARC Modülü) – bkz. [5.3.3 Lamları manuel olarak ARC Module'lerden \(ARC Modülü\) geri alma](#)

Lamların düşmesinin pek çok nedeni vardır. Bunlara aşağıdakiler dahildir:

- High-Speed Robot (Yüksek Hızlı Robot) üzerindeki Emme Kabininin temizlenmesi veya değiştirilmesi gerekmesi. Bkz. [4.10 Emme Kabını temizleme](#) veya [4.11 Emme Kabını değiştirme](#)
- etiketin lama yanlış yerleştirilmesi veya lamda ikiden fazla etiket olması. Bkz. [Lam etiketi teknik özellikleri](#)
- lam etiketi alanında doku, kalıntı veya sıvı olması.
- Vakum Sisteminde bir sorun olması.
- Preload Drawer'ın (Ön Yükleme Çekmecesi) veya Boşaltma Çekmecesinin değiştirilmesi ve hizalı olmaması.

İşlem Sırasında sorunun nedenini ve düzeltmek için gereken işlemi belirten bir mesaj görüntülenecektir.

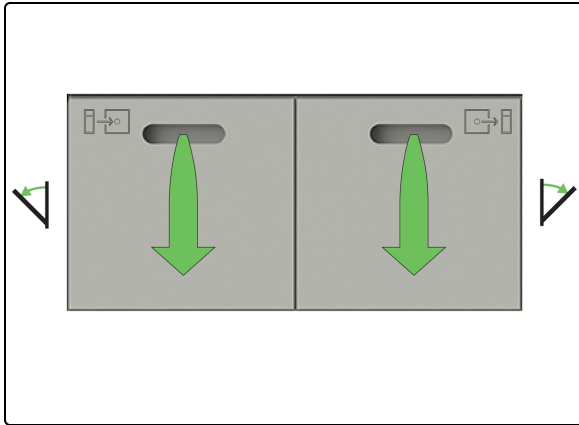
Lam aktarımı sürekli olarak başarısız oluyorsa, müşteri desteğiyle iletişime geçin.

5.3.1 Lamları manuel olarak Ön Yükleme ve Boşaltma Çekmecelerinden geri alma



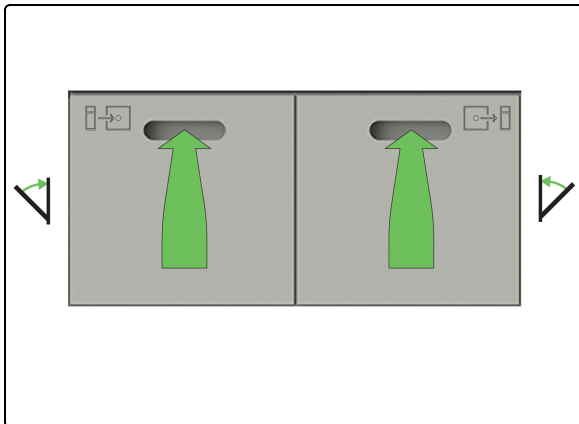
UYARI: İşleme modülüne bakım yapmadan önce gerekli minimum kişisel koruyucu ekipmanı kullanmanız gerekir. Bkz. [Genel dikkat edilecek hususlar](#).

Lamları Ön Yükleme ve Boşaltma Çekmecesinden çıkarmanızı isteyen bir İşlem Sırası mesajı olduğunda bu prosedürü izleyin.



1. Ön Yükleme ve Boşaltma Çekmecelerini açın ve lamları çıkarın.

Çekmeceleri kir bakımından kontrol edin. Kir varsa çekmeceleri temizleyin. Bkz. [4.12 Lam Çekmecesi Parçalarını, Atık Giderlerini ve Karterlerini ve Alım Filtresini temizleme](#).



2. Lam Ön Yükleme ve Boşaltma Çekmecelerini kapatın.

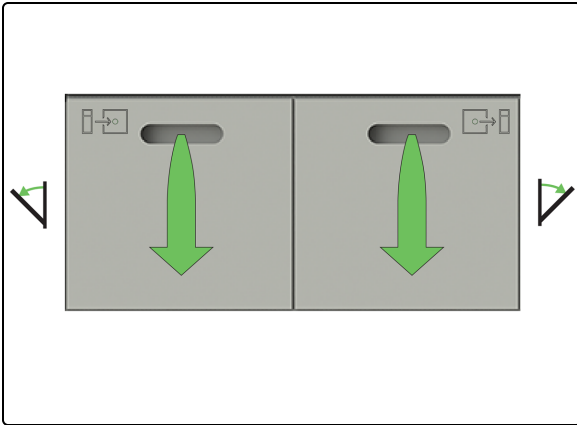
5.3.2 Lamları Çalışma Yüzeyinden manuel olarak geri alma



UYARI: İşleme modülüne bakım yapmadan önce gerekli minimum kişisel koruyucu ekipmanı kullanmanız gerekir. Bkz. **Genel dikkat edilecek hususlar.**

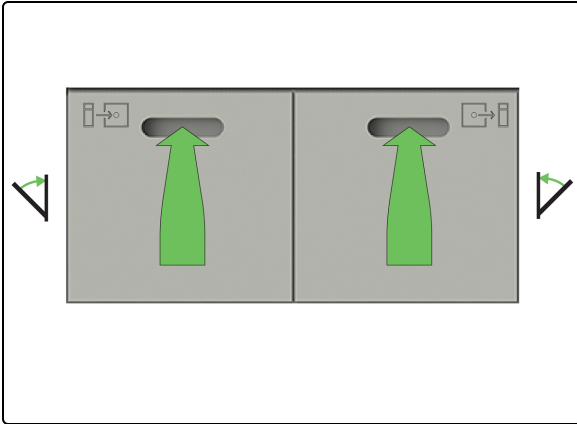


Bu prosedüre başlamadan önce işleme modülünde oturum açtığınızdan emin olun. Bkz. **2.1 Oturum açma ve kapatma.**

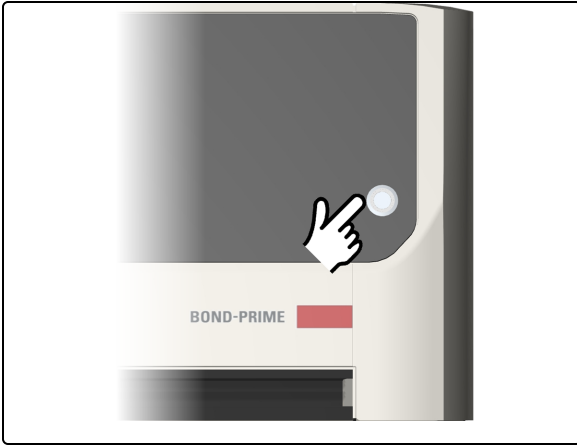


1. Ön Yükleme ve Boşaltma Çekmecelerini açın ve lamları geri alın.

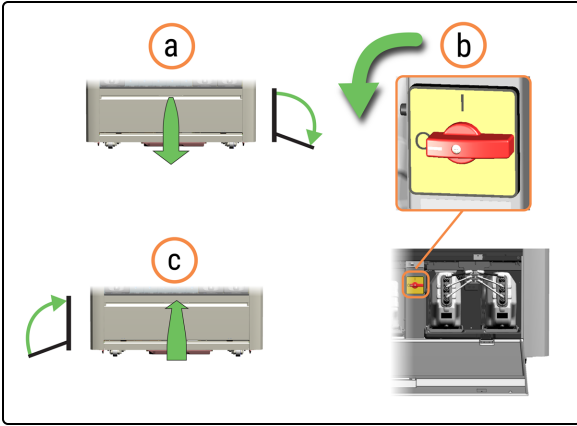
Çekmeceleri kir bakımından kontrol edin. Kir varsa çekmeceleri temizleyin. Bkz. **4.12 Lam Çekmecesi Parçalarını, Atık Giderlerini ve Karterlerini ve Alım Filtresini temizleme.**



2. Lam Ön Yükleme ve Boşaltma Çekmecelerini kapatın.



3. Bekleme güç düğmesine basın.

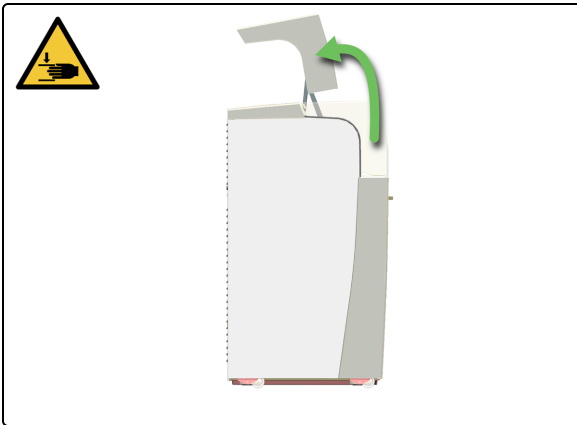


4. İşleme modülünün gücünü kapatın.

- a. Hazne Kabini kapısını açın.
- b. AC güç anahtarını saat yönünün tersine doğru çevirin.
- c. Hazne Kabini kapısını kapatın.

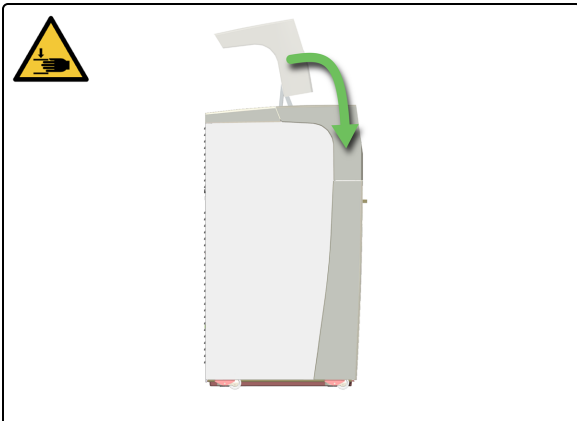


UYARI: Açık konumda olduğunda Hazne Kabini kapısına takılmamaya dikkat edin.



5. Kaputu açın ve lamları geri alın.

Çalışma Yüzeyini kir bakımından kontrol edin. Kir varsa Çalışma Yüzeyini temizleyin. Bkz. 4.9 Reagent Platform (Reaktif Platformu) ve ARC Bank (ARC Sırası) yüzeylerini silme.



6. Artık Çalışma Yüzeyine erişmeniz gerekmiyorsa Kaputu kapatın ve bu prosedüre devam edin.



- İşleme modülünü yeniden başlatın. Bkz. [3.2 İşleme modülünü başlatma](#).

5.3.3 Lamları manuel olarak ARC Module'lerden (ARC Modülü) geri alma



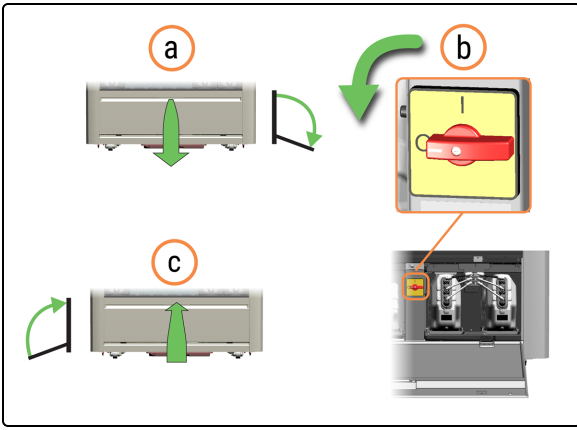
UYARI: İşleme modülüne bakım yapmadan önce gerekli minimum kişisel koruyucu ekipmanı kullanmanız gerekir. Bkz. [Genel dikkat edilecek hususlar](#).



Bu prosedüre başlamadan önce işleme modülünde oturum açtığınızdan emin olun. Bkz. [2.1 Oturum açma ve kapatma](#).



- Bekleme güç düğmesine basın.

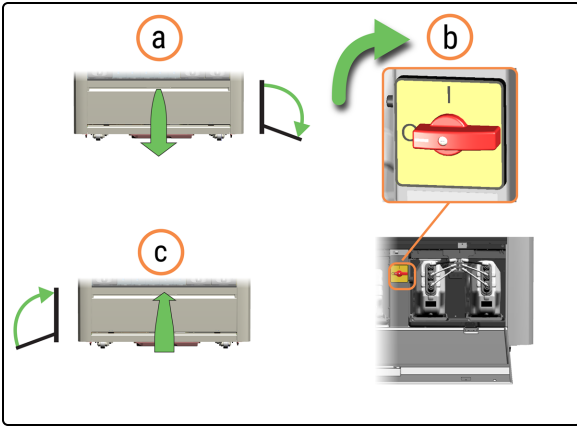


2. İşleme modülünün gücünü kapatın.

- a. Hazne Kabini kapısını açın.
- b. AC güç anahtarını saat yönünün tersine doğru çevirin.



UYARI: Açık konumda olduğunda Hazne Kabini kapısına takılmamaya dikkat edin.

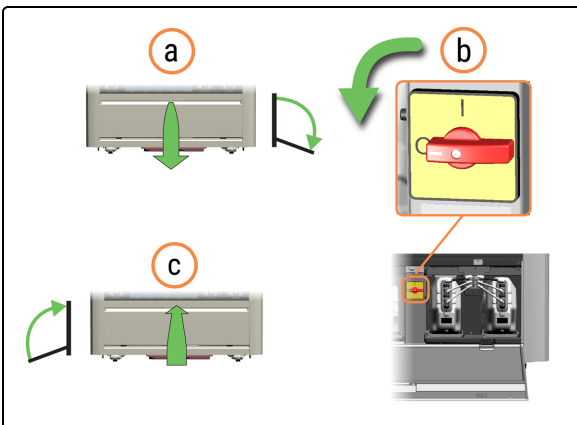


3. İşleme modülünün gücünü açın.

- c. AC güç anahtarını saat yönüne doğru çevirin.

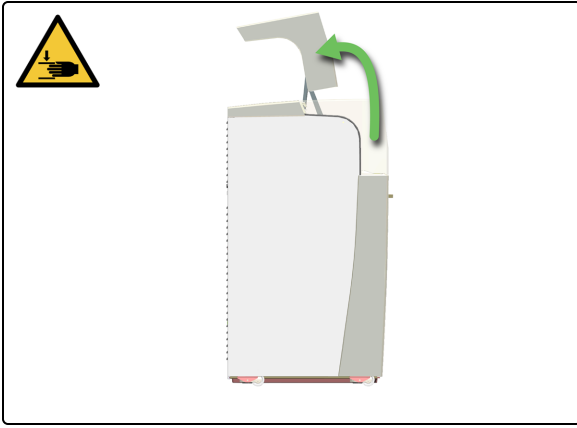


Başlatma başarısız olacaktır, ancak lamalar algılanan ARC Module'ler (ARC Modülü) otomatik olarak açılır.

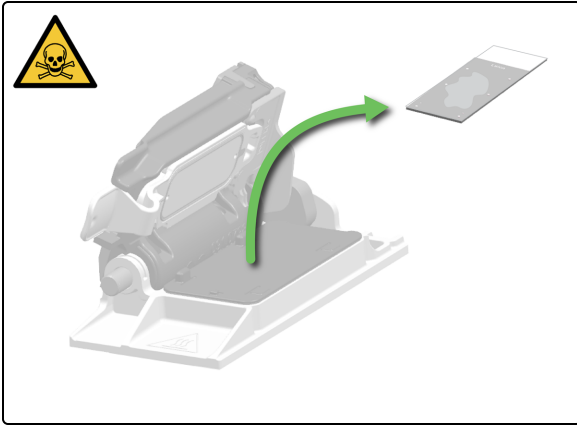


4. İşleme modülünün gücünü tekrar kapatın.

- a. AC güç anahtarını saat yönünün tersine doğru çevirin.
- b. Hazne Kabini kapısını kapatın.



5. Kaputu açın.



6. Lamı ARC Module'den (ARC Modülü) çıkarın ve tamamen açık halde bırakın. İşleme modülünü yeniden başlattığınızda ARC Module'ler (ARC Modülü) otomatik olarak kapatılır.



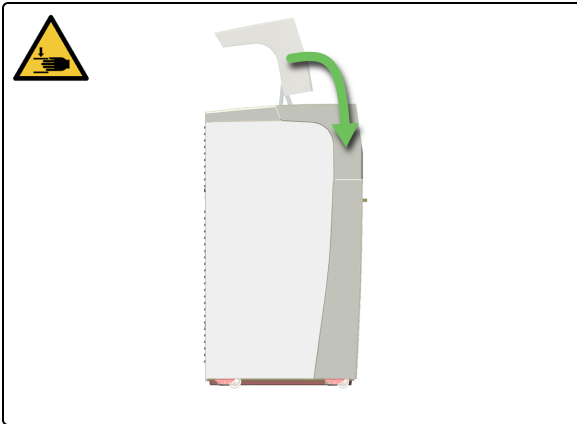
ARC Module'lere (ARC Modülü) daha kolay erişmek için Yıkama Robotlarını manuel olarak hareket ettirebilirsiniz.



DİKKAT: Çalışma Yüzeyi üzerinde manuel olarak tuttuğunuz lamları düşürmemeye dikkat edin.



DİKKAT: ARC Module'leri (ARC Modülü) manuel olarak kapatmayın. İşleme modülünü başlattığınızda bu otomatik olarak yapılır.



7. Artık Çalışma Yüzeyine erişmeniz gerekmiyorsa Kaputu kapatın ve bu prosedüre devam edin.



8. İşleme modülünü yeniden başlatın. Bkz. 3.2 İşleme modülünü başlatma.



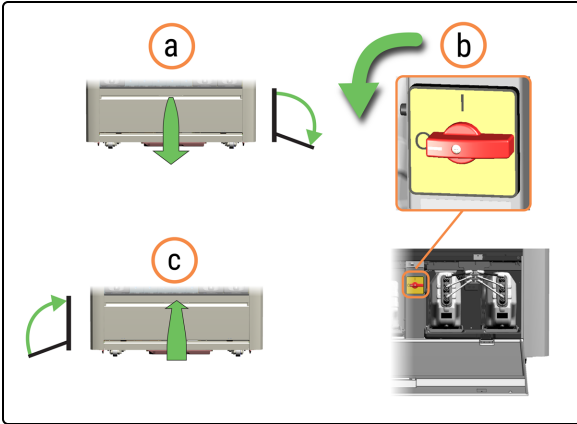
Güç kesintisi durumunda bkz. 5.3.4 Güç kesintisi sırasında lamları manuel olarak ARC Module'lerden (ARC Modülü) geri alma.

5.3.4 Güç kesintisi sırasında lamları manuel olarak ARC Module'lerden (ARC Modülü) geri alma

Güç kesintisi durumunda aşağıdaki adımlarla lamları manuel olarak geri alabilirsiniz.



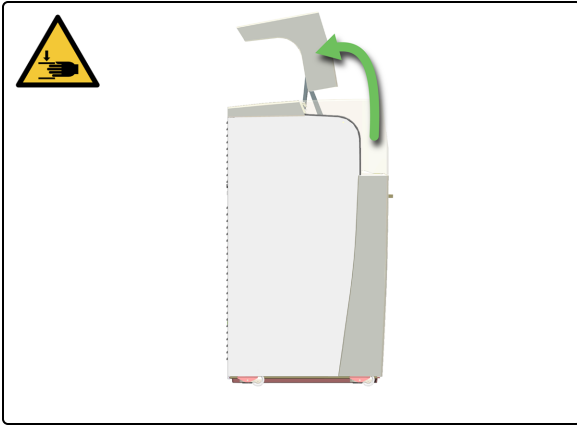
UYARI: İşleme modülüne bakım yapmadan önce gerekli minimum kişisel koruyucu ekipmanı kullanmanız gerekir. Bkz. Genel dikkat edilecek hususlar.



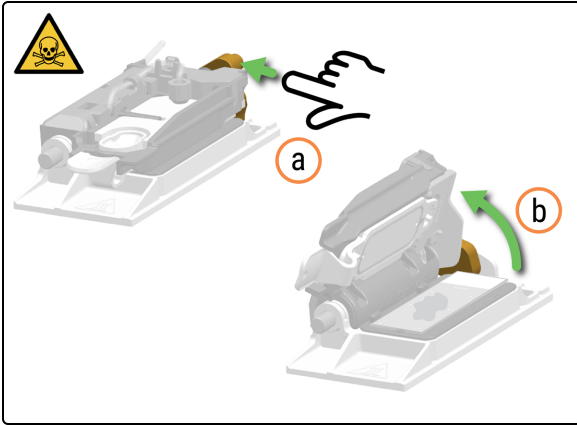
1. İşleme modülünün gücünü kapatın.
 - a. Hazne Kabini kapısını açın.
 - b. AC güç anahtarını saat yönünün tersine doğru çevirin.
 - c. Hazne Kabini kapısını kapatın.



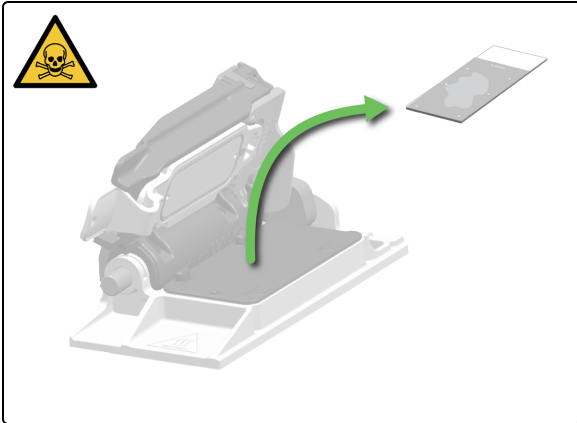
UYARI: Açık konumda olduğunda Hazne Kabini kapısına takılmamaya dikkat edin.



2. Kaputu açın.



3. ARC Module'ü (ARC Modülü) manuel olarak açın.
 a. ARC Module Latch'e (ARC Modülü Mandalı) basın.
 b. ARC Module Lid'i (ARC Modülü Başlığı) kaldırın.



4. Lamı ARC Module'den (ARC Modülü) çıkarın ve tamamen açık halde bırakın. İşleme modülünü yeniden başlattığınızda ARC Module'ler (ARC Modülü) otomatik olarak kapatılır.



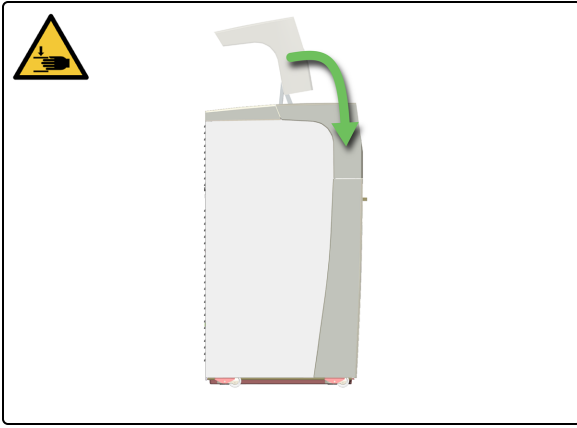
ARC Module'lere (ARC Modülü) daha kolay erişmek için Yıkama Robotlarını manuel olarak hareket ettirebilirsiniz.



DİKKAT: Çalışma Yüzeyi üzerinde manuel olarak tuttuğunuz lamları düşürmemeye dikkat edin.



DİKKAT: ARC Module'leri (ARC Modülü) manuel olarak kapatmayın. İşleme modülünü başlattığınızda bu otomatik olarak yapılır.



5. Kaputu kapatın.

5.4 ARC Module'den (ARC Modülü) lam parçasını çıkarma

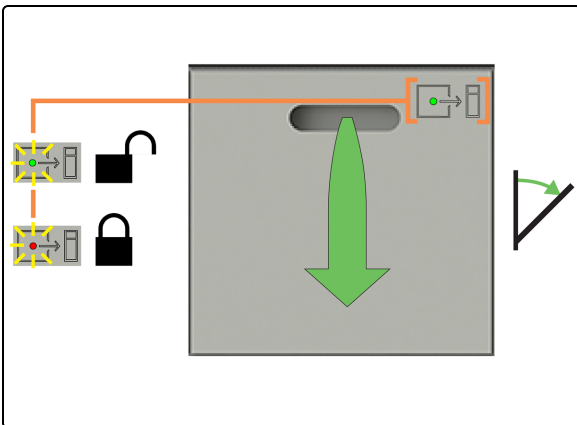
Boşaltma Çekmecesinde bir kısmı olmayan bir lam görürseniz, lam parçasını ARC Module'de (ARC Modülü) bulup çıkarmanız gerekir.



Yeni lam yüklemeyin.



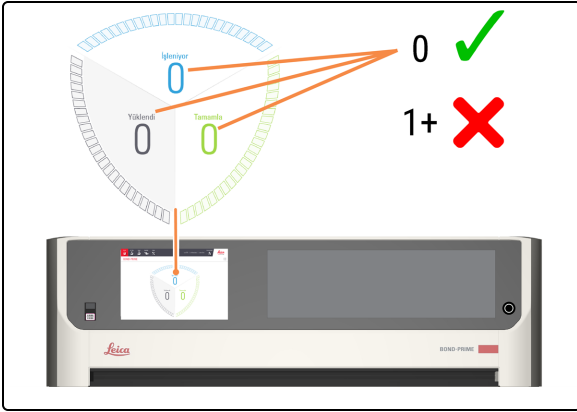
1. İşleme modülünün işaretlediği bir hata olup olmadığına bakmak için İşlem Sırasını kontrol edin. Yoksa, lam kırılması algılanmamıştır.



2. Preload Drawer'ı (Ön Yükleme Çekmecesesi) açın ve lamları çıkarın, ardından tüm lamların işlenmesi tamamlanana kadar bekleyin.

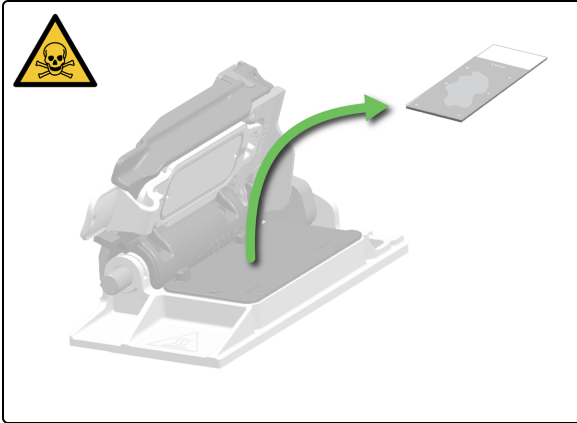


3. Durum öğesine dokunun.



4. İşlenmekte olan (İşleniyor) lam olmadığından emin olmak için Durum ekranına bakın.

Bkz. 2.3 Durum Ekranı.



5. Her bir ARC Module'ü (ARC Modülü) cam parçaları bakımından kontrol edin ve parçaları 5.3.3 Lamları manuel olarak ARC Module'lerden (ARC Modülü) geri alma uyarınca manuel olarak çıkarın.

6

Teknik Özellikler

Bu kısımda:

6.1 Sistem teknik özellikleri	202
6.2 Fiziksel teknik özellikler	202
6.3 Elektrik gücü ve UPS gereksinimleri	202
6.4 Çevresel teknik özellikler	203
6.5 Çalıştırma teknik özellikleri	203
6.6 Mikroskop lamı teknik özellikleri	204
6.7 Taşıma ve saklama teknik özellikleri	205

6.1 Sistem teknik özellikleri

BOND Uygulaması	7 Klinik veya üzeri
BOND Kontrolörü	Windows 10 IoT, Dell XE2, Dell XE3 veya Dell XE4
BOND-ADVANCE Terminali	Windows 10 IoT, Dell XE2 veya Dell XE3
BOND-ADVANCE Kontrolörü	Windows Server 2016, Dell T640, Dell T630
Ağ bağlantısı	Ethernet IEEE802.3, 10/100/1000BASE-T
Ağ kabloları	RJ-45 konektörlü, korumalı CAT5e veya CAT6 kabloları
Ethernet anahtarı gereksinimleri:	Ethernet IEEE802.3, 10/100/1000BASE-T
Tek yuvalı	8 portlu Ethernet anahtarı (maksimum 5 işleme modülü için) *
BOND-ADVANCE	8 veya 16 portlu Ethernet anahtarları (anahtarlar birbirlerine bağlandığında, maksimum 30 işleme modülü için) *
	* işleme modüllerinin herhangi bir kombinasyonu için: BOND-PRIME, BOND-III, BOND-MAX
Cihaz teknik özellikleri	Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd, BOND Kontrolörü, BOND-ADVANCE Kontrolörlerini ve BOND-ADVANCE Terminallerini sağlamalıdır.

6.2 Fiziksel teknik özellikler

Boyutlar	G – 1217 mm (47,9 inç) Y (kaput kapalıyken) – 1400 mm (55,1 inç) Y (kaput açıkken) – 1820 mm (71,7 inç) D (Hazne Kabini Kapısı kapalıyken) – 831 mm (32,7 inç) D (Hazne Kabini Kapısı açıkken) – 1096 mm (43,1 inç)
Ağırlık (boşken)	384 kg (847 lb)
Ağırlık (reaktif yüklüyken)	425 kg (937 lb)
Gerekli boşluklar	Ön – reagent container'lara (reaktif kabı) erişim için 800 mm (31,5 inç) Arka – 50 mm (2 inç) hava boşluğu

6.3 Elektrik gücü ve UPS gereksinimleri

Çalışma voltajı	90 V AC ila 264 V AC (100 V AC ila 240 V AC nominal voltaj için)
Şebeke frekansı	50/60 Hz
Maksimum güç tüketimi	1260 VA

6.4 Çevresel teknik özellikler

Aşağıdaki bilgiler yalnızca takılı işleme modülleri için geçerlidir.

Maksimum pik performans sıcaklığı	26 °C (79 °F)
Minimum pik performans sıcaklığı	18 °C (64 °F)
Maksimum çalışma sıcaklığı	34 °C (93 °F)
Minimum çalışma sıcaklığı	5 °C (41 °F)
Maksimum çalışma nemi (yoğuşmasız)	%80 BN
Minimum çalışma nemi (yoğuşmasız)	%30 BN
Maksimum çalışma yüksekliği	Deniz seviyesinden 2700 m (8858 ft)
Minimum çalışma yüksekliği	Deniz seviyesinden 0 m (0 ft)
Düzlük	Herhangi bir yönde 0 ila 1.5° eğim
Ses basıncı seviyesi çıkışı (1 m'de)	Normal çalışmada < 65 dBA Maksimum < 85 dBA
Maksimum ısıtma enerjisi çıkışı	Güç soketinde 1260 VA (güç kaynağı kayıplarından sonra ~1100 W)

6.5 Çalıştırma teknik özellikleri

Yüklenmiş lam kapasitesi	Maksimum 72 lam
Lam eş zamanlı boyama kapasitesi	Maksimum 24 lam
Reagent container (reaktif kabı) kapasitesi	7 mL ve 30 mL
Reagent container (reaktif kabı) ölü hacmi	260 µL (7 mL) ve 932 µL (30 mL)
Reagent container (reaktif kabı) yedek hacmi	280 µL (7 mL) ve 280 µL (30 mL)
Titrasyon kabı kapasitesi	6 mL (maksimum dolum hacmi 5,7 mL)
Titrasyon kabı ölü hacmi	220 µL
Titrasyon kabı yedek hacmi	280 µL
Maksimum reagent container (reaktif kabı) sayısı	70 (5 Reagent Container (Reaktif Kabı) x 14 Reagent Tray (Reaktif Tepsisi))
Yardımcı reaktif kapasitesi:	
Alcohol (Alkol)	1,25 L
BOND-PRIME Dewax Solution	1,25 L
BOND-PRIME Epitope Retrieval Solution 1	1,25 L
BOND-PRIME Epitope Retrieval Solution 2	1,25 L
BOND-PRIME Wash Solution Concentrate	1,25 L
BOND-PRIME Wash Working Solution	Hazne 1 L

Toplu DI Water (DI Su) kapasitesi	Kap 4,5 L Hazne 5 L
Toplu atık kapasitesi	Kap 4,5 L Hazne 5 L
Tehlikeli atık kapasitesi	Kap 4,5 L Hazne 5 L
Kimyasal uyumluluk	Yalnızca DI water (DI su) sınıfı Tüm BOND-PRIME reaktifleri %100 etanol veya reaktif sınıfı alkol. Reaktif sınıfı alkol şunları içerir: Etanol, %90 veya üzeri (a/a); İzopropanol, en fazla %5 (a/a); Metanol, en fazla %5 (a/a). Bazı parçaları temizlemek için %70 etanol çözeltisi kullanılır.
Hizmet ömrü	7 yıl.
BOND-PRIME Siber güvenlik sertifikası sona erme süresi	10 yıl

6.6 Mikroskop lamı teknik özellikleri

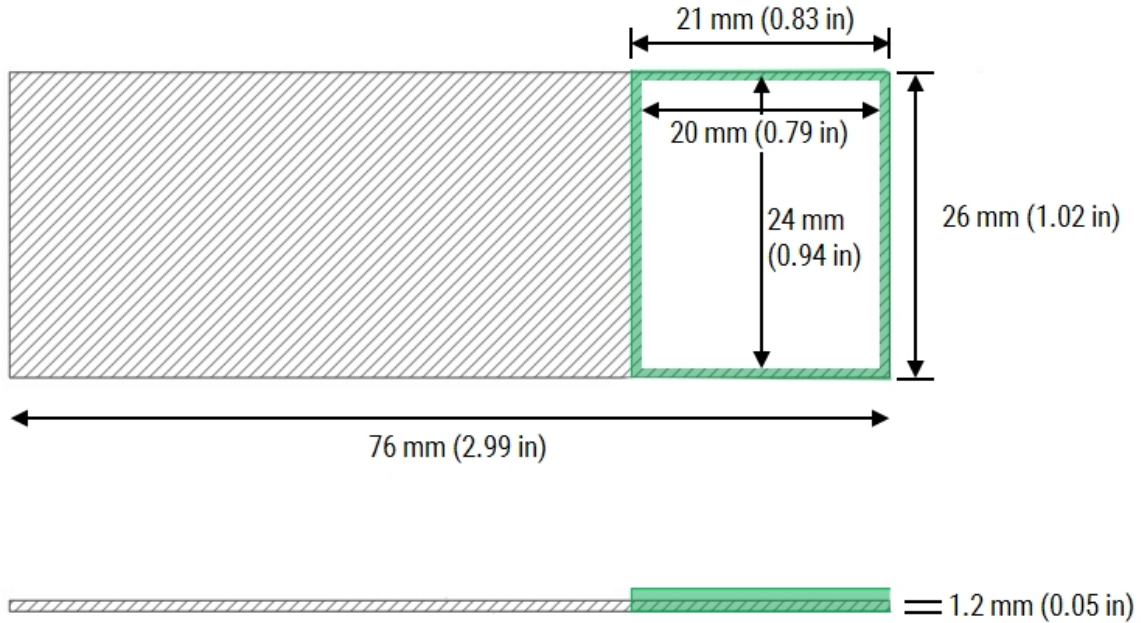
Lam teknik özellikleri

Boyutlar	Genişlik: 24,64–26,0 mm (0,97–1,02 inç) Uzunluk: 74,9–76,0 mm (2,95–2,99 inç) Kalınlık: 0,9–1,2 mm (0,03–0,05 inç)
Etiket alanı	Genişlik: 24,64–26,0 mm (0,97–1,02 inç) Uzunluk: 16,9–21,0 mm (0,67–0,83 inç)
Malzeme	Cam, ISO 8037/1
Kullanılabilir lam alanı	Aşağıdaki şemaya bakın.

Lam etiketi teknik özellikleri

Boyutlar	Genişlik: 22–24 mm (0,87–0,94 inç) Uzunluk: 15–20 mm (0,59–0,79 inç) Üst üste maksimum 2 etiket
Eğrilik açısı	Kullanıcı etiketi düz yerleştirecektir.
Kullanılabilir lam etiketi alanı (üst buzlu yüzey içerisinde) ve izin verilen lam etiketi yerleşimi	Etiket sarkmasına izin verilmez.

Şekil 6-1: Maksimum boyutlar



6.7 Taşıma ve saklama teknik özellikleri

Kutulu haldeki boyutları	G – 1828 mm (72,0 inç) Y – 1590 mm (62,6 inç) D – 1134 mm (44,6 inç)
Kutulu haldeki ağırlığı	553 kg (1219 lb)
Saklama sıcaklığı	-20 ila +50 °C (-4 ila +122 °F)
Saklama nemi (yoğuşmasız)	< %80 BN
Kutudan çıkarma gereksinimleri	Kutudan çıkarmak için yaklaşık 6000 mm x 4000 mm (236,2 inç x 157,4 inç) düz alan sağlayın
Tekerleklerle hareket	Minimum kapı genişliği 850 mm (33,5 inç) Maksimum 7 derecelik rampa açısıyla hareket ettirilebilir
Gönderim yöntemleri	Karayolu, hava ve deniz taşımacılığına uygundur

Dizin

A

AC güç anahtarı	38
ağ bağlantısı	28
ağ kablosu, bağlama	51
Aktif Reaktif Kontrolü	
ARC Module'ler (ARC Modülü)	46
alcohol (alkol)	
yeniden doldur	98, 115
Alım Filtresi	31
Alım tüpü, Lam Çekmeceleri	31
AQI	68, 70
ARC Bank (ARC Sırası)	40
ARC Bank (ARC Sırası) Yüzeyi	
temizleme	133
ARC Covertile	46
ARC Module'ler (ARC Modülü)	46
güç kesintisi sırasında lamı çıkarma	197
lamı çıkarma	194
temizleme	129
ARC Module'leri (ARC Modülü) silme	129
ARC Probe (ARC Probu)	43
ARC Probe Wash Station'ları (ARC Probu Yıkama İstasyonu)	48
temizleme	154
Arkadan görünüm	28
atık	
çıkarma	121
Atık Giderleri	31
Atık Giderleri ve Karterleri	
temizleme	145

Atık Kabı	121
boş	121
temizleme	177
Atık Kabını boşaltma	121
Atık Karteri	31
atma, işleme modülü	57

B

bakım	
başlatma	127
durdurma	182
Bakım Ekranı	98
bakım planlama	110
Bakım planları	110
bakım ve temizlik	109
bakımı durdurma	182
Barkod tarayıcısı	29
başlatma	
bakım	127
işleme modülü	101
başlatma hatası	190
başlık, uyarılar	70
beklenmeyen olaylar	68
BOND-PRIME ARC Refresh Kit (BOND-PRIME ARC Yenileme Kiti)	111, 158
BOND-PRIME ARC Refresh Kit (BOND-PRIME ARC Yenileme Kiti) kullanma	158
BOND-PRIME Cleaning Kit (BOND-PRIME Temizlik Kiti)	93, 123
çalıştırma	98
BOND-PRIME Cleaning Kit (BOND-PRIME Temizlik Kiti) çalıştırma	98
BOND-PRIME İşleme Modülü	27

BOND-PRIME Polymer DAB Detection.....	93
BOND Sistemi.....	24
Boşaltma Çekmecesi.....	30
lamı geri alma.....	191
temizleme.....	145
Boşaltma Çekmecesi görünümü, dokunmatik ekran.....	82
Boşaltma Ekranı.....	82
Boşaltma Vakası görünümü, dokunmatik ekran.....	82
Bulk Alcohol Container (Toplu Alkol Kabı), yeniden doldurma.....	115
Bulk DI Water Container (Toplu DI Su Kabı) temizleme.....	164
Bulk Probe Prime Station (Toplu Prob Hazırlama İstasyonu).....	48
temizleme.....	154
Bulk Reagent Container'lar (Toplu Reaktif Kabı).....	35
kapat.....	98
Bulk Reagent Container'ları (Toplu Reaktif Kabı) kapatma.....	98
Bulk Reagent Probe'lar (Toplu Reaktif Probu).....	43
Bulk Waste Container (Toplu Atık Kabı) boş.....	121
temizleme.....	177

C

CE işareti.....	10
CISPR 11 (EN 55011).....	11
cihaz çalıştırma tehlikeleri.....	18
Cleaning Kit (Temizlik Kiti) BOND-PRIME Cleaning kit (BOND-PRIME Temizlik kiti) kullanma.....	123
çalıştırma.....	98
Covertile değiştirme.....	158
Covertile, ARC.....	46

Ç

Çalışma Yüzeyi.....	40
erişim.....	98, 127, 182, 184
lamı geri alma.....	192
Çalışma Yüzeyine erişim Bakım Ekranı.....	98
bakımı başlatma.....	127
kapatma.....	184
çalıştırma tehlikeleri.....	21
çalıştırma teknik özellikleri.....	203
Çekmeceler, Boşaltma ve Ön Yükleme.....	30
çevresel teknik özellikler.....	203
çıkarma Atık Kabı.....	121
lamlar.....	190
lamları ARC Module'lerden (ARC Modülü).....	194
lamları ARC Module'lerden (ARC Modülü) (güç kesintisi).....	197
lamları Çalışma Yüzeyinden.....	192
lamları çekmecelerden.....	191
Reagent Tray'ler (Reaktif Tepsisi).....	97

D

değiştirme Covertile.....	158
Emme Kabı.....	141
güç kaynağı sigortaları.....	186
Mixing Well Plate (Karıştırma Kuyucuğu Plakası).....	158
depolama teknik özellikleri.....	205
DI Water (DI Su) kabı temizleme.....	164
yeniden doldur.....	113
DI Water (DI Su) Kabı temizleme.....	164

yeniden doldur.....	113
dikkat ibareleri.....	20, 70
dokunmatik ekran	
Bakım Ekranı.....	98
beklenmeyen olaylar.....	68
Boşaltma Ekranı.....	82
Durum Ekranı.....	62
Gezinme Çubuğu.....	61
lam bilgileri.....	67
Lamlar Yüklendi Durumu.....	62
lamları boşalt.....	80
Lamların İşlenmesi Durumu.....	64
Lamların İşlenmesi Tamamlandı Durumu.....	66
Ön Yükleme Ekranı.....	75
Reaktifler Ekranı.....	90
vaka görünümü.....	75
Dokunmatik Ekran.....	58
doldurma	
Bulk Alcohol Container (Toplu Alkol Kabı).....	115
DI Water (DI Su) Kabı.....	113
Kilitli Reaktif Kapları.....	118
donanım.....	23
DS9824 Saptama Sistemi tepsisi.....	103
Dual Reagent Tray (İkili Reaktif Tepsisi).....	34, 39
durdurma	
bakım.....	182
Durum Ekranı.....	62
düzenleyici semboller.....	12

E

ekipman sınıflandırması.....	11
elektrik bağlantıları.....	28
elektriksel tehlikeler.....	19
elektriksel teknik özellikler.....	202

Emme Kabı.....	43
değiştirme.....	141
temizleme.....	137
Ethernet.....	28
etiketler, lamlar.....	73

F

FCC.....	10
Filtre, Lam Çekmeceleri.....	31
fiziksel teknik özellikler.....	202
flakonlar, karıştırma.....	49

G

Gezinme Çubuğu.....	61
gizleme	
İşlem Sırası.....	70
Uyarı Başlığı.....	71
görüntüleme	
arka.....	28
İşlem Sırası.....	70
lam bilgileri.....	67
ön.....	27
reagent container (reaktif kabı) ayrıntıları.....	95
reaktif sistem ayrıntıları.....	95
gösterme	
İşlem Sırası.....	70
güç anahtarı.....	38
güç düğmesi.....	29
güç kablosu, bağlama.....	51
güç kaynağı.....	28
güç kaynağı sigortaları	
değiştirme.....	186
güç teknik özellikleri.....	202

güncelleme

İşlem Sırası.....	71
günlük bakım.....	110
güvenlik sembolleri.....	17

H

haftalık bakım.....	110
Hazardous Waste Container (Tehlikeli Atık Kabı)	
boş.....	121
temizleme.....	177
Hazırlama İstasyonu	
temizleme.....	154
Toplu Prob.....	48
Hazırlama İstasyonu, Lam.....	50
Hazneler.....	37
hızlı başlangıç.....	99
High-Speed Robot (Yüksek Hızlı Robot).....	43
ARC Probe (ARC Probu).....	43
Bulk Reagent Probe'lar (Toplu Reaktif Probu).....	43
Emme Kabı.....	43
ID Tarayıcı.....	43
Probe Selector (Prob Seçici).....	43
hizmetten çıkarma.....	57

I

ID Tarayıcı.....	43
IEC 60417.....	14
ISO 15223-1.....	12
ISO 7000.....	13
ISO 7010.....	17
iki aylık bakım.....	111

i

İşlem Sırası.....	68, 70
temizleme.....	71

I

işleme modülü.....	27
bağlanma.....	51
bağlantıyı kesme.....	53
bakımı başlatma.....	127
bakımı durdurma.....	182
başlatma.....	101
hizmetten çıkarma.....	57
kapatma.....	184
oturum açma.....	59
oturumu kapatma.....	59
taşımaya.....	55
işleme modülünü ayırma.....	53
işleme modülünü bağlama.....	51
işleme modülünü başlatma.....	101
işleme modülünü çıkarma.....	53
işleme modülünü hareket ettirme.....	55
işleme modülünü kapatma.....	53, 184

I

işleme modülünü takma 51

I

işleme modülünün yerini değiştirme 55

K

kapatma 184

Kaplara

Reaktif 34

Toplu Reaktif 35

Kapatma 29

Karıştırma İstasyonu 49

Karter tepsisi

temizleme 180

Karter Tepsisi 27

Kilitli Reaktif Kapları

yeniden doldur 118

kimyasal tehlikeler 19

Kişisel Koruyucu Ekipmanlar (PPE) 21

kontrol listesi

temizlik ve bakım 112

kullanım amacı beyanı 10

kurulum tehlikeleri 21

kuyucuk plakası, karıştırma 49

L

lam bilgileri, görüntüleme 67

Lam Çekmeceleri

Alım tüpü 31

Filtre 31

Gider 31

temizleme 145

Lam Çekmecesi Alım Filtresi

temizleme 145

Lam Çekmecesi Parçaları 31

temizleme 145

lam etiketi teknik özellikleri 204

lam etiketleri 73

lam fırınlama 73

Lam Hazırlama İstasyonu 50

lam işleme 105

lam konumları 75

lam özellikleri 86

lam teknik özellikleri 204

lamlar

ARC Module'lerden (ARC Modülü) çıkarma 194

ARC Module'lerden (ARC Modülü) çıkarma (güç kesintisi) 197

boşaltma 80, 105

Çalışma Yüzeyinden geri alma 192

Çekmecelerden geri alma 191

işleme modülünden geri alma 190

ön yükleme 105

lamlar ekle 105

Lamlar İşleniyor Bölümü 64

lamları boşalt 80, 105

lamları fırınlama 73

lamları geri alma 190

lamları işleme 99, 105

lamları ön yükleme 73, 105

lamları yükleme 73

Lamların İşlenmesi Tamamlandı Bölümü 66

Leica Biosystems ile iletişime geçme 8

Lotu Takip Edilen Reagent Container'lar (Reaktif Kabı)

yeniden doldur 118

M

mekanik tehlikeler.....	20
mevzuata ilişkin bildirimler.....	10
mikroskop lamı teknik özellikleri.....	204
Mixing Block (Karıştırma Bloğu).....	49
Mixing Well Plate (Karıştırma Kuyucuğu Plakası).....	49
değiştirme.....	158

O

olaylar, görüntüleme.....	68
oturum açma.....	59, 101
oturumu kapatma.....	59

Ö

Ön Yükleme Ekranı.....	75
Ön Yükleme Vaka Görünümü, dokunmatik ekran.....	75
Önden görünüm.....	27
önleyici bakım.....	110

P

Parça	
Lam Çekmecesi Parçası.....	31
planlama	
BOND-PRIME Cleaning Kit (BOND-PRIME Temizlik Kiti).....	123
Preload Drawer (Ön Yükleme Çekmecesi).....	30
lamı geri alma.....	191
temizleme.....	145
Probe Selector (Prob Seçici).....	43
profesyonel kullanım amaçlı in vitro tanısal ekipmanlar için talimatlar.....	10

R

reagent container (reaktif kabı) ayrıntıları, görüntüleme.....	95
Reagent Container (Reaktif Kabı) simgeleri.....	94
Reagent Container'lar (Reaktif Kabı).....	34, 90
Reagent Platform (Reaktif Platformu).....	34
temizleme.....	133
Reagent Tray (Reaktif Tepsisi) yükleme.....	92, 103
Reagent Tray'ler (Reaktif Tepsisi).....	39, 90
boşaltma.....	97
yükleme.....	92, 103
Reagent Tray'leri (Reaktif Tepsisi) boşaltma.....	97
reaktif sistem ayrıntıları, görüntüleme.....	95
reaktif sistemi.....	39
reaktif sistemi simgeleri.....	93
reaktif tehlikeleri.....	22
reaktifler.....	25
Reaktifler Ekranı.....	90
reaktifler, karıştırma.....	49
revizyon kaydı.....	9
Robot	
Yıkama.....	45
Yüksek Hızlı.....	43

S

Sarf malzemeleri.....	25
sekiz ayda bir bakım.....	111
semboller	
güvenlik.....	17
semboller sözlüğü.....	12
semboller ve işaretler.....	15
sigortalar.....	28
güç kaynağı sigortalarını değiştirme.....	186

sil	
ARC Bank (ARC Sırası) Yüzeyi.....	133
Reagent Platform (Reaktif Platformu).....	133
simgeler	
Reagent Container (Reaktif Kabi).....	94
reaktif sistemi.....	93
sistem teknik özellikleri.....	202

Ş

Şişeler, Toplu Reaktif.....	35
-----------------------------	----

T

tanımlama, ürün.....	6
Tarayıcı.....	29
taşıma teknik özellikleri.....	205
tehlikeler	
elektriksel.....	19
kimyasal.....	19
tehlikeler; cihaz çalışması.....	18
tehlikeler; kurulum.....	21
tehlikeler; operasyonel.....	21
tehlikeler; reaktif.....	22
Tekli Reaktif Tepsisi.....	34, 39
teknik özellikler.....	201
telef hakkı.....	6
temizleme	
ARC Bank (ARC Sırası) Yüzeyi.....	133
ARC Module'ler (ARC Modülü).....	129
Atık Kabi.....	177
Bulk DI Water Container (Toplu DI Su Kabi).....	164
Emme Kabi.....	137
Hazırlama İstasyonları.....	154
İşlem Sırası.....	71
Karter Tepsisi.....	180

Lam Çekmecesi Parçaları, Atık Giderleri ve Karterleri ve Alım Filtresi.....	145
Reagent Platform (Reaktif Platformu).....	133
Yıkama İstasyonları.....	154

Temizlik İstasyonu, Lam.....	50
------------------------------	----

temizlik ve bakım.....	109
------------------------	-----

Tepsiler

Lam Çekmeceleri.....	31
Reagent Tray'leri (Reaktif Tepsisi) boşaltma.....	97
Reagent Tray'leri (Reaktif Tepsisi) yükleme.....	92
Reaktif.....	34, 39

Toplu Kap

alkolü yeniden doldurma.....	115
DI Water (DI Su) yeniden doldurma.....	113

tutamak.....	29
--------------	----

tüm kullanıcılar için önemli bilgiler.....	6
--	---

U

UPS gereksinimleri.....	202
-------------------------	-----

Uyarı Başlığı

manuel olarak gizle.....	71
--------------------------	----

uyarılar.....	18, 70
---------------	--------

Ü

üretici.....	6
--------------	---

ürün tanımlaması.....	6
-----------------------	---

V

vaka bilgileri, görüntüleme.....	67
----------------------------------	----

vaka özellikleri.....	86
-----------------------	----

vaksı giderilmiş lamalar.....	73
-------------------------------	----

Y

Yardımcı Reaktifler.....	25
yasal bildirimler.....	6
Yedek parçalar.....	26
yeniden doldur	
alcohol (alkol).....	98
Bulk Alcohol Container (Toplu Alkol Kabı).....	115
DI Water (DI Su) Kabı.....	113
Kilitli Reaktif Kapları.....	118
yıkama	
ARC Module'ler (ARC Modülü).....	129
Emme Kabı.....	137
Yıkama/Hazırlama İstasyonları.....	154
Yıkama İstasyonları	
ARC Probe (ARC Probu).....	48
temizleme.....	154
Toplu Prob.....	48
Yıkama Robotu.....	48
Yıkama Robotları.....	45
Yıkama Robotu Yıkama İstasyonları.....	48
temizleme.....	154
Yüklenen Lam Bölümü.....	62